

Infinion Technologies Geschäftsbericht 2005

# Impulse geben



# Infineon auf einen Blick

Infineon Technologies entstand aus dem Halbleiterbereich der damaligen Muttergesellschaft Siemens und wurde im April 1999 mit Hauptsitz in München als Aktiengesellschaft gegründet. Seit dem 13. März 2000 ist das Unternehmen an den Börsen in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA von San Jose/Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum von Singapur und in Japan von Tokio aus. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro im Vergleich zu 7,19 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2004.

## Geschäftsbereiche

### Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket (AIM)

#### Im Auto:

Chips für Antriebssteuerung, Sicherheit, Komfortfunktionen und Navigation

#### In der Industrie:

Chips zur Steuerung von elektrischen Antrieben und Industrieanlagen, zur Energieübertragung und -wandlung

#### In Multimarket:

Breiter Einsatz in den Anwendungsgebieten Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Computer und Kommunikationsgeräte

#### In Chipkarten:

Chips mit kontaktbehafteter oder kontaktloser Schnittstelle

## Anwendungen

#### Automobilelektronik:

... Antriebsstrang (Motor- und Getriebesteuerung), Karosserie- und Komfortelektronik, Sicherheit (Airbag, ABS, EPS), Infotainment (Navigation und Telematik)

#### Industrie:

... Netzteile und Stromversorgungen für elektrische Antriebe und Industrieanlagen, Schweißgeräte, Windkraftanlagen, Züge, Bahnen und Medizintechnik

#### Multimarket:

... Netzteile und Stromversorgungen für PCs, Notebooks, Fernsehgeräte, DVD-Spieler und Elektromotorantriebe für Waschmaschinen, Ventilatoren, Klimaanlage, Lampensteuerung, Festplatten, Computer-Peripherie und Spielekonsolen

#### Chipkarten:

... Vielfältige Anwendungen für chipbasierte Karten in den Bereichen Kommunikation (SIM-, U-SIM-Karten, Telefonkarten), Zahlungsverkehr (Kredit- und Debitkarten), Identifikation (Ausweise, Versicherungskarten), Unterhaltung (Pay-TV-Karten), Objektidentifikation und Logistik (RFID-Etiketten), Plattformsicherheit bei Rechnern und in Netzwerken (TPM)

### Kommunikation (COM)

#### Drahtgebundene Kommunikation:

Chips für traditionelle Sprachkommunikation, Zugangstechnologien für Breitbandanschlüsse, Mobilfunkinfrastruktur sowie Endkundenanwendungen

#### Drahtlose Kommunikation:

Chips und Systemlösungen für Mobiltelefone sowie Infrastruktur für Mobilfunknetze, schnurlose Telefone und drahtlose Vernetzung

#### Drahtgebundene Kommunikation:

... Traditionelle Sprachkommunikation  
... Kupferbasierte Breitband-Datenkommunikation  
... Integrierte Sprach- und Datenkommunikation  
... Netzwerke im Heimbereich

#### Drahtlose Kommunikation:

... Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstationen  
... Schnurlose Telefone  
... Funktechnologie über kurze, mittlere und große Entfernungen  
... Fernsehempfänger  
... Navigation

### Speicherprodukte (MP)

#### DRAM-Speicher:

für Anwendungen in den Bereichen elektronische Datenverarbeitung, Kommunikation und Unterhaltungselektronik

#### Zahlreiche Spezialeinheiten:

optimiert auf hohe Übertragungsgeschwindigkeit und geringen Stromverbrauch

#### Nichtflüchtige Speicher:

für Anwendungen in den Bereichen mobile Kommunikation und Unterhaltungselektronik

... **Datenverarbeitung:** PCs, Notebooks, Workstations, Server

... **Grafikapplikationen:** Grafikkarten, Spielekonsolen

... **Mobile Anwendungen:** PDAs, Smartphones

... **Unterhaltungselektronik:** Digitalkameras, MP3-Player, Set-Top-Boxen, USB-Sticks

Produkte	Marktposition	Schlüsselkunden <sup>1</sup>	Wettbewerber <sup>1</sup>
<p><b>Automobilelektronik:</b> ... Mikrocontroller, Leistungshalbleiter, Sensoren (Reifendruck-sensoren, Temperatursensoren, Inertia, Magnetfeldsensoren), Komponenten für Bussysteme (CAN, LIN, MOST)</p> <p><b>Industrie:</b> ... Mikrocontroller, Leistungshalbleiter-ICs, diskrete Leistungshalbleiter, IGBT- und bipolare Module, diskrete Kleinsignalhalbleiter</p> <p><b>Multimarket:</b> ... Thyristoren und Dioden, Sensoren, Hochfrequenz-Halbleiter, diskrete Halbleiter, steckbare Speichermodule, Sicherheitschips, Leistungshalbleiter</p> <p><b>Chipkarten:</b> ... Kontaktbasierte und kontaktlose Sicherheitscontroller (8 Bit, 16 Bit, 32 Bit) und Speicher, Sicherheitsspeicher, Trusted Platform Module (TPM), RFID-Chips</p>	<p><b>Automobilelektronik:</b> ... <b>Nr. 2</b> bei Halbleitern im Automobilbereich (<b>Nr. 1</b> in Europa)</p> <p>... <b>Führend</b> bei Reifendrucküberwachungssystemen</p> <p><b>Industrie, Multimarket:</b> ... <b>Nr. 1</b> bei Leistungshalbleitern</p> <p>... <b>Nr. 2</b> bei Halbleitern in industriellen Antrieben und Traktion</p> <p>... <b>Nr. 4</b> über alle industriellen Anwendungen</p> <p><b>Chipkarten:</b> ... <b>Nr. 1</b> bei Chipkarten-ICs</p>	<p><b>Automobilelektronik, Industrie und Multimarket:</b> ... ABB, Asustec, Autoliv, Avnet ... Bosch ... Continental Automotive Systems ... Delphi, Delta, Denso ... Foxconn ... Gigabyte ... Hella, Hitachi ... ICS ... Lear ... Microsoft, Motorola ACES, MSI ... Rockwell ... SAC, Siemens ... TRW ... Visteon</p> <p><b>Chipkarten:</b> ... Axalto ... Gemplus, Giesecke &amp; Devrient ... Oberthur Card Systems</p>	<p><b>Automobilelektronik, Industrie und Multimarket:</b> ... Fairchild, Freescale ... International Rectifier ... Mitsubishi ... National Semiconductor ... ON Semiconductor ... Philips ... Renesas ... STMicroelectronics ... Toshiba</p> <p><b>Chipkarten:</b> ... Atmel ... Philips ... Renesas ... Samsung, STMicroelectronics</p>
<p><b>Drahtgebundene Kommunikation:</b> ... Schnittstellenbausteine für Sprachkommunikation in Vermittlungsstellen und Endgeräten (CODECs, SLICs, ISDN, T/E usw.) ... Lösungen für integrierte Sprach- und Datenkommunikation und VoIP ... Systemlösungen für drahtgebundene Breitbandtechnologien (ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2) ... Systemlösungen für DSL-Modems, Router, Home-Gateways, WLAN Access Points, NICs usw.</p> <p><b>Drahtlose Kommunikation:</b> ... Basisbandprozessoren und Hochfrequenz-Transceiver für die gängigen drahtlosen Kommunikationsstandards (GSM, GPRS, E-GPRS, EDGE, W-CDMA, DECT, WDCT, Bluetooth) ... 1-Chip-Lösungen oder Module, in denen Basisbandprozessor und Hochfrequenz-Transceiver in einem Bauteil zusammengefasst werden ... Systemlösungen für Mobilfunktelefone einschließlich Plattformdesign, Betriebssoftware, Applikationen ... Serviceleistungen für Systemintegration und kundenspezifische Anpassungen ... Analoge und digitale TV-Tuner für stationäre und mobile TV-Empfängergeräte ... Leistungstransistoren für Verstärker in Mobilfunk-Basisstationen (bis zu 180 Watt) für 2G- bis 3G-, CDMA/2000-Mobilfunkstandards ... GPS-Empfänger ... BAW-Filter</p>	<p><b>Drahtgebundene Kommunikation:</b> ... <b>Nr. 1</b> bei ISDN ... <b>Nr. 1</b> bei T/E Carrier ... <b>Nr. 1</b> bei analogen Linecards ... <b>Nr. 3</b> bei Zugangnetzwerken ... <b>Nr. 4</b> bei digitalen Linecards ... <b>Nr. 5</b> bei applikations-spezifischen Bausteinen</p> <p><b>Drahtlose Kommunikation:</b> ... <b>Nr. 1</b> bei Hochfrequenz-Transceivern ... Einer der zwei führenden Anbieter bei DECT/WDCT ... <b>Nr. 2</b> bei Leistungs-transistoren für Mobilfunk-Basisstationen ... <b>Nr. 3</b> bei applikations-spezifischen Bausteinen ... <b>Nr. 4</b> bei Bluetooth</p>	<p>... Alcatel ... BenQ ... Ericsson ... Huawei ... LG Electronics ... Matsushita, Motorola ... Nokia ... Samsung, Siemens ... ZTE</p>	<p>Agere Broadcom Conexant Ericsson Mobile Platforms Freescale Intel Philips Semiconductors Qualcomm Renesas Technology STMicroelectronics Texas Instruments</p>
<p>... Standard-DRAM-Speicher mit Speicherdichten von 64 Mbit bis 1 Gbit ... Speichermodule für PCs, Notebooks, Sub-Notebooks, Workstations und Server mit Speicherdichten von 64 MByte bis 8 GByte ... Speicherspeicher für Grafikanwendungen (Graphics RAM) ... Speicherspeicher für mobile Geräte (Mobile-RAM, CellularRAM) ... Nichtflüchtige Speicher (NAND-Flash) ... Flash-Speicherkarten mit Speicherdichten von 64 MByte bis 256 MByte in den gängigen Formaten SD-Card, MMC und USB-Stick</p>	<p>... <b>Nr. 4</b> bei DRAM-Speichern ... <b>Technologieführer</b> in der 300-Millimeter-Wafer-Produktion ... <b>Spitzenstellung</b> bei hochperformanten Grafikspeichern ... <b>Spitzenstellung</b> bei Stromsparenden Speicherspeichern ... <b>Spitzenstellung</b> bei hochkomplexen Speichermodulen für Workstations und Server</p>	<p>... Acer, Asustek, ATI ... Cisco ... Dell ... EMC ... Fujitsu-Siemens ... HP, HTC ... IBM ... Kingston ... Lenovo, Lexar Media, LG Electronics ... Microsoft, Motorola ... NEC, Nvidia ... Sony, Sun Microsystems</p>	<p>Elpida Hynix Micron Nanya PowerChip Samsung</p>

## Infineon-Kennzahlen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre<sup>1</sup>

Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September	2004		2005		2005:2004 Veränderung in %
	Mio. €	in % vom Umsatz	Mio. €	in % vom Umsatz	
<b>Umsatzerlöse</b>	7.195		<b>6.759</b>		-6
<b>nach Regionen</b>					
Deutschland	1.675	23	1.354	20	-19
Übriges Europa	1.263	18	1.210	18	-4
Nordamerika	1.524	21	1.504	22	-1
Asien-Pazifik	2.263	32	2.223	33	-2
Japan	364	5	332	5	-9
Andere	106	1	136	2	28
<b>nach Segmenten</b>					
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	2.540	35	2.516	37	-1
Kommunikation	1.689	24	1.391	21	-18
Speicherprodukte	2.926	41	2.826	42	-3
Sonstige Geschäftsbereiche	11	-	12	-	9
Konzernfunktionen	29	-	14	-	-52
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	2.525	35	<b>1.850</b>	27	-27
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.219	17	1.293	19	6
Betriebsergebnis	314		-268		-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	61		-312		-
Ebit Ebit-Marge	256	4	-183	-3	-
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert in €	0,08		-0,42		-
Dividende pro Aktie in €	-		-		-
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.857		1.039		-44
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.809		-238		87
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-402		-266		34
Free-Cash-Flow <sup>2</sup>	206		-281		-
Planmäßige Abschreibungen	1.320		1.316		-
Außerplanmäßige Abschreibungen	136		134		-1
Auszahlungen für Sachanlagen	1.163		1.368		18
Brutto-Cash-Position <sup>3</sup>	2.546		2.006		-21
Netto-Cash-Position <sup>4</sup>	548		341		-38
Sachanlagen	3.587		3.751		5
Bilanzsumme	10.864		10.284		-5
Summe Eigenkapital	5.978		5.629		-6
Eigenkapitalquote	55 %		55 %		-
Eigenkapitalrendite <sup>5</sup>	1 %		-5 %		-
Gesamtkapitalrendite <sup>6</sup>	1 %		-3 %		-
Anlagendeckung <sup>7</sup>	167 %		150 %		-10
Verschuldungsgrad <sup>8</sup>	33 %		30 %		-9
Gesamtverschuldungsgrad	18 %		16 %		-11
Mitarbeiter	35.570		36.440		2

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Free-Cash-Flow = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit minus Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit, verändert um Kauf/Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens.

3 Brutto-Cash-Position = Zahlungsmittel zuzüglich Wertpapiere des Umlaufvermögens.

4 Netto-Cash-Position = Brutto-Cash-Position, verringert um kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

5 Eigenkapitalrendite = Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital.

6 Gesamtkapitalrendite = Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital.

7 Anlagendeckung = Eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.

8 Verschuldungsgrad = Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

## Basisinformationen zur Aktie

Art der Aktien	Namensaktien (Stammaktien) in Form von Aktien oder American Depositary Shares (ADS) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 2,00 € (Verhältnis ADS:Aktien = 1:1)
Grundkapital	€1.495 Mio. (am 30.9.2005)
Ausstehende Aktien	748 Mio. (am 30.9.2005)
Börsennotierungen	Aktien: Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ADS: New York Stock Exchange (NYSE)
Optionshandel	Optionen auf die Aktien: Eurex Optionen auf die ADS: CBOE
Börsengang	13. März 2000 an der FWB und NYSE
Emissionspreis	€35,00 pro Aktie US-\$33,92 pro ADS
Börsenkürzel	IFX
ISIN-Code	DE0006231004
CUSIP	45662N103
Bloomberg	IFX.GY (Xetra-Handelssystem) IFX.US
Reuters	IFXGn.DE
Indexmitglied (Auswahl)	Dax-30 Dow-Jones-German-Titans-30 Dow Jones Stoxx Semiconductor FTSE-Euro-100 MSCI Germany SOX S&P-Europe-350

—	2	Informationen für Aktionäre
-----	4	Brief an die Aktionäre
-----	10	Der Vorstand der Infineon Technologies AG
-----	12	Die Infineon-Aktie
—	14	Unser Unternehmen
-----	16	Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket
-----	20	Kommunikation
-----	24	Speicherprodukte
-----	28	Infineon-Standorte weltweit
-----	30	Soziale Verantwortung
-----	33	Menschen bei Infineon
—	36	Finanzbericht
-----	39	Inhalt
-----	40	Bericht des Aufsichtsrats
-----	46	Corporate Governance
-----	50	Konzernlagebericht
-----	80	Konzernabschluss
-----	86	Anhang zum Konzernabschluss
—	140	Weitere Informationen
-----	140	Mehrjahresübersicht 2001–2005
-----	142	Finanz- und Technologieglossar
-----	148	Finanzkalender

**Zukunftsorientierte Aussagen:**

Der Geschäftsbericht enthält zukunftsorientierte Aussagen. Diese sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der Infineon Technologies AG. Diese beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen auf Grund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

# Akzente setzen.

2005 haben wir Infineon konsequent voran-  
gebracht – Strukturen optimiert, Eigenver-  
antwortung gefördert, Kundenorientierung  
gestärkt und unsere Effizienz erhöht.



Titelbild

In Zukunft können nicht nur Stimme und Daten, sondern ganze Spielfilme und Sportveranstaltungen gleichzeitig über die Telefonleitung übertragen werden. Dies ermöglicht die neueste Breitbandtechnologie VDSL2. In diesem Markt sind wir mit unserem VINAX führend.

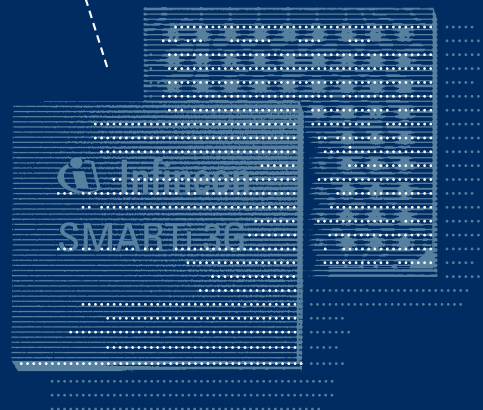
## Impulse geben.

2006 richten wir Infineon neu aus, um in Zukunft Wachstumschancen besser zu nutzen. Mit zwei eigenständigen Unternehmen gewinnen wir Wettbewerbsvorteile: für neue Potenziale und einen zielgerichteten Weg hin zu konstantem profitablen Wachstum.



# SMARTi 3G

Unsere Hochfrequenz-Transceiver finden Sie bei fast allen großen Handy-Herstellern. Auf unser neuestes Produkt für 3G-Mobiltelefone, den SMARTi 3G, sollte dies genauso zutreffen. Aber er kann noch mehr: Als bisher einziger Transceiver kann der SMARTi 3G in allen UMTS-Mobilfunknetzen dieser Welt eingesetzt werden – gleich, ob bei Ihnen zu Hause, am Hochufer des Huangpu oder am Fuße des Popocatepetl.



# Informationen für Aktionäre



## Brief an die Aktionäre

Dr. Wolfgang Ziebart  
Vorsitzender des Vorstands der Infineon Technologies AG



## Sehr geehrte Damen und Herren,

das Geschäftsjahr 2005 war für Infineon ein bewegtes Jahr, in dem wir vieles angepackt und erfolgreich umgesetzt haben. Wir haben große Fortschritte gemacht. So ist es uns gelungen, Infineon durch umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen, signifikante Kosteneinsparung und durch organisatorische Neuaufstellung noch näher am Markt zu orientieren. Allerdings hatten wir auch mit Problemen zu kämpfen: mit einem sehr starken Preisverfall bei Speicher- und Chipkartenprodukten sowie mit massiven Umsatzeinbußen bei einem unserer Schlüsselkunden im Bereich Mobilfunk. Infolge dieser negativen Effekte spiegelt unser Ergebnis unsere Fortschritte nicht wider: Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern belief sich auf – 183 Millionen Euro nach einem Überschuss von 256 Millionen Euro im Vorjahr. Darin enthalten sind allerdings Sonderaufwendungen von netto 104 Millionen Euro vor Steuern.

Auch wenn die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs den Blick dafür verstellen mögen, möchte ich Ihr Augenmerk auf die konsistente Entwicklung lenken, die wir im Vorstand als Ziel verfolgen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einen deutlichen Richtungswechsel vorgenommen. In der Vergangenheit hat Infineon eine primär auf Wachstum ausgerichtete Strategie verfolgt und damit beachtliche Marktanteile gewonnen. Wir haben damit eine kritische Größe und eine gute Marktposition erreicht und somit die Basis für die Zukunft geschaffen. Veränderungen in allen Bereichen der Halbleiterindustrie erfordern jedoch nun die Konzentration auf profitables Wachstum. Ich möchte Ihnen die Schritte darlegen, die wir im abgelaufenen Jahr auf diesem Weg bereits gegangen sind, und Ihnen anschließend die Maßnahmen erläutern, die wir künftig durchführen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir einige grundlegende organisatorische Veränderungen vorgenommen. Von größter Bedeutung war die Neuorganisation unseres Unternehmens, die Anfang 2005 umgesetzt wurde. Mit der Schaffung von Einheiten, die heute erheblich mehr Eigenverantwortung und Handlungsfreiheit aufweisen, haben wir unternehmerische Entscheidungen tiefer in das Unternehmen hinein verlagert als bisher. Wir agieren damit nicht nur flexibler, sondern verkürzen auch unsere Entscheidungswege deutlich und erhöhen unsere Effizienz. Jedes operative Segment wird heute durch einen Vorstand verantwortet. Zusätzlich haben wir unsere zentrale Forschungsabteilung in die einzelnen Segmente eingegliedert, um die von der Forschung ausgehenden Innovationen schneller in neue Produkte umzusetzen.

Ebenfalls im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unverzüglich diejenigen Themen angepackt, bei denen es für uns offensichtlichen Handlungsbedarf gab. Die neue, verstärkt divisionale Struktur hat uns dies erleichtert. Wir haben ein Programm auf den Weg gebracht, mit dem wir 320 Millionen Euro niedrigere Kosten als ursprünglich geplant verzeichneten. Aktivitäten, die nicht zu unserem Kerngeschäft gehören, haben wir beendet oder veräußert. Darunter fallen beispielsweise der Verkauf von Infineon Ventures und die Bereinigung des Emerging-Business-Portfolios, zu dem unter anderem der Bereich Wearable Electronics und die Biochip-Aktivitäten gehörten. Innerhalb unseres Kerngeschäfts haben wir dann die Geschäftseinheiten identifiziert, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering war, wieder in die Gewinnzone zu gelangen. Trotz hervorragender Technik haben wir diese Aktivitäten entweder veräußert oder eingestellt. Beispielsweise haben wir unsere Controller-Aktivitäten im Bereich Mobilfunkinfrastruktur beendet. Ein Teil des Glasfasergeschäfts wurde an Finisar veräußert, der überwiegende Teil unseres Geschäftsfelds Optische Netzwerke an Exar verkauft. Zudem haben wir strategisch wichtige Teile des Glasfasergeschäfts in das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket integriert. Schon heute sehen wir, dass diese Entscheidungen richtig waren. Die beschriebenen Maßnahmen im Bereich drahtgebundene Kommunikation dienen dazu, das Geschäft zu fokussieren, und bereits heute verzeichnen die Breitband-Zugangsprodukte eine hervorragende Entwicklung mit signifikanten Marktanteilsgewinnen. Das Geschäftsfeld Drahtgebundene Kommunikation insgesamt ist heute so erfolgreich wie lange nicht mehr.

Bei zwei bedeutenden Aktivitäten haben wir Potenzial für eine profitable Fortführung identifiziert. Die beiden Bereiche, Basisbandprozessoren für Mobiltelefone und Sicherheits- und Chipkarten-ICs, setzen derzeit den definierten Restrukturierungsplan um. Bei Basisbandprozessoren haben wir einen aggressiven und konsequenten Plan entwickelt, mit dem wir neue Kunden gewinnen wollen. Er basiert auf der Weiterentwicklung unserer im Weltmarkt führenden Hochfrequenztechnologie sowie auf neuen Prozessoren für Mobiltelefone. Diese Technologie wird durch die UMTS/EDGE/GSM-Protokoll-Software vervollständigt. Insgesamt stellen wir damit dem Markt ein hervorragend wettbewerbsfähiges Angebot für Mobilfunkplattformen zur Verfügung, die vom Einstiegssegment bis hin zum High-End-Segment skalierbar sind. Damit sollten wir gegen Ende des Geschäftsjahrs 2006 deutlich verbesserte Ergebnisse erwirtschaften. Infolge großer Anstrengungen zur Kostensenkung und Produktentwicklung ist absehbar, dass sich die Lage auch bei Sicherheits- und Chipkarten-ICs zum Ende des Kalenderjahrs 2006 wesentlich verbessern wird. Wir werden Produkte mit höherer Wertschöpfung wie Zugangstechnologien, Zahlungsverkehr und Identifikationssysteme stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Verbesserung unserer Ertragslage hat in diesem

Fall klar Vorrang vor der Sicherung unseres Weltmarktanteils, der bei knapp 40 Prozent liegt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Vorgabe, profitables Wachstum zu erzielen, erfolgreich sein werden.

Mit den genannten Maßnahmen haben wir das Unternehmen im abgelaufenen Jahr in jenen Bereichen neu aufgestellt, die den dringendsten Handlungsbedarf aufwiesen. Ich möchte mich damit den Schritten zuwenden, die wir im neuen Geschäftsjahr einleiten werden. Bereits seit längerem zeichnen sich grundlegende Änderungen in der Halbleiterindustrie ab. Vor allem stellen wir fest, dass sich das Wachstum des Halbleitersektors insgesamt verlangsamt. Stärker unterscheiden werden sich künftig auch die Wachstumsgeschwindigkeiten der einzelnen Segmente. Außerdem erleben wir eine immer weiter gehende Spezialisierung der Unternehmen bei Entwicklung und Fertigung. Bisherige Fertigungsmodelle werden sich auf Grund von Marktverschiebungen und Spezialisierungen nicht unverändert fortführen lassen. Zusätzlich rücken in bestimmten Segmenten Systemlösungen stärker in den Vordergrund als Einzelprodukte.

Diese Veränderungen machen ein größeres Maß an Differenzierung in der Unternehmensstruktur erforderlich, über die bereits vollzogene divisionale Aufstellung des Unternehmens hinaus. In der Vergangenheit konnten wir stets Synergien in der Fertigung von Speicher- und Logikprodukten innerhalb des gleichen Unternehmens erkennen und nutzen. Infolge der unterschiedlichen technischen Entwicklung nehmen diese Synergien künftig jedoch im Zeitverlauf ab. Märkte und Kunden sowie Produkt- und Prozessentwicklung von Speicherprodukten auf der einen und Logikprodukten auf der anderen Seite entwickeln sich verstärkt auseinander: Die hochvolumige Produktion von Speicherprodukten bleibt wegen der aufwändigen Technik äußerst kapitalintensiv und prozessorientiert. Für Logikprodukte sehen wir hingegen wesentlich differenziertere Märkte mit geringeren Produktionsvolumina der Einzelprodukte und mit wachsenden Anforderungen für Systemlösungen. Die enge Einbindung von Kunden in die Produktentwicklung ist hier ein zentraler Erfolgsfaktor. Unser Portfolio an Technologien und Fertigungsprozessen muss sich daher am Kundenbedarf orientieren, eine zentral gesteuerte Bereitstellung der neuesten Fertigungsprozesse und Kapazitäten ist zu kostenintensiv. Zudem unterscheiden sich die Innovationsgeschwindigkeiten bei Speicher und Logik immer mehr. Während manche Logikprodukte Lebenszyklen von wenigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt aufweisen, erneuern sich Speicherprodukte im Jahresrhythmus. Hier ist die schnellstmögliche Einführung der jeweils neuesten und kostengünstigsten Fertigungstechnologien gefragt, die mit einer hohen Kapitalintensität des Geschäfts verbunden ist.

Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren sehen wir deshalb heute und für die Zukunft eine deutlich unterschiedliche Entwicklung bei Speicher- und Logikprodukten. Daraus resultieren andere Notwendigkeiten in Strukturen und Geschäftsmodellen sowie in Steuerung und Strategien.

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Speichergeschäft rechtlich zu verselbstständigen. Ein späterer Börsengang ist unsere bevorzugte Option. Wir sind überzeugt, dass eine solche Trennung sowohl dem Bereich Speicherprodukte als auch dem Logikbereich eine Fülle von neuen Möglichkeiten eröffnet. Für den Speicherbereich bietet die Ausgliederung die Chance eines eigenen Kapitalmarktzugangs. Dies stellt in einer kapitalintensiven Industrie einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Auch erleichtert die rechtliche Selbstständigkeit dem Speicherbereich, Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Der Logikbereich des Unternehmens könnte Mittelzuflüsse aus dem Börsengang der Speichersparte verwenden, um das eigene Geschäft durch selektive Akquisitionen zu stärken. Schließlich haben Anleger nach Börsennotiz des Speicherbereichs die Möglichkeit, differenzierter zu investieren.

Wir werden aber nicht nur den Speicherbereich in eine selbstständig tätige Gesellschaft überführen, sondern auch in den Logikbereichen von Infineon einige Veränderungen vornehmen. So werden wir in Zukunft eine differenziertere Produktionsstrategie für Logikprodukte verfolgen. Für Bauteile, die in wesentlichen Teilen auf den Standardprozess der Halbleiterfertigung zurückgreifen, die so genannte CMOS-Technologie, investieren wir nicht in eigene Fertigungskapazitäten für 65-Nanometer-Technologien. Hingegen werden wir die in den Bereichen Leistungs- und Hochfrequenzhalbleiter benötigten speziellen Fertigungsschritte nach wie vor im Unternehmen selbst vornehmen, da diese Spezialfertigungsfähigkeiten weiterhin einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor darstellen. In diesem Zusammenhang möchte ich unser neues Werk in Kulim, Malaysia, erwähnen, das wir ausschließlich für die Herstellung von Leistungshalbleitern für den Automobil- und Industriebereich errichten. Die Märkte für diese Produkte wachsen stetig, und Infineon ist hier in vielen Segmenten Marktführer. Im Herbst 2006 wird dieses Werk die Produktion aufnehmen.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen vermitteln, dass wir in den vergangenen Monaten ganz wesentliche Themen für das Unternehmen angepackt haben. Nach eingehender strategischer Bestandsaufnahme haben wir uns vorgenommen, die von uns identifizierten Maßnahmen konsequent umzusetzen. Wir haben es in der Hand, unsere Zukunft zu gestalten. Wir müssen alles daran setzen, dass 2006 ein besseres Jahr für uns wird, auch wenn der Marktausblick, den Experten für die Halbleiterindustrie geben, erneut von einem einstelligen Wachstum ausgeht.

Unsere Mitarbeiter zeigen trotz der Umstrukturierung und der Veränderung in ihrer Arbeit weiterhin Höchstleistungen und Hingabe an das Unternehmen. Dafür danke ich ihnen persönlich und im Namen des gesamten Vorstands. Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam bereits viel erreicht: eine erfolgreiche und wegweisende Neuorganisation, die Neuausrichtung und die Restrukturierung vieler Geschäftsfelder. Die noch vor uns liegenden Herausforderungen werden wir gemeinsam ebenso erfolgreich meistern.

München, im November 2005

Mit freundlichen Grüßen

Ihr



Dr. Wolfgang Ziebart  
Vorsitzender des Vorstands



## Der Vorstand der Infineon Technologies AG



von links:

Prof. Dr. Hermann Eul

Leiter des Segments Kommunikation

Studium der Elektrotechnik, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit Juli 2005

Peter J. Fischl

Finanzvorstand und Arbeitsdirektor

Industriekaufmann; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Dr. Wolfgang Ziebart

Vorsitzender des Vorstands

Studium des Maschinenbaus, Promotion zum Dr.-Ing.; Mitglied des Vorstands seit September 2004

Peter Bauer

Leiter des Segments Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Studium der Elektrotechnik, Diplomingenieur; Mitglied des Vorstands seit April 1999

Kin Wah Loh

Leiter des Segments Speicherprodukte

Studium der Verfahrenstechnik, Bachelor of Science; Mitglied des Vorstands seit Dezember 2004

## Die Infineon-Aktie Infineon-Aktie kann vom allgemeinen Aufwärtstrend nicht profitieren

Kursniveau der Infineon-Aktie im Berichtsjahr nahezu unverändert.  
DJ-Stoxx-Halbleiterindex steigt im Geschäftsjahr 2005 um 13 Prozent.  
Im Durchschnitt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr täglich 9,7 Millionen Infineon-Aktien gehandelt.

Chipaktien konnten im vergangenen Jahr nicht in vollem Umfang von der positiven Stimmung am Aktienmarkt profitieren. So stieg der DJ-Stoxx-Halbleiterindex nur um 13 Prozent, während die Indizes DJ-Stoxx-50 und Dax um 22 bzw. 30 Prozent zulegten. Der Grund: Die Gewinnschätzungen für viele Halbleiterwerte mussten teilweise wegen Unterauslastung der Kapazitäten als Folge des Abbaus zu hoher Lagerbestände bei ihren Kunden nach unten korrigiert werden.

Auch Infineon war von diesem Effekt betroffen, jedoch zusätzlich noch von dem starken Preisdruck im DRAM- und Chipkartengeschäft sowie von deutlichen Marktanteilsverlusten bei einem seiner größten Kunden im Mobilfunk. Das hat mit dazu beigetragen, dass sich die Infineon-Aktie im letzten Jahr schlechter als der Halbleitersektor entwickelte. Doch zu Beginn des Geschäftsjahrs hat sie sich zunächst im Einklang mit dem Markt bewegt und am 18. November 2004 das Jahreshoch von 9,00 Euro markiert. Anschließend kam es zu einem stärkeren Kursrückgang, der am 29. April 2005 mit dem Jahrestief von

6,43 Euro sein Ende fand. Insbesondere in dieser Phase hat die Infineon-Aktie gegenüber anderen Halbleiteraktien an Boden verloren. Danach erholte sich die Aktie mit dem Markt und erreichte zum Ende des Berichtsjahrs den Kurs von 8,18 Euro, im Vergleich zu 8,22 Euro zum Ende des Vorjahrs. Durch das nahezu unveränderte Kursniveau hat sich auch die enttäuschende langfristige Kursentwicklung nicht verändert. Wie auch im Vorjahr verzeichnet die Infineon-Aktie einen Kursrückgang von 77 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis zum Börsengang am 13. März 2000. Im Vergleich zum DJ-Stoxx-Halbleiterindex hat die Infineon-Aktie im gleichen Zeitraum jedoch weniger an Wert verloren.

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie hat sich nach einem kontinuierlichem Anstieg seit dem Börsengang erstmals reduziert. So wurden im letzten Geschäftsjahr im Durchschnitt täglich 9,7 Millionen Infineon-Aktien auf Xetra, auf dem Frankfurter Parkett und an den Regionalbörsen gehandelt, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch repräsen-

**Relative Entwicklung von Infineon Technologies, DJ-Stoxx-Halbleiterindex und Dax seit Beginn des Geschäftsjahrs 2003 (Schlusskurse)**



tierte dieses Volumen 9,5 Prozent des gesamten Dax-30-Handelsvolumens im selben Zeitraum. Nur ein Unternehmen im Dax-30 konnte ein höheres Handelsvolumen verzeichnen.

### Kursdaten der Infineon-Aktie

Geschäftsjahr zum 30.9.	2004	2005
<b>Europa</b> Xetra-Schlusskurse in €		
Höchstkurs	13,65	<b>9,00</b>
Tiefstkurs	7,80	<b>6,43</b>
Jahresendkurs Ende September	8,22	<b>8,18</b>
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	11.743.938	<b>9.666.303</b>
davon auf Xetra in %	96	<b>97</b>
<b>USA</b> NYSE-Schlusskurse in US-Dollar		
Höchstkurs	15,87	<b>11,47</b>
Tiefstkurs	9,39	<b>8,40</b>
Jahresendkurs Ende September	10,22	<b>9,92</b>
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag in Stück	896.317	<b>583.101</b>

### Langfristige Entwicklung Infineon-Aktie und Indizes in %

Zeitraum zum 30.9.2005	Seit IPO am 13.3.2000	Seit Oktober 2003	Seit Oktober 2004
<b>Europa</b>			
Infineon (Xetra)	-77 <sup>1</sup>	-27	0
DJ-Stoxx-Halbleiter	-84	-13	13
DJ-Stoxx-Technologie	-75	29	21
DJ-Stoxx-50	-35	37	22
Dax	-34	55	30
<b>USA</b>			
Infineon (NYSE)	-71 <sup>1</sup>	-23	-3
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	-64	13	24

1 Basiert auf dem Ausgabepreis von 35 Euro bzw. 33,92 US-Dollar.

### Grundkapital, Anzahl Aktien und Marktkapitalisierung Infineon Technologies AG

Stichtag	30.9.2004	30.9.2005	Entwicklung
Grundkapital in Mio. €	1.495	<b>1.495</b>	0 %
Ausstehende Aktien in Mio. <sup>1</sup>	748	<b>748</b>	0 %
im Jahresdurchschnitt in Mio. <sup>1</sup>	735	<b>748</b>	+2 %
Marktkapitalisierung in Mio. €	6.149	<b>6.119</b>	0 %
Marktkapitalisierung in Mio. \$	7.645	<b>7.420</b>	-3 %

1 Unverwässert.

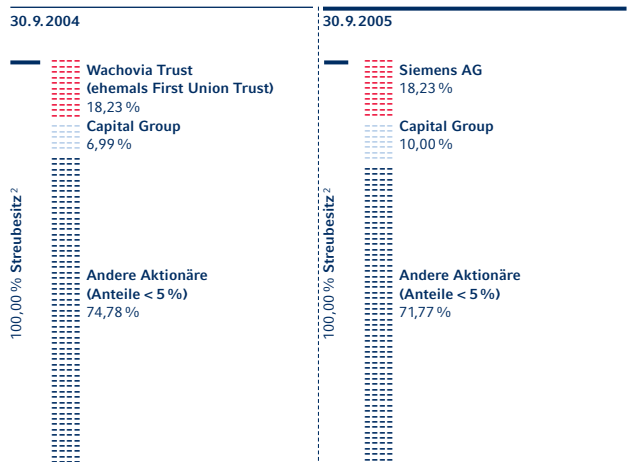
### Infineon zahlt keine Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat können der Hauptversammlung keine Dividendenzahlung vorschlagen, da die Muttergesellschaft des Konzerns, die Infineon Technologies AG, keinen Bilanzgewinn ausweist. Der entsprechende Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2005 beträgt 1.546 Millionen Euro im Vergleich zu einem Bilanzverlust in Höhe von 1.209 Millionen Euro im Vorjahr.

### Aktionärsstruktur

Im Berichtsjahr gab es zwei mitteilungspflichtige Veränderungen in der Aktionärsstruktur, die Infineon bekannt sind. Zum einen hat die Capital Group ihren Anteil bis zum 12. Mai 2005 auf 10,00 Prozent erhöht. Zum anderen wurden die Anteile im Besitz der Wachovia Trust Company National Association am 28. November 2004 an Siemens zurückübertragen. Dadurch ist Siemens wieder berechtigt, die Stimmrechte aus diesen Anteilen auszuüben.

### Aktionärsstruktur<sup>1</sup>



1 Gemäß der Infineon bekannten Pflichtmeldungen.

2 Streubesitz gemäß Definition von FTSE. Deutsche Börse und Stoxx berechnen den Infineon-Streubesitz ohne die Anteile von Siemens bzw. des Wachovia Trust.

Für Fragen steht das Investor-Relations-Team von Infineon in München und San Jose/Kalifornien, USA, jederzeit zur Verfügung.

**Büro München**  
Tel. +49 (0)89 234-26 655  
Fax +49 (0)89 234-26 155

**Büro San Jose**  
Tel. +1 408 501 6800  
Fax +1 408 392 8023

**E-Mail**  
investor.relations@infineon.com

# 512M GDDR3

Die anspruchvollsten Kunden unter den Computerkäufern sind die Grafikanwender. Sie benötigen äußerst schnelle Grafikspeicher, die sie in Spielekonsolen und Grafikkarten einsetzen. Wirkliche Spielfreude entsteht bei ihnen nur bei einem reibungslosen Bildaufbau der komplizierten Grafiken, Szenen und Animationen. Nur ganz wenige Hersteller haben dafür Bausteine im Programm. Bei uns ist es der 512M GDDR3.



# Unser Unternehmen



## Wussten Sie, dass ...

- eine bislang kaum genutzte Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung die Rückgewinnung der Bremsenergie ist? Sie kommt nun bei **Hybridautos** zum Tragen, wo Halbleiter im Wert von 400 bis 600 US-Dollar eingebaut werden, mehr als doppelt soviel, wie im Auto mit Verbrennungsmotor.
- die amerikanische Gesetzgebung vorschreibt, dass ab September 2007 alle PKWs mit **Sensoren zur Reifendrucküberwachung** ausgestattet sein sollen?
- durch den Einsatz **effizienterer PC-Netzteile** allein in den USA vier Kraftwerke eingespart werden könnten?
- durch den Ruhestrom von im Stand-by-Betrieb gehaltenen Geräten in Deutschland **20 Milliarden** Kilowattstunden pro Jahr verbraucht werden? Das entspricht rund zwei Milliarden Euro und der Leistung von zwei Kraftwerken.
- sich bis zum Jahr 2005 mehr als 40 europäische und asiatische Staaten für einen Personalausweis mit **Sicherheitschip** entschieden haben? Das betrifft mehr als zwei Milliarden Bürger.

## Energieverbrauch senken, Wachstum sichern

Die asiatische Wirtschaft wächst, und damit der Energieverbrauch. Mit zunehmendem Wohlstand halten Auto, Klimaanlage, Waschmaschine und Unterhaltungselektronik Einzug in die Haushalte. Nun steht diese Region, wie auch der Rest der Welt, vor der schwierigen Aufgabe, ihren Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten. Dies kann nur erreicht werden, wenn die Verlustleistung elektrischer Geräte vermindert wird, die in Form von Wärme durch ineffiziente Energiewandlung verloren geht. Hierbei helfen Leistungshalbleiter, die Netzteile mit höheren Wirkungsgraden ermöglichen.

Autos begeistern, vor allem die größtenteils unsichtbare Elektronik darin. Halbleiter sind heutzutage in fast alle Bestandteile eines Autos integriert. Neue Fahrerassistenzsysteme verarbeiten Umgebungsinformationen des Fahrzeugs, warnen den Fahrer vor Gefahrensituationen oder greifen im Notfall aktiv in das Fahrverhalten ein. Dafür werden beispielsweise Nah- und Fernbereichssensoren eingesetzt, die auf Radartechnologie basieren.

Ausgeklügelte Elektronik für die Antriebssteuerung auf Basis von Infineons Bauelementen sorgt bereits heute für geringeren Kraftstoffverbrauch. Auf Grund des rapiden Anstiegs der Rohölpreise ist die Kraftstoff sparende Hybrid-Antriebstechnik – eine Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor – in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. In diesen Systemen schalten Leistungshalbleiter je nach Fahrsituation den Elektromotor hinzu oder speisen einen speziellen Hochspannungsakku mit der überschüssig erzeugten Energie.

Wie auch immer Wirtschaftswachstum das Verbraucherverhalten beeinflusst, Infineon bietet mit seinen Produkten Möglichkeiten zum Energie sparen.



## Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket Elektronik sorgt für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort

Unsere Halbleiter für die Automobilelektronik entsprechen industrieweit höchsten Qualitätsanforderungen. Durch die flexible Ansteuerung von Motoren und Lampen lässt sich der Energieverbrauch senken. Wir liefern höchste Sicherheit für Ausweise, Pässe und in Netzwerken.

### Automobil: von Kraftstoffeinsparung und Fahrgastsicherheit bestimmt

In der Automobilindustrie sind Autohersteller und Elektronikzulieferfirmen auf Grund der langen Produktlebenszyklen auf hohe Planungssicherheit und dauerhafte Kundenbeziehungen angewiesen. Auch Infineon, in Europa Nummer eins und weltweit Nummer zwei im Automobilsektor, pflegt hier stabile Geschäftsbeziehungen, direkt zu mehr als 200 Kunden und indirekt über unsere Distributionspartner zu mehreren tausend. Viele der Kunden kommen aus Europa, wo nach wie vor die meisten Innovationen rund ums Auto hervorgebracht werden.

Ausgelöst von dem stärkeren Sicherheits- und Komfortbewusstsein der Autofahrer steigt seit Jahren der Elektronikanteil und damit auch die Anzahl der Halbleiter im Auto. Für alle Produkte in der Automobilbranche und die zugehörigen Halbleiter ist Qualität dabei oberstes Gebot. Um den höchsten Anforderungen zu genügen, hat Infineon das Automotive-Excellence-Programm gestartet. Ziel dieses Programms ist, Bauteildefekte vollkommen auszuschließen. Im Juli 2005 hat uns Continental Automotive Systems als erstes Halbleiterunternehmen zum „Lieferant des Jahres 2004“ ernannt – ein deutlicher Beleg für die erfolgreiche Umsetzung dieses Programms.

Auch technische Entwicklungen zu Kraftstoffeinsparung und Emissionsminderung werden immer wichtiger. Die in der Motor- und Getriebesteuerung eingesetzten 32-Bit-Controller aus unserer TriCore-Familie, allen voran der → **TriCore TC1796**, ermöglichen durch ihre enorme Rechenleistung einen höheren Wirkungsgrad des Motors und erfüllen höchste Anforderungen an die Leistung bei zugleich optimiertem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

Ein weiterer Trend im Auto ist der Ersatz mechanischer und hydraulischer Baugruppen durch elektrische Systeme. Hierbei müssen hohe Ströme bei minimaler Wärmeentwicklung geregelt werden. Speziell für Automobilanwendungen hat Infineon die Produktfamilie → **OptiMOS-T** entwickelt.

Höhere Ansprüche an die Sicherheit beim Autofahren und neue Regelungen in der Verkehrssicherheit haben die Entwicklung von Sensoren wie Druck-, Gierraten-, Magnetfeld-, Aufprall- und Überrollsensoren vorangetrieben. Dieses Segment von Automobilhalbleitern verspricht weiterhin höchste Wachstumsraten.

### Industrie: Wirkungsgrad erhöhen und Bauteile verkleinern

Im letzten Geschäftsjahr hat Infineon sein Engagement im Industriegeschäft neu ausgerichtet und dafür seine Mikrocontroller-Familien sowie das Power-Produktportfolio, beispielsweise rund um die Antriebssteuerung von Elektromotoren, ausgebaut. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Entwicklung von Leistungstransistoren mit höherem Wirkungsgrad und der Verkleinerung von Baugruppen und Modulen für Netzteile. Schaltnetzteile, wie sie etwa in PCs, Notebooks und anderen Geräten der Unterhaltungselektronik vorkommen, stehen daher bei uns im Vordergrund; aber auch elektrische Antriebe für Klimaanlage, Waschmaschinen, Industrieautomation, Züge und Windkraftanlagen sind Endanwendungen dieser Bauteile.

Die programmierte Steuerung macht auch vor der Energiewandlung und der Laststeuerung nicht Halt. Werden Verbraucher wie Motoren und Pumpen flexibel je nach Last angesteuert und nicht mehr nur durch einfaches Ein oder Aus, lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken. Der Fachmann nennt das variable speed drive. Die digitale Ansteuerung von Leistungshalbleitern, auch digitales Power-Management genannt, ist bei Industrie- und Automobilanwendungen im Kommen.

### Chipkarte: höchste Sicherheitsanforderungen im Vordergrund

Die Wachstumstreiber bei den Sicherheitschips sind Personenidentifikation (Pässe, Personalausweise, Gesundheitskarten) und Zahlungsmittel (Geldkarten und Kreditkarten). Kontaktbasierte wie kontaktlose Chipkarten müssen höchste Ansprüche in Bezug auf Sicherheit und Leistung erfüllen.

Aber auch SIM-Karten haben vor allem durch das starke Wachstum des Mobiltelefonmarkts in den Schwellenländern weiter an Bedeutung gewonnen. Die niedrigen Sicherheitsstandards für die Karten in diesen Ländern führten allerdings zu geringen Eintrittsbarrieren und damit einem hohen Wettbewerbsdruck für Chiphersteller. Karten mit Speicherkonfigurationen von 8 bis 64 Kilobyte sind 2005 endgültig zum Standardgeschäft mit den hierbei üblichen geringen Margen geworden. Um die Profitabilität des Geschäfts zu steigern, führen wir neue kostenreduzierte Versionen ein und verstärken unser Portfolio im Bereich kontaktlose Sicherheitsanwendungen. So haben wir zum Beispiel im vergangenen Geschäftsjahr neben einer neuen Fertigungstechnologie die Speichertechnologie --> **MicroSlim** sowie die Modulbestückungstechnologie Flip Chip On Substrate (--> **FCOS**) auf den Markt gebracht.

... Brief an die Aktionäre, S. 4

Der frühe Eintritt in die PC- und Netzwerksicherheit mittels Trusted Platform Modules (TPM) zahlt sich aus. Die Chips der aktuellen Version (--> **TPM 1.2**) werden in den nächsten Monaten von den PC-Herstellern in ihre ersten Produkte eingebaut. Infineon liefert als einziger Hersteller Chips und Software aus einer Hand.

### ASIC & Design Solutions: kundenspezifische Chips mit hoher Systemexpertise

Mit der Geschäftseinheit ASIC & Design Solutions übertragen wir vorhandenes Know-how, Patente und Systemexpertise in neue Produkte, die in enger Kooperation mit unseren Kunden entwickelt werden. So können wir Entwicklungsphasen kurz halten und unseren Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Jüngstes Beispiel ist die Kooperation mit Microsoft, zu dessen Spielekonsole Xbox 360 wir drei Komponenten (--> **steckbares Speichermodul, Sicherheitschip, Gamepad-Controller**) beisteuern.

### Standorte in Asien und Europa ausgebaut

Der Bau unserer neuen Fabrik für die Produktion von Leistungshalbleitern im Automobil- und Industriebereich im Kulim-High-Tech-Park, Malaysia, verläuft planmäßig. Im März 2006 werden voraussichtlich die ersten Reinraummaschinen eingestellt, der Produktionsstart ist für das letzte Kalenderquartal 2006 geplant. Mit dieser Investition sorgen wir für die nötige Ausweitung unserer Fertigungskapazität zur Unterstützung unseres Wachstums

sowie für eine erhebliche Senkung der Fertigungskosten durch einen niedrigeren Lohnkostenanteil dieses Werkes.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir auch unsere Entwicklungsaktivitäten ausgebaut. So haben wir im April 2005 in Bukarest, Rumänien, ein neues Entwicklungszentrum eröffnet und in Villach, Österreich, sowie in Padua, Italien, die bestehenden Forschungszentren erweitert.

... Infineon-Standorte weltweit, S. 28

### Innovationsbox

#### TriCore TC1796

Die Motorsteuerung zählt zu den rechenintensivsten und zeitkritischsten Aufgaben im Auto. Für diese anspruchsvollen Berechnungen im Echtzeitbetrieb haben wir die 32-Bit-Mikrocontroller-Familie TriCore konzipiert. Der TC1796 ist mit 40 Millionen Transistoren unser bisher komplexester Baustein im Automobilbereich.

#### OptiMOS-T

Gleichspannungswandler beispielsweise in Notebooks oder Servern, aber auch im Auto sind typische Anwendungen für unsere OptiMOS-Produktfamilie. Speziell für den Automobilbereich wurde die neue Trench-55V-Technologie (OptiMOS-T) entwickelt.

#### MicroSlim

Die Speicher, basierend auf der MicroSlim-Technologie, können künftig mit nur noch einem Transistor pro Bit-Zelle statt wie bisher zwei gebaut werden. Das spart Platz auf dem Chip und Kosten in der Herstellung.

#### FCOS

Flip Chip On Substrate (FCOS) ist ein neues Verfahren, das Siliziumplättchen mit den goldenen Kontaktflächen einer Chipkarte verbindet. Man setzt den Chip dabei mit der Oberfläche nach unten (flip chip) auf den Träger (substrate).

#### TPM 1.2

Die zweite Generation von TPM-Chips wurde an unsere Kunden, PC- und Notebook-Hersteller, ausgeliefert. Wir sehen langfristig auch Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und Mobiltelefone als Anwendungsfelder.

#### Steckbares Speichermodul, Sicherheitschip, Gamepad-Controller

Solche ASICs wandern in die Grundausstattung oder in die Accessoires. Mit dem steckbaren Speichermodul können Spielstände gespeichert werden. Der Sicherheitschip sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel der Accessoires. Und der Gamepad-Controller ist durch unsere Funkchips kabellos.

## Wussten Sie, dass ...

- Afrika mit inzwischen mehr als 52 Millionen Mobilfunknutzern in den letzten fünf Jahren der am schnellsten wachsende Mobilfunkmarkt der Welt war? Festnetzanschlüsse gibt es dagegen nur etwa 25 Millionen.
- in Japan bald jedes Handy über ein Navigationssystem verfügt?
- Sie Daten mit dem neuen Übertragungsstandard VDSL2 hundertmal schneller empfangen können als mit einem DSL-Anschluss der ersten Generation?
- Korea das erste Land weltweit ist, in dem Mobilfunknutzer bereits heute digitales Fernsehen auf ihrem Mobiltelefon empfangen und in der U-Bahn, auf der Straße oder im Café neueste Nachrichten, Musikfernsehen und Sportveranstaltungen verfolgen können?
- bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 erstmals ausschließlich per Voice-over-IP zwischen den zwölf WM-Stadien telefoniert wird und diese für Sprach- und Datenkommunikation miteinander verbunden sein werden?

## Mobilfunkboom in Schwellenländern

Selten zuvor gab es in der Kommunikationstechnologie so viele gravierende Veränderungen wie zurzeit: sichtbar oder unsichtbar für den Anwender, im Festnetz oder im Mobilfunk, in etablierten oder aufstrebenden Industrienationen.

Beispiel Mobiltelefon. Die einfachsten Modelle haben inzwischen ein Preisniveau erreicht, das sie für Käufer in Schwellenländern erschwinglich macht. Und die Branche arbeitet mit Hochdruck an der weiteren Reduzierung der Herstellungskosten. Preiswerte Telefone finden überwiegend Abnehmer in Afrika, China, Indien, Russland und Südamerika und gehören damit heute und in Zukunft zum am schnellsten wachsenden Segment des Mobiltelefonmarkts. Aber auch das obere Ende der Skala kommt in Bewegung: UMTS gewinnt an Fahrt und zeigte 2005 erstmals nennenswerte Verbreitung.

Beispiel Breitbandzugang. Sah man vor Jahren das Aufkommen der ersten DSL-Anschlüsse noch als höheren Komfort beim Internet-Surfen, so wird die Datenverbindung über die alte, weit verbreitete Telefonkupferleitung heute allmählich zum Allzweckmedium. Wir telefonieren über Datenleitungen und empfangen über sie inzwischen auch Fernsehbilder. Konvergenz der Medien Telefon, Computer und TV (Triple-Play) ist hier der Trend.

Beispiel digitales Fernsehen. In allen Regionen der Welt findet der Übergang vom analogen zum digitalen Fernsehen statt. Treibende Kraft dahinter ist die effizientere Ausnutzung der Übertragungskanäle. Das gilt für den terrestrischen Empfang genauso wie für Kabel oder Satellit. Und selbst auf Mobiltelefonen kann man heute bereits fernsehen. Digitale Fernsehempfänger sind ein dynamischer Wachstumsmarkt.

Wo immer Kommunikation stattfindet – sehr oft läuft die Verbindung über Chips von Infineon.

## Kommunikation

### Drahtgebundene und mobile Kommunikation wachsen zusammen

Wir ermöglichen preiswerte Telefone für Schwellenländer und Multimedia-Telefone für höchste Ansprüche. Unsere VDSL2-Lösung sorgt für Rekordraten bei der Datenübertragung. Wir vernetzen drahtgebundene und mobile Kommunikationsgeräte im digitalen Heim.

#### Bewegung in der Kommunikationstechnologie

Eine erfreuliche Entwicklung des vergangenen Jahres war die starke Nachfrage nach Mobiltelefonen in Schwellenländern. Sie erklärt größtenteils das starke Wachstum von 520 Millionen Geräten im Jahr 2003 auf 674 Millionen 2004, das übrige Wachstum ergab sich aus dem Ersetzen vorhandener Modelle. Durch das weitere Absenken des Preises für Einstiegsmodelle wird sich dieser Trend wohl 2006 fortsetzen. Preiswerte Mobiltelefone bieten Sprach- und Textübertragungsfunktionen und verzichten auf Extras wie Spiele oder Kameras. Die Herstellungskosten sollen schon 2006 unter 20 US-Dollar liegen.

Das Mobiltelefongeschäft ist ferner von einer schnelleren Einführung neuer Produktgenerationen und einem zunehmenden Integrationsgrad der elektronischen Komponenten gekennzeichnet. Zusatzfunktionen wie Kamera oder MP3-Spieler treiben die Komplexität der Chips nach oben. Auf Grund der schnellen Kostensenkungen erwarten wir 2006 jedoch wertmäßig eine flache oder gar fallende Entwicklung des weltweiten Halbleiterumsatzes für den Mobilfunkmarkt.

Bei der drahtgebundenen Kommunikation sehen wir die Konvergenz von Sprach-, Daten- und TV-Netzwerken als eine übergeordnete Entwicklung mit vielfältigen Auswirkungen: Bei der digitalen Sprachübertragung (Voice-over-IP) werden gesprochene Worte nicht mehr analog über die Telefonleitung, sondern in digitalisierten Häppchen über ein Rechnernetzwerk übertragen. In neuen Firmengebäuden wie unserer Unternehmenszentrale Campeon, Hotels oder Universitäten werden daher praktisch keine Telefonleitungen mehr verlegt. Mehr noch: Es ist zu erwarten, dass die Telekommunikationsunternehmen in Zukunft von Sprachnetzen auf Internet-Protokoll-basierte Datennetze umrüsten und damit erhebliche Einsparpotenziale realisieren.

... Menschen bei Infineon, S. 33

Ausgehend von ISDN gilt nach ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL nun VDSL2 als vorerst leistungsfähigster Übertragungsstandard für die Strecke vom Netzbetreiber über die Kupferleitung zum Endkunden (letzte Meile). VDSL2 erlaubt mit einer Bandbreite von bis zu 100 Megabit pro Sekunde „Triple Play“, also die Übertragung von mehreren Fernsehkanälen in HDTV-Qualität, Sprachübertragung und

einen schnellen Internet-Zugang. Auch im privaten Wohnbereich schreitet die drahtgebundene und drahtlose Vernetzung von Unterhaltungselektronikgeräten weiter voran. Home-Gateway-Lösungen bilden die Funktion von integrierten Zugangspunkten von Sprach-, Video- und Datendiensten im Haus und übernehmen die Funktion von Routern zur Einrichtung und Steuerung von Heimnetzwerken.

#### Für jeden Trend das richtige Produkt

Als Spezialist für Kommunikationstechnologien unterstützen wir mit GSM, GPRS, EDGE und UMTS die wesentlichen Mobilfunkstandards der Welt. Telefonhersteller konzentrieren sich zunehmend auf Funktionalitäten, die Produktpalette sowie das Design und beziehen komplette Systemplattformen von den Chiplieferanten. Entsprechend konsequent haben wir unsere Software- und Systementwicklung vorangetrieben und decken heute mit verschiedenen Plattformen sämtliche Marktsegmente ab (→ **Referenz-Plattformen ULC** und **MP-E**). Für kostengünstigere Telefone haben wir die Ultra-Low-Cost(ULC)-Plattform mit der 1-Chip-Lösung → **E-GOLDradio** entwickelt, in der Basisband und Hochfrequenz-Transceiver auf einem Chip in der CMOS-Technologie integriert sind. Für das mittlere Marktsegment integrieren wir die populärsten Multimedia-Anwendungen in unsere Basisband-Chips. Unser S-GOLD2 ist der erste Vertreter dieser neuen Generation. Für diese Chips entwickeln wir auch die entsprechende Software wie beispielsweise EDGE- und UMTS-Protokolle sowie mit dem Produkt APOXI eine Plattform für Applikationssoftware. Für das Smartphone-Segment stellen wir durch entsprechende Software die Kompatibilität unserer Basisband-Chips mit den marktgängigen Applikationsprozessoren sicher, die Infineon nicht selbst entwickelt.

... Brief an die Aktionäre, S. 4

Im Bereich der drahtlosen Kommunikation hat Infineon bei Hochfrequenz-Transceivern den Übergang von der BiCMOS- zur CMOS-Fertigungstechnologie maßgeblich vorangetrieben. Mit dem SMARTi SD brachte Infineon den weltweit ersten Single-Chip-CMOS-Transceiver für GSM und GPRS in großen Stückzahlen auf den Markt, gefolgt vom → **SMARTi PM** für EDGE und dem → **SMARTi 3G** für UMTS.

Als Markt- und Technologieführer bei Hochfrequenz-Transceivern konzentrieren wir uns auf Connectivity Solutions, also die Kombination unterschiedlicher Funkstandards wie WLAN, GPS, Bluetooth oder DECT in einem Gerät oder gar auf einem Chip. In der Herstellung von Chips für den digitalen Fernsehempfang ist Infineon ebenfalls führend und am Start des digitalen Zeitalters für das Antennenfernsehen DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) ganz entscheidend beteiligt (→ **DVB-T-Empfänger**). Und auch auf dem Handy kann man bereits fernsehen – in Korea als weltweit erstem Land. Dort sind die ersten Geräte mit unseren Empfängern erhältlich.

### Höchstgeschwindigkeit auf der letzten Meile

Darüber hinaus punkten wir mit unseren Chips bei der digitalen Sprachübertragung in Rechnernetzen (Voice-over-IP). Die exzellente Qualität unserer Produkte bei den DSL-Zugangstechnologien (→ **GEMINAX Pro**, **VINAX**) sichert uns einen Wettbewerbsvorteil beim Stromverbrauch und bei der Leistungsfähigkeit der DSL-Leitungen. Infineon ist eines der wenigen Unternehmen, die beide Seiten der Kommunikationsleitung umfassend bedienen – vom Vermittlungssystem bis hin zum einzelnen Nutzer. So stellen wir durchgehende xDSL-Zugangstechnologien für Anwendungen wie Broadband-in-the-Home und digitales Home-Networking her und bieten mit den Halbleitern für Teilnehmeranschlüsseinrichtungen (Customer Premises Equipment) komplette Breitband-Kommunikationslösungen an. Zusätzlich können unsere Kunden aus einer umfassenden Palette an traditionellen Produkten für analoge Telefonanschlüsse, ISDN-Anschlüsse und T/E Carrier auswählen.

### Forschung & Entwicklung sowie Kooperationen

Ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Ausbau unserer Prozesstechnologien. Um hierbei einen Wettbewerbsvorteil zu möglichst niedrigen Kosten zu sichern, sind wir beispielsweise mit IBM, Chartered Semiconductor Manufacturing und Samsung und auch mit Konsortien Allianzen eingegangen. So läuft in der 130-Nanometer-Technologie die Volumenproduktion, in der 90-Nanometer-Technologie fahren wir gegenwärtig einige Produkte hoch, und in der 65-Nanometer-Technologie wurde die Qualifikationsphase gestartet. Der 45-Nanometer-Prozess ist bereits in Entwicklung.

## Innovationsbox

### Referenz-Plattform ULC

Telefone, basierend auf dieser Referenz-Plattform für GSM/GPRS-Mobiltelefone der untersten Preisklasse, haben weniger als 100 Bestandteile. Die hierfür erforderliche Elektronik passt auf 9 cm<sup>2</sup>. Telefone der gehobenen Preisklasse haben demgegenüber über 200 Komponenten und benötigen rund 30 cm<sup>2</sup> Platinenfläche. Der als Basisband-Chip eingesetzte E-GOLDradio unterstützt neben der Sprachtelefonie noch SMS und ein Farbdisplay. Telefone zu Herstellungskosten von unter 20 US-Dollar werden damit künftig möglich.

### Referenz-Plattform MP-E

Unsere Referenz-Plattform für GSM/GPRS/EDGE-Multimedia-Mobiltelefone im mittleren Preissegment basiert auf dem S-GOLD2. MP-E unterstützt alle üblichen Frequenzbänder sowie Kamera, mehrstimmige Klingeltöne und Farbdisplay. Solche Plattformen werden von Mobiltelefonherstellern, die eine komplette Lösung aus einer Hand wünschen, nachgefragt.

### E-GOLDradio

Vereint einen 4-Band-Hochfrequenz-Transceiver und einen Basisbandprozessor auf einem Chip. Damit ist er weltweit die erste und höchstintegrierte monolithische 1-Chip-Lösung der beiden wichtigsten Komponenten eines Mobiltelefons. Zugeschnitten auf GSM/GPRS-Mobiltelefone der unteren und mittleren Preisklasse.

### SMARTi PM

Weltweit erster CMOS-basierter Hochfrequenz(HF)-Transceiver für den EDGE-Standard.

### SMARTi 3G

Weltweit erster Hochfrequenz-Transceiver, der alle sechs Frequenzen der 3G-Standards unterstützt. Damit kann er in allen UMTS-Telefonen der Welt eingesetzt werden. Weiterer Pluspunkt: Er wird auch in der Strom sparenden und kostengünstigeren CMOS-Technologie gefertigt.

### DVB-T-Empfänger

Damit ermöglichen wir den Empfang von terrestrisch ausgestrahlten, digitalen Fernsehsignalen. Wird von Herstellern von Fernsehempfängern und Set-Top-Boxen eingesetzt.

### GEMINAX Pro

In den Vermittlungsstellen der Netzbetreiber spielen Stromverbrauch, Packungsdichte und Systemkosten der Teilnehmeranschlusskarten eine entscheidende Rolle. Der GEMINAX Pro hat für den ADSL2+-Standard Zeichen gesetzt.

### VINAX

Der Chip unterstützt die volle VDSL2-Spezifikation und erlaubt darüber hinaus die industrieweit größte Reichweite bei Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde. Er kommt sowohl in den Vermittlungsstellen als auch beim Endkunden zum Einsatz und ist einer der komplexesten Chips, die wir je entwickelt haben.

## Wussten Sie, dass ...

- Hochleistungsserver bis zu 512 Gigabyte-Hauptspeicher enthalten? Das entspricht dem Speichervolumen von rund 1.000 handelsüblichen PCs.
- in der nächsten Generation von Spielekonsolen eine Speicherkapazität von 512 Megabyte stecken wird? Das entspricht der Ausstattung heutiger PCs.
- in den USA für Spielesoftware mehr Geld ausgegeben wird als für Kinokarten und es inzwischen weltweit 18.000 verschiedene Computerspiele gibt?
- Smartphones derzeit mit 64 Megabyte so viel Speicherkapazität enthalten wie PCs vor rund sechs Jahren?
- auf einer 512-Megabyte-Flash-Karte etwa 125 Lieder im MP3-Format abgespeichert werden können?

## Neue Produkte, neue Märkte, neue Kunden

Der Vormarsch der Digitalisierung – also der Verteilung und Verarbeitung von Informationen in Paketen von Bits und Bytes – ist nirgendwo augenfälliger als in der Unterhaltungselektronik. Endlich können Daten ohne Qualitätsverlust kopiert, komprimiert und zudem einfacher verschickt und bearbeitet werden.

Die Digitalisierung von Bildern und Tönen hat zu einer wahren technischen Revolution bei Endgeräten geführt: Bis zu 15.000 Lieder werden heute in MP3-Playern digital auf Festplatten gespeichert. Fotografen nutzen verstärkt Digitalkameras, die Fotos auf handliche Speicherkarten schreiben. So können die Bilder bequem zu Hause am Computer nachbearbeitet und ausgedruckt werden. Auch Spielekonsolen werden immer beliebter. Wegen der zunehmenden Ausstattung der aktuellen Generationen mit hochleistungsfähigen Grafikspeichern sind diese Geräte für den DRAM-Markt von immer größerer Bedeutung.

Der Boom bei Digital- und Videokameras, Mobiltelefonen und PDAs treibt auch die Nachfrage nach Energie sparenden DRAMs und nichtflüchtigen Flash-Speichern. Letztere gehören gerade wegen der Portabilität der Endgeräte zum am schnellsten wachsenden Speichersegment überhaupt.

Für Mobiltelefone der mittleren und oberen Preisklasse gilt: Im Jahr 2010 erwarten Marktforscher 512 Megabyte bis 1 Gigabyte Speicherausstattung für diese Modelle und damit einen Nachlauf der Speicherausstattung gegenüber dem PC von fünf bis sieben Jahren.

Infineon bietet für all diese Produkte den passenden Speicher.



## Speicherprodukte

### Schnell und innovativ im Geschäft mit Speichern

Mit einem stetig wachsenden Produktportfolio bedienen wir die neuesten Trends auf dem Elektronikmarkt. Unsere DRAMs bieten industrieweit mit den geringsten Stromverbrauch und die höchste Geschwindigkeit. Mit der planmäßigen Einführung der 90-Nanometer-Prozesstechnik sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit.

#### Das Geschäft mit Speichern – zyklisch und schnell

Workstations, Desktop- und Notebook-PCs machen mit rund 50 bis 60 Prozent den größten Anteil bei DRAM-Speicherchips aus. Server und Netzwerkinfrastruktur folgen mit etwa 20 bis 30 Prozent. Unterhaltungselektronik sowie Telekommunikation gehören mit je unter zehn Prozent zu den kleineren Marktsegmenten. Dabei verbucht gerade die Telekommunikation die höchsten Wachstumsraten, angetrieben von dem hohen Anspruch an Volumen und Speicherausstattung bei Mobiltelefonen.

Marktforscher erwarten für die nächsten Jahre einen Anstieg der DRAM-Nachfrage in Bit um etwa 50 Prozent pro Jahr. Dieses Marktwachstum bewältigen Halbleiterhersteller zum großen Teil, indem sie immer fortschrittlichere Fertigungstechnologien einführen. Den Rest leisten Investitionen in neue Produktionsanlagen. Das Geschäft mit Speicherprodukten zeichnet sich somit durch einen hohen Kapitaleinsatz aus; Angebots- und Nachfragewachstum sind starken Schwankungen ausgesetzt. Dies führt zu deutlichen Schwankungen im Preisverlauf und einer zyklischen Entwicklung von Umsatz- und Ertragslage. Entsprechend der aktuellen Preisentwicklung konfigurieren die PC-Hersteller ihre Modelle. Bei niedrigen DRAM-Preisen werden PCs mit hoher Speicherausstattung gebaut und umgekehrt.

Im Mittelpunkt des Interesses der DRAM-Hersteller steht derzeit die neueste Generation von Spielekonsolen. Für die Darstellung der hochqualitativen Grafiken benötigen diese Geräte die industrieweit schnellsten Speicher, die nur von wenigen Herstellern entwickelt und gefertigt werden – Infineon ist einer von ihnen. Im Unterschied zu PCs handelt es sich bei Spielekonsolen um ein bezüglich Nachfrage und Preisentwicklung stabileres Geschäft, das enge Beziehungen zum Speicherlieferanten erfordert.

Die immer größere Vielfalt an mobilen Anwendungen wie Digitalkameras, Smartphones und PDAs erfordert zunehmend Speicherbausteine mit geringem Stromverbrauch. Aber auch für Hochleistungsserver und Grafiksysteme in Notebooks werden Strom sparende Speicher benötigt, um

die Wärmezeugung unter Volllast so gering wie möglich zu halten. Unsere DRAM-Produkte zeichnen sich dabei durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch aus.

Eine der interessantesten Entwicklungen im gesamten Halbleitermarkt war das rasante Wachstum bei NAND-Flash-Speichern. Sie finden sich in austauschbaren Speichermedien wie MultiMediaCard, SD Card, Memory Stick oder USB-Stick, die in Digitalkameras und MP3-Playern für hohe Speicherkapazität sorgen. Auch Infineon bietet Flash-Karten verschiedener Formate an, derzeit noch mit vergleichsweise kleinen Speicherdichten. In den nächsten Jahren werden wir hier unsere Entwicklung gezielt beschleunigen, um den Vorsprung der Marktführer in diesem schnell wachsenden Segment aufzuholen.

#### Auf Marktbedingungen flexibel reagieren

Im Markt für Speicherprodukte sind Innovationen und Flexibilität die im Wettbewerb entscheidenden Voraussetzungen für profitables Wachstum. Infineon ist in der Lage, durch seine modernsten Fertigungstechnologien die Kosten der Speicherproduktion Jahr für Jahr deutlich zu senken. So wurde im Juni 2005 mit der Umstellung auf den **90-Nanometer-Fertigungsprozess** für DRAMs begonnen. Zudem haben wir neue Kapazitäten in der 300-Millimeter-Technologie geschaffen, bei der Infineon die Vorreiterrolle einnimmt und mit der sich Speicher noch wirtschaftlicher produzieren lassen. Dadurch wollen wir sicherstellen, dass wir auch in Zukunft die Produktivität bei der Herstellung von Speicherbausteinen jährlich um etwa 30 Prozent steigern können. Im Februar 2005 haben wir bereits einen DRAM-Prototyp vorgestellt, der auf dem künftigen **70-Nanometer-Fertigungsprozess** basiert.

Seit Mitte der neunziger Jahre haben wir unsere Wettbewerbsposition im DRAM-Markt deutlich verbessert. Mit einem Marktanteil von nunmehr 14 Prozent gehören wir zu den vier Schwergewichten weltweit. Um unser Ziel eines weiteren, profitablen Wachstums zu erreichen, treiben wir die Kostensenkung durch Produktivitätssteigerung voran und richten unser Produktportfolio auf Markt-

segmente aus, die ein höheres Preisniveau und geringere Preisschwankungen aufweisen. Wir sind überzeugt, das Speichersegment auf diesem Weg zu einer verbesserten Rentabilität zu führen.

Wir haben uns in den letzten Jahren einen Namen als innovativer Lieferant von Speichermodulen (→ **FB-DIMM**) für Server erarbeitet. An dieses Computersegment liefern wir heute bis zu 30 Prozent unserer Speicherchips und erzielen im Vergleich zu üblichen PC-Modulen höhere und stabilere Margen. Bei den Grafikspeichern oder → **Graphics RAMs**, die auf höchste Schreib- und Lesegeschwindigkeit ausgerichtet sind, liegt Infineon technologisch im Spitzenfeld. Die frühzeitige Entwicklung der nächsten Speichergenerationen (→ **DDR3**) und die führende Position bei der Einführung neuer Speichermodultypen (→ **Micro-DIMM**) stellen weitere Schritte auf dem Weg zu profitablen Wachstum dar.

Um den Anforderungen einer Vielzahl von Herstellern von PCs und Notebooks, insbesondere in den stark wachsenden PC-Märkten der Schwellenländer, Rechnung zu tragen, haben wir unsere Zweitmarke „Aeneon“ eingeführt. In der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern verstärken wir unser Engagement in einem stark fragmentierten Kundensegment.

### Ausbau von Entwicklung und Fertigung

In unserer 300-Millimeter-Fabrik in Richmond/Virginia, USA, haben wir im September 2005 mit der Serienfertigung von Speicherchips begonnen. Darüber hinaus setzen wir auch in Zukunft auf Kooperationen, um unsere Kapazitäten auszubauen und neue Produkte und Prozesse zu entwickeln. Risiken und Kosten lassen sich auf diese Weise teilen und Projekte auf eine breite Ressourcen- und Finanzbasis stellen. Auch unsere Fertigungskooperationen mit Winbond in Taiwan und SMIC in China verlaufen planmäßig. Die neue 300-Millimeter-Fabrik von SMIC in Peking wurde mit unserer 110-Nanometer-Technologie hochgefahren. Zusätzlich fertigt SMIC für uns in einer 200-Millimeter-Fabrik bei Shanghai. Mit Nanya betreiben wir das Fertigungs-Joint-Venture Inotera Memories, aus dem Infineon die Hälfte der Produktion erhält. Ende 2005 erfolgte der Transfer unserer 90-Nanometer-Technologie zu Inotera. Zusätzlich haben wir unsere langjährige Entwicklungskooperation mit Nanya erweitert. Neben der gemeinsamen Entwicklung der 90-Nanometer-Technologie

und den laufenden Aktivitäten zur 70-Nanometer-Technologie werden wir nun auch die 60-Nanometer-Technologie gemeinsam auf den Weg bringen.

... Infineon-Standorte weltweit, S. 28; ... Konzernlagebericht, S. 50

## Innovationsbox

### 90-Nanometer-Fertigungsprozess

Dieser Fertigungsprozess erlaubt kleinere Strukturgrößen. Damit reduziert sich die Chipfläche um rund 30 Prozent gegenüber der heutigen 110-Nanometer-Technologie. Infineon ist der zweite DRAM-Hersteller, der diese Fertigungstechnologie einführt. Kleinere Chips bedeuten mehr Chips pro Wafer und damit geringere Herstellungskosten. Mit der 90-Nanometer-Technologie steigt die Anzahl der 512-Megabit-Chips pro 300-Millimeter-Wafer auf über 1.000 Stück.

### 70-Nanometer-Fertigungsprozess

Erste Prototypen wurden bereits Anfang des Geschäftsjahrs vorgestellt. Der Start der Volumenproduktion ist für das Kalenderjahr 2006 vorgesehen.

### FB-DIMM

Ab Ende 2005 sollen die neuesten Server mit diesem Speichermodulformat (Fully Buffered-Dual Inline Memory Module) ausgestattet werden. Der hierzu erforderliche AMB (Advanced Memory Buffer) ist ein komplexer Logikchip, der die Signale bündelt und mit hoher Geschwindigkeit über die Datenleitungen in Richtung Prozessor sendet. Infineon ist der einzige Hersteller, der neben den Speicherchips auch den AMB fertigen kann. Erste Muster wurden im Frühjahr 2005 vorgestellt.

### Graphics RAM

Entwickelt für das oberste Leistungssegment mit Taktraten von bis zu 800 Megahertz. Diese Königsklasse der DRAM-Speicher findet als Arbeitsspeicher auf Grafikkarten und in Spielekonsolen ihre Anwendung. Hersteller von 3D-Grafikkarten und Spielekonsolen haben höchste Ansprüche: Bei den heutigen Computerspielen mit fotorealistischen Szenen und ruckelfreier Bildwiederholrate müssen mehrere Millionen Polygone pro Sekunde berechnet werden. Da darf der Zugriff auf den Grafikspeicher nicht zum Engpass werden.

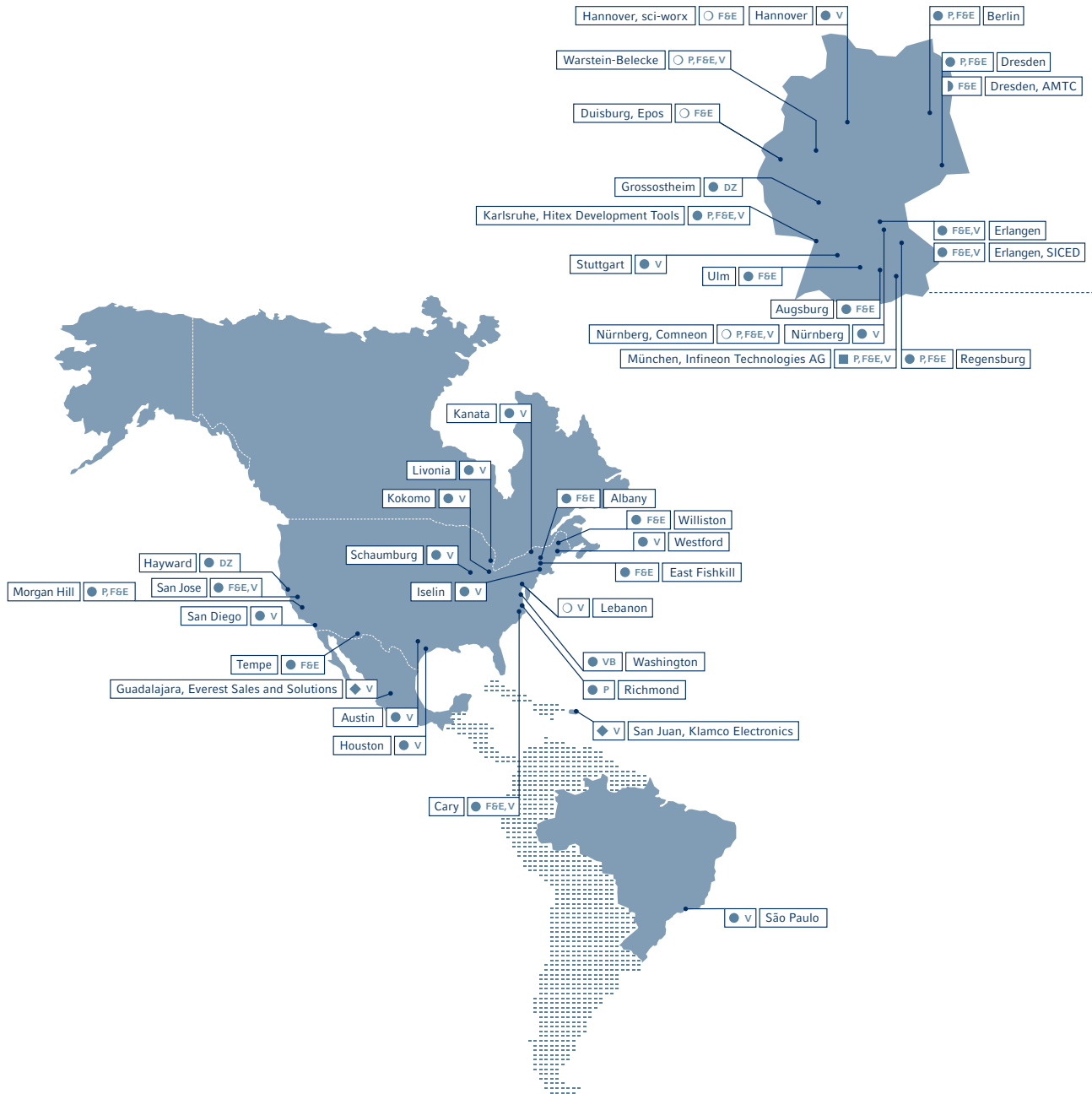
### DDR3

Die ersten Speichermodule, basierend auf der nächsten Generation der Standardspeicher, wurden 2005 vorgestellt. Die Markteinführung wird für 2007 erwartet. Bis 2012 ist DDR3 dann das Massenprodukt für PCs, Notebooks, Workstations und Server.

### Micro-DIMM

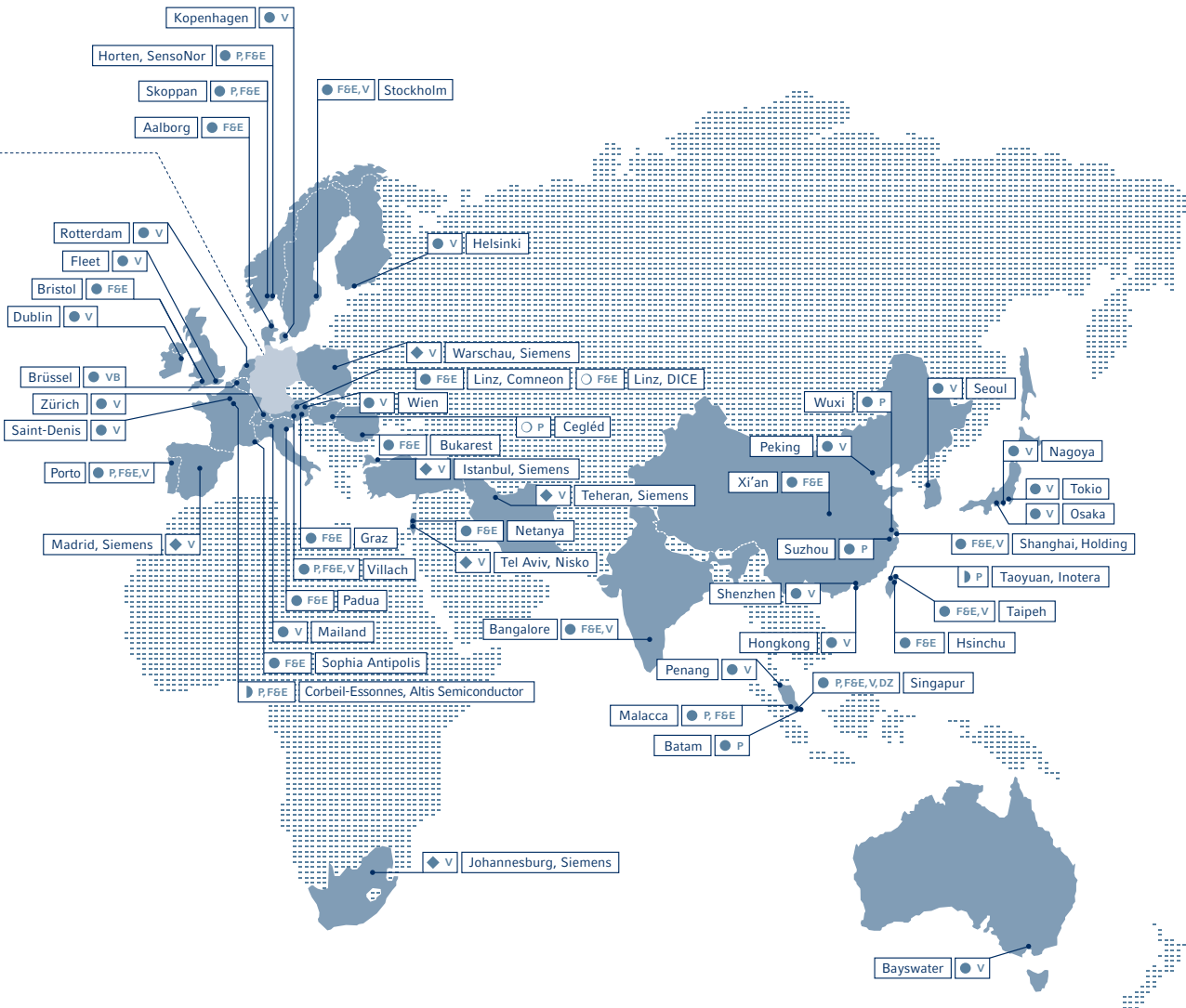
Kleines Speichermodulformat für Sub-Notebooks.

## Infineon-Standorte weltweit



Infineon: Standorte und Vertretungen (Stand: Oktober 2005)

- |                             |                      |                               |                         |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Länder mit Infineon-Präsenz | Joint Venture        | P Produktion                  | DZ Distributionszentrum |
| Infineon-Headquarter        | Mehrheitsbeteiligung | F&E Forschung und Entwicklung | VB Verbindungsbüro      |
| Infineon                    | Vertretung           | V Vertrieb                    |                         |



## Wussten Sie, dass ...

- rund **36.400** Mitarbeiter aus **107 Nationen** bei Infineon beschäftigt sind?
- rund **7.400** Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an jedem Arbeitstag knapp **ein Dutzend** neuer Erfindungen melden?
- unsere Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2005 **Ideen** im Wert von über **160 Millionen** Euro im Rahmen des Programms zum Ideenmanagement Your Idea Pays (YIP) entwickelt und umgesetzt haben?
- sich unser International Graduate Program an Hochschulabsolventen mit **herausragendem Profil** richtet und in einem kleinen, aber exklusiven Kreis Teilnehmer aus **sieben Nationen** umfasst?
- Infineon als eines der ersten Halbleiterunternehmen weltweit Mitglied im **Global Compact**, einer freiwilligen UN-Initiative, ist?

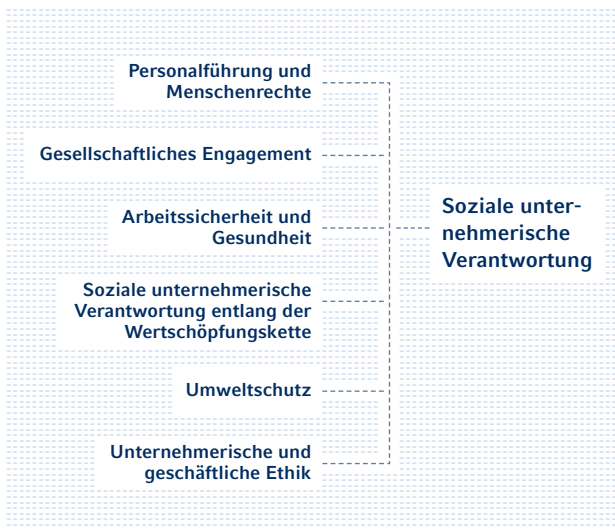
## Soziale Verantwortung

### Verantwortung ernst nehmen – gegenüber Gesellschaft, Mitarbeitern und Umwelt

Wir legen hohe ethische und gesetzliche Anforderungen bei allen Überlegungen zu Grunde. Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind fester Bestandteil all unserer Prozesse. Unsere Mitarbeiter engagieren sich an ihren Standorten und weltweit für soziale Belange.

Als weltweit tätiges Unternehmen hat Infineon eine große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Diese Aufgabe nehmen wir ernst. Wir haben eine klare Vorstellung von ethischer Geschäftsführung, die wir auch konsequent umsetzen. Soziale Verantwortung oder Corporate Social Responsibility (CSR) ist ein entscheidender Aspekt bei all unseren geschäftlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten. Dass wir die relevanten gesetzlichen Normen und Anforderungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten, ist hierfür eine wichtige Grundlage. Nur mit diesem umfassenden Verständnis können wir optimale Bedingungen schaffen, nicht nur für unser Geschäftsumfeld, sondern auch für unsere Mitarbeiter.

### Soziale unternehmerische Verantwortung



Die soziale unternehmerische Verantwortung bei Infineon erstreckt sich übergreifend über viele Bereiche und umfasst eine Vielzahl von unternehmerischen Tätigkeiten. Die Wahrnehmung unserer sozialen unternehmerischen Verantwortung ist für Infineon selbstverständlich.

### Ethischen und sozialen Anforderungen gerecht werden

Strategische Überlegungen und ihre Umsetzung im Tagesgeschäft müssen hohen ethischen und gesetzlichen Anforderungen genügen. Diese sind für unser Unternehmen in den Business Conduct Guidelines beschrieben, die verbindliche Grundsätze für ethisches, soziales und umweltbewusstes Handeln enthalten. Alle Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass unser Unternehmen weltweit seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht wird. Beim täglichen Miteinander unterstützen wir Chancengleichheit unabhängig von beispielsweise Hautfarbe, Alter, Behinderung, Geschlecht, gewerkschaftlicher oder politischer Zugehörigkeit und fördern so eine offene Kommunikations- und Unternehmenskultur. Infineon ist Ende 2004 als eines der ersten Halbleiterunternehmen weltweit dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten. Die von Generalsekretär Kofi Annan ins Leben gerufene freiwillige Initiative beruht auf zehn Grundsätzen rund um Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Menschenrechte, gerechte Arbeitsbedingungen, Antidiskriminierung und Antikorruption und ist seit 2000 operativ tätig. Mit dem Beitritt haben wir uns zur Einhaltung dieser Grundsätze verpflichtet und unterstützen die Initiative mit aller Kraft.

... Corporate Governance, S. 46

Nicht nur intern haben wir soziale und ethische Grundsätze verankert. Infineon trägt seine CSR-Werte in die gesamte Wertschöpfungskette. Dienstleistungen, die von unseren Auftragnehmern erbracht werden, und zugekaufte Produkte und Materialien sowie Equipment und Anlagen müssen unseren Anforderungen an den Umweltschutz, die Arbeitssicherheit, Gesundheit und sozialen Bedingungen entsprechen.

### Umweltschutz und Arbeitssicherheit

Bei Infineon gehören die Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Arbeitssicherheit sowie der Umweltschutz zur Unternehmensverantwortung und sind fester Bestandteil unserer Prozesse. Die Motivation und Fortbildung unserer Mitar-

beiter sind uns sehr wichtig. Es war und wird uns immer ein großes Anliegen sein, übergreifende gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Ziele auch im Tagesgeschäft bei der Produktion und Entwicklung komplexer Halbleiter und Systemlösungen zu erreichen. Aus diesem Grund ist Umweltschutz an allen Standorten und ebenso bei der Entwicklung neuer Produkte und Herstellungsprozesse eine feste Größe. Wir verstehen unter Umweltschutz nicht nur den reinen Schutz der Natur. Vielmehr gehören bei uns auch der produktbezogene Umweltschutz, Gefahrguttransporte, Notfallmanagement sowie Teilgebiete der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes dazu, wie beispielsweise die chemische Sicherheit.

Bereits vor vielen Jahren haben wir unser Umweltmanagementsystem eingeführt, das einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegt. Unsere Produktionsstandorte sind nach dem EN-ISO-14001-Standard matrixzertifiziert, und neue Standorte werden konsequent darauf vorbereitet. Zusätzlich wurde Ende 2005 unser Arbeitsschutzmanagementsystem nach dem Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) matrixzertifiziert. Schließlich haben wir 2005 IMPRES (Integrated Management Program for Environment, Safety and Health) etabliert, das sämtliche Prozesse, Strategien und entsprechende Ziele in den Bereichen Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz umfasst.

### Auch unsere Produkte schützen die Umwelt

Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage umweltfreundlicher Produktion. Auch mit unseren Produkten selbst tragen wir zum Umweltschutz bei. Sie reduzieren beispielsweise den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten oder senken den Benzinverbrauch und damit die Emission schädlicher Gase.

... Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, S. 16

Die ehrgeizige Umsetzung von Umweltschutzziele und -anforderungen bietet unseren Kunden ein Höchstmaß an Umweltverantwortung und Rechtssicherheit. Dies wird seit langem von unabhängigen Experten und unseren Kunden bestätigt. So wurde unser Unternehmen 2005 unter anderem Samsung Eco-Partner und von Sony als Green Partner rezertifiziert.

Eine ganze Reihe von Preisen für unsere Leistungen beweist, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben.

Um Anerkennung an die Mitarbeiter weiterzugeben, loben wir jährlich den ESH (Environment, Safety and Health)-Award aus. Hier werden Mitarbeiter für nachhaltige Entwicklungen und innovative Maßnahmen ausgezeichnet, die die hohen internen Umwelt- und Arbeitsschutzstandards noch verbessern.

### Weltweites Engagement der Mitarbeiter

Gute Ideen sind bekanntlich wertlos, wenn sie nicht umgesetzt werden. Um unserer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung gerecht zu werden, ist jeder Mitarbeiter in das Thema CSR eingebunden und zum Handeln aufgerufen. So engagieren wir uns an den jeweiligen Standorten für Gesundheit und Ausbildung und setzen uns für die Arbeitssicherheit und den Schutz der Umwelt ein. Hinter Infineons Aktivitäten und Initiativen stehen unsere Mitarbeiter, die sich engagieren, indem sie beispielsweise Blut spenden oder nach Naturkatastrophen wie dem Tsunami in Südostasien 2004 oder dem Hochwasser in New Orleans/Louisiana, USA, 2005 Spenden für die Flutopfer sammeln.

Auch der Nachwuchs erfährt ganz besondere Aufmerksamkeit im Rahmen unseres sozialen Engagements – gerade um ungleichen Chancen entgegenzutreten. Weltweit haben wir viele Aktivitäten gestartet, um bedürftigen Kindern zu einer Ausbildung zu verhelfen. Dazu arbeiten wir vielfach mit lokalen und internationalen Schulen und Universitäten zusammen. Außerdem beteiligen wir uns an einer Reihe von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, um das Lernen für künftige Generationen zu erleichtern. Beispiele sind Programme für Auszubildende, die aktive Teilnahme am Girls' Day, der das Interesse von Mädchen für Wissenschaft und Technik wecken soll, oder das Young Professionals Program, das herausragende Auszubildende fördert.

Wir alle wissen, dass schon kleine Dinge einen großen Unterschied ausmachen. Als ein verantwortliches Mitglied der Gesellschaft leistet Infineon in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag.

Mehr Information zu Infineons Corporate Social Responsibility erhalten Sie direkt vom Unternehmen. 2006 wird Infineon einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.

## Menschen bei Infineon Vier Leitmotive bestimmen unser Denken und Handeln

Die neue Infineon-Mission bildet mit vier Leitmotiven die Grundlage unserer Unternehmenskultur. Die Bereitschaft, fortlaufend Veränderungen zu initiieren und umzusetzen, ist für uns Schlüsselfaktor für den Erfolg am Markt. Durch das vielfältige Wissen unserer Mitarbeiter kommen wir zu innovativen Ergebnissen.

### Ein solides Fundament – Infineons vier Leitmotive

**Kundenorientierung, operative Spitzenleistung, profitables Wachstum und kooperative Führung** sind bei Infineon leitende Motive für eine erfolgreiche Zukunft – an ihnen richtet sich nicht nur unser tägliches Miteinander aus, sie sind gleichzeitig richtungweisend für unser Denken und unser Handeln. In der Praxis bedeutet dies: Wir denken zuerst an den Kunden und seine Marktbedürfnisse. Dabei setzen wir Maßstäbe im Hinblick auf Kosten, Qualität und Schnelligkeit und konzentrieren uns im Interesse unserer Aktionäre und Mitarbeiter auf profitables Wachstum. Kooperative Führung ist die Grundlage unseres Wirkens. Gemeinschaftlich setzen wir als globales Team alles daran, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Unseren Führungskräften kommt bei der Umsetzung der vier Leitmotive eine besondere Verantwortung zu. Sie sind nicht nur dazu aufgefordert, eine Vorbildfunktion einzunehmen, sondern auch, ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihr Handeln an den Eckpfeilern von Infineons Mission auszurichten. Die Grundsätze kooperativer Führung sind in unserer so genannten „Leadership Charter“ verankert, einem Leitfaden, der für jede Führungskraft bei Infineon verpflichtend ist.

### Engagement der Mitarbeiter von internationalem Umfeld geprägt

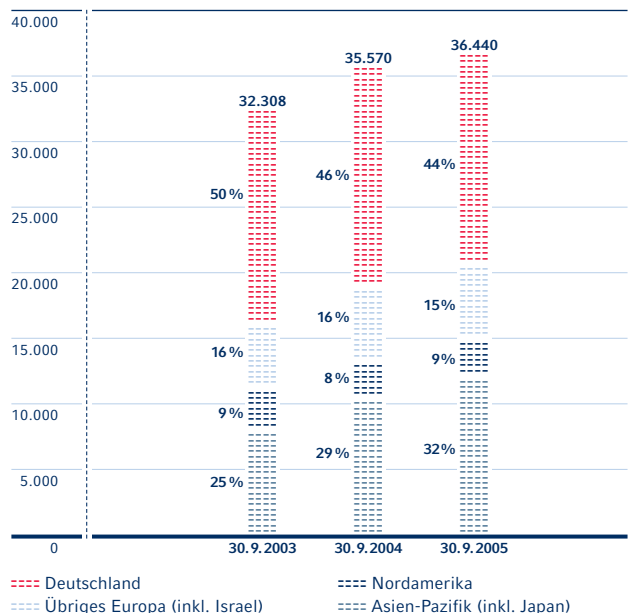
In der schnelllebigen Halbleiterindustrie ist es für uns wichtig, ständig unsere Innovationskraft zu stärken, unsere Effizienz zu erhöhen und die Qualität unserer Leistungen und unserer Produkte zu verbessern. Der Schlüssel und die treibende Kraft dafür sind Mitarbeiter, die selbstständig und engagiert an anspruchsvolle Aufgaben herangehen. Wie engagiert unsere Mitarbeiter sind, zeigt unter anderem der Erfolg unseres Ideenmanagement-Programms Your Idea Pays (YIP). Die eingebrachten Vorschläge von einzelnen Mitarbeitern oder auch Teams reichen von Kosten sparenden Prozessverbesserungen bis hin zu Ideen, mit denen wir die Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig erhöhen können. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben die Verbesserungsvorschläge von rund 11.500 Mitarbeitern zu Einsparungen in Höhe von über 160 Millionen Euro

geführt, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu anderen deutschen Großunternehmen liegen wir mit unserem Vorschlagswesen ganz weit vorn: Auch in diesem Jahr sind wir in der Bewertung des Deutschen Instituts für Betriebswirtschaft in der Kategorie „Großunternehmen/ Elektrotechnik“ als Sieger hervorgegangen.

Wir fördern die Kooperation in Teams und Netzwerken auch über Ländergrenzen hinweg, denn der internationale Austausch trägt in hohem Maße zu unserem Erfolg im weltweiten Wettbewerb bei. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, dass unsere Mitarbeiter sich als globales Team verstehen und kulturübergreifende Zusammenarbeit als selbstverständlich erachten. Mit Mitarbeitern aus 107 Nationen und Standorten in 24 Ländern ist Infineon ein internationales Unternehmen, das von der kulturellen Vielfalt seiner Mitarbeiter lebt. Wie dies in der Praxis aussieht, zeigt zum Beispiel unser Standort in Dresden, wo nicht nur Mitarbeiter aus 45 Nationen zusammenkommen, sondern auch im Rahmen der 90-Nanometer-Fertigung ein enger Austausch mit den Produktionsstandorten in Richmond/Virginia, USA, und in Taiwan erfolgt.

... Speicherprodukte, S. 24

Mitarbeiter nach Regionen





### Wir unterstützen den Unternehmenswandel

Das Geschäftsjahr 2005 war auch ein Jahr organisatorischer Veränderungen für Infineon. Erklärtes Ziel solcher Veränderungen ist immer, die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens zu steigern und sicherzustellen, dass wir unser gesamtes Potenzial ausschöpfen. Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf eine optimale Ausrichtung von Strategie, Struktur, Prozessen und Kultur. Damit sich unsere Mitarbeiter auch in Zeiten der Veränderung mit „ihrem Unternehmen“ identifizieren können und den Wandel leben, unterstützen wir sie aktiv bei dem notwendigen Veränderungsprozess.

... Brief an die Aktionäre, S. 4

In diesem Zusammenhang haben wir unter anderem unser Angebot an interkulturellen Workshops erheblich erweitert, um der immer weiter zunehmenden länderübergreifenden Projektarbeit Rechnung zu tragen und den zahlreichen internationalen Projektteams, die sich im Zuge der Neuorganisation gebildet haben, die entsprechende Unterstützung zu liefern. Darüber hinaus fördern wir verstärkt die Kommunikation zwischen Technikexperten, unserem Management und den Mitarbeitern im Vertrieb und haben hierzu verschiedene neue Foren zum Austausch der Experten etabliert. Auf diese Weise tragen wir zu einer besseren Vernetzung und Abstimmung zwischen den unterschiedlichsten Bereichen bei, eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg unserer neuen Unternehmensstruktur.

### Lernende Organisation

Ein grundlegendes Element unserer Personalstrategie ist eine kontinuierliche Personalentwicklung, die sich am Prinzip des lebenslangen Lernens orientiert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vermittlung von relevantem Expertenwissen und Erfahrungen sowie die Entwicklung von Ideen mit direktem Bezug zu unserem Geschäft. Neben technischen Trainings haben unsere Mitarbeiter grundsätzlich die Auswahl aus einer Vielzahl an allgemeinen und speziellen Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei allen Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung unserer Mitarbeiter legen wir dabei besonderen Wert auf einen interdisziplinären Ansatz. Die Projektmanagement-Seminare für technische Mitarbeiter konzentrieren sich auf die Vermittlung von Führungsqualitäten und betriebswirtschaftlichen

Grundlagen. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Trainings an, so genannte „Learning Solutions“, die auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen operativen Segmente abgestimmt sind. E-Learning spielt in unserer schnelllebigen Industrie eine zunehmend wichtige Rolle, da es flexibles Lernen und einen schnellen Wissenstransfer auf globaler Ebene ermöglicht.

Gleichzeitig profitieren neue Kollegen vom Wissen langjähriger, erfahrener Mitarbeiter, wobei der Wissenstransfer auch nicht vor nationalen Grenzen Halt macht. Für unser neues Werk in Kulim, Malaysia, werden beispielsweise rund 400 Mitarbeiter nach Europa entsandt, um an unseren Standorten in Villach, Österreich und Regensburg von erfahrenen Kollegen zu lernen. Für den Aufbau unseres neuen Standorts in Malaysia ist diese Wissensweitergabe von elementarer Bedeutung.

... Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, S. 16

### Hervorragende Mitarbeiter gewinnen und halten

Nur wenn wir in allem, was wir tun, ausgezeichnete Leistungen erbringen, können wir im weltweiten Wettbewerb langfristig bestehen. Wir möchten daher die besten Talente für uns gewinnen, um auch in Zukunft in Forschung, Entwicklung und Produktion zu den Ersten unserer Branche zu gehören. Noch wichtiger ist uns allerdings, diese Talente langfristig zu halten. Wir bieten daher unseren Mitarbeitern viel versprechende Entwicklungsmöglichkeiten, wie die technische Expertenlaufbahn oder eine Management-Karriere. Eine internationale Ausrichtung ist dabei für uns selbstverständlich. So nutzen Mitarbeiter zum Beispiel die Gelegenheit, ihr Wissen im Rahmen von Auslandsentsendungen an einem der weltweiten Infineon-Standorte einzubringen, um auf diese Weise einen Mehrwert für sich persönlich und für das Unternehmen zu schaffen.

Wir unterstützen Arbeitsmodelle, die einen reibungslosen Betrieb in Spitzenzeiten sicherstellen und uns auch helfen, schnell auf die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Darüber hinaus unterstützen wir an unseren Standorten in Deutschland Arbeitsmodelle, die unseren Mitarbeitern Gelegenheit geben, Beruf und Privatleben besser miteinander in Einklang zu bringen, wie zum Beispiel Teilzeit und Telearbeit.

Außerordentliche Leistungen zu honorieren ist für uns selbstverständlich. So zeichnen wir regelmäßig exzellente Arbeitsergebnisse von Teams und einzelnen Mitarbeitern aus, zum Beispiel mit den jährlichen Infineon Awards und den monatlichen Team-of-the-Month-Awards. Auch hier spielen unsere vier Leitmotive eine zentrale Rolle. So wurde im Rahmen der Infineon Awards 2004 unter anderem ein Projekt ausgezeichnet, das eindrucksvoll zeigt, wie Infineon ein globales Partnernetzwerk auch bei komplexen Strukturen erfolgreich umsetzt und damit eine wichtige Voraussetzung für profitables Wachstum erfüllt. Innerhalb von nur vier Monaten gelang dem Team „UMCI Production Readiness für S-GOLDlite“ der Produktionsstart von 1.200 Wafern mit einer Ausbeute von über 80 Prozent für das Mobilfunkprodukt S-GOLDlite.

... Kommunikation, S. 20

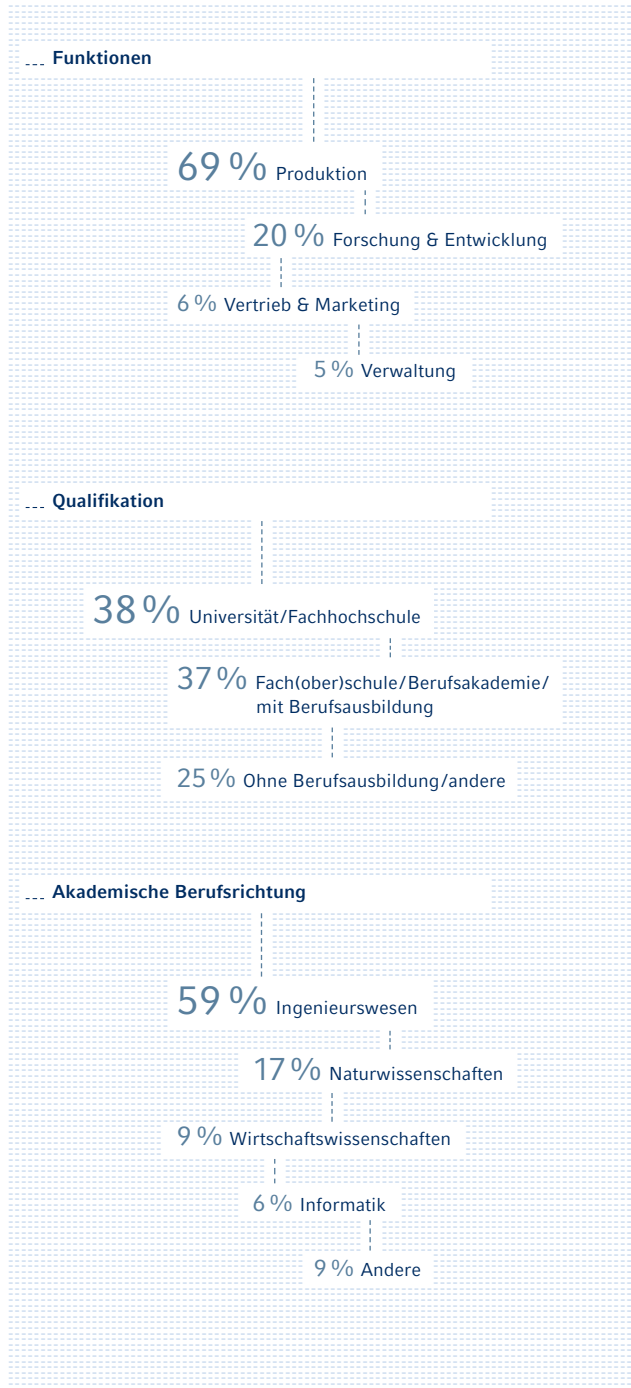
Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und für das Unternehmen erfolgskritische Ziele nachhaltig verfolgen. Daher orientiert sich auch unser Vergütungssystem an Leistung und Ergebnissen. Um das Zusammenspiel von Leistung, Erfolg und Vergütung transparenter zu machen und den messbaren Beitrag des Einzelnen zur Erreichung unserer Unternehmensziele besser zu honorieren, haben wir die variable Vergütung für die übertariflich bezahlten Mitarbeiter in Deutschland mit dem Geschäftsjahr 2006 neu gestaltet.

### Mit neuen Standorten die Zusammenarbeit erleichtern

Schnelligkeit, Begegnung und kurze Wege – auch im vergangenen Geschäftsjahr haben wir Arbeitsorte geschaffen, die den Anforderungen der dynamischen Halbleiterbranche gerecht werden. Dies trifft sowohl auf unseren neuen Unternehmenssitz Campeon bei München zu, an dem bis Anfang 2006 ein Großteil unserer Münchner Mitarbeiter zusammengeführt wird, als auch auf das neue Gebäude unseres Asien-Pazifik-Headquarter in Singapur, das Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen unter einem Dach beherbergt. Die Architektur dieser Neubauten fördert nicht nur die Kommunikation, sondern auch moderne, für unsere Industrie wichtige Arbeitsformen wie Team- und Projektstrukturen und den Wissensaustausch über funktionale Grenzen hinweg.

... Infineon-Standorte weltweit, S. 28

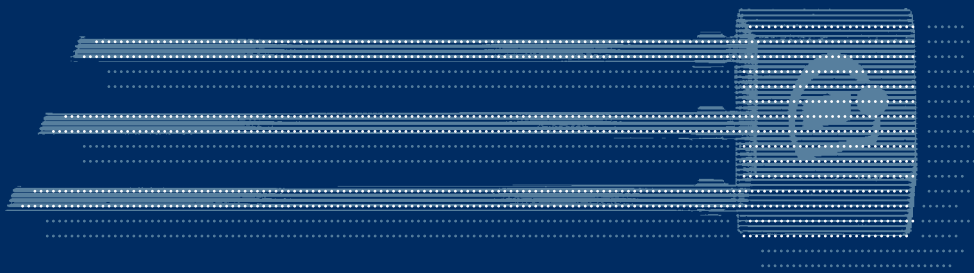
## Menschen bei Infineon



Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2005.

# HALL-SENSOR

Um Sicherheitskonzepte im Auto umsetzen zu können, muss eine Vielzahl von physikalischen Größen gemessen werden. Dies leisten Temperatursensoren oder Aufprallsensoren für den Airbag. Die eher unbekannteren Magnetfeldsensoren überwachen die Stellung von Pedalen und Scheiben oder die Position von Schalthebeln und Schaltern. Für all diese Funktionen sind hochpräzise Messungen nötig. Dies erfüllt bei uns der Hall-Sensor.

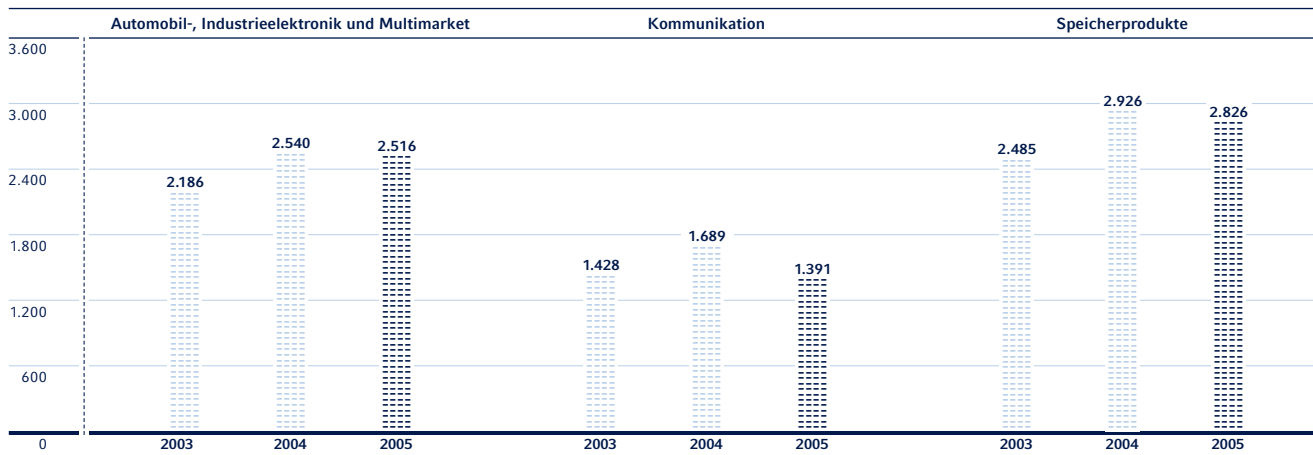


# Finanzbericht

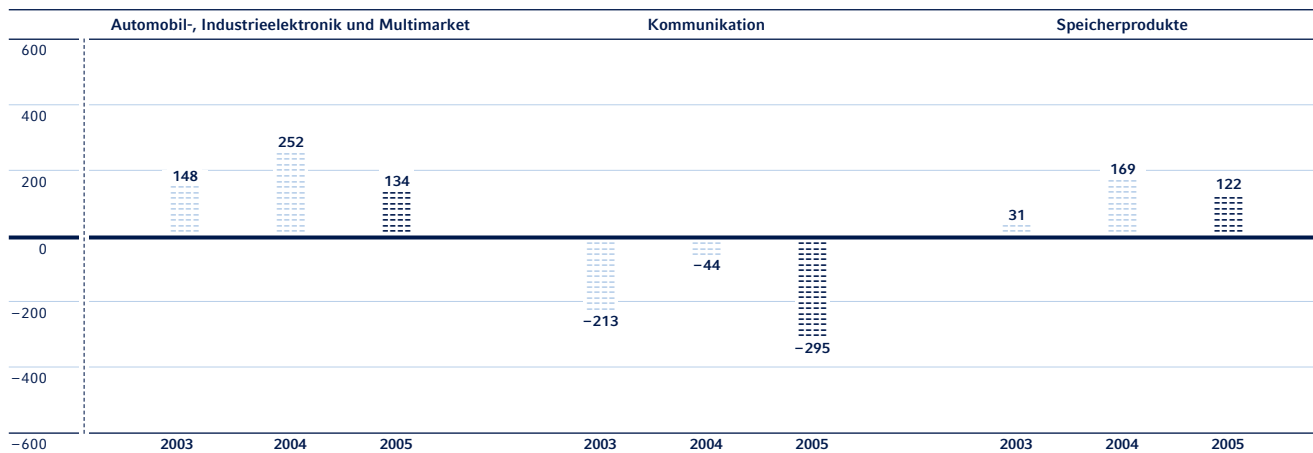


## Die Segmente: Umsatzerlöse und Ebit

### Umsatzerlöse in Mio. €



### Ebit in Mio. €



# Inhalt

## 40...Bericht des Aufsichtsrats

### 46...Corporate Governance

### 50... Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005

- 50 Überblick über das Geschäftsjahr 2005
- 52 Unser Geschäft
- 52 Darstellung der Halbleiterindustrie und der Faktoren mit Einfluss auf unser Geschäft
- 54 Herausforderungen in der Zukunft
- 55 Darstellung des Halbleitermarkts im Geschäftsjahr 2005
- 55 Pläne für die neue Ausrichtung der Gesellschaft
- 56 Entwicklung der Ertragslage
  - 56 Reorganisation
  - 57 Umsatzerlöse
  - 58 Umsatzerlöse nach Segmenten
  - 60 Umsatzerlöse nach Regionen und Kunden
  - 61 Umsatzkosten – Bruttoergebnis vom Umsatz
  - 62 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
  - 63 Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten
  - 64 Weitere Bestandteile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung
  - 64 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)
  - 65 Zinsergebnis
  - 66 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
  - 66 Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag
- 67 Darstellung der Vermögenslage
- 68 Darstellung der Finanzlage
  - 68 Cash-Flow
  - 68 Free-Cash-Flow
  - 69 Netto-Zahlungsmittelbestand
  - 70 Kapitalbedarf
  - 71 Vertragliche Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen
  - 71 Investitionen
  - 71 Kreditlinien
  - 72 Finanzierung der Pensionsverpflichtungen
- 73 Mitarbeiter und Campeon
- 73 Risiken und Chancen
- 77 Infineon Technologies AG
- 78 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- 78 Ausblick

## 79...Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

### 80...Konzernabschluss

- 80 Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen
- 81 Konzern-Bilanzen
- 82 Konzern-Eigenkapital-Veränderungsrechnungen
- 84 Konzern-Kapitalflussrechnungen

## 86...Anhang zum Konzernabschluss

- 86 Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung
- 86 Bilanzierung und Bewertung
- 91 Akquisitionen
- 93 Aufgegebene Geschäfte und Geschäftsanteilsveräußerungen
- 95 Lizenzen
- 96 Zuschüsse und Zulagen
- 96 Zusätzliche Angaben zu betrieblichen Aufwendungen
- 97 Umstrukturierungsmaßnahmen
- 98 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- 100 Ergebnis je Aktie
- 100 Wertpapiere
- 101 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 101 Vorräte
- 101 Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände
- 102 Sachanlagen
- 103 Finanzanlagen
- 104 Sonstige Vermögensgegenstände
- 106 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 106 Rückstellungen
- 106 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
- 107 Finanzverbindlichkeiten
- 108 Sonstige Verbindlichkeiten
- 109 Grundkapital
- 110 Aktienoptionspläne
- 112 Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren
- 112 Ergänzende Informationen zur Kapitalflussrechnung
- 113 Verbundene Unternehmen
- 115 Pensionsverpflichtungen
- 118 Derivative Finanzinstrumente
- 119 Risiken
- 120 Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten
- 125 Segmentberichterstattung
- 128 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
- 128 Ergänzende Erläuterungen
- 131 Vorstand und Aufsichtsrat
- 139 Wesentliche Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen

## 140...Weitere Informationen

- 140 Mehrjahresübersicht 2001–2005
- 142 Finanz- und Technologieglossar
- 148 Finanzkalender

## Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Max Dietrich Kley

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG



Sehr geehrte Damen und Herren,

während des abgelaufenen Geschäftsjahrs hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit der Lage und zukünftigen Positionierung der Gesellschaft befasst. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung durch den Vorstand regelmäßig überwacht und den Vorstand beratend unterstützt.

Tätigkeitsschwerpunkte des Aufsichtsrats. Von den Themen, mit denen sich der Aufsichtsrat im Berichtsjahr befasst hat, möchte ich besonders erwähnen:

- die neue Organisation und Struktur des Unternehmens,
- die Neustrukturierung des Fertigungsverbunds Regensburg, München, Villach und
- die Aufarbeitung der Vorgänge im Bereich Motorsportsponsoring.

Mit Beginn des Jahres 2005 wurde die Organisationsstruktur von Infineon neu ausgerichtet. Die drei operativen Segmente Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket (AIM), Kommunikation (COM) und Speicherprodukte (MP) werden nun jeweils von einem Vorstandsmitglied mit direkter unternehmerischer Verantwortung geführt. Außerdem wurden alle Geschäftsfelder mit den wesentlichen Funktionen eines Unternehmens im Unternehmen ausgestattet. Der Aufsichtsrat begrüßt diese Neuorganisation, da damit die Chancen von Infineon für ein erfolgreiches Agieren in einem immer dynamischeren und volatileren weltweiten Halbleitermarkt verbessert werden. In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat dem neuen Geschäftsverteilungsplan des Vorstands zugestimmt.

Die Effizienz und die Kosten der Produktion werden durch den Vorstand und Aufsichtsrat fortlaufend überprüft. Im Zusammenhang damit befasste sich der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung mit den vom Vorstand vorgetragenen Gründen für eine Neustrukturierung des Fertigungsverbunds Regensburg, München, Villach und die beabsichtigte Schließung des Infineon-Werks in München-Perlach Anfang 2007. Das Werk ist auf die Fertigung von Halbleiterbauelementen in Spezialtechnologien auf 150-Millimeter-Siliziumscheiben ausgerichtet und kann in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich und technisch sinnvoll genutzt werden. Der Kostennachteil der 150-Millimeter-Fertigung gegenüber der 200-Millimeter-Fertigung ist erheblich und nimmt immer weiter zu. Es ist daher vorgesehen, die Produktion aus München-Perlach zu einem großen Teil nach Regensburg und zu einem kleineren Teil nach Villach zu verlagern.

Dem Aufsichtsrat wurde außerdem ein Konzept für eine Verselbstständigung des Segments Speicherprodukte vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat dieses Konzept ausführlich diskutiert und diesem zugestimmt. Der Vorstand wurde gebeten, die weiteren Schritte zur Umsetzung des Vorhabens auszuarbeiten und dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Vorwürfe gegen das frühere Vorstandsmitglied Dr. von Zitzewitz im Zusammenhang mit dem Motorsportsponsoring des Unternehmens, das nach dem Ausscheiden Dr. Schumachers im Jahr 2004 gestoppt wurde, wurden in einer Sitzung des Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschusses am 22. Juli 2005 erörtert. Der Ausschuss kam zu dem Ergebnis, dass der Präsidialausschuss den Fall umfassend und korrekt behandelt hat. Darüber hinaus beschloss der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss, eine unabhängige, externe Prüfung des internen Informations- und Kontrollsystems der Gesellschaft in Auftrag zu geben. Die Prüfung sollte feststellen, ob die Infineon-Kontrollsysteme Schwachstellen aufweisen, die es möglicherweise verhinderten, das Dr. von Zitzewitz vorgeworfene Fehlverhalten früher zu erkennen. Die Prüfung hat keine solchen Schwachstellen ergeben. Das Prüfungsergebnis wurde im zuständigen Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss am 16. November 2005 besprochen und in der Sitzung des Aufsichtsrats am 17. November 2005 vorgestellt und erörtert.

In der Sitzung vom 28. Juli 2005 hat der Aufsichtsratsvorsitzende den Aufsichtsrat umfassend darüber informiert, welche internen und externen Untersuchungen durch den Präsidialausschuss seit Erhebung der ersten Vorwürfe gegen Herrn Dr. von Zitzewitz im März 2004 durchgeführt wurden. Im Anschluss an diesen Bericht finden Sie eine Chronologie der Maßnahmen des Aufsichtsrats. Auch der Aufsichtsrat hat festgestellt, dass der Präsidialausschuss den Fall eingehend und korrekt behandelt hat und dass keine Vorwürfe gegen den Präsidialausschuss erhoben werden können. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand gebeten, die Aufklärung des Sachverhalts weiter voranzutreiben und auch zu prüfen, ob im Zusammenhang mit dem Motorsportsponsoring auch anderen Personen Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Über die Durchsetzung eventueller Ansprüche wird der Aufsichtsrat dann entscheiden, wenn ihm alle Fakten vorliegen.

Außerdem hat der Vorstand den Aufsichtsrat im Rahmen der ordentlichen Sitzungen umfassend über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Segmente sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert und ausführliche Quartalsberichte vorgelegt. Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen die vom Vorstand vorgelegten Informationen umfassend erörtert. Der Vorstand hat auch schriftlich und mündlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet. Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Entscheidungen im Unternehmen unterrichten lassen.

**Corporate Governance.** Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass eine gute Corporate Governance eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unternehmens darstellt, und hat sich regelmäßig mit deutschen und internationalen Corporate-Governance-Regeln und ihrer Umsetzung im Unternehmen auseinander gesetzt. Vom Investitions-,



Finanz- und Prüfungsausschuss wurden Richtlinien für die Behandlung von Hinweisen und Beschwerden im Hinblick auf die Rechnungslegung und Prüfung (so genannte Whistle Blowing Procedures) beschlossen. Die Entsprechenserklärung 2004 gemäß § 161 Aktiengesetz hatte der Aufsichtsrat im November 2004, die Entsprechenserklärung 2005 im November 2005 beschlossen. Dabei waren nur zwei Abweichungen vom Kodex zu erwähnen. Dies und weitere Ausführungen zur Corporate Governance des Unternehmens sind im Geschäftsbericht gesondert dargestellt.

Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse. Im Berichtsjahr fanden vier regelmäßige und eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt. Der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr fünfmal getagt.

Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die Prüfung der Zwischenabschlüsse, die Vorprüfung des Jahresabschlusses, die Erörterung des Prüfungsberichts mit dem Wirtschaftsprüfer und die Prüfung der Finanz- und Investitionsplanung. Im Ausschuss wurde die geplante Errichtung eines neuen Werkes für Logik- und Leistungshalbleiter für den Einsatz in Automobil- und Industrieanwendungen in Kulim, Malaysia, erörtert und von diesem freigegeben. Durch das neue Werk wird das erfolgreiche Geschäft mit Halbleitern für Automobil- und Industrieanwendungen gestärkt und die Präsenz der Gesellschaft im Zukunftsmarkt Asien weiter ausgebaut.

Der Dialog zwischen Aufsichtsrat und Vorstand über die technischen Entwicklungen ist von besonderer Bedeutung für das Unternehmen. Hierzu diente bis zum 30. April 2005 der Strategie- und Technologieausschuss, der im Berichtsjahr zu vier Sitzungen zusammenkam. Der Ausschuss befasste sich intensiv mit der Geschäftsentwicklung und Strategie der operativen Segmente Kommunikation (COM) und Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket (AIM). Daneben erörterte der Ausschuss die Patent- und Kooperationsstrategie des Unternehmens. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, die Erörterung von Fragen der Technologie und Strategie zukünftig mit mehr zeitlicher Flexibilität außerhalb eines gesonderten Gremiums zu führen, und hat den Ausschuss daher zum 30. April 2005 aufgelöst. Der Dialog wird nunmehr zwischen einzelnen, ehemaligen Mitgliedern des Ausschusses und dem Vorstand zu Einzelfragen und -projekten fortgesetzt.

Der Präsidialausschuss kam zu einer Sitzung zusammen. Der gemäß § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss hat nicht getagt.

Jahres- und Konzernabschluss. Die Infineon-Rechnungslegung wurde im Berichtsjahr wiederum von der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, geprüft. Die KPMG hat den Jahresabschluss der Infineon Technologies AG und den Konzernabschluss zum 30. September 2005 sowie den zusammengefassten Lagebericht der Infineon Technologies AG und des Infineon-Konzerns geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Diese Unterlagen haben wir auch selbst geprüft. Die KPMG hat außerdem bestätigt, dass der Konzernabschluss nach US-GAAP erstellt wurde und dass der Befreiungstatbestand nach § 292a HGB in Verbindung mit Art. 58 Abs. 3 EGHGB vorlag.

Die Berichte der KPMG über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden zunächst in der Sitzung des Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschusses am 16. November 2005 und dann in unserer Bilanzsitzung am 17. November 2005 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hatte keine Einwendungen, hat dem Ergebnis der Abschlussprüfung seine Zustimmung erteilt und den Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht der Infineon Technologies AG und des Infineon Konzerns gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

**Personalia Vorstand.** Im November 2004 hat der Aufsichtsrat Herrn Kin Wah Loh zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Loh übernahm im Dezember 2004 die Leitung des Segments Kommunikation und im Juli 2005 die Leitung des Segments Speicherprodukte. Im Juli 2005 hat Herr Dr. von Zitzewitz sein Amt als Vorstandsmitglied niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat seine Niederlegungserklärung angenommen. Herr Prof. Dr. Eul wurde im Juli 2005 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt und hat von Herrn Loh die Leitung des Segments Kommunikation übernommen.

**Besetzung des Aufsichtsrats.** In der Hauptversammlung am 25. Januar 2005 wurden Frau Prof. Dr. Köcher, Frau Prof. Dr. Schmitt-Landsiedel und Herr Feldmayer neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Herren Dr. Faber, Dr. Jentzsch, Kley, Prof. Dr. Winterkorn und Prof. Dr. Wucherer wurden als Aufsichtsräte wiedergewählt. Aus dem Aufsichtsrat schieden mit Ablauf der Hauptversammlung 2005 die Herren Fritsch, Dr. Kohlhaussen und Prof. Dr. Ruge aus. Wir danken den ausgeschiedenen Aufsichtsräten für ihre engagierte Mitarbeit in diesem Gremium.

In der ordentlichen Aufsichtsratssitzung am 25. Januar 2005 wurden Herr Kley zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herr Luschtinetz zu seinem Stellvertreter gewählt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Leistung im vergangenen Geschäftsjahr. Auch allen Betriebsräten gilt der Dank des Aufsichtsrats für ihre konstruktive Mitarbeit.

München, im November 2005

Für den Aufsichtsrat



Max Dietrich Kley  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

## Anhang zum Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

### ZUSAMMENFASSUNG DER AKTIVITÄTEN DES AUFSICHTSRATS ZUR AUFKLÄRUNG DER EREIGNISSE IM BEREICH MOTORSPORTSPONSORING

1... Unmittelbar vor seiner Amtsniederlegung am 25. März 2004 hat Herr Dr. Schumacher dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats mehrere Dokumente übergeben, die nicht von ihm stammten. Darunter befand sich eine „Eidesstattliche Versicherung“ von Ralf-Udo Schneider, dem Inhaber der BF Consulting. In dieser Erklärung behauptete Herr Schneider, er habe Herrn Dr. von Zitzewitz Zahlungen aus „Sponsoringgeldern“ zukommen lassen. Auch die anderen Dokumente enthielten verschiedene Vorwürfe gegen Dr. von Zitzewitz, die sich aber später als haltlos herausstellten oder ausdrücklich widerrufen wurden.

2... Sofort nach Erhalt hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herrn Dr. von Zitzewitz aufgefordert, diesen Vorgang zu erklären und eine Stellungnahme abzugeben. Herr Dr. von Zitzewitz hat dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats gegenüber die Behauptungen in der Erklärung von Herrn Schneider mehrfach ausdrücklich bestritten.

3... Parallel dazu – und kurz bevor Herr Kley vorübergehend den Vorstandsvorsitz übernahm – beauftragte er als Vorsitzender des Präsidialausschusses am selben Tag den Justitiar damit, die Vorwürfe im Auftrag des Aufsichtsrats zu prüfen. Gegenstand der Prüfung sollte neben der Klärung des Sachverhalts insbesondere sein, welche Folgerungen der Aufsichtsrat bereits aus der Tatsache des Vorliegens dieser „Versicherung“ und der anderen Dokumente ziehen müsse. Außerdem wurden auch externe Anwälte mit der Prüfung dieser Fragen beauftragt.

4... Der Justitiar führte in der Woche ab 29. März 2004 mehrere Gespräche, auch mit Herrn Schneider. Dieser weigerte sich dabei strikt, auch nur irgendeinen Beweis vorzulegen, und er konnte auch keinerlei schlüssige Begründungen für die behaupteten Zahlungen geben.

5... Auch der externe Anwalt legte Anfang April 2004 eine erste gutachterliche Stellungnahme zu den Vorwürfen vor, Mitte April dann eine zweite Stellungnahme. Beide kamen zu dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte, geschweige denn Belege, für ein Fehlverhalten von Dr. von Zitzewitz vorlagen.

6... Über die interne Untersuchung wurde am 21. April 2004 ein Bericht für den Aufsichtsrat erstellt. Auch dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass es für die Richtigkeit der Anschuldigungen gegen Dr. von Zitzewitz keine Belege gebe.

7... Dieser Bericht wurde im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats am 22. April 2004 beraten. Hier wurden nochmals sämtliche Umstände beraten: keinerlei Beweise; keinerlei Zuständigkeit des Dr. von Zitzewitz für das Motorsportsponsoring; erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Herrn Schneider auch wegen seiner Weigerung, den Sachverhalt aufzuklären. Vor diesem Hintergrund kam der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass kein Anlass für eine Abberufung von Dr. von Zitzewitz wegen Pflichtverletzung vorlag.

8... Unabhängig davon erteilte der Aufsichtsrat Ende April 2004 den Auftrag, den Sachverhalt weiter aufzuklären und ihn über neue Erkenntnisse jeweils unverzüglich zu unterrichten. Das Unternehmen hat die BF Consulting wiederholt schriftlich und mündlich aufgefordert, alle relevanten Unterlagen vorzulegen und Beweise für die Anschuldigungen vorzutragen. Alle diese Bitten wurden ignoriert, und Beweise wurden nie vorgelegt.

Die Untersuchungen (inklusive einer Revision bei BF Consulting) ergaben schließlich, dass BF Consulting Aufträge Infineon gegenüber ständig zu hoch abgerechnet hatte. Außerdem wurden Infineon anscheinend erhebliche Gelder vorenthalten, auf die das Unternehmen einen Anspruch hat, nämlich aus dem Co-Sponsoring auf Rennwagen. Die Revision ergab aber keinerlei Anhaltspunkte für Zahlungen an Dr. von Zitzewitz oder andere Personen bei Infineon.

Ein zweites umfangreicheres Audit, das daraufhin für den Februar 2005 geplant war, wurde von der BF Consulting verweigert.

9... Unabhängig von den internen Untersuchungen hat Infineon die Geschäftsbeziehung mit BF Consulting aus wichtigem Grund gekündigt. BF Consulting klagte dagegen vor dem Landgericht München. Anlässlich der mündlichen Verhandlung im November 2004 wurden die Vorwürfe gegen Dr. von Zitzewitz wieder in der Presse lanciert. Sofort wurde Herr Schneider von Infineon erneut zur Vorlage von Belegen aufgefordert, auch noch direkt in der mündlichen Verhandlung. Erneut verweigerte Herr Schneider jeden Beweis für seine Vorwürfe. Außerdem hat die BF Consulting in einer Presseerklärung diese Vorwürfe am 22. November 2004 dann sogar ausdrücklich widerrufen.

10... Nachdem genügend Erkenntnisse über das vertragswidrige Handeln der BF Consulting vorlagen, hat Infineon im Februar 2005 eine Schiedsklage gegen BF Consulting erhoben. Mit dieser Schiedsklage werden einerseits zirka 1,6 Millionen Euro direkt geltend gemacht, andererseits wird Auskunft über Infineon zustehende Gelder in Höhe von vermutlich weiteren rund 3 Millionen Euro verlangt.

11... Davon unabhängig ermittelte die Staatsanwaltschaft München gegen Herrn Schneider und andere Personen. Diese Ermittlungen waren Aufsichtsrat und Vorstand bis zum 15. Juli 2005 unbekannt. An diesem Tag führte die Staatsanwaltschaft München bei Infineon eine Durchsuchung durch und befragte Herrn Dr. von Zitzewitz. Später erklärte Herr Dr. von Zitzewitz seinen Rücktritt, um sich auf seine Verteidigung in einem vermutlich länger dauernden Verfahren zu konzentrieren und das Unternehmen mit der Angelegenheit nicht zu belasten.

12... Unmittelbar im Anschluss an die staatsanwaltliche Durchsuchung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats – im Einvernehmen mit dem Vorstand – die Rechtsabteilung erneut angewiesen, den Sachverhalt im Lichte neuer Erkenntnisse zu würdigen und weiter aufzuklären.

13... Selbstverständlich werden die Anschuldigungen gegen Herrn Dr. von Zitzewitz und der Sachverhalt insgesamt weiter aufgeklärt. Diese Untersuchungen werden völlig ergebnisoffen geführt. Der Aufsichtsrat will den wahren Sachverhalt aufklären und wird daher auch bei allen anderen mit dem Motorsport-sponsoring befassten Personen prüfen, ob Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten vorliegen. Das Unternehmen kooperiert umfassend mit den Behörden.

14... Der Aufsichtsrat wird dabei auch prüfen, ob Schadenersatzansprüche des Unternehmens gegen die beteiligten Personen bestehen. Ergibt die Untersuchung, dass solche Ansprüche bestehen, wird der Aufsichtsrat über die Durchsetzung entscheiden.

## Corporate Governance Unser ganzheitliches Konzept

Corporate Governance – das sind Standards guter und verantwortlicher Unternehmensführung.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Infineon verstehen unter Corporate Governance ein ganzheitliches Konzept, das alle unternehmerischen Werte, Prozesse und Ziele einschließt, die unserem unternehmerischen Auftrag dienen. Es umfasst die Standards des internen Controllings, die „Business Conduct Guidelines“ (Leitlinien für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb), die Regelungen, die die Organisations- und Aufsichtspflichten des Unternehmens betreffen, unseren Infineon-Corporate-Governance-Kodex und einen Corporate-Governance-Beauftragten, der direkt an Vorstand und Aufsichtsrat berichtet.

Wir haben unsere Corporate Governance aus Anlass der Ereignisse und Vorwürfe im Zusammenhang mit dem früheren Motorsportsponsoring selbstverständlich überprüft. Ziel dieser – internen und externen – Untersuchungen war, herauszufinden, ob unsere Regeln und internen Kontrollsysteme Schwachstellen aufweisen, die eine Entdeckung möglichen Fehlverhaltens verhindert haben. Die Untersuchungen haben ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Trotzdem haben wir die unabhängig von diesen Vorwürfen bereits vorher begonnenen Verbesserungen an unseren internen Richtlinien erweitert.

Wir wollen auch dadurch die Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben – und zu den Unternehmen mit der besten Corporate Governance gehören.

### INFINEON HÄLT HOHE DEUTSCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS EIN

#### Deutsche Rahmenbedingungen

Infineon hat fast alle Regelungen übernommen, die die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ empfiehlt oder anregt; außerdem entsprechen wir den Vorgaben des US-amerikanischen Kapitalmarktrechts. So haben wir zum Beispiel in der Directors- und Officers-Versicherung einen Selbstbehalt der Mitglieder des Vorstands von 25 Prozent und des Aufsichtsrats von 100 Prozent des jeweiligen Jahresfixums vereinbart.

Infineon hat sich über die Regelungen des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ hinaus zusätzliche Ziele hinsichtlich guter Unternehmensleitung und -kontrolle gesteckt:

- ... Wir werden unsere Aktionäre und die Öffentlichkeit weiterhin umfassend und offen über das Unternehmen informieren.
- ... Wir wollen die Aktionäre bei der Ausübung ihrer Rechte so weit wie möglich unterstützen. Die Aktionäre können sich zum Beispiel online zur Hauptversammlung anmelden, über das Internet an Abstimmungen teilnehmen oder die Generaldebatte im Internet verfolgen.

- ... Wir werden die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat noch weiter stärken. Um unsere Ziele zu erreichen, wollen wir das positive Klima offener und respektvoller Gespräche weiter fördern.

#### Amerikanische Kapitalmarktregeln

Die Infineon Technologies AG ist an der Börse in New York („NYSE“) notiert. Die Gesellschaft unterliegt daher bestimmten amerikanischen Kapitalmarktgesetzen und Regeln der amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission („SEC“) und der NYSE. Seit Juli 2002 haben der US-Gesetzgeber, die SEC und daneben auch die NYSE verschiedene Regeln zur Verbesserung des Anlegerschutzes und der Corporate-Governance-Vorgaben für US-amerikanische Unternehmen erlassen. Zum größten Teil gelten diese Regelungen aber auch für nicht amerikanische Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind.

Die meisten dieser neuen Vorgaben haben wir bereits vorher erfüllt.

Zur weiteren Umsetzung der US-amerikanischen Bestimmungen haben wir einen Offenlegungsausschuss („Disclosure Committee“) eingerichtet, der die Veröffentlichung bestimmter Finanzinformationen und anderer wesentlicher Informationen überprüft und freizugeben hat. Außerdem haben wir ein internes Verfahren zur Zertifizierung eingeführt, in dem Führungskräfte, die unternehmerische Verantwortung tragen, bestimmte Angaben bestätigen müssen. Diese Verfahren und Bestätigungen dienen dem Vorsitzenden des Vorstands und dem Finanzvorstand dazu, die Zertifizierungen der Abschlüsse gegenüber der SEC abzugeben. Außerdem haben wir weitere Regeln überarbeitet oder neu geschaffen, darunter eine Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Ferner haben wir Regelungen über bilanz- und buchführungsbezogene Beschwerden und die Beziehungen zum Abschlussprüfer aufgestellt.

### STRUKTUR DER FÜHRUNG UND KONTROLLE DES UNTERNEHMENS

#### Aufsichtsrat

Das deutsche Aktienrecht, dem die Infineon Technologies AG als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt, sieht ein zweistufiges System der Unternehmensführung und -kontrolle vor, nämlich die Unternehmensführung durch den Vorstand und die Unternehmenskontrolle durch den Aufsichtsrat. Wir sind davon überzeugt, dass diese Trennung der beiden Funktionen eine wesentliche Voraussetzung für gute Corporate Governance ist.

Der Aufsichtsrat umfasst 16 Mitglieder, die gemäß dem deutschen Mitbestimmungsgesetz zu gleichen Teilen mit Vertretern der Eigentümer und der Mitarbeiter besetzt sind. Die Vertreter der Eigentümer werden von der Hauptversammlung gewählt; dies geschah zuletzt im Geschäftsjahr 2005. Die Vertreter der Mitarbeiter werden nach den Regelungen des deutschen Mitbestimmungsgesetzes gewählt. Die Mitarbeitervertreter werden durch Delegierte der Mitarbeiter deutscher Infineon-Betriebsstätten gewählt. Sechs dieser Mitarbeitervertreter sind Mitarbeiter des Unternehmens, und zwei werden als externe von bestimmten deutschen Gewerkschaften vorgeschlagen.

Nach der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats müssen die Vertreter der Eigentümer im Aufsichtsrat unabhängig sein. Einige Mitglieder des Aufsichtsrats sind oder waren in hochrangiger Position bei anderen Unternehmen tätig, zu denen Infineon gewöhnliche Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese erfolgen zu Bedingungen wie unter fremden Dritten. Die Vertreter der Mitarbeiter gelten – mit einer Ausnahme – ebenfalls als unabhängig im Sinne von auf das Unternehmen anwendbaren Regelungen. Der Aufsichtsrat hat daher nach Erörterung der Situation festgestellt, dass ihm eine genügende Zahl unabhängiger Mitglieder angehört.

Die Amtszeit des Aufsichtsrats beträgt regelmäßig fünf Jahre. Der Aufsichtsrat hat sich in den vergangenen Jahren jeweils zwischen fünf und sieben Mal zu Sitzungen getroffen, die auch regelmäßig ohne den Vorstand abgehalten werden. Die Aufgaben und die Arbeitsweise des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sind in Geschäftsordnungen geregelt, die auch Vorgaben zur Unabhängigkeit, zur ausreichenden Erfahrung und Fachkenntnis sowie zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten.

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Unternehmensführung. Er erörtert die Geschäftsentwicklung und Planung, die Strategie und deren Umsetzung. Er behandelt die Quartalsberichte und verabschiedet den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Infineon Technologies AG, wofür ihm der Prüfungsausschuss zuarbeitet und der Abschlussprüfer berichtet. Wesentliche Vorstandsentscheidungen wie größere Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen unterliegen seiner Zustimmung. Der Aufsichtsrat entscheidet auch über die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.

### Aufsichtsratsausschüsse

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht die Bildung von drei Ausschüssen vor; weitere können ad hoc gebildet werden. Die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten und die Arbeitsweise dieser Ausschüsse erfüllen die Anforderungen des deutschen

Corporate-Governance-Kodex, der verbindlichen Regelungen der US-amerikanischen Gesetze und der NYSE. Zum Teil gehen wir über die für uns verbindlichen Regelungen sogar hinaus.

Der Präsidialausschuss („Executive Committee“), dem zwei Vertreter der Eigentümer und ein Vertreter der Mitarbeiter angehören, hat die Aufgabe eines „Nominating, Compensation and Corporate Governance Committee“, weil er für die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, für deren Vergütung und für die Einhaltung der Corporate-Governance-Grundsätze im Unternehmen zuständig ist. Der Präsidialausschuss legt die Beschäftigungsbedingungen, die Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung fest. Er entscheidet auch über die Höhe der aktienbasierten Vergütungskomponenten.

Der Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss („Audit Committee“) besteht aus zwei Vertretern der Eigentümer und einem Vertreter der Mitarbeiter. Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses sind „unabhängig“ im Sinne der anwendbaren US-Regelungen. Der Prüfungsausschuss beaufsichtigt die Angemessenheit und Funktionsfähigkeit der externen und internen Rechnungslegung des Unternehmens, erörtert die vom Vorstand aufgestellten Quartals- und Jahresabschlüsse und macht auf der Grundlage des Berichts des Abschlussprüfers über die Prüfung der Jahresabschlüsse Vorschläge zur Feststellung der Jahresabschlüsse durch den Aufsichtsrat. Er befasst sich auch mit dem internen Kontrollsystem des Unternehmens und dem Verfahren zur Risikoerfassung, zur Risikokontrolle und zum Risikomanagement. Dazu kann er sich direkt an alle Mitarbeiter des Unternehmens wenden und auch externe Hilfe in Anspruch nehmen. Die interne Revision berichtet regelmäßig an den Ausschuss, der Prüfungsplan und Prüfungsschwerpunkte festlegen kann. Darüber hinaus überwacht der Ausschuss die Einhaltung von Rechtsvorschriften und behördlichen Regelungen. Er ist auch für die Beziehung der Gesellschaft zum Abschlussprüfer, für die Erteilung des Prüfungsauftrages und die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte und der Vergütung des Abschlussprüfers zuständig.

Der Aufsichtsrat hat Herrn Max Dietrich Kley als Finanzexperten („Audit Committee Financial Expert“) benannt.

Der Vermittlungsausschuss, dem ein Vertreter der Eigentümer und zwei Vertreter der Mitarbeiter angehören, unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.

### Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Bruttovergütung:

Name	Gesamtvergütung in Euro	davon variabler Anteil
Kley, Max Dietrich	58.000,00	0
Luschtinetz, Klaus	43.500,00	0
Eibl, Alfred	37.458,00	0
Faber, Dr. Joachim	35.041,00	0
Feldmayer, Johannes	19.333,00	0
Hauser, Jakob	37.458,00	0
Fritsch, Günther	9.666,00	0
Jentzsch, Dr. Stefan	29.000,00	0
Köcher, Prof. Dr. Renate	19.333,00	0
Kohlhaussen, Dr. h. c. Martin	14.500,00	0
Ruth, Michael	29.000,00	0
Ruge, Prof. Dr. Ingolf	14.500,00	0
Scheitor, Dieter	29.000,00	0
Schmidt, Gerd	29.000,00	0
Schmitt-Landsiedel, Prof. Dr. Doris	22.958,00	0
Schulzendorf, Kerstin	29.000,00	0
Trüby, Alexander	37.458,00	0
Winterkorn, Prof. Dr. Martin	39.875,00	0
Wucherer, Prof. Dr. Klaus	37.458,00	0

### Vorstand

Der Vorstand der Infineon Technologies AG – derzeit fünf Mitglieder – ist das Leitungsorgan des Unternehmens. Er ist allein an das Unternehmensinteresse gebunden und orientiert sich dabei an dem Ziel der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts. Nach zwingendem deutschem Aktienrecht ist er insgesamt für die wertschaffende Führung des Unternehmens verantwortlich. Nach seiner Geschäftsordnung leiten alle Mitglieder das Unternehmen gemeinsam. Zum 1. Dezember 2004 wurde der Vorstand umorganisiert: Seitdem verantworten drei Vorstandsmitglieder je einen Unternehmensbereich direkt. Weiterhin werden aber alle wesentlichen Entscheidungen im Gesamtvorstand erörtert und getroffen.

### Aktionäre und Hauptversammlung

Die Aktionäre der Gesellschaft treffen ihre Entscheidungen in der Hauptversammlung der Gesellschaft, die mindestens einmal im Jahr stattfindet. Jede Aktie gibt dabei eine Stimme. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Hauptversammlung beschließt über alle ihr zugewiesenen Angelegenheiten, insbesondere die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers, Satzungsänderungen und kapitalverändernde Maßnahmen. Im Sinne bester Corporate Governance hat der

deutsche Gesetzgeber von jeher sämtliche kapitalverändernden Maßnahmen der zwingenden Zustimmung der Eigentümer der Gesellschaft unterworfen. Dazu zählen auch Aktienoptionspläne, die in Aktien der Gesellschaft bedient werden. Aktionäre können Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung stellen und haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, Beschlüsse der Hauptversammlung anzufechten und gerichtliche Sonderprüfungen zu verlangen, wenn sie Fehlverhalten oder Missstände bei der Unternehmensführung und -kontrolle vermuten.

Wir berichten unseren Aktionären nach einem festen Finanzkalender vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung und über die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Außerdem informieren Mitglieder des Vorstands Anleger, Analysten und die Öffentlichkeit regelmäßig über die Quartals- und Jahresergebnisse. Unsere umfangreiche Investor-Relations-Arbeit umfasst regelmäßige Treffen mit Analysten und institutionellen Anlegern sowie jährliche Analystenkonferenzen und Telefonkonferenzen und sieht den ständigen Dialog mit Aktionären und Analysten vor.

### LAUFENDE ÜBERPRÜFUNG DES REGELWERKS

Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte sorgen dafür, dass unser Corporate-Governance-Regelwerk aktiv im Unternehmen gelebt wird. Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt. So haben wir in 2005 erneut erörtert, ob wir die Vergütung der Mitglieder des Vorstands jeweils individuell angeben wollen. Die Prüfung hat ergeben:

Nach zwingendem deutschem Aktienrecht und der Geschäftsordnung ist der gesamte Vorstand für die wertschaffende Führung des Unternehmens verantwortlich. Selbstverständlich informieren wir unsere Aktionäre über die Struktur der Vorstandsvergütung und geben die Gesamtvergütung des Vorstands an, jeweils getrennt nach Fixum, erfolgsabhängigen Komponenten und Aktienoptionen, so dass jeder Aktionär erkennen kann, wie sich die Leistung des Vorstands auf dessen Gehalt auswirkt. Für alle Mitglieder des Vorstands halten wir einen individuellen Ausweis der Vergütung daher nicht für veranlasst. Herr Dr. Ziebart, der Vorsitzende des Vorstands, hat sich allerdings entschlossen, seine Vergütung offen zu legen (siehe Seite 131).

Das Gesamteinkommen der Vorstandsmitglieder setzt sich zusammen aus dem Jahreseinkommen (Barvergütung), aus Aktienoptionen und aus einkommenswirksamen Nebenleistungen. Das Jahreseinkommen besteht

- aus einem festen Jahresgrundgehalt, das – nach Abzug der gesetzlichen Abgaben – teils monatlich anteilig, teils nach Ende des Geschäftsjahrs ausgezahlt wird, und
- aus dem Jahresbonus als variabler erfolgsabhängiger Komponente. Im Geschäftsjahr 2005 war der Jahresbonus vorrangig an die Gesamtkapitalrendite gekoppelt, die wir als

Geschäftsergebnis nach Steuern, bereinigt um Sondereffekte, im Verhältnis zum eingesetzten Kapital definieren. Ein Bonus kann auch für besondere Leistungen gewährt werden. Der Jahresbonus wird nach Geschäftsjahresende ausgezahlt.

Als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter erhalten die Vorstandsmitglieder Optionen auf Aktien der Infineon Technologies AG aus dem Aktienoptionsplan 2001. Hinzu kommen Nebenleistungen, zum Beispiel für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ein Dienstwagen mit Fahrer auch zur privaten Nutzung.

Den Aktienoptionsplan 2001 können Sie im Volltext im Internet unter [www.infineon.com/Aktienoptionsplan2001](http://www.infineon.com/Aktienoptionsplan2001) einsehen. Dieser Plan läuft 2006 aus. Der Hauptversammlung 2006 wird daher ein neuer Aktienoptionsplan vorgeschlagen. Wesentliche Merkmale dieses neuen Plans sind die Einführung auch eines relativen Erfolgsziels (Übertreffen eines Vergleichsindex) und die Erhöhung der Mindestwertsteigerung der Aktie auf 20 Prozent. Das bedeutet: Führungskräfte und Mitarbeiter des Konzerns sollen erst dann von einer Wertsteigerung der Aktien profitieren, wenn die Eigentümer eine gewisse Mindestrendite mit ihrer Investition erwirtschaftet haben.

#### Weitere Verbesserungen der Corporate-Governance-Regelungen

Wir führen unser Geschäft verantwortungsvoll in Übereinstimmung mit gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Regelungen – und wir haben verschiedene Richtlinien aufgestellt, die dazu beitragen, dass dieses Ziel erreicht wird. Unsere Business Conduct Guidelines sind für Vorstand und Mitarbeiter verbindlich. Wir haben sie im Jahr 2005 überarbeitet und insbesondere die Regelungen zur Erhebung und Behandlung von Beschwerden und Hinweisen auf Verstöße gegen diese Richtlinien und Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften neu gefasst. Ein „Compliance“-Beauftragter und der „Corporate-Governance“-Beauftragte, die an den Prüfungsausschuss berichten, nehmen Beschwerden und Hinweise – auch anonym – entgegen. Die Business Conduct Guidelines enthalten auch unseren Ethik-Kodex in Finanzangelegenheiten und sind auf unserer Internetseite veröffentlicht.

#### Verbesserung des Infineon-Corporate-Governance-Kodex

Wir haben unseren unternehmenseigenen Corporate Governance Kodex weiter verbessert. Dabei haben wir sämtliche Neuregelungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex vom Sommer 2005 übernommen. Im November 2005 haben Vorstand und Aufsichtsrat sodann über die Abgabe der Entsprechenserklärung 2005 gemäß § 161 AktG entschieden.

Wir freuen uns, dass wir hier unseren Corporate-Governance-Standard weiter verbessern konnten.

#### Angabe nach Ziffer 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ist dem Unternehmen folgende Transaktion gemeldet worden:

Datum des Geschäftsabschlusses: 27. Januar 2005

Name, Vorname: Kley, Max Dietrich

Funktion: Vorsitzender des Aufsichtsrats

Bezeichnung: Aktien der Infineon Technologies AG

Kauf/Verkauf: Kauf

Preis (pro Stück): 7,15 Euro

Stückzahl: 7.000

Geschäftsvolumen: 50.050,00 Euro

Geschäftsort: Börse Frankfurt/Main (Xetra)

#### Entsprechenserklärung 2005 gem. §161 Aktiengesetz

„Die Infineon Technologies AG hat seit Abgabe der letzten Erklärung gem. § 161 Aktiengesetz allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (Fassung 21. Mai 2003) mit folgenden Ausnahmen entsprochen:

- Wir verzichteten auf die individualisierte Angabe der Vergütung aller Mitglieder des Vorstands (Ziffer 4.2.4).
- Die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands (Ziffer 4.2.2) wurde im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats beraten und beschlossen.

Die Infineon Technologies AG wird allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex (Fassung 2. Juni 2005) mit folgenden Ausnahmen entsprechen:

- Wir geben die Vergütung des Vorsitzenden des Vorstands individualisiert an, verzichten im Übrigen aber auf die individualisierte Angabe der Vergütung aller anderen Mitglieder des Vorstands (Ziffer 4.2.4).
- Die Struktur des Vergütungssystems des Vorstands (Ziffer 4.2.2) wird im Präsidialausschuss des Aufsichtsrats beraten und beschlossen.

Weitere Informationen zu Corporate Governance allgemein finden Sie im Internet unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com), „Investor Informationen“. Konkret zur Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse berichten wir im Geschäftsbericht im Bericht des Aufsichtsrats. Unser Risikomanagement stellen wir unter „Risiken und Chancen“ vor. Eine detaillierte Erläuterung der Regeln unserer Konzernrechnungslegung finden Sie im Anhang zum Konzernabschluss.

--- Bericht des Aufsichtsrats, S. 40; --- Risiken und Chancen, S. 73;  
--- Anhang zum Konzernabschluss, S. 86



## Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005

### Wichtiger Hinweis

Dieser zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht (Lagebericht) sollte im Kontext mit den geprüften Konzernfinanzdaten und den Konzernanhangsangaben, die an anderer Stelle stehen, gelesen werden. Die geprüften Konzernabschlüsse basieren auf einer Reihe von Annahmen, die detaillierter in den Konzernanhangsangaben Nr. 1 (Beschreibung der Geschäftstätigkeit, der Gründung und der Grundlagen der Darstellung) und Nr. 2 (Bilanzierung und Bewertung) dargestellt sind.

Da die Infineon Technologies AG („Infineon“ oder die „Gesellschaft“) Teil des konzernweiten Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Marketingnetzwerks ist, wird der Lagebericht der Infineon Technologies AG mit dem des Infineon-Konzerns zusammengefasst.

Dieser Lagebericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen; Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Planungen, Annahmen und Schätzungen beruhen. Zukunftsaussagen sind immer nur für den Zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden. Infineon übernimmt keine Verpflichtung, diese beim Auftreten neuer Informationen zu überarbeiten. Zukunftsaussagen unterliegen immer Risiken und Unsicherheiten. Wir möchten Sie diesbezüglich deutlich darauf hinweisen, dass eine Reihe von Faktoren die tatsächlichen Ergebnisse dahingehend beeinflussen können, dass diese von den prognostizierten wesentlich abweichen. Einige dieser Faktoren sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ und in weiteren Teilen dieses Berichts beschrieben.

### ÜBERBLICK ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2005

Im Geschäftsjahr 2005 entwickelte sich die Weltwirtschaft schwächer als im Vorjahr, und der Halbleitermarkt erlebte eine Phase moderaten Wachstums. Als Global Player auf dem Halbleitermarkt wurde unser Geschäft von dieser ungünstigen Weltwirtschaftslage und den schwierigen Marktbedingungen auf dem Halbleitermarkt nachteilig beeinflusst, insbesondere von dem starken Preisdruck und zusätzlich von der rückläufigen Nachfrage in unseren operativen Segmenten. Um die derzeitigen Herausforderungen des Halbleitermarkts anzunehmen, haben wir unsere Organisationsstruktur vereinfacht mit dem Ziel, kürzere und schnellere Entscheidungswege innerhalb der gesamten Gesellschaft zu schaffen sowie eine größere Kundenorientierung, höhere Effizienz und Flexibilität zu erzielen. Wir haben auch bestimmte zentrale Funktionen, zum Beispiel den Verkauf und die Produktion, in die operativen Segmente integriert. Darüber hinaus haben wir Meilensteine bei unseren produzierenden Gemeinschaftsunternehmen und bei der Entwicklung neuer Produkttechnologien erreicht. Wesentliche Entwicklungen im Geschäftsjahr 2005 waren:

- Der Geschäftsbereich Mobile und das Segment Drahtgebundene Kommunikation wurden in dem neuen Segment Kommunikation gebündelt, um unsere Unternehmensstruktur an die Marktentwicklung anzupassen. Gleichzeitig wurden die Sicherheits- und Chipkarten-Aktivitäten sowie die Sparte ASIC & Design Solutions in das erweiterte Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket eingegliedert.
- Die Umsatzerlöse verringerten sich von 7.195 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 um 6,1 Prozent auf 6.759 Millionen Euro. Unser Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging von einem positiven Ebit von 256 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 auf ein negatives Ebit von 183 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2005 zurück.
- Im Geschäftsjahr 2005 verringerte sich unser Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von 1.857 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 auf 1.039 Millionen Euro. Dies beruht vor allem auf einem niedrigeren Bruttoergebnis vom Umsatz und der Veränderung von verschiedenen kurzfristigen Verbindlichkeiten.
- Wir haben mit der ProMOS Technologies Inc. („ProMOS“) eine Vereinbarung über die Lizenzvergabe von früher an ProMOS transferierten Technologien abgeschlossen. ProMOS darf Produkte auf Basis dieser Technologien herstellen und vertreiben sowie darauf basierende eigene Prozesse und Produkte entwickeln. Als Gegenleistung erhalten wir einen Betrag von 156 Millionen US-Dollar, der in vier Raten bis zum 30. April 2006 zu zahlen ist. Die Parteien haben die in diesem Zusammenhang stehenden Klagen zurückgezogen.

- Wir haben den verbleibenden 30-prozentigen Anteil von Saifun Semiconductors Ltd. („Saifun“) an dem Infineon Technologies Flash Joint Venture übernommen. Als Teil dieser Akquisition erhält die Gesellschaft eine Lizenz für die Nutzung der NROM®-Technologie von Saifun.
- Wir veräußerten bestimmte Vermögensgegenstände unseres Glasfaserkomponentengeschäfts an die Finisar Corporation („Finisar“) und erhielten als Gegenleistung 34 Millionen Finisar-Aktien, die wir anschließend verkauft haben.
- Wir veräußerten die Infineon Venture GmbH, die den Großteil der Wagniskapitalbeteiligungen der Gesellschaft beinhaltete.
- Wir haben mit der Rambus Inc. („Rambus“) eine Übereinkunft getroffen, wonach auf sämtliche gegenseitige Ansprüche verzichtet wird und wir das Patentportfolio von Rambus weltweit für unsere bestehenden und zukünftigen Produkte nutzen können.
- Wir haben weitere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen, die einen Abbau der Mitarbeiterzahl sowie die Zusammenfassung bestimmter Funktionen und Geschäfte beinhalten. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen fielen im Geschäftsjahr 2005 Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 78 Millionen Euro an.
- Im Geschäftsjahr 2005 haben wir Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände in Höhe von 134 Millionen Euro vorgenommen, im Wesentlichen im Zusammenhang mit unserem verbliebenen Glasfaserkomponentengeschäft, der Reorganisation innerhalb des Segments Kommunikation sowie unseren Finanzanlagen.
- Wir haben weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung investiert. Bedeutende Erfolge, die im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzeichnen waren, sind die Einführung von:
  - E-GOLDradio, dem neuesten Mitglied unserer erfolgreichen E-GOLD-Familie, das die vollständige Funktionalität unseres Basisbandprozessors, E-GOLDLITE, und des hoch entwickelten RF Transceiver, SMARTi SD2, vereint;
  - 90-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie und Demonstration von ersten funktionierenden Halbleitern auf Basis der 70-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie;
  - VINAX, unsere neue VDSL2-Chiplösung, konstruiert für Anwendungen im Bereich der Low-End-Modems bis hin zu High-End-Home-Gateways;
  - SMARTi 3G, das neueste Mitglied unserer erfolgreichen UMTS-Transceiver-Familie, konstruiert für mobile Anwendungen, das alle derzeitigen sechs UMTS-Frequenzen weltweit unterstützt;
  - neuen 8-, 16-, 32-Bit-Mikrocontrollern mit integriertem Flash für Anwendungen im Industrie- und Automobilbereich;
  - der neuen komprimierten Produktionsmethode FCOS (Flip Chip On Substrate), gemeinschaftlich entwickelt mit Giesecke & Devrient GmbH („Giesecke & Devrient“); und
  - Trusted-Platform-Modul (TPM), eine vollständig unabhängige Hard- und Software-Lösung, die den Spezifikationen der Trusted-Computing-Group entspricht.
- Erfolge im Rahmen unserer fortlaufenden Bemühungen, Produktionsprozesse zu verbessern und unsere Produktionsleistungsfähigkeit zu erhöhen, sind:
  - Erfolgreicher Transfer unserer leistungsfähigen Prozesstechnologie für die Herstellung von Logikchip-Produkten auf der Basis von 130-Nanometer-Strukturen an verschiedene Fertigungsstätten zur Erhöhung unserer Produktionsflexibilität.
  - Im Bereich der Speicher-Prozesstechnologien haben wir erfolgreich die 90-Nanometer-Prozesstechnologie für DRAM-Produkte in unserer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Dresden eingeführt.
  - Erweiterung der gemeinsamen Kooperation mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) zur Entwicklung der nächsten Generation 60-Nanometer-DRAM-Trench-Technologie.
  - Unser Gemeinschaftsunternehmen Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan („Inotera“), hat ein Produktionsvolumen von 60.000 Waferstarts pro Monat mehrere Monate vor dem Zeitplan erreicht.
  - Unsere 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, und unser Produktionspartner Semiconductor Manufacturing International Corporation („SMIC“) in Peking, China, haben mit der kommerziellen Produktion begonnen.
  - Beginn der Produktion in unserer Fertigungsstätte für Montage und Prüfung von Speicherprodukten in Suzhou, China.
  - Beginn des Aufbaus einer Front-End-Fabrik im Kulim High Tech Park, Kulim, Malaysia, mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von zirka 1 Milliarde US-Dollar. Die Fabrik wird hauptsächlich Power- und Logikchips für Automobil- und Industrieanwendungen produzieren.
  - Eröffnung eines neuen Entwicklungszentrums in Bukarest, Rumänien, mit dem Schwerpunkt auf Power-ICs einschließlich analoger und digitaler Funktionen.

## UNSER GESCHÄFT

Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen eingesetzt, wie Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten. Unser Produktspektrum umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Unsere Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika.

Nach unserer internen Reorganisation im Geschäftsjahr 2005 ist unser Geschäft nun schwerpunktmäßig in drei operative Segmente gegliedert, die auf einer Reihe von Märkten der Halbleiterbranche tätig sind:

- Unser Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte sowie Systemlösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrieelektronik und im Multimarket-Bereich.
- Unser Segment Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite von ICs, anderen Halbleiterprodukten sowie kompletten Systemlösungen für drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsanwendungen.
- Unser Segment Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Konfigurationen und Gehäusen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für standardisierte, spezielle und eingebettete Speicheranwendungen.

Für Zwecke der Berichterstattung führen wir zwei weitere Segmente auf: Das Segment Sonstige Geschäftsbereiche umfasst verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften wie auch andere Geschäftsaktivitäten. Das Segment Konzernfunktionen erfasst die Positionen, die nicht den anderen Segmenten zugerechnet werden können, wie bestimmte Kosten der Konzernzentrale, strategische Investitionen, nicht verrechnete Leerkosten, Restrukturisierungskosten und zentrale IT-Entwicklungskosten.

## DARSTELLUNG DER HALBLEITERINDUSTRIE UND DER FAKTOREN MIT EINFLUSS AUF UNSER GESCHÄFT

Unser Geschäft und die Halbleiterindustrie sind durch eine hohe Zyklizität gekennzeichnet. Charakteristisch sind konstante und rapide technologische Veränderungen, schnelle Produktveralterung und Preiserosion, die kontinuierliche Entstehung neuer Standards, kurze Produktlebenszyklen und starke Schwankungen bei Produktangebot und -nachfrage. Obwohl diese Faktoren alle Segmente unseres Geschäfts beeinflussen, treffen sie in besonderem Maße auf das Segment Speicherprodukte und zunehmend auch auf das Segment Kommunikation zu. Den geringsten Einfluss haben diese Faktoren auf das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket.

### Zyklizität

Die Zyklizität in der Halbleiterindustrie beruht auf einem komplexen Zusammenspiel von Faktoren, insbesondere der fluktuierenden Nachfrage nach Endprodukten, die Halbleiter enthalten, und Schwankungen in der zur Verfügung stehenden Kapazität zur Herstellung von Halbleitern. Diese Zyklizität ist im Bereich der Speicherprodukte besonders stark ausgeprägt. Weil sich Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Halbleiterfertigungsstätten über mehrere Jahre hinziehen können, neigen Halbleiterhersteller zu Investitionen in Zeiten günstiger Marktbedingungen, um so auf mögliche zukünftige Nachfragesteigerungen zu reagieren. Wenn mehr als eine der neu errichteten Fertigungsstätten ihren Betrieb innerhalb desselben Zeitfensters aufnehmen, kann das Angebot an Chips auf dem Markt beträchtlich ausgeweitet werden. Ohne anhaltendes Nachfragewachstum führt dieses Verhalten typischerweise zu Überkapazitäten in der Produktion und einem Überangebot an Produkten und in der Folge zu einschneidenden Preiseinbrüchen für Halbleiterprodukte. Fallen die Preise, reduzieren die Hersteller in der Vergangenheit die Investitionen in neue Fertigungsstätten. Da aber zurzeit die Nachfrage nach Chips wieder zunimmt, steigen die Preise ohne Inbetriebnahme zusätzlicher Fertigungsstätten, was zu einem neuen Investitionszyklus führt. Die Halbleiterindustrie reagiert auf einen Nachfragerückgang üblicherweise träge, da sie kapitalintensiver ist und Entscheidungen über den Zukauf von Produktionsanlagen weit vor einer geplanten Expansion zu treffen sind.

Wir sind bestrebt, den Einfluss der Zyklizität im Segment der Speicherprodukte mit Hilfe von kontinuierlichen Investitionen in Fertigungskapazitäten über den gesamten Zyklus, von Kooperationsvereinbarungen und Auftragsfertigungsabkommen zu mindern, damit wir auf Zyklusänderungen flexibler reagieren zu können. Wir sind der Überzeugung, dass wir unser Bruttoergebnis vom Umsatz im Segment Speicherprodukte durch die

Fokussierung unserer Investitionen auf zwei Kerngebiete verbessern können: die kontinuierliche Verbesserung der Kostenstruktur und der Produktivität durch Einführung fortschrittlicher Speicherprozesstechnologien sowie die Entwicklung und Vermarktung einer diversifizierteren Produktpalette, die sich im Besonderen auf höhere Margen und weniger volatile Anwendungen wie Infrastruktur, hoch auflösende grafische und mobile Anwendungen sowie Anwendungen für Konsumenten fokussiert.

### Substanzielle Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsaufwendungen

Die Halbleiterproduktion ist höchst kapitalintensiv. Die zu einer wettbewerbsfähigen Kostenposition notwendigen Produktionskapazitäten fordern hohe Investitionen in Fertigungsanlagen. Nach einer Studie von IC Insights beträgt der Anteil der zehn größten Investoren in der Halbleiterindustrie, wovon wir Rang acht belegen, mehr als 50 Prozent der Gesamtausgaben im Bereich der Halbleitertechnologie. Fertigungsprozesse und Produktgestaltung basieren auf Spitzentechnologien, denen beträchtliche Forschungs- und Entwicklungskosten vorangehen. Der Großteil der Betriebskosten einer Fertigungsstätte sind Fixkosten; daher können sich Fluktuationen in der Auslastung der Kapazitäten signifikant auf die Profitabilität auswirken.

Besonders der Markt für DRAM-Speicherprodukte ist durch eine marktsensible Preisfindung gekennzeichnet, die sich teilweise unserem Einfluss entzieht. Einen Schlüsselfaktor zur Sicherung der Profitabilität stellt für uns daher die kontinuierliche Verringerung unserer Stückkosten durch Verringerung der Herstellungskosten und Erhöhung der Produktionsmenge dar.

Zur Verringerung unserer gesamten Kosten zielen wir auch darauf ab, die Kosten für Forschung und Entwicklung und für Fertigungsstätten mit Dritten zu teilen. Dazu dienen uns Allianzen oder Vereinbarungen zur Auftragsfertigung. Wir sind der Überzeugung, dass strategische Allianzen bei Forschung und Entwicklung und bei der Produktion sowie die Zusammenarbeit mit Auftragsherstellern uns eine Vielzahl von Vorteilen verschaffen. Dazu gehören die Aufteilung der Risiken und Kosten, die Reduktion unseres eigenen Kapitalbedarfs, die Möglichkeit, eine breitere Produktpalette zu entwickeln, der Erwerb technischen Know-hows und der Zugriff auf weitere Produktionskapazitäten. Wir entwickeln gemeinsam mit Nanya DRAM-Technologien auf Basis von 70-Nanometer- und 60-Nanometer-Strukturen. Zusätzlich sind wir in Asien Vereinbarungen zur Auftragsfertigung mit SMIC und Winbond Electronics Corp.,

Hsinchu, Taiwan („Winbond“), eingegangen, um unsere Produktionskapazitäten und somit unsere Umsatzbasis zu erhöhen, ohne selbst in Produktionsanlagen zu investieren. Bedeutende Allianzen in unserem Logikgeschäft bestehen mit International Business Machines Corporation („IBM“), Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd., Singapur („Chartered Semiconductor“), und Samsung Electronics Co. Ltd. für die Entwicklung und Produktion von CMOS auf Basis der 65-Nanometer und 45-Nanometer Technologie, mit United Microelectronics Corporation („UMC“) für die 90-Nanometer-Produktion und mit IBM durch unser Joint Venture ALTIS Semiconductor S.N.C. („ALTIS“) in Essonnes, Frankreich.

Wir planen eine Erhöhung der Stückzahlen durch Produktivitätssteigerungen in der Herstellung, indem wir Chips von geringerer Strukturgröße produzieren, das heißt mehr Bits pro Chip und mehr Chips pro Wafer, durch Verwendung größerer Wafer. Bezüglich der DRAM-Prozesstechnologie basiert der größte Teil unserer Kapazität auf 110-Nanometer-Strukturen. Darüber hinaus starteten wir die Volumenproduktion mit 90-Nanometer-Strukturen, die gemeinsam mit Nanya entwickelt wurde. Wir erweiterten unseren 300-Millimeter-Kapazitätsanteil während des Geschäftsjahrs 2005 durch einen kontinuierlichen Kapazitätsaufbau im Gemeinschaftsunternehmen mit Nanya, Inotera, und dem Beginn des Kapazitätsaufbaus bei SMIC in Peking sowie in unserer Produktionsstätte in Richmond. Wir erwarten den Anteil unserer Speicherproduktion auf 300-Millimeter Wafern durch kontinuierliches Hochfahren unserer 300-Millimeter-Produktion in Richmond und aus neuen Kapazitäten unseres Produktionspartners Winbond im Geschäftsjahr 2006 auszubauen. Im Logikgeschäft basiert der größte Teil unserer Kapazität auf 130-Nanometer-Strukturen. Unsere 130-Nanometer-Produktionstechnologie mit bis zu acht Kupferschichten befindet sich in der Volumenproduktion, unter anderem in unserer Fertigungsstätte in Dresden und in unserer Produktions-Joint-Venture mit IBM in Essonnes, Frankreich. Zurzeit beginnen wir die Produktion mit unserer 90-Nanometer-Logiktechnologie hochzufahren, und wir haben darüber hinaus die Qualifizierung unserer 65-Nanometer-Logiktechnologie gestartet.

### Technologische Entwicklung und Wettbewerb

Die Verkaufspreise pro Stück sind volatil und sinken wegen der technologischen Entwicklung und des Wettbewerbdruks üblicherweise im Zeitverlauf. Speziell Speicherprodukte sind standardisierte Produkte. Die Standardisierung der meisten Spezifikationen ermöglicht es den Kunden, kurzfristig den Lieferanten zu wechseln. Dies führt zu einem starken Wettbewerb innerhalb des Markts und zwingt die Hersteller, Kosteneinsparungen an den Kunden weiterzugeben, um Marktanteile auszubauen.

Logikchip-Produkte stellen normalerweise kein standardisiertes Produkt dar und beschränken sich in einem gewissen Grad auf bestimmte Anwendungsbereiche. Trotz der im Vergleich zu Speicherprodukten üblicherweise geringeren Stückpreisvolatilität sinken auch im Bereich der Logikchip-Produkte die Verkaufspreise mit der Weiterentwicklung der Technologie.

Unser Ziel ist es, die Auswirkungen auf unsere Erlöse durch die sinkenden Preise zu kompensieren, indem wir das Verkaufsvolumen erhöhen und den Produkt-Mix optimieren. Weiteren Auswirkungen auf das Bruttoergebnis vom Umsatz begegnen wir, indem wir kontinuierlich unsere Stückkosten reduzieren. Zunahmen im Verkaufsvolumen hängen teilweise von der Verbesserung der Produktivität bei der Herstellung von Halbleitern ab. Durch die Reduzierung der Strukturgrößen in der Herstellung hat sich historisch gesehen die Anzahl funktionaler Elemente etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Dieser auch als „Moore's Law“ bekannte Trend führte zu einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate der Bit-Volumen von 40 Prozent bis 45 Prozent und, unter der Annahme konstanter Preise für ein Quadratzentimeter Silizium, zu einer jährlichen Kostenreduktion von ungefähr 30 Prozent pro Bit.

### Saisonabhängigkeit

Das umsatzstärkste Quartal ist erfahrungsgemäß das vierte Quartal des Geschäftsjahrs, umsatzschwächer sind das erste und das zweite Quartal. In der Saisonabhängigkeit unserer Verkäufe wird die saisonale Nachfrage nach Produkten, die unsere Halbleiter verwenden, widergespiegelt. Wenn antizipierte Umsätze und Lieferungen nicht wie erwartet stattfinden, können in einem solchen Quartal überproportional hohe Ausgaben und Lagerbestände auftreten, was das Ergebnis des Quartals und möglicherweise das Ergebnis der folgenden Quartale negativ beeinflussen kann.

### Produktentwicklungszyklen

Bei Logikprodukten kann sich die Zeitspanne vom Test über die Evaluierung und Kundenakzeptanz bis hin zur Serienfertigung über mehrere Monate bis mehr als ein Jahr hinziehen. Wegen der Länge dieses Zyklus kann es zu signifikanten zeitlichen Verzögerungen zwischen den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Marketingaktivitäten und dem Aufbau von Vorräten bis zur Einnahme der entsprechenden Erlöse kommen. Speicherprodukte werden auf Grund der größeren Standardisierung der Speicherprodukte von Entwicklungszyklen weniger beeinflusst.

### Akquisitions- und Desinvestitionsstrategie

Die Akquisition und Desinvestition von Geschäften, Vermögensgegenständen, Produkten oder Technologien sind ein Schlüsselfaktor unserer Geschäftsstrategie, der die Entwicklungszeit neuer Technologien und Produkte und deren Markteinführung verkürzt und unser existierendes Produktangebot, die Marktdeckung, den Einsatz von Ingenieuren sowie unsere technologischen Kompetenzen optimiert. Wir planen die Fortsetzung der Evaluierung sich bietender strategischer Möglichkeiten. Dies umfasst Unternehmensakquisitionen, strategische Partnerschaften, Investitionen und auch den Erwerb oder Verkauf von Vermögensgegenständen.

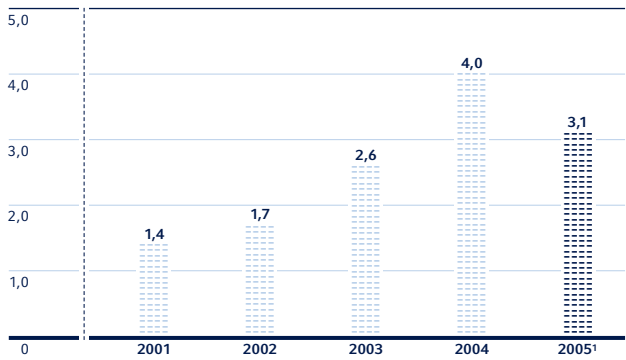
### Geistiges Eigentum

Bedingt durch den High-Tech-Charakter der Halbleiterindustrie sind immaterielle Vermögensgegenstände, die sich auf geschützte Technologien wie geistiges Eigentum beziehen, von großer Bedeutung. Unternehmen stellen für gewöhnlich Dritten ihr patentiertes geistiges Eigentum gegen Lizenzgebühren zur Verfügung. Es kann kostspielig und schwierig sein, sich gegen Verletzungen Dritter zur Wehr zu setzen oder sich bei Klagen Dritter, die eine Verletzung ihrer Rechte behaupten, zu verteidigen. Eigenentwickeltes geistiges Eigentum wird nicht aktiviert. Nur erworbenes oder durch Lizenzerwerb genutztes geistiges Eigentum wird in der Bilanz aufgeführt und über die erwartete technische und wirtschaftliche Lebensdauer abgeschrieben. Bewertungsansätze für erworbenes geistiges Eigentum gestalten sich in der Regel äußerst komplex.

### HERAUSFORDERUNGEN IN DER ZUKUNFT

Unser künftiger Erfolg wird vor allem von unserer Fähigkeit abhängen, weiterhin Spitzentechnologien zu entwickeln und unser Produktportfolio zu optimieren. Wir müssen beide Ziele erreichen, um der fluktuierenden Nachfrage nach verschiedenen Halbleiterprodukten zu begegnen. Wir sind der Überzeugung, dass die Fähigkeit, ein breites Portfolio anzubieten und flexibel zu fertigen, in zunehmendem Maße zu unserem langfristigen Erfolg auf vielen Märkten in der Halbleiterindustrie beitragen wird. Die Entwicklung und Erhaltung eines Technologievorsprungs, Entwicklungs- und Fertigungsallianzen, einschließlich der Auftragsfertigung durch Dritte, sowie beständige Bemühungen zur Portfolio-Diversifikation werden die Reaktion auf veränderte Marktbedingungen erleichtern und unsere finanzielle Ertragskraft stärken.

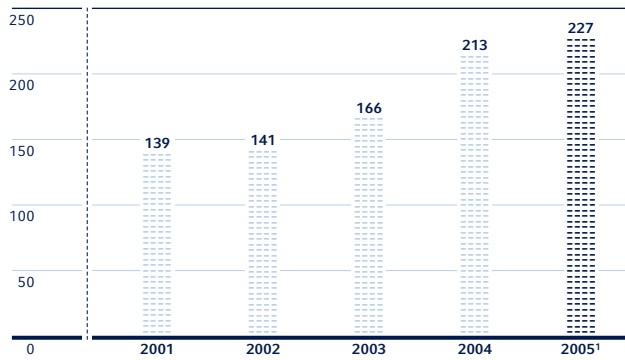
Weltwirtschaftswachstum in %



Das abgeschwächte Weltwirtschaftswachstum im Kalenderjahr 2005 gibt dem Halbleitermarkt keine deutlichen Wachstumsimpulse.

Quelle: Internationaler Währungsfonds; Stand: September 2005.  
1 Geschätzt.

Entwicklung des Halbleitermarkts in Mrd. US-\$



Abgeschwächtes Wachstum des Halbleitermarkts im Kalenderjahr 2005 beeinflusste auch die Infineon-Geschäfte negativ.

Quelle: WSTS; Stand: Oktober 2005.  
1 Geschätzt.

## DARSTELLUNG DES HALBLEITERMARKTS IM GESCHÄFTSJAHR 2005

Im Kalenderjahr 2005 hat sich das Wachstum des Halbleitermarkts deutlich abgeschwächt. Nachdem der Halbleitermarkt im Kalenderjahr 2004 entsprechend World Semiconductor Trade Statistics („WSTS“) um 28 Prozent gewachsen war, erwartete WSTS im Oktober 2005 für das Kalenderjahr 2005 ein Wachstum von 7 Prozent. Seinen Umsatz weiter ausweiten wird laut WSTS der asiatisch-pazifische Raum mit einem prognostizierten Wachstum von 16 Prozent im Kalenderjahr 2005. Für den japanischen Markt wird ein leichter Rückgang von minus 3 Prozent erwartet, Europa wird nach dieser Prognose stagnieren, Amerika mit 2 Prozent leicht wachsen. Der Bereich der Nicht-Speicher-Produkte (Logikchips, analoge, diskrete und optische Komponenten), der 79 Prozent des Gesamtmarkts im ersten Kalenderhalbjahr 2005 ausmachte, soll gegenüber dem Kalenderjahr 2004 um 8 Prozent wachsen. Für den Bereich der Speicherprodukte wird im Vergleich zum Kalenderjahr 2004 eine Wachstumsrate von 3 Prozent prognostiziert.

Für das Kalenderjahr 2005 sieht das Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest ein weltweites Marktwachstum von 5 Prozent bei Halbleitern im Bereich der Kommunikation (drahtlose und drahtgebundene Kommunikation). Im Bereich Halbleiter für Datenverarbeitung werden 7 Prozent, für Konsumelektronik 12 Prozent und für die Automobilelektronik 7 Prozent Wachstum angenommen.

## PLÄNE FÜR EINE NEUE AUSRICHTUNG DER GESELLSCHAFT

Unser Hauptziel ist, profitables Wachstum zu erreichen und den Nutzen für unsere Gesellschafter zu maximieren. Dementsprechend prüfen wir regelmäßig zweckmäßige Schritte zur Erreichung dieser Ziele. Nach umfangreicher Analyse unserer Märkte und Geschäfte sowie im Hinblick auf die Förderung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat im November 2005 dem Vorhaben zugestimmt, unsere Gesellschaft neu auszurichten um uns darauf vorzubereiten, die Marktchancen im Speicher- und Logik-Geschäft besser auszuschöpfen, sofern und sobald sie eintreten.

Der erste Schritt in diesem Prozess wird die Übertragung aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten unseres Segments Speicherprodukte auf eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft sein (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten oder einem Teilbetrieb als Ausgliederung bekannt).

Wir glauben, dass diese organisatorischen Maßnahmen uns schnell in die Lage versetzen werden, Vorteile aus den entsprechenden Marktchancen für das Speichergeschäft zu ziehen, sofern und sobald sie eintreten. Wir beabsichtigen, die finanziellen und industriellen Entwicklungen kontinuierlich während des Geschäftsjahrs 2006 zu überwachen und zu bewerten sowie weitere Reorganisationschritte, soweit zweckmäßig, in Betracht zu ziehen. Unser Vorstand bevorzugt die Alternative, die Marktposition der Speicherproduktgruppe durch einen Börsengang der neuen Tochtergesellschaft zu verstärken. Nichtsdestoweniger haben wir über spezifische Schritte oder den zeitlichen Rahmen solcher Schritte noch nicht entschieden. Mittel- bis langfristig gesehen würden wir auch eine Reduzierung unserer Position im Speichersegment auf einen Minderheitsanteil in Betracht ziehen.

## Hintergrund

Unser Geschäft schließt sowohl die Speicheraktivitäten unseres Segments Speicherprodukte als auch die Logikaktivitäten unserer zwei anwendungsorientierten Segmente – Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket sowie Kommunikation – ein. Sowohl der Speicher- als auch der Logikbereich unseres Geschäfts haben historisch von bestimmten Synergien profitiert. Allerdings glauben wir, dass sich die beiden Geschäfte, was wesentliche Erfolgsfaktoren betrifft, auseinander bewegen. Dies spiegelt die Unterschiede in der technologischen Innovation und der wirtschaftlichen Entwicklung wider. Die Synergien werden daher sinken. Insbesondere das Speichergeschäft bleibt weiter durch den hohen Kapitalbedarf zur Erneuerung der Fertigungsprozesse und Verbesserung der Kostenposition gekennzeichnet. Hingegen entwickelt sich das Logikgeschäft zu einem anwendungs- beziehungsweise lösungsgeprägten Bereich, der eine kontinuierliche Produktentwicklung und spezialisierte Fertigung benötigt. Der intensive Kapitalbedarf im Speichergeschäft spiegelt die Notwendigkeit von kontinuierlichen Investitionen in aufwändige, effiziente und neueste Fertigungsstätten und Spitzenfertigungstechnologien wider. Der Einfluss der Fertigung ist im Logikgeschäft geringer. Bestimmte Bereiche des Logikgeschäfts (unser „advanced logic business“ besteht im Wesentlichen aus Basisband-ICs für Mobiltelefone und einer Angebotspalette aus Chipkarten, drahtgebundener Kommunikation, Mikrocontrollern sowie anderen kundenspezifischen ICs) sind gut darauf vorbereitet, die Produktionskapazität von Anbietern standardisierter Fertigungsprozesse für Halbleiter zu nutzen (die so genannte CMOS-Technologie). Bestimmte andere Bereiche des Logikgeschäfts, im Wesentlichen unser Power- und RF-IC-Geschäft, können sich auf hoch entwickelte, erheb-

lich weniger kapitalintensive Fertigungsprozesse stützen, die firmenintern beherrscht werden und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb sind. Darüber hinaus wird von den eingesetzten Technologien in den beiden Geschäften erwartet, dass sie sich weiter auseinander entwickeln. Dies resultiert unter anderem aus den unterschiedlichen Entwicklungspfaden – wobei sich der Speicherbereich überproportional stark auf die Prozesstechnologie konzentriert – und dem Erfordernis von Strategie- und Entwicklungsallianzen mit unterschiedlichen Partnern. Die Synergien hinsichtlich Konstruktionsmethoden und -geräten werden sehr eingeschränkt sein. Schlussendlich unterliegen die zwei Geschäftsbereiche einer sehr unterschiedlichen Finanzmarktdynamik, die für Investoren in einem zusammengefassten Geschäft weniger transparent sein könnten.

## ENTWICKLUNG DER ERTRAGSLAGE

### Reorganisation

Bis zum Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahrs 2005 war die Gesellschaft in vier Hauptsegmenten organisiert, davon waren drei Segmente anwendungsorientiert – Drahtgebundene Kommunikation, Sichere Mobile Lösungen und Automobil- und Industrieelektronik – und ein Segment produktorientiert – Speicherprodukte. Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 haben wir unsere Organisationsstruktur vereinfacht und schaffen damit insgesamt Unternehmen kürzere und schnellere Entscheidungswege, eine stärkere Ausrichtung auf unsere Kunden und eine höhere Effizienz und Flexibilität. Der Geschäftsbereich Mobile und das Segment Drahtgebundene Kommunikation wurden in dem neuen Segment Kommunikation gebündelt, um die Struk-

### Positionen der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung in % vom Umsatz

Geschäftsjahr zum 30. September <sup>1</sup>	2003	2004	2005
Umsatzerlöse	100,0	100,0	100,0
Umsatzkosten	-75,0	-64,9	-72,6
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>25,0</b>	<b>35,1</b>	<b>27,4</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	-17,7	-16,9	-19,1
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	-11,0	-10,0	-9,7
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	-0,5	-0,2	-1,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo	-1,4	-3,6	-1,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>-4,0</b>
Zinsergebnis	-0,8	-0,6	-0,1
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	0,3	-0,2	0,9
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhung bei assoziierten Unternehmen	-0,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	0,3	-0,9	0,4
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	0,1	0,3	0,0
<b>Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-5,7</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,8</b>
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,4	-2,1	-1,8
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>-4,6</b>

<sup>1</sup> Abweichungen durch Rundungsdifferenzen möglich.

tur der Gesellschaft entsprechend der Entwicklung im Markt anzupassen. Gleichzeitig haben wir das Sicherheits- und Chipkartengeschäft und das ASIC & Design-Solutions-Geschäft in das erweiterte Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket eingegliedert.

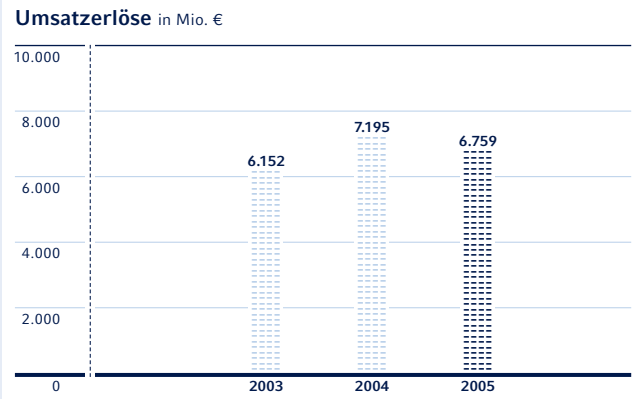
Somit ist die Gesellschaft in drei Hauptsegmenten organisiert, davon sind zwei Segmente anwendungsorientiert – Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket und Kommunikation – und ein Segment produktorientiert – Speicherprodukte. Diese Segmente entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen, die in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen eingesetzt werden.

Die Gesellschaft berichtet ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 unter der neuen Organisationsstruktur. Die Ergebnisse von früheren Berichtszeiträumen wurden entsprechend umgestellt, um einen Vergleich zum aktuellen Zeitraum zu ermöglichen.

### Umsatzerlöse

Wir generieren Erlöse im Wesentlichen aus dem Verkauf von Halbleiterprodukten und Systemlösungen. Zusätzliche Erlöse von weniger als 4 Prozent unserer Umsätze generieren wir mit Hilfe von Aktivitäten wie der Auftragsfertigung für verkaufte Geschäfte und Lizenzvergaben auf unser geistiges Eigentum. Unsere Halbleiterprodukte gliedern sich in zwei Hauptkategorien:

- Die Palette unserer Logikchip-Produkte wie Chips und Komponenten findet breite Anwendung in elektronischen Geräten zur drahtlosen Kommunikation (Mobilfunk und Bluetooth-Datenübertragung), Chipkarten, Modems und anderen drahtgebundenen Technologien wie DSL, Automobilelektronik und Industrietechnik.
- Die Palette unserer Speicherprodukte umfasst Dynamic-Random-Access-Memory (DRAM)-Chips für Computer und andere elektronische Geräte. Wir bieten außerdem eine begrenzte Palette nicht-flüchtiger Flash-Speicherprodukte an, die in der Konsumelektronik in Digitalkameras oder bei Mobiltelefonen Anwendung finden.



Starker Preisdruck in allen Segmenten lässt die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2005 zurückgehen.

Der Großteil der Verkäufe erfolgt über unseren direkten Vertrieb. Ungefähr 14 Prozent des Gesamtumsatzes wurden in den genannten Perioden über Distributoren getätigt.

Wir erzielen unsere Einkünfte aus Lizenzen über Stück- und Pauschalgebühren, indem wir an Dritte Lizenzen auf Technologien vergeben, deren Eigentümer wir sind. So können wir einen Teil unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen abdecken und erlangen oft gleichzeitig über Lizenzierungs- und Kapazitätsreservierungs-Vereinbarungen Zugang zu zusätzlichen Fertigungskapazitäten bei Auftragsherstellern. Wir erzielen die Lizenzeneinnahmen hauptsächlich im Segment Speicherprodukte. Diese entstanden durch Technologietransfer an unsere derzeitigen und ehemaligen Kooperationspartner wie Winbond, Nanya und ProMOS.

Unsere Umsatzerlöse schwanken auf Grund von verschiedensten Faktoren, unter anderem:

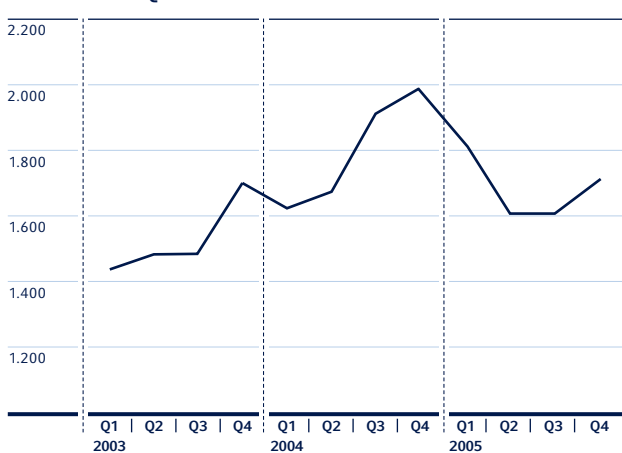
- Marktpreisen für unsere Produkte, insbesondere bei Speicherprodukten,
- unserem gesamten Produkt-Mix und unserem Verkaufsvolumen,
- der Phase im Lebenszyklus unserer Produkte sowie
- Wettbewerbseffekten und konkurrenzfähigen Preisstrategien.

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse</b>	6.152	7.195	6.759
Prozentuale jährliche Veränderung		17 %	-6 %
darin enthalten:			
Einkünfte aus Lizenzvergaben in Mio. €	183	76	175
Prozent des Umsatzes	3 %	1 %	3 %
Fremdwährungseffekte im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	-317	-445	-177
Prozent des Umsatzes	-5 %	-6 %	-3 %
Auswirkungen von Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr in Mio. €	126	29	2
Prozent des Umsatzes	2 %	0 %	0 %



Die Zunahme der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 war größtenteils von einer gesteigerten Nachfrage nach Speicherprodukten und Chips für Mobiltelefone und der weiterhin starken Entwicklung unseres Segments Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket getrieben. Im Geschäftsjahr 2005 sanken die Umsatzerlöse im Wesentlichen auf Grund der schwächeren Nachfrage nach Produkten im drahtlosen Bereich und wegen des Preisrückgangs bei Speicherprodukten. Die Lizenzeinnahmen sanken im Geschäftsjahr 2004 vor allem als Resultat reduzierter Lizenzerlöse mit ProMOS. Im Geschäftsjahr 2005 erhöhten sich die Lizenzeinnahmen als Folge einer mit ProMOS erreichten Einigung, wobei 118 Millionen Euro als Lizenzerlöse vereinnahmt wurden. Zusätzlich wurde der Umsatz durch die Schwäche der wichtigsten Fremdwährungen in Relation zum Euro (vorwiegend des US-Dollars) während der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 negativ beeinflusst. Der Fremdwährungseffekt im Vergleich zum Vorjahr wird ermittelt, indem der durchschnittliche Wechselkurs des vergangenen Jahrs als konstanter Wechselkurs auf die Umsatzerlöse des aktuellen Jahrs angewendet wird. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus zugekauften Aktivitäten seit Beginn des vergangenen Jahrs spiegelt vorwiegend die ganzjährige Konsolidierung der Umsätze im Jahr nach der Akquisition wider.

**Umsatz nach Quartalen** in Mio. €



Höhere Volumina lassen die Umsatzerlöse im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 wieder ansteigen.

## Umsatzerlöse nach Segmenten

### --- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

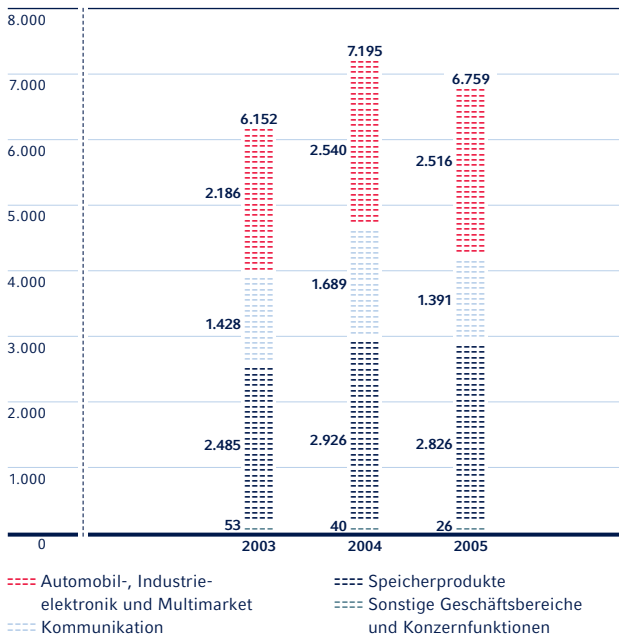
Das Segment setzte die Wachstumsphase im Geschäftsjahr 2004 fort, vor allem durch den Absatz von Automobilanwendungen. Dies resultierte aus einem steigenden Einsatz von Halbleitern in der Automobilelektronik, der stärker als der anhaltende Preisdruck durch technischen Fortschritt und Wettbewerb war. Die Umsatzsteigerung war überwiegend auch auf einen Volumenanstieg der Automobil- und Industrieprodukte und auf gestiegene Nachfrage nach Chipkarten und Sicherheitsprodukten zurückzuführen. Im Markt für Chipkarten-ICs waren wir im Geschäftsjahr 2003 einem anhaltenden Preisdruck ausgesetzt. Im Geschäftsjahr 2004 profitierte der Umsatz von einem geringeren Preisrückgang. Der Umsatz profitierte zudem von der ganzjährigen Konsolidierung von SensoNor AS („SensoNor“), die im Juni 2003 erworben worden war, und vom steigenden Absatz von Industrieapplikationen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004. Im Geschäftsjahr 2005 gingen die Umsätze in diesem Segment im Vergleich zum Geschäftsjahr 2004 leicht zurück, wobei sich das Wachstum mit Automobilanwendungen fortsetzte. Der Umsatzrückgang ist vorwiegend auf starken Preisdruck, kombiniert mit sinkenden Marktvolumina im Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs zurückzuführen.

### --- Kommunikation

Im Geschäftsjahr 2003 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 erlebten wir eine steigende Nachfrage nach digitalen Zugangsprodukten, da der Bedarf an DSL-Internetbasierter Kommunikation stieg und sich die Situation der Märkte in den Entwicklungsländern verbesserte. Ein gegenläufiger Trend war der Nachfragerückgang bei traditionellen analogen Kommunikationsprodukten, der in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2004 stärker ausgeprägt war als in den vorhergehenden Perioden. Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2004 lag vorwiegend im zweiten Halbjahr, da die Nachfrage nach mobilen Lösungen anzog. Im Jahresvergleich sank der Absatz im Geschäftsjahr 2005 im Segment Kommunikation aufgrund sinkender Umsätze im Geschäft für drahtlose Kommunikation. Die Ursachen sind sowohl ein Nachfragerückgang bei bestimmten Kunden von Basisband-Komponenten, beginnend mit dem zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005,

#### Geschäftsjahr zum 30. September

	2003		2004		2005	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	2.186	36	2.540	35	2.516	37
Kommunikation	1.428	23	1.689	24	1.391	21
Speicherprodukte	2.485	40	2.926	41	2.826	42
Sonstige Geschäftsbereiche	21	-	11	-	12	-
Konzernfunktionen	32	1	29	-	14	-
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>6.152</b>	<b>100</b>	<b>7.195</b>	<b>100</b>	<b>6.759</b>	<b>100</b>

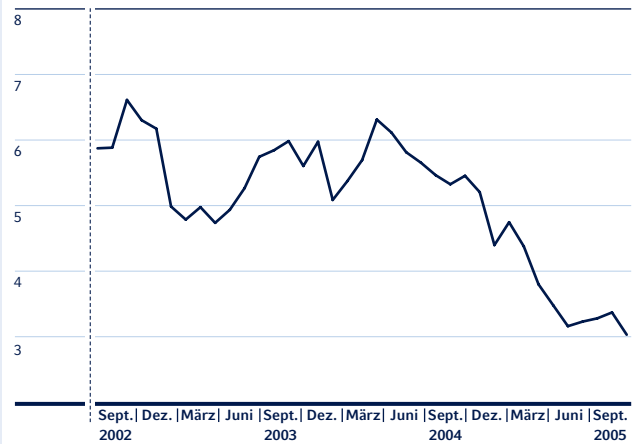
**Umsatzerlöse nach Segmenten** in Mio. €

Neben dem Preisdruck beeinflusste der Nachfragerückgang bei drahtloser Kommunikation die Umsatzerlöse in den Segmenten erheblich.

als auch der anhaltende Preisdruck. Dieser Rückgang konnte durch den stabilen Absatz drahtgebundener Produkte nicht ausgeglichen werden.

**--- Speicherprodukte**

Die Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2004 resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen, was den ungünstigen Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar und die geringeren Lizenzeinnahmen im Vergleich zum vorhergehenden Jahr mehr als ausgleichen konnte. Der Absatz wurde weiterhin von dem Produktionshochlauf der 300-Millimeter-Fertigung in Dresden, der Umstellung auf 110-Nanometer-Technologie und der zusätzlichen Kapazität aus der Kooperation mit Winbond und SMIC begünstigt, was den Rückgang der von ProMOS gekauften Produkte kompensierte. Das Absatzvolumen in Megabit erhöhte sich im Laufe des Geschäftsjahrs 2004 durch die gestiegene Nachfrage nach PCs und Datenspeichern. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2005 sank verglichen zum Vorjahr. Dies lag insbesondere an dem Preisdruck in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs, der nicht durch gestiegene Bit-Kapazität pro Chip und gestiegene Umsätze aus Lizenzen und bei Flash-Speicherprodukten kompensiert werden konnte. Zusätzlich erschwerend wirkte sich ein ungünstiger Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar aus. Die Produktionsvolumina stiegen im Geschäftsjahr 2005, da das Gemeinschaftsunternehmen Inotera hochgefahren wurde und Zugang zu zusätzlicher Kapazität durch un-

**DRAM-Preisentwicklung** DRAM-Marktpreis je 256-Mbit-Äquivalent in US-\$

Quelle: WSTS

sere Kooperation mit Winbond und SMIC geschaffen wurden. Generell wurde der Megabit-Absatz im Geschäftsjahr 2005 gesteigert. Ursachen waren gestiegene Marktnachfrage unter anderem bei PCs und Datenspeichern. Die Mehrheit der Umsätze mit Speicherprodukten war im ersten Halbjahr 2005 auf die 256-Megabit-DRAM zurückzuführen und im zweiten Halbjahr 2005 auf die 512-Megabit-DRAM, da sich der Markt zur nächsten Produktgeneration mit höherer Speicherdichte verlagerte.

Im Geschäftsjahr 2005 fielen die Preise in US-Dollar beider Hauptprodukte, DDR- und DDR2-Speicherbausteine, insbesondere während der saisonal schwächeren Phase zwischen Januar und April, drastisch. Ab April stabilisierten sich die DDR-Preise wieder, während die DDR2-Preise, vorwiegend wegen Angebotsüberschuss und eines langsamer als erwarteten Wechsels hin zu DDR2 als führendem Speicherstandard, weiter unter Druck blieben. Vertrags- und Spotmarktpreise folgten einem ähnlichen Trend. Die Preise pro Bit für SDRAM-Produkte kleinerer Speicherdichte fielen während des Geschäftsjahrs ebenfalls. Verglichen mit DDR und DDR2 verblieben die Preise allerdings auf höherem Niveau auf Grund ihres etablierten Charakters. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Produktangebot auszuweiten und unseren Produkt-Mix zu optimieren, um Preisdifferenzen ausgleichen zu können. Des Weiteren versuchen wir, uns verstärkt auf Produkte zu fokussieren, von denen wir erwarten, dass sie eine geringere Volatilität und höhere Margen aufweisen. Dazu zählen Produkte für Server, Konsumenten, hoch auflösende grafische und mobile Anwendungen. Unsere durchschnittlichen Megabit-Verkaufspreise sanken im Geschäftsjahr 2005 um zirka 27 Prozent.

**--- Sonstige Geschäftsbereiche**

Im Geschäftsjahr 2005 blieben die Umsatzerlöse relativ stabil.

### Umsatzerlöse nach Regionen und Kunden

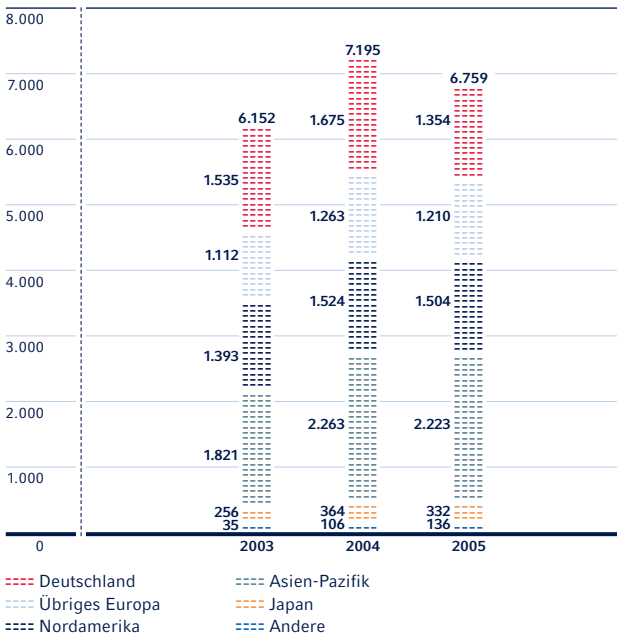
Im Geschäftsjahr 2005 sind unsere Umsatzerlöse in allen Regionen zurückgegangen. Dies ist vor allem eine Folge des Preisdrucks und einer geringeren Nachfrage nach Halbleiterprodukten, insbesondere nach Basisband-Komponenten im drahtlosen Geschäft in Deutschland.

Im Segment Kommunikation haben wir eine weitere Konsolidierung in der Industrie gesehen. Im Geschäftsjahr 2005 haben die größten Hersteller von Mobiltelefon Endgeräten Marktanteile zu Lasten anderer Wettbewerber gewonnen. Von der Übernahme der Siemens-Mobilfunksparte durch den taiwanesischen Konzern BenQ Corporation („BenQ“) erwarten

wir uns, dass ein Teil des Produktvolumens eines unserer größten Kunden für Mobiltelefonplattformen wegen der geringeren Herstellungskosten in Asien und den Schwellenländern dorthin transferiert wird. Die Anzahl unserer Kunden im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket blieb stabil. Im Geschäftsjahr 2005 haben wir mit unseren 20 größten Kunden nahezu 60 Prozent unserer Umsätze in diesem Segment erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2005 brachte im Zusammenhang mit einer Verlagerung der Produktionsstätten unserer Kunden von Deutschland in andere europäische Staaten, im Wesentlichen nach Osteuropa, eine Verlagerung unserer Umsatzerlöse in diese Länder. Die Anzahl der Kunden im Segment Speicherprodukte erhöhte sich auf Grund der Diversifikation unseres Produktportfolios. Demgegenüber verringerte sich die Kundendichte als Folge der Erhöhung der Kundenanzahl im Speicherbereich. Im Geschäftsjahr 2005 erwirtschafteten wir mit unseren 20 größten Kunden nahezu 80 Prozent der Umsätze in diesem Segment.

Auf den Siemens-Konzern entfielen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 14 Prozent, 13 Prozent und 13 Prozent unserer Umsatzerlöse. Der Umsatz mit Siemens beinhaltet sowohl Direktverkäufe an den Siemens-Konzern in Höhe von 13 Prozent, 13 Prozent und 12 Prozent für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 als auch Verkäufe an die Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Drittkunden in Höhe von 1 Prozent, 0 Prozent und 1 Prozent in den Jahren 2003, 2004 und 2005. Die Umsätze mit dem Siemens-Konzern werden hauptsächlich in den Nicht-Speicher-Segmenten getätigt. Auf keinen anderen Kunden entfielen 10 Prozent oder mehr unserer Umsatzerlöse in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2005 wurde die Siemens-Mobilfunksparte an den taiwanesischen Konzern BenQ verkauft. Wir nehmen zwar an, dass Siemens einer unserer größten Kunden im Geschäftsjahr 2006 bleiben wird, erwarten aber, dass sich auf Grund des Verkaufs dieser Sparte der Umsatz mit Siemens wesentlich verringern wird.

Umsatzerlöse nach Regionen in Mio. €



Verlagerung von Umsatzerlösen von Deutschland in andere europäische Staaten.

### Umsatzerlöse nach Regionen

Geschäftsjahr zum 30. September	2003		2004		2005	
	in Mio. €	%	in Mio. €	%	in Mio. €	%
Deutschland	1.535	25	1.675	23	1.354	20
Übriges Europa	1.112	18	1.263	18	1.210	18
Nordamerika	1.393	23	1.524	21	1.504	22
Asien-Pazifik	1.821	29	2.263	32	2.223	33
Japan	256	4	364	5	332	5
Andere	35	1	106	1	136	2
<b>Gesamt</b>	<b>6.152</b>	<b>100</b>	<b>7.195</b>	<b>100</b>	<b>6.759</b>	<b>100</b>

### Umsatzkosten – Bruttoergebnis vom Umsatz

Unsere Umsatzkosten enthalten hauptsächlich:

- direktes Material, das hauptsächlich Kosten für Rohwafer beinhaltet,
- Lohnkosten,
- Gemeinkosten einschließlich der Wartung der Produktionsanlagen, indirekter Materialien, der Betriebsmittel und Lizenzgebühren,
- Abschreibungen und Amortisation,
- Kosten für Zulieferer für Montage und Test,
- Fertigungsunterstützung inklusive Gebäudeflächen, Versorgungsanlagen, Qualitätskontrolle, Automatisierung und Leitungsfunktionen sowie
- Kosten für Auftragsfertigung.

Zusätzlich zu den umsatzbezogenen Faktoren ist die Bruttomarge beeinflusst durch:

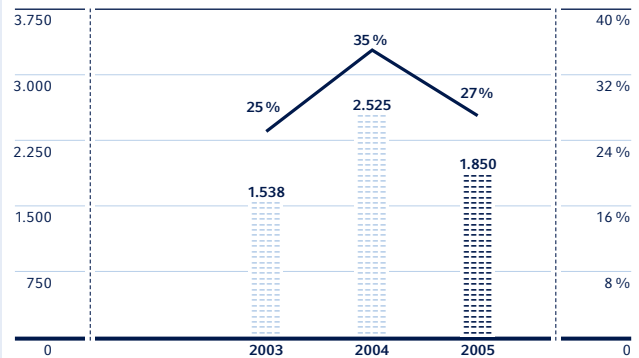
- Auslastung der Fertigungsstätten und damit verbundene Leerkosten,
- Abschreibung erworbener immaterieller Vermögensgegenstände,
- Produktgarantieleistungen,
- Wertberichtigungen für überschüssigen oder veralteten Lagerbestand sowie
- Zulagen und Zuschüsse, die über die wirtschaftliche Restlebensdauer der Fertigungsanlagen realisiert werden.

Die Kosten für die Materialbezüge von unseren Gemeinschaftsunternehmen und anderen verbundenen und assoziierten Unternehmen wie ALTIS und Inotera, und bis zum 1. Januar 2003 auch ProMOS, weisen wir unter den Umsatzkosten aus. Diese Bezüge von diesen Fertigungen und von assoziierten und verbundenen Unternehmen beliefen sich im Berichtsjahr 2005 auf 615 Millionen Euro, gegenüber 357 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2004 und 470 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2003.

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Umsatzkosten in Mio. €	4.614	4.670	4.909
Prozentuale jährliche Veränderung		1 %	5 %
Prozent des Umsatzes	75 %	65 %	73 %
Bruttoergebnis vom Umsatz	25 %	35 %	27 %

Der Anstieg des Bruttoergebnisses vom Umsatz im Geschäftsjahr 2004 war auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf die bessere Integration und die höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten in den meisten operativen

### Bruttomarge absolut in Mio. € und im Verhältnis zum Umsatz in %



Preisdruck und Leerkosten überkompensieren die Produktivitätsfortschritte.

Segmenten, eine beträchtliche Verbesserung der Kostenposition im Segment Speicherprodukte und ein verbessertes Preisumfeld im Vergleich zu den vergangenen Geschäftsjahren. Unser Bruttoergebnis vom Umsatz im Geschäftsjahr 2005 verschlechterte sich insbesondere als Folge der Leerkosten, des hohen Preisdrucks in den meisten unserer operativen Segmente sowie des weiterhin ungünstigen US-Dollar/Euro-Wechselkurses, insbesondere in unserem Segment Speicherprodukte, der nicht vollständig durch Produktivitätserhöhungen ausgeglichen werden konnte.

Das Bruttoergebnis vom Umsatz unserer operativen Segmente hat sich folgendermaßen entwickelt:

#### --- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Im Geschäftsjahr 2004 verbesserte sich das Bruttoergebnis vom Umsatz auf Grund von erhöhter Produktivität und Kosteneinsparungen infolge der Umstellung von 5-Zoll- auf 6-Zoll- und 8-Zoll-Wafer-Fertigung. Höhere Verkaufsmengen und eine bessere Kapazitätsauslastung der Fertigungsanlagen trugen zu einer besseren Effizienz bei und kompensierten damit negative Einflüsse, denen das Bruttoergebnis vom Umsatz durch den Preisdruck ausgesetzt war. Im Geschäftsjahr 2005 verschlechterte sich das Bruttoergebnis vom Umsatz auf Grund höherer Leerkosten im ersten Geschäftshalbjahr und eines starken Preisdrucks. Die negativen Effekte konnten nicht vollständig durch Produktivitätsmaßnahmen ausgeglichen werden.

#### --- Kommunikation

Das Bruttoergebnis vom Umsatz im Geschäftsjahr 2004 blieb stabil im Vergleich zum Geschäftsjahr 2003, trotz eines Rückgangs des Bruttoergebnisses vom Umsatz nach dem zweiten

Quartal des Geschäftsjahrs. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich von einem anhaltenden Preisrückgang bei den Access-Produkten ausgelöst. Im Geschäftsjahr 2005 verschlechterte sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Wesentlichen auf Grund von erhöhten Leerkosten.

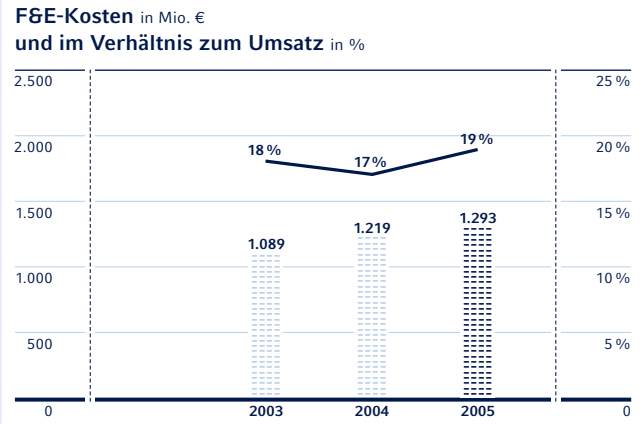
### --- Speicherprodukte

Die Verbesserung des Bruttoergebnisses vom Umsatz im Geschäftsjahr 2004 resultierte im Wesentlichen aus einer höheren Produktivität und geringeren Herstellungskosten, die wiederum auf die Umstellung auf die 140- und 110-Nanometer-Prozesstechnologie sowie auf die effiziente 300-Millimeter-Fertigung zurückzuführen war. Diese Faktoren konnten die negativen Effekte aus niedrigeren Verkaufspreisen im Geschäftsjahr 2004 mehr als kompensieren und führten zu einer signifikanten Erhöhung des Bruttoergebnisses vom Umsatz im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2004. Die Auswirkung von geringeren Lizenzeinnahmen auf das Bruttoergebnis vom Umsatz wurde teilweise durch verringerte Abschreibungen auf Grund erhaltener staatlicher Zulagen und Zuschüsse kompensiert. Das Bruttoergebnis ging im Geschäftsjahr 2005 zurück, da weitere Produktivitätserhöhungen und geringere Herstellungskosten aus der Umstellung auf die 110-Nanometer-Prozesstechnologie sowie ein erhöhter Anteil der 300-Millimeter-Fertigung die Effekte aus geringeren Verkaufspreisen und des ungünstigen US-Dollar/Euro-Wechselkurses nicht ausgleichen konnten.

### Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) umfassen vor allem Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen und Instandhaltung der Laboreinrichtungen, die wir für unsere F&E-Projekte benötigen, sowie Kosten aus vertraglich vereinbarter Technologieentwicklung. Materialkosten beinhalten Ausgaben für Wafer zu Entwicklungszwecken und Kosten aus Pilotprojekten, die vor dem Start der Serienproduktion anfallen. In den Aufwendungen für F&E sind die Vereinbarungen über die Entwicklungen von gemeinsamer Technologie mit

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Aufwendungen für F&E in Mio. €	1.089	1.219	1.293
Prozentuale jährliche Veränderung		12 %	6 %
Prozent des Umsatzes	18 %	17 %	19 %
Erworbene F&E-Aufwendungen in Mio. €	6	9	0
Prozent des Umsatzes	0 %	0 %	0 %
Zulagen und Zuschüsse in Mio. €	59	74	50
Prozent des Umsatzes	1 %	1 %	1 %



Fokus auf Entwicklung von fortschrittlichen Fertigungstechnologien und Produkten mit großem Wachstumspotenzial und Profitabilität.

unseren Partnern wie Nanya und IBM enthalten. Wir werden weiterhin unsere Investitionen auf die Entwicklung von fortschrittlichen Fertigungstechnologien sowie von Produkten mit großem Wachstumspotenzial und Profitabilität fokussieren.

Erworbene F&E-Aufwendungen beziehen sich vorwiegend auf die Akquisitionen von SensoNor im Geschäftsjahr 2003 und ADMtek Inc., Hsinchu, Taiwan („ADMtek“), im Geschäftsjahr 2004. Im Geschäftsjahr 2005 haben wir keine Akquisitionen durchgeführt, die erworbene F&E-Aufwendungen zur Folge hatten. Jede Position bezieht sich einzig auf die dazugehörige Akquisition und hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie dem Entwicklungsstand der Technologie und der antizipierten, künftigen Verwendung am Akquisitionstag.

Einige unserer F&E-Projekte erhalten Zulagen und Zuschüsse von lokalen und regionalen Behörden am Ort unserer Aktivitäten. Werden die Kriterien für solche Zuwendungen erfüllt, reduzieren die Zuschüsse die F&E-Aufwendungen über die Projektdauer, in der die Kosten anfallen.

### --- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Die Kosten für F&E stiegen im Geschäftsjahr 2004 in absoluten Zahlen auf Grund höherer F&E-Aufwendungen im Mikrocontroller-Bereich und bei Automobilanwendungen, blieben aber im Verhältnis zum Umsatz konstant. Die F&E-Aufwendungen stiegen im Geschäftsjahr 2005 leicht sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zum Umsatz. Die Erhöhung ergab sich im Wesentlichen im Geschäftsbereich Automotive & Power.

### --- Kommunikation

Die Aufwendungen für F&E stiegen im Geschäftsjahr 2004 sowohl absolut als auch in Relation zu den Umsatzerlösen. Der Anstieg ist auf erworbene F&E-Kosten in Verbindung mit der

Akquisition von ADMtek und auf erhöhte Anstrengungen bei Software- und Lösungsaktivitäten und der dritten Halbleitergeneration für Mobiltelefone zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2005 blieben die F&E-Aufwendungen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2004 in absoluten Zahlen relativ stabil und stiegen in Relation zum Umsatz. Das stetig hohe Niveau der F&E-Aufwendungen wurde in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2005 mit Fokus auf Software- und Lösungsaktivitäten und der dritten Halbleitergeneration für Mobiltelefone beibehalten. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2005 wurden die F&E-Aufwendungen in absoluten Zahlen verringert. Dies war die Folge erfolgreicher Effizienzverbesserungen, die in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs 2005 initiiert wurden.

#### --- Speicherprodukte

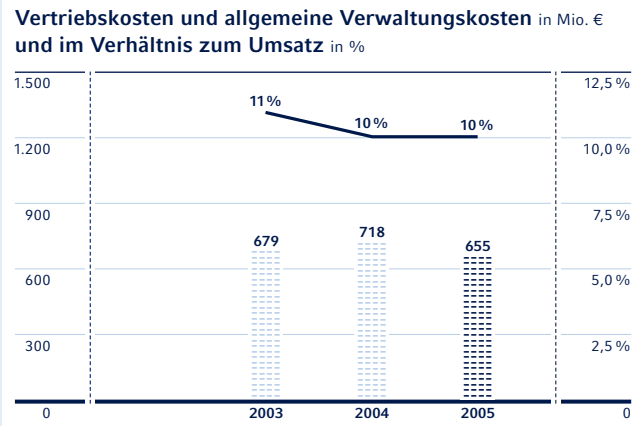
Die Aufwendungen für F&E stiegen im Geschäftsjahr 2004 absolut, verhielten sich aber konstant in Relation zu den Umsatzerlösen. Der Anstieg liegt in der stärkeren Fokussierung auf die Entwicklung von Standard-DRAM-Produkten und Flash-Technologien begründet, der nicht vollständig durch Effizienzgewinne in der gemeinsamen Entwicklung von DRAM-Produkten mit Nanya ausgeglichen werden konnte. Im Geschäftsjahr 2005 stiegen die F&E-Aufwendungen sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu den Umsatzerlösen. Die Ursache dafür ist in der beschleunigten Entwicklung neuer Speichertechnologiegenerationen und der Verbreiterung des Portfolios an Speicherprodukten zu sehen.

#### Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten

Die Vertriebskosten umfassen Personalkosten für die Mitarbeiter des Vertriebs und des Marketings, Kosten für Kundenmuster, Aufwendungen im Zusammenhang mit Prototypen, Verkaufsförderungsmaßnahmen und Marketingaufwendungen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten umfassen im Wesentlichen die Personalkosten der Mitarbeiter in der Verwaltung, nicht produktionsbezogene Gemeinkosten, Beratungshonorare, Rechtsanwaltskosten und andere Honorare für externe Dienstleister sowie Personalbeschaffungs- und Ausbildungskosten.

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten in Mio. €	679	718	655
Prozentuale jährliche Veränderung		6 %	-9 %
Prozent des Umsatzes	11 %	10 %	10 %



Reduzierte Vertriebs- und Verwaltungskosten durch Kosteneinsparungen in allen Bereichen.

Der geringe prozentuale Rückgang der Vertriebskosten und allgemeinen Verwaltungskosten im Geschäftsjahr 2004, gemessen an den Umsatzerlösen, wurde im Wesentlichen durch die Umsatzsteigerung hervorgerufen. Während des Geschäftsjahrs 2005 sind wir trotz der starken Erhöhung des Umsatzvolumens in der Lage gewesen, die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten als ein Resultat unserer Kostensparmaßnahmen speziell in den zentralen Konzernfunktionen und im Bereich der Informationstechnologien zu reduzieren.

Die Vertriebskosten stiegen absolut im Geschäftsjahr 2004 wegen des höheren Umsatzvolumens und der Expansion in der Region Asien-Pazifik und wurden teilweise durch Kostensenkungsprogramme in den Segmenten Kommunikation und Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket wieder kompensiert. Trotz des signifikanten Anstiegs des Umsatzvolumens konnten wir während des Geschäftsjahrs 2005 die Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten in absoluten Zahlen durch Kostenreduktion verringern.

Der Anstieg im Geschäftsjahr 2004 ist hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Informationstechnologien, Kosten für externe Dienstleister und Ausgaben in Verbindung mit der Erweiterung unserer Präsenz in den USA und Asien zurückzuführen, der aber teilweise durch unsere Kostensenkungsprogramme kompensiert werden konnte. Im Geschäftsjahr 2005 sanken die allgemeinen Verwaltungskosten als Folge genereller Kosteneinsparungen in allen Bereichen.

### Weitere Bestandteile der Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Restrukturierung in Mio. €	29	17	<b>78</b>
Prozent des Umsatzes	0 %	0%	<b>1 %</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo in Mio. €	85	257	<b>92</b>
Prozent des Umsatzes	1 %	4%	<b>1 %</b>
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften in Mio. €	18	-14	<b>57</b>
Prozent des Umsatzes	0 %	-0%	<b>1 %</b>
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo in Mio. €	21	-64	<b>26</b>
Prozent des Umsatzes	0 %	-1%	<b>0 %</b>

### Restrukturierung

Im Geschäftsjahr 2003 haben wir Rückstellungen für Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Verringerung von Gemeinkosten gebildet. In Verbindung mit unserer Entscheidung, verschiedene Entwicklungszentren im Geschäftsjahr 2004 zu schließen, entstanden Restrukturierungskosten, hauptsächlich für Abfindungszahlungen. Im Geschäftsjahr 2005 führten wir unsere Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen weiter. Diese Maßnahmen beinhalten die Verringerung unseres Personalbestandes und die Zusammenführung von Funktionen und Geschäftsbetrieben. Hauptsächlich bedingt durch die Schließung unseres Glasfaserkomponentengeschäfts in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie Restrukturierungsmaßnahmen der Clusterfertigung im Front-End-Bereich in München-Perlach, Regensburg und Villach wurde der Abbau von Arbeitsplätzen vereinbart. Die Produktion in München-Perlach wird zum größten Teil nach Regensburg und zu einem kleineren Anteil nach Villach verlagert.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo

Im Geschäftsjahr 2004 bestanden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (netto) im Wesentlichen aus Aufwendungen aus der Vereinbarung mit dem US-Bundesjustizministerium im kartellrechtlichen Verfahren und verbundenen Vereinbarungen mit Kunden sowie ähnlichen laufenden Ermittlungen in Europa. Ebenso war eine Wertberichtigung des Geschäfts- und Firmenwerts in Höhe von 71 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran im Geschäftsjahr 2001 enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2005 beinhalten im Wesentlichen Kosten in Höhe von 96 Millionen Euro aus der Neuorganisation von verschiedenen Geschäftsbereichen im Segment Kommunikation und Wertberichtigungen auf Goodwill und andere immaterielle Vermögensgegenstände.

### Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Die wichtigsten Beteiligungen sind ALTIS, Inotera (seit dem Geschäftsjahr 2003) und ProMOS (anteilig im Geschäftsjahr 2003). ProMOS und Inotera sind DRAM-Produzenten. Unser anteiliges Ergebnis unterliegt daher den Fluktuationen der DRAM-Preise und ist im Ergebnis des Segments Speicherprodukte enthalten.

Im Geschäftsjahr 2003 führte die Erholung der DRAM-Preise zu gesteigerten Erträgen bei ProMOS, vor unserem Ausstieg aus der Gemeinschaftsunternehmung. Verluste während der Hochlaufphase von Inotera trugen zu den Verlusten im Geschäftsjahr 2004 bei. Im Geschäftsjahr 2005 hat Inotera den Hauptteil zum positiven Ergebnis aus assoziierten Unternehmen beigetragen, resultierend aus dem Anlauf der Volumenproduktion im Gemeinschaftsunternehmen.

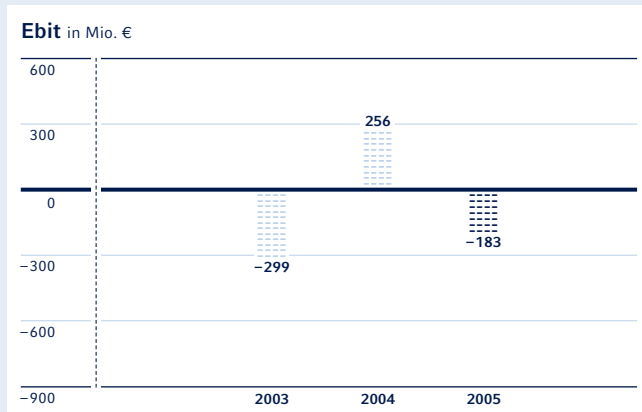
### Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo

Sonstige Erträge sind nicht unseren Kernaktivitäten direkt zugeordnet und können von Periode zu Periode aus vielfältigen Positionen bestehen, einschließlich der Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens. Im Geschäftsjahr 2004 bestehen die sonstigen Aufwendungen hauptsächlich aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen in Höhe von 65 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2005 bestanden die sonstigen Erträge aus Nettogewinnen aus derivativen Fremdwährungssicherungsgeschäften und Fremdwährungstransaktionen in Höhe von 40 Millionen Euro sowie aus einem Gewinn aus der Veräußerung unserer Venture-Capital-Aktivitäten in Höhe von 13 Millionen Euro. Diese Gewinne wurden teilweise durch Wertberichtigungen auf Beteiligungen in Höhe von 29 Millionen Euro aufgezehrt.

### Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit)

Wir definieren Ebit als Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management nutzt das Ebit als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Infineon berichtet Ebit-Daten, um Investoren aussagekräftige Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft im Allgemeinen und über die einzelnen operativen Segmente im Besonderen zur Verfügung zu stellen. Das Ebit wird wie folgt aus den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Konzernüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	<b>-312</b>
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom			
Ertrag	84	154	<b>120</b>
Zinsaufwendungen	52	41	<b>9</b>
<b>Ebit</b>	<b>-299</b>	<b>256</b>	<b>-183</b>



Preisdruck, schwacher US-Dollar/Euro-Wechselkurs und Sondereffekte beeinflussen das Ebit negativ.

Die Veränderung des Ebit ist das Resultat der unten aufgeführten Effekte innerhalb der Segmente:

#### --- Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Die Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2004 resultierte hauptsächlich aus einem höheren Verkaufsvolumen und einer verbesserten Effizienz in der Produktion, teilweise kompensiert durch den anhaltenden Preisdruck. Der Ebit-Rückgang im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus dem geringeren Bruttoergebnis vom Umsatz. Das Ebit wurde negativ beeinflusst durch Kosten des Produktionstransfers im Zusammenhang mit dem geplanten Auslaufen der Produktion in München-Perlach sowie Kosten in Verbindung mit der neuen Produktionsstätte in Kulim, Malaysia.

#### --- Kommunikation

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2004, hauptsächlich auf Grund geringerer Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs, die aber teilweise durch Verluste aus der Akquisition von ADMtek aufgezehrt wurden. Das Ebit des Geschäftsjahrs 2004 enthält die Wertberichtigung auf den Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von 71 Millionen Euro aus unserer Catamaran-Akquisition. Der höhere Ebit-Verlust im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus Kosten in Verbindung mit der Neuorganisation bestimmter Kommunikationsgeschäfte und Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 96 Millionen Euro sowie der Verringerung des Bruttoergebnisses vom Umsatz.

#### --- Speicherprodukte

Gründe für die Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2004 waren vorwiegend höhere Stückzahlen und die gestiegene Produktivität. Teilweise kompensiert wurde die Erhöhung von einem Rückgang der Lizenzeinnahmen, dem schwachen US-Dollar/Euro-Wechselkurs und von Aufwendungen im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Ermittlungen. Der Ebit-Rückgang im

Das Ebit verteilt sich wie folgt auf die Segmente<sup>1</sup>:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	148	252	134
Kommunikation	-213	-44	-295
Speicherprodukte	31	169	122
Sonstige Geschäftsbereiche	-50	-75	-4
Konzernfunktionen	-215	-46	-140
<b>Gesamt</b>	<b>-299</b>	<b>256</b>	<b>-183</b>

<sup>1</sup> Die Beträge der Vorjahre wurden an die aktuelle Darstellung angepasst.

Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus einem Preisrückgang bei DRAM-Produkten und einem schwachen US-Dollar/Euro-Wechselkurs sowie gestiegenen F&E-Aufwendungen, die im Wesentlichen aus einer beschleunigten Technologieentwicklung und der Erweiterung unseres Produktportfolios resultieren. Diese Effekte konnten nicht vollständig durch Produktivitätsverbesserungen und gestiegene Lizenzeinnahmen kompensiert werden.

#### --- Sonstige Geschäftsbereiche

Der Ebit-Verlust in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 spiegelt im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Finanzanlagen wider. Zur Ebit-Verbesserung im Geschäftsjahr 2005 trug ein Erlös von 13 Millionen Euro aus der Veräußerung von Venture-Capital-Aktivitäten bei.

#### --- Konzernfunktionen

Der Ebit-Verlust verringerte sich im Geschäftsjahr 2004 im Wesentlichen durch geringere unverrechnete Leerkosten als Folge verbesserter Auslastung. Die Ebit-Verschlechterung im Geschäftsjahr 2005 resultierte hauptsächlich aus Restrukturierungskosten in Höhe von 78 Millionen Euro in Verbindung mit dem geplanten Auslaufen der Produktion in der Fertigungsstätte München-Perlach und der Restrukturierung unseres Glasfaserkomponentengeschäfts.

#### Zinsergebnis

Zinserträge erzielen wir hauptsächlich aus Zahlungsmitteln und Wertpapieren. Zinsaufwendungen entstehen uns hauptsächlich aus Bankdarlehen und Wandelanleihen, abzüglich aktivierter Zinsen für im Bau befindliche Fertigungsgebäude.

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Zinsergebnis in Mio. €	-52	-41	-9
Prozent des Umsatzes	-1%	-1%	0%



Zinsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 hatten wir hauptsächlich aus unserer im Februar 2002 und der im Juni 2003 ausgegebenen Wandelanleihen. Zusätzlich beinhalteten die Zinsaufwendungen im Geschäftsjahr 2004 angefallene Zinsen in Höhe von 21 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit der Rückzahlung der rückgewährbaren Einlagen anderer Investoren an der Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG („SC300“), Dresden, gezahlt wurden. Diese Zinsaufwendungen wurden im Geschäftsjahr 2004 und 2005 teilweise durch den Rückkauf eines Teils unserer Wandelanleihen, durch gestiegene aktivierte Zinsen im Zusammenhang mit dem Bau von Fertigungsstätten und durch Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten reduziert.

### Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

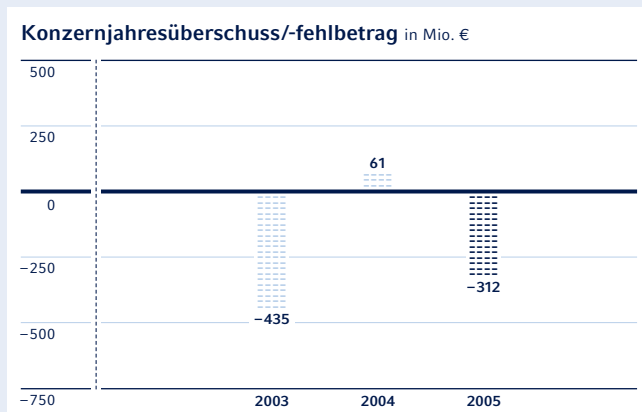
Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag in Mio. €	-84	-154	-120
Prozent des Umsatzes	-1%	-2%	-2%
Steuerquote	-24%	72%	-63%

Gemäß US-GAAP unterliegen aktive latente Steuern in Steuergebieten mit kumulativen Verlusten in den letzten drei Jahren einer Wertberichtigung, ohne dabei den Einfluss von erwarteten zukünftigen steuerpflichtigen Einkommen zu berücksichtigen. Im Geschäftsjahr 2003 wiesen wir eine Erhöhung der Wertberichtigung in Höhe von 182 Millionen Euro aus, die den realisierbaren Steuerertrag begrenzte. Wir erhöhten die Wertberichtigung infolge kumulativer Verluste in den letzten drei Jahren bis zum 30. September 2003 in bestimmten Steuergebieten. Trotzdem weisen wir im Geschäftsjahr 2003 Steueraufwendungen

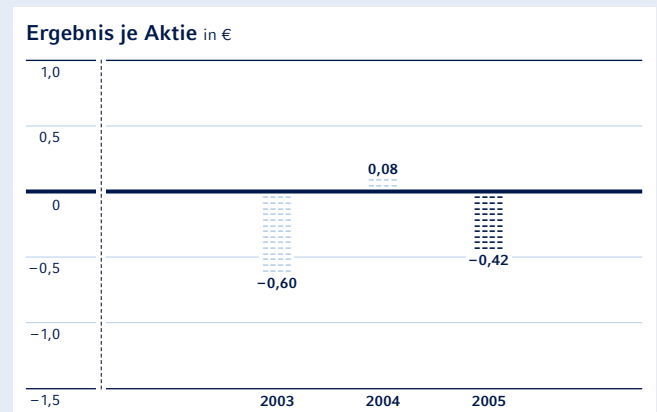
in profitablen Steuergebieten aus. Im Geschäftsjahr 2004 erhöhte sich unsere Steuerquote auf Grund von zusätzlichen Wertberichtigungen in Höhe von 54 Millionen Euro in Steuergebieten, die weiterhin kumulative Verluste in den letzten drei Jahren ausweisen, und höherer nicht abzugsfähiger Aufwendungen. Im Geschäftsjahr 2005, wie auch im Geschäftsjahr 2004, haben wir weiterhin einen kumulativen Verlust in den letzten drei Jahren in bestimmten Steuergebieten ausgewiesen und die Wertberichtigung in Höhe von 192 Millionen Euro erhöht, die den realisierbaren Steuerertrag begrenzte. Wir bewerten unsere latenten Steuern regelmäßig. Unsere Fähigkeiten zur Realisierung von Steuererträgen aus latenten Steuern hängen von der Möglichkeit ab, in Zukunft steuerliche Einkünfte zu erzielen und steuerliche Verlustvorträge sowie Steuervergünstigungen vor Eintritt der Verjährung zu nutzen. Wir erwarten, so lange keine Erträge für Steuern vom Einkommen und Ertrag in den besagten Steuergebieten auszuweisen, wie in diesen Steuergebieten über den Zeitraum der letzten drei Jahre ein kumulativer Verlust ausgewiesen wird.

### Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Konzernjahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2003 verringerte sich deutlich, hauptsächlich als Folge des Umsatzwachstums, der gesteigerten Effizienz in der Fertigung und von Kostensenkungsprogrammen. Auf Grund der Fortführung dieses Trends erreichten wir im Geschäftsjahr 2004 wieder die Profitabilität. Die positive Entwicklung wurde durch Wertberichtigungen, Aufwendungen für kartellrechtliche Verfahren und Steueraufwendungen reduziert. Der Konzernjahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2005 ergab sich im Wesentlichen aus einer Kombination von geringeren Umsatzerlösen, eines geringeren Bruttoergebnisses vom Umsatz, Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Restrukturierungsmaßnahmen und Steueraufwendungen.



Geringere Umsatzerlöse und Bruttomarge sowie Restrukturierungsaufwendungen führen zu einem Konzernjahresfehlbetrag.



**DARSTELLUNG DER VERMÖGENSLAGE**

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €			Veränderung in %
	2004	2005	
Umlaufvermögen	5.292	<b>4.574</b>	-14 %
Anlagevermögen	5.572	<b>5.710</b>	3 %
<b>Summe Aktiva</b>	<b>10.864</b>	<b>10.284</b>	-5 %
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.870	<b>2.382</b>	-17 %
Langfristige Verbindlichkeiten	2.016	<b>2.273</b>	13 %
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>4.886</b>	<b>4.655</b>	-5 %
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>5.978</b>	<b>5.629</b>	-6 %

Zum 30. September 2005 ging das Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Das Umlaufvermögen sank zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen worden war.

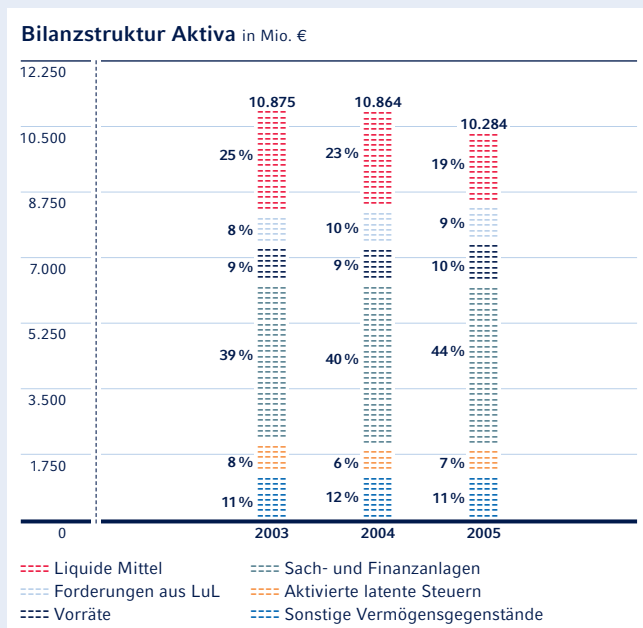
Das Anlagevermögen stieg zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 geringfügig an, da die Abschreibungen und Wertberichtigungen die Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen nahezu kompensierten.

Die gesamten Verbindlichkeiten sanken zum Ende des Geschäftsjahrs 2005 im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden

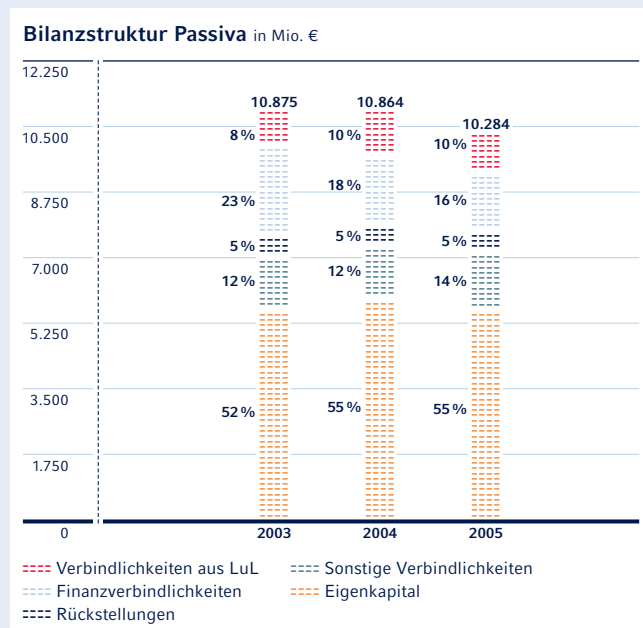
aufgenommen wurde. Gegenläufig dazu hat sich die Kreditaufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 175 Millionen Euro ausgewirkt. Die Verringerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten ergab sich im Wesentlichen auf Grund der Rückzahlung des Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro. Die langfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich leicht auf Grund der Aufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 175 Millionen Euro, die im Wesentlichen für die Finanzierung von F&E-Projekten und Fertigungsstätten in Portugal und Österreich bestimmt sind.

Im Geschäftsjahr 2005 reduzierte sich unser Eigenkapital im Wesentlichen durch den Konzernjahresfehlbetrag 2005. Die Eigenkapitalquote beträgt 55 Prozent zum 30. September 2005 (Vorjahr: 55 Prozent).

Im Geschäftsjahr 2005 betrug die Eigenkapitalrendite minus 5 Prozent, und die Gesamtkapitalrendite lag bei minus 3 Prozent gegenüber plus 1 Prozent im Geschäftsjahr 2004. Die Anlagendeckung sank auf Grund des Konzernjahresfehlbetrags sowie der Investitionen in Sachanlagen, die die planmäßigen Abschreibungen überstiegen, im Geschäftsjahr 2005 auf 150 Prozent im Vergleich zu 167 Prozent im Vorjahr. Die Verringerung des Verschuldungsgrads auf 30 Prozent im Geschäftsjahr 2005 (Vorjahr: 33 Prozent) war im Wesentlichen bedingt durch die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden stand.



Rückgang bei Liquide Mittel durch Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten.



Rückgang bei Finanzverbindlichkeiten durch Rückzahlung eines Darlehens.

## DARSTELLUNG DER FINANZLAGE

### Cash-Flow

Geschäftsjahr zum 30. September in Mio. €	2003	2004	2005
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von fortgeführten Geschäften	731	1.857	1.039
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522	-1.809	-238
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Finanzierungstätigkeit	566	-402	-266
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von aufgegebenem Geschäft	-1	-	-
Zahlungsmittel zum Ende des Geschäftsjahrs	969	608	1.148

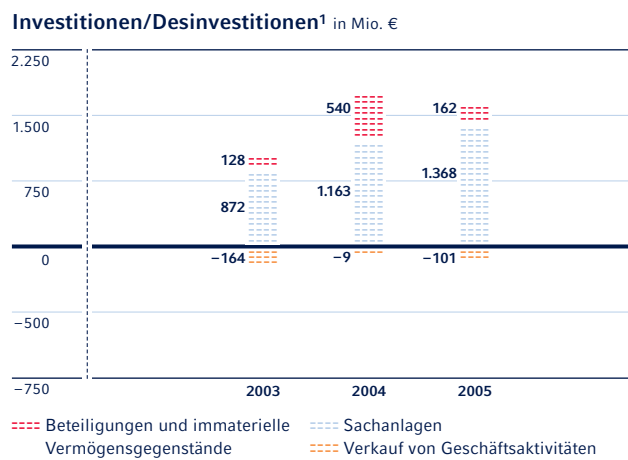
Der Cash-Flow zeigt Herkunft und Verwendung der Geldströme in den Berichtsperioden. Ihm kommt damit eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft zu.

Die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit und die Mittelzuflüsse aus Finanzierungstätigkeit sind jeweils indirekt zahlungsbezogen ermittelt. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird ausgehend vom Konzernjahresergebnis indirekt abgeleitet. Die Veränderungen von Bilanzpositionen sind um Effekte aus Währungsschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen bereinigt. Sie können deshalb nicht mit den entsprechenden Veränderungen in den Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2005 ergibt sich im Wesentlichen aus dem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 312 Millionen Euro, Abschreibungen in Höhe von 1.316 Millionen Euro, Wertberichtigungen in Höhe von 134 Millionen Euro und latenten Steuern in Höhe von 88 Millionen Euro. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde durch den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 119 Millionen Euro positiv beeinflusst. Diese Effekte wurden teilweise aufgehoben durch die Verringerung der Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 166 Millionen Euro.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2005 resultiert überwiegend aus Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 1.368 Millionen Euro, im Wesentlichen zum Ausbau unserer Fertigungsstätten in Dresden und Richmond, Investitionen in Höhe von 135 Millionen Euro in assoziierte Unternehmen, wie Inotera, der Netto-Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens in Höhe von 1.082 Millionen Euro sowie den Einzahlungen in Höhe von 101 Millionen Euro aus der Veräußerung von Geschäften.

Im Geschäftsjahr 2005 bestand der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit im Wesentlichen aus der Rückzahlung eines



Investitionen in Sachanlagen und Beteiligungen dienen der Verbesserung der Produktionsprozesse und dem Ausbau der Fertigungskapazitäten.  
 1 Ohne Wertpapiere.

Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen worden war.

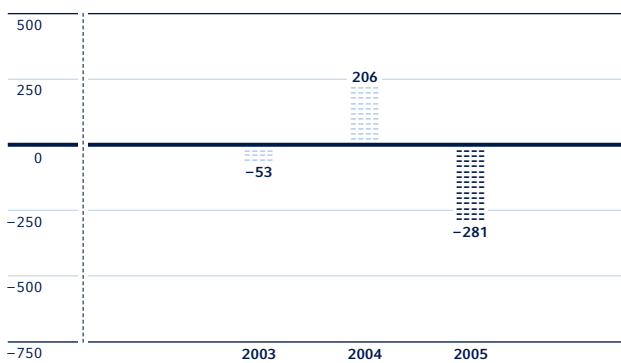
### Free-Cash-Flow

Wir definieren den Free-Cash-Flow als Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit, bereinigt um den Kauf und Verkauf von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren. Da wir einen Großteil unserer liquiden Mittel in Form von kurzfristig verfügbaren Wertpapieren halten und in einer kapitalintensiven Industrie tätig sind, berichten wir den Free-Cash-Flow. Damit wollen wir den Investoren eine Kennzahl zur Verfügung stellen, die die Veränderung der Liquidität unter Berücksichtigung von Investitionen zeigt. Das bedeutet nicht, dass der restliche verfügbare Cash-Flow für

sonstige Ausgaben verwendet werden kann, da Schuldendienstverpflichtungen oder andere feste Ausgaben noch nicht abgezogen sind. Der Free-Cash-Flow wird wie folgt aus den Konzern-Kapitalflussrechnungen hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit aller Geschäfte	730	1.857	1.039
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.522	-1.809	-238
Kauf/Verkauf von Wertpapieren, Saldo	739	158	-1.082
<b>Free-Cash-Flow</b>	<b>-53</b>	<b>206</b>	<b>-281</b>

#### Free-Cash-Flow in Mio. €



Die Mittelzuflüsse aus laufender Geschäftstätigkeit können die Mittelabflüsse aus Investitionstätigkeit, bereinigt um die Erlöse aus dem Verkauf von kurzfristigen Wertpapieren, nicht ausgleichen.

#### Netto-Zahlungsmittelbestand

Die folgende Tabelle stellt unseren Brutto- und Netto-Zahlungsmittelbestand sowie die Finanzverbindlichkeiten nach ihren Fälligkeiten dar. Die Darstellung ist kein Ausblick auf die verfügbaren Zahlungsmittel der künftigen Periode.

Zum 30. September 2005 in Mio. €, Zahlung fällig in:	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1-2 Jahren	2-3 Jahren	3-4 Jahren	4-5 Jahren	5 Jahren und länger
Zahlungsmittel	1.148	1.148	-	-	-	-	-
Wertpapiere des Umlaufvermögens	858	858	-	-	-	-	-
Brutto-Zahlungsmittelbestand	2.006	2.006	-	-	-	-	-
Abzüglich:							
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1.566	-	650	51	64	733	68
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristige Bestandteile langfristiger Finanzverbindlichkeiten	99	99	-	-	-	-	-
<b>Gesamte Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>1.665</b>	<b>99</b>	<b>650</b>	<b>51</b>	<b>64</b>	<b>733</b>	<b>68</b>
<b>Netto-Zahlungsmittelbestand</b>	<b>341</b>	<b>1.907</b>	<b>-650</b>	<b>-51</b>	<b>-64</b>	<b>-733</b>	<b>-68</b>

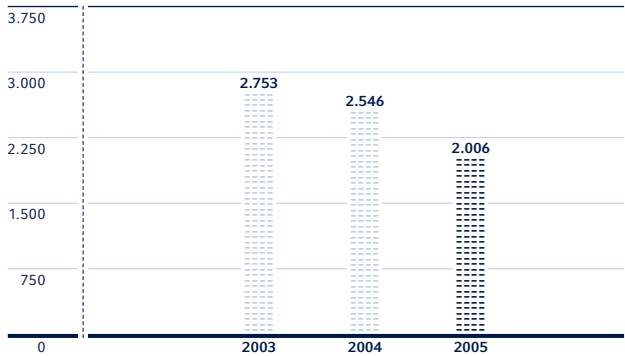
Unserer Brutto-Zahlungsmittelbestand – definiert als Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens – verringerte sich zum 30. September 2005 auf 2.006 Millionen Euro (Vorjahr: 2.546 Millionen Euro). Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 450 Millionen Euro, das im Zusammenhang mit dem Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden aufgenommen worden war.

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten hauptsächlich Wandelanleihen, die zur Stärkung unserer Liquidität ausgegeben wurden und uns eine gesteigerte finanzielle Flexibilität in der Führung unseres operativen Geschäfts ermöglichen. Der gesamte ausstehende Betrag der Wandelanleihen belief sich am 30. September 2005 auf 1.340 Millionen Euro.

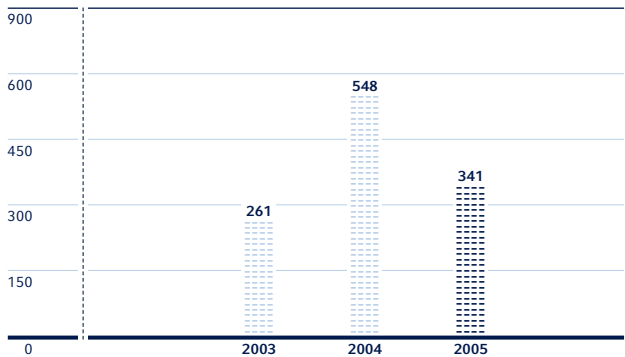
Am 5. Juni 2003 gaben wir nachrangige Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen Euro, mit Fälligkeit im Jahr 2010, im Rahmen eines an europäische institutionelle Investoren gerichteten verbindlichen Übernahmeangebots aus. Die Anleihen sind durch ihre Halter über die Laufzeit als Option wandelbar zu einer maximalen Anzahl von 68,4 Millionen Stammaktien und zu einem Wandelpreis von 10,23 Euro pro Aktie.

Am 6. Februar 2002 gaben wir nachrangige Wandelanleihen im Wert von 1.000 Millionen Euro, mit Fälligkeit im Jahr 2007, im Rahmen eines an europäische institutionelle Investoren gerichteten verbindlichen Übernahmeangebots aus. Die Anleihen sind durch ihre Halter über die Laufzeit als Option wandelbar zu einer maximalen Anzahl von 28,2 Millionen Stammaktien und zu einem Wandelpreis von 35,43 Euro pro Aktie. Während des Geschäftsjahrs 2004 kauften wir im Kalenderjahr 2007 fällige Wandelanleihen im Wert von 360 Millionen Euro zurück. Der ausstehende Betrag beläuft sich auf 640 Millionen Euro zum 30. September 2005.

Die Netto-Cash-Position – Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens abzüglich Finanzverbindlichkeiten (Kurz- und langfristige) – reduzierte sich um 207 Millionen Euro auf 341 Millionen Euro zum 30. September 2005 (Vorjahr: 548 Millionen Euro), hauptsächlich wegen des negativen Free-Cash-Flows in Höhe von 281 Millionen Euro.

**Brutto-Cash-Position** in Mio. €

Die Brutto-Cash-Position verringerte sich durch Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten.

**Netto-Cash-Position** in Mio. €

Durch das negative Ergebnis wurde die positive Netto-Cash-Position reduziert.

Zur Sicherung unserer Cash-Position und zur Gewährleistung flexibler Liquidität haben wir eine Richtlinie implementiert, die das Anlagevolumen bezüglich Geschäftspartner, Rating, Branche, Laufzeit und Instrument begrenzt.

**Kapitalbedarf**

Im Geschäftsjahr 2006 benötigen wir Kapital zur

- Finanzierung der operativen Geschäftstätigkeit,
- Rückzahlung fälliger Darlehen,
- Zahlung unserer Eventualverpflichtungen, sofern sie eintreten, und
- planmäßigen Durchführung von Investitionen.

Wir erfüllen diese Anforderungen durch

- Cash-Flow aus dem laufenden Geschäft,
- verfügbare Zahlungsmittel und veräußerbare Wertpapiere sowie
- verfügbare Kreditlinien.

Zum 30. September 2005 benötigen wir für das Geschäftsjahr 2006 Geldmittel in Höhe von 1.618 Millionen Euro, bestehend aus 99 Millionen Euro für kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und 1.519 Millionen Euro für vertragliche Verpflichtungen. Zusätzlich könnten 166 Millionen Euro derzeit bekannte Eventualverpflichtungen auftreten. Wir planen, maximal weitere 700 Millionen Euro für Investitionen in Sachanlagen aufzuwenden, für die wir noch keine Verpflichtungen eingegangen sind. In der Summe beläuft sich der Kapitalbedarf für finanzielle Verpflichtungen, Eventualverpflichtungen und geplante Investitionsaufwendungen für das Geschäftsjahr 2006 am 30. September 2005 auf 2.484 Millionen Euro. Unser Brutto-Zahlungsmittelbestand beläuft sich am 30. September 2005 auf 2.006 Millionen Euro, und wir können 1.149 Millionen Euro aus den verfügbaren Kreditlinien finanzieren.

Zum 30. September 2005 weisen wir Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 99 Millionen Euro aus, die innerhalb eines Jahres fällig werden.

## Vertragliche Verpflichtungen und Eventualverpflichtungen

Zum 30. September 2005 <sup>1,2</sup> in Mio. €, Zahlung fällig in:	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	5 Jahren und länger
<b>Vertragliche Verpflichtungen:</b>							
Zahlungen aus Leasingverträgen	850	94	71	61	56	54	514
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.505	1.379	45	24	9	9	39
Andere langfristige Verpflichtungen	138	46	46	46	–	–	–
<b>Summe vertragliche Verpflichtungen</b>	<b>2.493</b>	<b>1.519</b>	<b>162</b>	<b>131</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>553</b>
<b>Eventualverpflichtungen:</b>							
Garantien	462	99	204	23	5	–	131
Bedingte Zulagen und Zuschüsse <sup>3</sup>	516	67	101	128	42	55	123
<b>Summe Eventualverpflichtungen</b>	<b>978</b>	<b>166</b>	<b>305</b>	<b>151</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>254</b>

Die oben stehende Tabelle sollte im Zusammenhang mit Anhang Nr. 31 zu unserem Konzernabschluss des Geschäftsjahrs 2005 gelesen werden.

- Oben stehende Tabelle enthält bestimmte Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen. Die wahrscheinliche Fälligkeit wurde von der Gesellschaft abgeschätzt. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.
- Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2005 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen zirka 950 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2005.
- Bedingte Zulagen und Zuschüsse beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und nicht anderweitig garantiert sind. Diese müssen gegebenenfalls zurückerstattet werden, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

## Investitionen

Geschäftsjahr zum 30. Sept. in Mio. €	2003	2004	2005
Speicherprodukte	576	716	921
Logik-Produkte	296	447	447
<b>Gesamt</b>	<b>872</b>	<b>1.163</b>	<b>1.368</b>

Abhängig von der Geschäftssituation erwarten wir, im Geschäftsjahr 2006 zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro in Sachanlagen zu investieren, größtenteils in unsere Fertigungsstätten in Richmond/Virginia, USA und Kulim, Malaysia. Wir werden auch fortlaufend die Produktivität in unseren Fertigungsstätten verbessern und die Technologie, vor allem in Dresden, weiterentwickeln. Zum 30. September 2005 waren davon ungefähr

650 Millionen Euro fest vereinbart; sie sind in den unbedingten Abnahmeverpflichtungen enthalten. Auf Grund der Länge des Zeitraums zwischen der Bestellung und der Lieferung von Anlagen sind üblicherweise erhebliche Investitionsbeträge vorab festgelegt. Etwa 50 Prozent der erwarteten Investitionen sollen auf die Front-End- und die Back-End-Fabriken des Segments Speicherprodukte entfallen.

## Kreditlinien

Wir haben verschiedene voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart. Diese Kreditlinien haben eine Höhe von 1.491 Millionen Euro, von denen 1.149 Millionen Euro zum 30. September 2005 verfügbar waren. Die Kreditlinien bestehen aus den folgenden vier Gruppen:

Kreditlinien in Mio. €			Zum 30. September 2005		
Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
Kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien	120	51	69
Kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital, Cash-Management	305	–	305
Langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	731	–	731
Langfristig <sup>1</sup>	feste Zusage	Projektfinanzierung	335	291	44
<b>Gesamt</b>			<b>1.491</b>	<b>342</b>	<b>1.149</b>

<sup>1</sup> Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Im September 2004 haben wir einen 400 Millionen US-Dollar/400 Millionen Euro-Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart. Dieser Kredit besteht aus zwei Tranchen: Tranche A umfasst 400 Millionen US-Dollar und ist zur Finanzierung der Erweiterung der Produktionsanlagen am Standort Richmond/Virginia, USA vorgesehen. Tranche B ist eine revolvingende 400 Millionen Euro Mehrwährungskreditlinie, die für generelle betriebliche Zwecke genutzt werden kann. Der maximal ausstehende Betrag der Tranche A reduziert sich durch ab dem 30. September 2006 einsetzende gleichmäßige Rückzahlungen. Die neue Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Zum 30. September 2005 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Der Zinssatz schwankt in Abhängigkeit von einer Profitabilitäts-Kennzahl. Gegenüber den Darlehensgebern der dargestellten 400 Millionen US-Dollar/400 Millionen Euro Kreditlinien wurde eine Negativerklärung bezüglich der Bestellung von nicht zugelassenen Sachversicherungen abgegeben.

Im Mai 2005 haben wir einen 124 Millionen Euro Projektfinanzierungskredit auf unbesicherter Basis für den Ausbau der Produktionsstätte in Porto, Portugal, vereinbart. Zum 30. September 2005 haben wir einen Betrag in Höhe von 80 Millionen Euro dieses Kredits in Anspruch genommen. Zum 30. September 2005 halten wir die geforderten Bilanzrelationen in Bezug auf die entsprechenden Kreditlinien ein.

Nach unserer Planung soll die Finanzierung des Nettoumlaufvermögens und des übrigen Finanzmittelbedarfs aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, Darlehen, staatlichen Zulagen und Zuschüssen, falls notwendig, durch die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente erfolgen. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch staatliche Zulagen und Zuschüsse beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Wir können nicht garantieren, dass wir in der Lage sein werden, zusätzlich Finanzmittel für F&E, zur Finanzierung des Nettoumlaufvermögens oder für andere Investitionen zu günstigen Konditionen beschaffen zu können.

Unter Berücksichtigung der verfügbaren finanziellen Ressourcen einschließlich der intern generierten Zahlungsmittel und der derzeit verfügbaren Kreditlinien erwarten wir, in der Lage zu sein, unseren derzeit geplanten Kapitalbedarf für das Geschäftsjahr 2006 bedienen zu können.

### Finanzierung der Pensionsverpflichtungen

Der Anwartschaftsbarwert (PBO) unserer Gesellschaft, der künftige Gehaltssteigerungen berücksichtigt, betrug 477 Millionen Euro zum 30. September 2005 im Vergleich zu 349 Millionen Euro zum 30. September 2004. Der Marktwert des Planvermögens betrug 243 Millionen Euro zum 30. September 2005 im Vergleich zu 204 Millionen Euro zum 30. September 2004.

Für das nächste Geschäftsjahr haben wir eine Rendite auf das Planvermögen in Höhe von 6,5 Prozent oder 14 Millionen Euro für inländische Pensionspläne und in Höhe von 6,7 Prozent oder 2 Millionen Euro für ausländische Pensionspläne geschätzt. Die tatsächliche Gesamtrendite auf das Planvermögen zwischen den letzten Fälligkeitszeitpunkten betrug für inländische Pensionspläne 10,9 Prozent oder 19 Millionen Euro und für ausländische Pensionspläne 6,7 Prozent oder 2 Millionen Euro. Die erwartete Gesamtrendite auf das Planvermögen für diesen Zeitraum betrug für inländische Pensionspläne 7,3 Prozent und für ausländische Pensionspläne 6,9 Prozent.

Zum 30. September 2004 und 2005 wies der zusammengefasste Finanzierungsstatus für unsere Pensionspläne eine Unterdeckung von 145 Millionen Euro und 234 Millionen Euro auf. Die Gesellschaft schätzt, dass die aggregierten Zuschüsse zu den Pensionsplänen während des Geschäftsjahrs 2006 die Zuschüsse im Geschäftsjahr 2005 maßgeblich übersteigen werden.

Unsere Investitionsstrategie für den Pensionsplan beinhaltet ein gewisses Maß an Flexibilität, um sich ergebende Anlagechancen frühestmöglich ergreifen zu können. Gleichzeitig stellen angemessene Kennzahlen sicher, dass die Vorsichts- und Sorgfaltspflichten bei der Ausführung des Investitionsprogramms erfüllt werden. Das Vermögen des Pensionsfonds wird von mehreren Anlageberatern angelegt. Die Pläne sehen eine Kombination aus aktiven und passiven Investitionsprogrammen vor. Unter Berücksichtigung der Laufzeit der zu Grunde liegenden Verpflichtungen wird ein Portfolio der Investitionen des Planvermögens, bestehend aus Anteils-, Gläubiger- und anderen Wertpapieren, angestrebt, um die langfristige Gesamtkapitalrendite bei einem bestimmten Risiko zu maximieren. Das Investitionsrisiko wird durch laufende periodenweise Prüfungen des Portfolios, durch Meetings mit Anlageberatern und durch Verbindlichkeitsberechnungen kontrolliert. Die Investitionsmethoden und -strategien werden periodisch überprüft, um sicherzustellen, dass die Ziele der Versorgungspläne, unter Berücksichtigung jeder Änderung im Aufbau des Versorgungsplans, der Marktbedingungen oder anderer wesentlicher Punkte, erreicht werden.

Die Verteilung unseres Planvermögens auf das Anlagevermögen des Pensionsplans basiert auf der Einschätzung der Geschäfts- und Finanzlage, ferner auf demographischen und versicherungsmathematischen Daten, Finanzierungsmöglichkeiten, geschäftsbezogenen Risikofaktoren, Marktsensitivitätsanalysen und anderen relevanten Faktoren. Insgesamt soll die Verteilung der Sicherung des Planvermögens dienen und gleichzeitig für ausreichend stabile, also beispielsweise inflationsbereinigte Einkünfte sorgen, um sowohl derzeitige wie auch künftige Pensionszusagen zu erfüllen. Auf Grund des aktiven Portfoliomanagements kann die tatsächliche Verteilung des Anlagevermögens, innerhalb bestimmter Grenzen, von der geplanten Verteilung abweichen. Gemäß unseren Richtlinien investieren die Pensionspläne nicht in eigene Aktien.

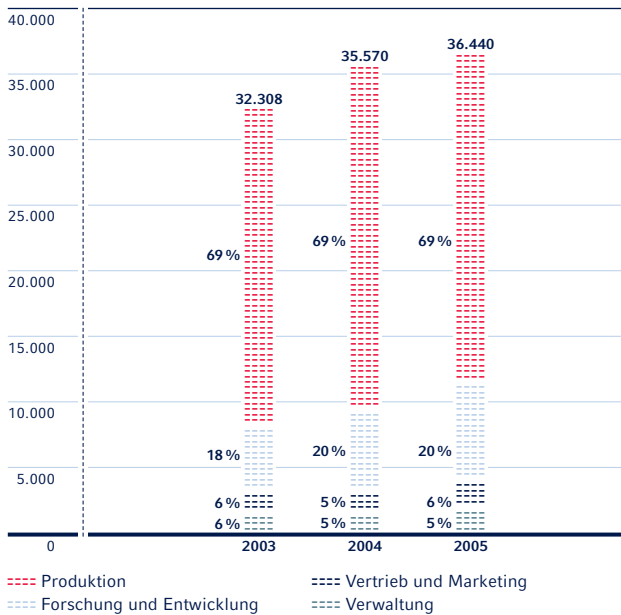
## MITARBEITER UND CAMPEON

### Mitarbeiter

Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung unserer Belegschaft nach Regionen und Funktionen jeweils zum 30. September der genannten Geschäftsjahre.

Zum 30. September	2003	2004	2005
<b>Funktionen:</b>			
Produktion	22.405	24.540	<b>25.114</b>
Forschung und Entwicklung	5.935	7.160	<b>7.401</b>
Vertrieb und Marketing	2.048	1.948	<b>2.016</b>
Verwaltung	1.920	1.922	<b>1.909</b>
<b>Gesamt</b>	<b>32.308</b>	<b>35.570</b>	<b>36.440</b>
<b>Regionen:</b>			
Deutschland	16.166	16.387	<b>16.119</b>
Übriges Europa	5.034	5.631	<b>5.482</b>
Nordamerika	2.757	2.982	<b>3.193</b>
Asien-Pazifik	8.116	10.340	<b>11.451</b>
Japan	118	133	<b>158</b>
Andere	117	97	<b>37</b>
<b>Gesamt</b>	<b>32.308</b>	<b>35.570</b>	<b>36.440</b>

### Mitarbeiter in den Bereichen<sup>1</sup>



Weiterhin hoher Mitarbeiterereinsatz zu Gunsten von Forschung und Entwicklung.  
1 Rundungsdifferenzen sind möglich.

Im Geschäftsjahr 2004 waren vorwiegend die Erweiterungen der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Malaysia und China für die Einstellung weiterer Mitarbeiter ausschlaggebend. Im Geschäftsjahr 2005 setzte sich dieser Trend in Malaysia und China fort.

### Campeon

Wir haben einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG („MoTo“) über einen Bürokomplex im Süden Münchens abgeschlossen, der von MoTo errichtet worden ist. Dieser Bürokomplex, genannt Campeon, ermöglicht uns, die meisten Mitarbeiter, die derzeit über verschiedene Standorte im Raum München verteilt sind, in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammenzuführen. MoTo war für den Bau verantwortlich, der in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2005 fertig gestellt worden ist. Wir haben keine Finanzierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen. Wir haben das Leasingobjekt im Oktober 2005 übernommen und mit dem stufenweisen Umzug unserer Mitarbeiter zum neuen Standort begonnen.

## RISIKEN UND CHANCEN

### Vorbemerkung

Das Halbleitergeschäft ist wie kaum ein anderes Geschäft in sehr hohem Maße durch den regelmäßigen Wechsel von Perioden des Marktwachstums mit Perioden der Marktrückgänge gekennzeichnet. Marktrückgänge sind insbesondere geprägt durch Überkapazitäten, steigende Auftragsstornierungen sowie überdurchschnittlich sinkende Preise und rückläufige Umsatzerlöse. Ergänzt wird diese Risikolage durch den sehr hohen Investitionsbedarf zur Erreichung und Absicherung der Marktführerschaft sowie den außerordentlich schnellen technologischen Wandel. Diesen hohen Risiken stehen im Halbleitergeschäft allerdings auch vergleichsweise größere Chancen gegenüber.

### Das Risikomanagementsystem bei Infineon Technologies

Gerade wegen der hohen Volatilität des Halbleitergeschäfts ist die Risiko- und Chancenpolitik insbesondere auf die Erreichung beziehungsweise Absicherung eines nachhaltig profitablen Wachstums ausgerichtet. Frühzeitige Reaktion auf die sich verändernden Marktbedingungen sind hierbei dringend erforderlich. Wir haben deshalb ein unternehmensweites Risiko- und Chancenmanagementsystem installiert, das uns in die Lage versetzt, die sich aus dem Markt heraus ergebenden Chancen und Risiken zu identifizieren beziehungsweise zu antizipieren. Der alle Bereiche umfassende Ansatz und die zugehörige Berichterstattung als zentrales Element des Risiko- und Chancenmanagementsystems geben der Unternehmensleitung die Möglichkeit, schnell und effektiv zu handeln. In jedem Bereich des Unternehmens sind Risikobeauftragte und Risikoberichterhalter benannt, die für die Umsetzung des Reporting-Prozesses Verantwortung tragen. Der Reporting-Prozess sieht vor, dass Risiken und Chancen in Risiko- beziehungsweise Chancenkategorien



eingeteilt und zusammen mit einer Einschätzung des wahrscheinlichen Eintritts und ihrer Auswirkungen, gemessen in Ebit, berichtet werden.

Das Risiko- und Chancenmanagementsystem ist umfassend in unserem Intranet dokumentiert und damit für unsere Mitarbeiter weltweit zugänglich.

Das System basiert auf individuellen Beobachtungen, unterstützt durch entsprechende Managementprozesse, und ist in unsere Kernaktivitäten integriert. Es beginnt bei der strategischen Planung und setzt sich über die Fertigung und den Vertrieb einschließlich des Forderungsmanagements fort. Als eine Erweiterung des Planungsprozesses dient das Risiko- und Chancenmanagementsystem zur Identifikation und Bewertung möglicher Abweichungen von erwarteten Entwicklungen. Neben der Identifikation und Bewertung von wesentlichen Entwicklungen, die unser Geschäft beeinflussen können, wird das System auch herangezogen, um Aktivitäten zu priorisieren und zu implementieren, um Chancen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren.

Die Geschäftseinheiten erstellen regelmäßig Risiken- und Chancenberichte, die den Kern des Risiko- und Chancenmanagementsystems darstellen. Die Berichte werden vom Vorstand und von den Geschäftsbereichsverantwortlichen bewertet und sind Teil des Berichtsprozesses.

Neben diesem zentralen System wird die Methodik der quantitativen Risikoanalyse im Rahmen von Investitions- beziehungsweise F&E-Projekten eingesetzt, um größere Transparenz zu erzeugen und entsprechende Maßnahmen, die zum Erfolg der Projekte führen können, abzuleiten. Die durch Simulationen unterstützte Analyse von quantifizierbaren Risiken ist hier fester und integrativer Bestandteil des Managements von F&E-Projekten. Des Weiteren wird die Methodik der quantitativen Risikoanalyse bei Finanzentscheidungen wie Investments oder bei Umsatzprognosen eingesetzt. Ziel ist, neben der Risikobewertung eine Analyse und Bewertung von risikominimierenden Maßnahmen unter Ausnutzung quantifizierbarer Unsicherheiten sicherzustellen.

Die systematische Weiterentwicklung bestehender und neuer Systeme mit Frühwarncharakter trägt maßgeblich zur weiteren Festigung und zum gezielten Ausbau unserer unternehmensweiten Risiko- und Chancenkultur bei. Diese wird auch unterstützt durch regelmäßig stattfindende Risiko/Chancenforen, die vorrangig als Diskussionsbasis und Informationsplattform dienen und so das Bewusstsein für diese wichtige Thematik weiter stärken.

Im Rahmen einer jährlich durchzuführenden Risikomanagementsystemanalyse (RMSA) werden über einen Fragenkatalog in den Geschäfts- und Zentralbereichen die Elemente des Risi-

komanagementsystems systematisch hinterfragt und so zwangsläufig Schwachstellen identifiziert. Die RMSA dient damit zum einen der Selbstbeurteilung mit anschließenden gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Subsysteme und zum anderen der Unterstützung der Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision und den externen Wirtschaftsprüfer.

Das Risikofrüherkennungssystem ist vom Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft worden. Der Abschlussprüfer hat bestätigt, dass der Vorstand die nach §91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen, insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems, in geeigneter Weise getroffen hat und das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

### Gesamtwirtschaftliche Risiken

Durch Veränderungen in einigen geographischen Teilen der Welt, in denen wir aktiv sind, könnten Risiken entstehen. Unsere weltweite Strategie sieht vor, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen Entwicklungs- und Fertigungsstandorte über den ganzen Globus verteilt unterhalten. Dies können Marktzugangs- oder auch Technologie- sowie Kostengründe sein. Mehr als die Hälfte unserer Umsatzerlöse wird außerhalb Europas generiert. Mit den weiterhin zu erwartenden hohen Wachstumsraten in asiatischen Ländern wird unsere Investitionstätigkeit in dieser Region weiter zunehmen. Es können daher Risiken entstehen, die sich daraus ergeben, dass

- wirtschaftliche und geopolitische Krisen Auswirkungen auf regionale Märkte haben,
- länderspezifische Gesetze und Regelungen den Investitionsrahmen und die Möglichkeiten, freien Handel zu betreiben, beeinflussen und
- unterschiedliche Praktiken bei der Auslegung von steuerlichen, juristischen oder administrativen Regeln die Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten eingrenzen.

Substanzielle Veränderungen in dem jeweiligen Umfeld können negative Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Es ist daher nicht auszuschließen, dass regionale Krisen wie in der Vergangenheit zum Beispiel SARS auch in Zukunft negative Auswirkungen auf unsere Ertragsfähigkeit haben können. Die breite Diversifikation innerhalb unseres Produktportfolios und eine Streuung der Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten sind jedoch ein wirksames Mittel gegen die Auswirkungen solcher regionaler Krisen, weil die Abhängigkeiten generell geringer sind.

### Branchen- und unternehmensspezifische Risiken

Im Segment Speicherprodukte ist die Volatilität der DRAM-Speicherpreise weiterhin das bedeutendste Risiko, aber auch eine Chance sowohl für das Segment als auch für Infineon als Ganzes. Im vergangenen Geschäftsjahr schwankte der Preis für das Hauptumsatzprodukt, einen 256Mbit DDR SDRAM Speicherbaustein auf dem Markt zwischen 4,82 US-Dollar und 2,25 US-Dollar (Quelle: DRAM eXchange, 256M DDR400 average). Die Erweiterung unseres Produktportfolios etwa durch neue Speichermodule, Grafikspeicher und Flash-Produkte kann neben den damit verbundenen Chancen auch erhebliche Risiken mit sich bringen. Dies wird bei Flash-Produkten, insbesondere aufgrund der starken Marktposition und des derzeitigen technologischen Vorsprungs der führenden Wettbewerber deutlich. Bei der Produktion sehen wir im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr höhere Risiken, da die Umstellung auf die neueste 90-Nanometer-Technologie im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2006 erfolgen wird.

Bei den Logiksegmenten Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket sowie Kommunikation bestehen bei merklich geringerer Volatilität des Geschäfts zumindest in Teilbereichen auch weiterhin deutliche Volumenrisiken. Der schnelle technologische Wandel kann zusätzlich z. B. bei Verzögerungen in einzelnen Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Geschäftsvolumens bis hin zum Verlust von ganzen Kundenbeziehungen führen. Der hohe Preisdruck mit entsprechenden Risiken bleibt in beiden Segmenten bestehen. Durch die Konzentration bei bestimmten Produkten auf wenige Kunden sind unsere Geschäftsvolumen stark vom Geschäftserfolg dieser Kunden im Markt abhängig. Zudem kann bei nicht von uns beeinflussbaren Veränderungen im Rahmen von Marktkonsolidierungen wie zum Beispiel dem Verkauf der Siemens-Handysparte an BenQ das Geschäftsvolumen erheblich tangiert werden.

Ein insgesamt für die Halbleitertechnologie wesentliches geschäftstypisches Risiko ist der Hochlauf neuer Technologien mit dem Risiko von Verzögerungen beziehungsweise deutlichen Ausbeuteschwankungen. Diesem Risiko versuchen wir mit kontinuierlich verbessertem Projektmanagement und entsprechendem engem Monitoring der betroffenen Geschäftsprozesse zu begegnen.

Gegen Produkt Risiken setzen wir modernste qualitätssichernde Methoden zur Vorbeugung, Problemlösung und kontinuierlichen Verbesserung unserer Geschäftsprozesse ein, insbesondere bei Entwicklung, Fertigung und Logistik. Das unternehmensweit gültige Qualitätsmanagementsystem ist seit Jahren nach den Normen ISO9001 beziehungsweise ISO/TS16949 zertifiziert und bezieht auch die Entwicklung unserer Lieferanten mit ein.

Wir schützen uns mit Versicherungen bestmöglich gegen Auswirkungen von Haftungsrisiken oder Schadensfällen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Im Patentbereich profitiert Infineon vom Schutz mehrerer Verträge mit wichtigen Wettbewerbern. Die Gesellschaft bemüht sich deshalb intensiv, diesen Schutz durch Verhandlungen mit führenden Wettbewerbern, mit denen noch keine patentrechtlichen Vertragsbeziehungen bestehen, weiter auszudehnen und somit Risiken zu minimieren.

Steuerliche, wettbewerbs- und börsenrechtliche Regelungen können ebenfalls Unternehmensrisiken beinhalten. Die Gesellschaft lässt sich deshalb umfassend von internen und externen Fachleuten beraten.

### Marktrisiken

#### Fremdwährungsmanagement

Die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit bringt eine Vielzahl von Zahlungsströmen in unterschiedlichen Währungen – vor allem in US-Dollar – mit sich. Da wir aus diesen Geschäften einem Währungsrisiko ausgesetzt sind, kommt der Absicherung des Währungsrisikos eine hohe Bedeutung zu.

Ein bedeutender Anteil unserer Umsatzerlöse, Fertigungs-, Vertriebs-, Verwaltungs- sowie F&E-Kosten entsteht originär nicht in Euro, sondern vorwiegend in US-Dollar. Wechselkurschwankungen gegenüber dem Euro können einen negativen Effekt auf Umsatzerlöse, Kosten und Ergebnis haben.

Unsere Geschäftspolitik zur Begrenzung von kurzfristigen Fremdwährungsrisiken ist es, mindestens 75 Prozent des erwarteten Nettorisikos über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten im Voraus, je nach Art des Grundgeschäfts für einen bedeutenden Anteil auch darüber hinaus, zu sichern. Ein Teil des Fremdwährungsrisikos bleibt auf Grund des Unterschieds zwischen tatsächlichen und erwarteten Beträgen bestehen. Wir berechnen dieses Nettorisiko auf Basis des Kapitalflusses unter Berücksichtigung von eingegangenen oder vergebenen Aufträgen und allen anderen geplanten Einnahmen und Ausgaben.

#### Management des Zinsrisikos

Unsere Zinsrisikopositionen resultieren hauptsächlich aus Geldanlageinstrumenten, Wertpapieremissionen und Kreditaufnahmen. In den Geschäftsjahren 2002 und 2003 haben wir jeweils eine Wandelschuldverschreibung begeben. Vor dem Hintergrund der hohen Geschäftszyklizität und der operativen Flexibilität halten wir einen vergleichsweise hohen Kassenbestand, den wir in Instrumente mit kurzer Zinsbindungsdauer anlegen. Zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos nutzen wir Zinsderivate, um die aktive und passive Zinsbindungsdauer einander anzunähern.

### Materialpreisrisiken

Wir sind auf Grund unserer Abhängigkeit von verschiedenen Materialien Preisrisiken ausgesetzt. Wir versuchen, diese Risiken durch unsere Einkaufsstrategien und durch Einsatz geeigneter Instrumente zu minimieren. Wir setzen keine derivativen Finanzinstrumente zur Vermeidung von Restrisiken aus Preisschwankungen ein.

### Finanzierungsrisiken

Alle Halbleiterunternehmen, die eigene Fertigungsstätten betreiben, müssen erhebliche Kapitalbeträge für den Bau, die Erweiterung, die Modernisierung und die Instandhaltung dieser Anlagen einsetzen. Darüber hinaus müssen erhebliche finanzielle Mittel für F&E aufgewendet werden. Der Finanzmittelbedarf soll aus Mittelzuflüssen der laufenden Geschäftstätigkeit, der Inanspruchnahme von Kreditlinien, staatlichen Zulagen und Zuschüssen und – abhängig von den Marktbedingungen – durch die Aufnahme von Fremdkapital am öffentlichen Kapitalmarkt oder an Eigenkapital gebundene Instrumente gedeckt werden. Im Zusammenhang mit bestimmten Investitionsprojekten haben wir auch staatliche Zulagen und Zuschüsse beantragt, können jedoch nicht garantieren, dass die Mittel rechtzeitig oder überhaupt genehmigt werden. Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen von F&E und der Fertigung werden weiterhin aktiv genutzt, um den Finanzierungsbedarf zu reduzieren.

### Rechtliches Risiko

Wie bei vielen Unternehmen in der Halbleiterbranche wird auch Infineon gegenüber behauptet, das Unternehmen habe gewerbliche Schutzrechte verletzt, fehlerhafte Produkte geliefert, die Umweltschutzauflagen nicht eingehalten oder gesetzliche Pflichten verletzt. Ungeachtet der Erfolgsaussichten derartiger Ansprüche können dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Abwehr derartiger Ansprüche hohe Kosten entstehen. Infineon wehrt sich in solchen Angelegenheiten energisch mit Unterstützung interner und externer Experten.

### Reorganisation des Segments Speicherprodukte

Die vorgeschlagene Reorganisation unseres Segments Speicherprodukte – und alle weiteren Schritte, die wir unternehmen könnten – könnten unerwartete Belastungen auf unser Geschäft zur Folge haben und nicht die von uns erwarteten Vorteile bringen.

Im November 2005 hat unser Aufsichtsrat dem Vorhaben zugestimmt, unsere Gesellschaft neu auszurichten, um uns besser darauf vorzubereiten, die Marktchancen im Speicher- und

Logik-Geschäft auszuschöpfen, sofern und sobald sie eintreten. Der erste Schritt in diesem Prozess wird die Übertragung von allen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten unseres Segments Speicherprodukte an eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft sein (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten oder einem Teilbetrieb als Ausgliederung bekannt). Wir erwarten, dass die Ausgliederung der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten unseres Segments Speicherprodukte bis zum Juni 2006 abgeschlossen sein wird. Wir beabsichtigen, die finanziellen und industriellen Entwicklungen kontinuierlich während des Geschäftsjahrs 2006 zu prüfen und zu bewerten sowie weitere Reorganisationsschritte, soweit zweckmäßig, in Betracht zu ziehen.

Die Ausgliederung des Speichergeschäfts könnte schwieriger und teurer werden als von uns angenommen sowie größere Managementkapazitäten und andere Ressourcen benötigen als erwartet, was unser Geschäft und unser Ergebnis nachteilig beeinflussen könnte. Diese Transaktionen werden extrem vielschichtig sein, so dass wir nicht sicherstellen können, sie in der effizientesten und kostengünstigsten Art und Weise durchzuführen. Darüber hinaus könnten sich weitere Schritte, die wir der anfänglichen Reorganisation folgen lassen könnten, nicht als die strategisch vorteilhaftesten Alternativen erweisen, die für uns möglich sind. Diese Reorganisation sowie die gegebenenfalls zugehörigen Folgeschritte könnten unser Speicher- und Logik-Geschäft nachteilig beeinflussen. In jedem Fall werden wir nicht alle Vorteile für jeden unserer Geschäftsbereiche realisieren können, die wir mit diesen Transaktionen beabsichtigen zu erzielen.

### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, sind nicht erkennbar.

Ergänzende Beschreibungen der Risiken können Sie aus dem anliegenden Anhang zum Konzernabschluss und dem „Annual Report on Form 20-F“ entnehmen.

**INFINEON TECHNOLOGIES AG**

Die Infineon Technologies AG ist die Führungsgesellschaft des Infineon-Konzerns und führt die entsprechenden Leitungs- und Zentralfunktionen aus. Die Infineon Technologies AG übernimmt wesentliche übergreifende Aufgaben, wie das konzernweite Finanz- und Rechnungswesen, das Personalwesen, strategische und produktionsorientierte F&E-Aktivitäten sowie die weltweite Unternehmens- und Marketingkommunikation, und steuert die logistischen Prozesse im Konzern. Die Infineon Technologies AG verfügt über eigene Fertigungen in München und Regensburg.

Die Infineon Technologies AG stellt ihren Jahresabschluss nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuches („HGB“) auf. Der vollständige Abschluss wird separat veröffentlicht.

**Gewinn- und Verlust-Rechnungen<sup>1</sup> (Kurzfassung) in Mio. €**

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Umsatz	8.122	8.852	<b>9.038</b>
Umsatzkosten	-7.201	-7.325	<b>-8.045</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	921	1.527	<b>993</b>
Aufwendungen für übrige Funktionsbereiche	-1.460	-1.533	<b>-1.483</b>
Übrige Aufwendungen und Erträge	252	136	<b>155</b>
<b>Ergebnis vor Ertragssteuer</b>	-287	130	<b>-335</b>
Ertragssteuer	0	0	<b>-2</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-287	130	<b>-337</b>
Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.052	-1.339	<b>-1.209</b>
<b>Bilanzverlust</b>	-1.339	-1.209	<b>-1.546</b>

<sup>1</sup> Erstellt nach HGB.

Die Umsatzerlöse der Infineon Technologies AG im Geschäftsjahr 2005 sind durch einen Rückgang im Segment Kommunikation, eine deutliche Steigerung im Segment Speicherprodukte sowie eine Erhöhung bei den Lizenzlösen gekennzeichnet. Der Jahresfehlbetrag der Infineon Technologies AG für das Geschäftsjahr 2005 ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Umsatzkosten wegen erhöhter Leerkosten und einem starken Preisdruck. Auf Grund der betriebsbedingten Abrechnungsstruktur im Infineon-Konzern mit der Infineon Technologies AG als Verrechnungs-Drehscheibe für die Lieferungen und Leistungen der produzierenden und vertreibenden Tochtergesellschaften weist die Muttergesellschaft höhere Umsätze und Umsatzkosten aus als der Konzern.

Das Jahresergebnis ist durch außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 2 S. 3 HGB auf Beteiligungen und Intellectual Property (160 Millionen Euro) belastet und positiv beeinflusst worden durch Gutschriften für Vorjahre von der

Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden, (82 Millionen Euro), sowie der Vereinnahmung des entnehmfähigen Gewinns des Vorjahrs (98 Millionen Euro) der Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. KG, Dresden.

**Bilanzen<sup>1</sup> (Kurzfassung) in Mio. €**

Geschäftsjahr zum 30. September	2004	2005
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	768	<b>718</b>
Finanzanlagen	5.733	<b>6.182</b>
<b>Anlagevermögen</b>	6.501	<b>6.900</b>
Vorräte	470	<b>463</b>
Forderungen und Sonstiges	1.992	<b>1.908</b>
Wertpapiere, Zahlungsmittel	2.395	<b>1.886</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	4.857	<b>4.257</b>
<b>Summe Aktiva</b>	11.358	<b>11.157</b>
Eigenkapital	7.182	<b>6.845</b>
Rückstellungen	798	<b>846</b>
Verbindlichkeiten und Sonstiges	3.378	<b>3.466</b>
<b>Summe Passiva</b>	11.358	<b>11.157</b>

<sup>1</sup> Erstellt nach HGB.

Die Vermögens- und Finanzlage der Infineon Technologies AG ist bei den Aktiva geprägt durch den Anstieg der Finanzanlagen und den Rückgang bei Wertpapieren und flüssigen Mitteln, im Wesentlichen auf Grund der Erhöhung unserer Beteiligungen an SensoNor AS, Infineon Technologies Finance GmbH und Inotera, teilweise kompensiert durch eine Kapitalherabsetzung bei der Infineon Technologies Holding B.V., Niederlande. Der Rückgang an flüssigen Mitteln kommt aus dem operativen Geschäft. Die Reduzierung des Eigenkapitals ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2005. Die Eigenkapitalquote beträgt 61 Prozent (Vorjahr: 63 Prozent).

**Dividende**

Da der Jahresabschluss der Infineon Technologies AG für 2004 keinen Bilanzgewinn auswies, wurde für das Geschäftsjahr keine Dividende ausgeschüttet. Ebenso kann für das Geschäftsjahr 2005 keine Dividende ausgeschüttet werden, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust ausweist.

**Verschmelzung EUPEC**

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 ist die EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke, auf die Infineon Technologies AG, München, verschmolzen worden.

## WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Im November 2005 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft dem Vorhaben zugestimmt, Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Segments Speicherprodukte an eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft zu übertragen (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten oder einem Teilbetrieb als Ausgliederung bekannt).

## AUSBLICK

Branchenexperten prognostizieren für den weltweiten Halbleitermarkt ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich im Kalenderjahr 2006. Für das Geschäftsjahr 2006 erwarten wir mindestens eine Geschäftsentwicklung, die diesen Trend widerspiegelt. Im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket gehen wir von einem weiteren Wachstum durch die zunehmende Nachfrage nach Elektronik in Fahrzeugen, Spannungswandlern und energiesparenden Technologien aus. Darüber hinaus erwarten wir im Segment Kommunikation eine positive Geschäftsentwicklung im Wesentlichen wegen unserer leistungsfähigen Hochfrequenztechnologien. Im Segment Speicherprodukte werden wir unser Portfolio weiter auf Produkte mit höheren Margen konzentrieren.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 erwarten wir im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 leicht steigende Umsätze. Wir werden den Auslauf der Produktion in München-Perlach, den Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Kulim, Malaysia, sowie den Ausbau der 300-Millimeter-Produktion in Richmond fortführen. Zusätzlich werden wir ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in unserem Konzernergebnis ausweisen.

Im November 2005 hat unser Aufsichtsrat Pläne zur Ausgliederung des Segments Speicherprodukte und zur Gründung einer 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Infineon zum 1. Juli 2006 genehmigt. Für unser Management ist anschließend ein Börsengang dieser Gesellschaft die gegenwärtig bevorzugte Lösung.

Ausblick für unsere Segmente für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2006:

--- Im Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket gehen wir davon aus, dass Umsatz und Ebit im Bereich

Automobil- und Industrieelektronik im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 leicht steigen werden, auch wenn jährliche Preissenkungen bei großen Kunden sich erstmals im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 auswirken werden. Im Geschäft mit Sicherheits- und Chipkarten-ICs erwarten wir, dass Umsatz und Ebit weiter unter Druck bleiben werden. Wir gehen jedoch derzeit davon aus, dass dieser Trend auf Grund der begonnenen Kostensenkungsmaßnahmen ab dem zweiten Geschäftsjahresquartal 2006 umgekehrt wird. Insgesamt erwarten wir für das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 einen leichten Umsatzanstieg und ein stabiles Ebit. Berücksichtigt sind dabei bereits die Auswirkungen der erwähnten Preissenkungen, Aufwendungen für das planmäßige Auslaufen der Produktion in München-Perlach und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Produktionsstätte in Kulim, Malaysia.

--- Für das Segment Kommunikation gehen wir davon aus, dass der Umsatz im Segment Kommunikation im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 im Vergleich zum vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 stabil bleiben wird. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 erwarten wir für dieses Segment ein negatives Ebit in der Größenordnung des Vorquartals.

--- Im Segment Speicherprodukte wird unserer Ansicht nach im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 die saisonal bedingt hohe Nachfrage nach Computern das Bit-Wachstum im DRAM-Markt fördern. Auf der Angebotsseite zeichnet sich ein Wachstum von Kapazitäten und Produktivitäten in der Branche ab, was nur teilweise durch Verlagerung von Kapazitäten einiger Wettbewerber zu Non-DRAM-Produkten ausgeglichen wird. Diese Entwicklung sowie der Preisdruck und die Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit von Chipsätzen im PC-Segment erschweren eine Prognose der Preisentwicklung. Wir gehen davon aus, dass unsere Bit-Produktion auf Grund der zusätzlichen Kapazitäten unseres Joint Ventures Inotera und unserer 300-Millimeter-Produktionsanlage in Richmond weiter steigt. Wir werden unser Portfolio auch weiterhin auf Wachstumsbereiche mit höheren Margen konzentrieren, darunter Infrastruktur, High-End-Grafikchips sowie Consumer- und mobile Applikationen.

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

### An den Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG

Wir haben die beigefügten Konzernbilanzen der Infineon Technologies AG, einschließlich ihrer Tochterunternehmen, zum 30. September 2004 und 2005 sowie die zugehörigen Konzern-Gewinn- und-Verlust-Rechnungen, die Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnungen sowie die Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre (Konzernrechnungslegung) geprüft. Die Konzernrechnungslegung liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über die Konzernrechnungslegung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach den Standards des Public Company Accounting Oversight Board (United States) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Konzernrechnungslegung frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Wertansätze und Angaben in der Konzernrechnungslegung auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Konzernrechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung stellt die oben genannte Konzernrechnungslegung die Vermögens- und Finanzlage des Infineon-Konzerns zum 30. September 2004 und 2005 sowie die Ertragslage und die Zahlungsströme für die am 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (United States Generally Accepted Accounting Principles) in allen wesentlichen Belangen angemessen dar.

München, Deutschland

31. Oktober 2005, bis auf Anhangsangabe Nr. 33, die dem Stand vom 17. November entspricht

**KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

**Hoyos**  
Wirtschaftsprüfer

**Feege**  
Wirtschaftsprüfer

## Konzernabschluss

**Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre** in Mio. €

	Anhang Nr.	2003	2004	2005
Umsatzerlöse				
aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	5	5.153	6.169	5.843
aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen	27	999	1.026	916
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		6.152	7.195	6.759
Umsatzkosten	7	4.614	4.670	4.909
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		1.538	2.525	1.850
Forschungs- und Entwicklungskosten		1.089	1.219	1.293
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten		679	718	655
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	8	29	17	78
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo	7	85	257	92
<b>Betriebsergebnis</b>		-344	314	-268
Zinsergebnis		-52	-41	-9
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	16	18	-14	57
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	16	-2	2	-
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo		21	-64	26
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		8	18	2
<b>Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		-351	215	-192
Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9	-84	-154	-120
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-435	61	-312
Konzernüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – verwässert und unverwässert in €	10	-0,60	0,08	-0,42

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

**Konzern-Bilanzen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre** in Mio. €

	Anhang Nr.	2004	2005
<b>Aktiva</b>			
Umlaufvermögen:			
Zahlungsmittel		608	1.148
Wertpapiere des Umlaufvermögens	11	1.938	858
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	1.056	952
Vorräte	13	960	1.022
Aktive kurzfristige latente Steuern	9	140	125
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	14	590	469
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>5.292</b>	<b>4.574</b>
Sachanlagen	15	3.587	3.751
Finanzanlagen	16	708	779
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel		109	88
Aktive latente Steuern	9	541	550
Sonstige Vermögensgegenstände	17	627	542
<b>Summe Aktiva</b>		<b>10.864</b>	<b>10.284</b>
<b>Passiva</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten:			
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristig fällige Bestandteile			
langfristiger Finanzverbindlichkeiten	21	571	99
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	1.098	1.069
Rückstellungen	19	555	497
Passive kurzfristige latente Steuern	9	16	17
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20	630	700
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		<b>2.870</b>	<b>2.382</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	21	1.427	1.566
Passive latente Steuern	9	21	65
Sonstige Verbindlichkeiten	22	568	642
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>4.886</b>	<b>4.655</b>
Eigenkapital:			
Grundkapital	23	1.495	1.495
Zusätzlich eingezahltes Kapital		5.800	5.800
Verlustvortrag		-1.200	-1.512
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	-117	-154
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>5.978</b>	<b>5.629</b>
<b>Summe Passiva</b>		<b>10.864</b>	<b>10.284</b>

Siehe auch die beigegeführten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.



**Konzern-Eigenkapital-Veränderungsrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre** in Mio. €

	Anhang Nr.	Ausgegebene Stückaktien Anzahl	Ausgegebene Stückaktien Betrag Mio. €
<b>Konzernbilanz zum 1. Oktober 2002</b>		720.784.218	1.442
Konzernjahresfehlbetrag		–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Kauf von Catamaran		96.386	–
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo		–	–
Andere Einlagen		–	–
<b>Konzernbilanz zum 30. September 2003</b>		720.880.604	1.442
Konzernjahresüberschuss		–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	–	–
Konzernjahresüberschuss unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Rückzahlung rückgewährbarer Einlagen		26.679.255	53
Abgrenzung von Personalaufwendungen, Saldo		–	–
<b>Konzernbilanz zum 30. September 2004</b>		747.559.859	1.495
Konzernjahresfehlbetrag		–	–
Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	25	–	–
Konzernjahresfehlbetrag unter Berücksichtigung der Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren			
Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien:			
Ausübung von Aktienoptionen	24	9.500	–
<b>Konzernbilanz zum 30. September 2005</b>		747.569.359	1.495

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

Zusätzlich eingezahltes Kapital Mio. €	Verlustvortrag Mio. €	Kumulierte Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen Mio. €	Zusätzliche Pensionsverbindlichkeiten Mio. €	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren Mio. €	Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften Mio. €	Gesamt Mio. €
5.569	-826	-5	-20	-2	-	6.158
-	-435	-	-	-	-	-435
-	-	-76	2	13	-	-61
						-496
1	-	-	-	-	-	1
7	-	-	-	-	-	7
-4	-	-	-	-	-	-4
5.573	-1.261	-81	-18	11	-	5.666
-	61	-	-	-	-	61
-	-	-41	18	-7	1	-29
						32
225	-	-	-	-	-	278
2	-	-	-	-	-	2
5.800	-1.200	-122	-	4	1	5.978
-	-312	-	-	-	-	-312
-	-	64	-84	8	-25	-37
						-349
-	-	-	-	-	-	-
5.800	-1.512	-58	-84	12	-24	5.629

**Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre** in Mio. €

	Anhang Nr.	2003	2004	2005
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		-435	61	-312
<b>Anpassungen zur Überleitung des Konzernjahresüberschusses/-fehlbetrags auf Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit:</b>				
Planmäßige Abschreibungen	15/17	1.437	1.320	1.316
Erworbene, nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	3	6	9	-
Auflösung der Abgrenzung von Personalaufwendungen		7	2	-
Wertberichtigungen auf Forderungen	12	-16	15	3
Gewinn aus dem Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens	11	-56	-9	-8
Gewinn/Verlust aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten	4	10	2	-39
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen		3	-5	-8
Anteiliger Überschuss/Fehlbetrag von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften	16	-18	14	-57
Aufwendungen/Erträge aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	16	2	-2	-
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile		-8	-18	-2
Außerplanmäßige Abschreibungen	16/17	98	136	134
Latente Steuern	9	16	96	88
<b>Veränderungen des Nettoumlaufvermögens:</b>				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12	-227	-219	119
Vorräte	13	-112	-40	-25
Sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	14	156	154	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	-217	228	-52
Rückstellungen	19	164	92	-114
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	20	-17	-22	-
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten	17/22	-62	43	-2
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>731</b>	<b>1.857</b>	<b>1.039</b>

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

**Konzern-Kapitalflussrechnungen für die am 30. September endenden Geschäftsjahre** in Mio. €

	Anhang Nr.	2003	2004	2005
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:</b>				
Auszahlungen für Wertpapiere des Umlaufvermögens		-2.752	-2.678	-2.228
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens		2.013	2.520	3.310
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftsanteilen		164	9	101
Einzahlungen/Auszahlungen für Beteiligungen, abzüglich erworbene Zahlungsmittel		6	-29	-
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an assoziierten und verbundenen Unternehmen	16	-76	-386	-135
Dividende von den nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften		-	-	51
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17	-58	-125	-27
Auszahlungen für Sachanlagen	15	-872	-1.163	-1.368
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	15	53	43	58
<b>Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.522</b>	<b>-1.809</b>	<b>-238</b>
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit:</b>				
Veränderungen der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21	-36	62	-20
Veränderung der Finanzforderungen und -verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen	27	-76	75	18
Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten	21	700	-	192
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	21	-25	-549	-500
Veränderung der als Sicherheitsleistungen hinterlegten liquiden Mittel		3	-43	21
Einzahlungen aus Ausgabe von Aktien an Minderheitsgesellschafter		-	53	23
<b>Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>566</b>	<b>-402</b>	<b>-266</b>
Währungsumrechnungseffekte auf Zahlungsmittel		-4	-7	5
Veränderung der Zahlungsmittel		-229	-361	540
Veränderung der Zahlungsmittel von aufgegebenem Geschäft		-1	-	-
Zahlungsmittel am Geschäftsjahresanfang		1.199	969	608
<b>Zahlungsmittel am Geschäftsjahresende</b>		<b>969</b>	<b>608</b>	<b>1.148</b>

Siehe auch die beigefügten Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen.

## Anhang zum Konzernabschluss

### 1 BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, DER GRÜNDUNG UND DER GRUNDLAGEN DER DARSTELLUNG

#### Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Die Infineon Technologies Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften („die Gesellschaft“) entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten ein breites Spektrum von Halbleiterprodukten und kompletten Systemlösungen. Diese werden in einer Vielzahl von mikroelektronischen Anwendungen, wie in Computersystemen, Telekommunikationssystemen, Konsumgütern, Produkten der Automobilindustrie und der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik sowie Chipkarten, eingesetzt. Das Produktspektrum der Gesellschaft umfasst Standardkomponenten, kundenspezifische Teil- oder Komplettlösungen sowie spezifische Bauelemente für Speicher-, Analog-, Digital- und Mixed-Signal-Anwendungen. Fertigungsstätten, Beteiligungen und Kunden der Gesellschaft befinden sich hauptsächlich in Europa, Asien und Nordamerika. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 30. September.

#### Gründung

Die Gesellschaft wurde als eigenständiges Rechtssubjekt mit Wirkung zum 1. April 1999 gegründet („Gründung“). Im Zuge der Gründung erfolgte die Übertragung des nahezu vollständigen mit dem Halbleitergeschäft verbundenen Vermögens der Siemens AG („Siemens“) mit allen Beteiligungen, Betrieben und Geschäftsaktivitäten. Der Börsengang der Gesellschaft fand am 13. März 2000 statt. Die Gesellschaft wird an der New York Stock Exchange gehandelt und ist eines der 30 Dax-Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

#### Grundlagen der Darstellung

Der Konzernabschluss wurde nach den in den Vereinigten Staaten von Amerika geltenden Grundsätzen der Rechnungslegung („US-GAAP“) erstellt. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuchs („HGB“) muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufstellen. Gemäß der Übergangsregelung auf Grund des Bilanzrechtsreformgesetzes in Art. 58 Abs. 3 EGHGB braucht ein Konzernabschluss nach deutschem Recht nicht aufgestellt zu werden, sofern ein Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie zum Beispiel US-GAAP vorgelegt wird. Mit dem vorliegenden Konzernabschluss nimmt die Gesellschaft die Befreiungsmöglichkeit gemäß der Übergangsregelung auf Grund des Bilanzrechtsreformgesetzes Art. 58 Abs. 3 EGHGB in Anspruch.

Alle in diesem Konzernabschluss gezeigten Beträge sind in Millionen Euro („€“), außer wenn anders angegeben.

Im Konzernabschluss und Konzernanhang des Vorjahrs wurden bestimmte Beträge umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zum abgeschlossenen Geschäftsjahr zu gewährleisten. Das Konzernjahresergebnis wird von diesen Umgliederungen nicht beeinflusst.

### 2 BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bei der Erstellung des konsolidierten Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

#### Konsolidierungsgrundsätze

Der vorliegende konsolidierte Konzernabschluss umfasst, jeweils auf konsolidierter Basis, die Gesellschaft und deren wesentliche Tochtergesellschaften. Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mit 20 Prozent oder mehr beteiligt ist, die jedoch nicht unter der einheitlichen Leitung der Gesellschaft stehen („assoziierte Unternehmen“), werden unter Anwendung der Equity-Methode bilanziert (siehe Anhang Nr. 16). Das anteilige Jahresergebnis der nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften mit anderem Geschäftsjahresende wird im Allgemeinen um drei Monate zeitversetzt erfasst. Sonstige Beteiligungen, an denen die Gesellschaft einen Eigentumsanteil von weniger als 20 Prozent hält, werden zu Anschaffungskosten aufgenommen. Die Auswirkungen aller wesentlichen Geschäftsvorfälle zwischen den konsolidierten Gesellschaften sind im Konzernabschluss eliminiert.

Der Infineon-Konzern besteht neben der Gesellschaft aus der folgenden Anzahl von Unternehmen:

	Konsolidierte Unternehmen	Assoziierte Unternehmen	Gesamt
<b>30. September 2004</b>	56	15	<b>71</b>
Zugänge	2	–	2
Abgänge	–2	–4	–6
<b>30. September 2005</b>	56	11	<b>67</b>

Zusätzlich umfasst der Konzernabschluss 31 (2004: 30) Tochtergesellschaften und 7 (2004: 9) assoziierte Unternehmen, die in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 nach der Equity-Methode und früher nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanziert wurden, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben. Der Effekt der Nicht-Konsolidierung dieser Unternehmen auf die

Konzernbilanzsumme, die Konzernumsätze und das Konzernjahresergebnis war im Geschäftsjahr 2003 geringer als 1 Prozent. Die Auswirkung der Nicht-Konsolidierung dieser Unternehmen hatte keinen Effekt auf das Konzernjahresergebnis; der Effekt auf die Konzernbilanzsumme und die Konzernumsätze für die Geschäftsjahre 2004 und 2005 war geringer als 1 Prozent.

### Berichtswährung und Währungsumrechnung

Die Berichtswährung der Gesellschaft ist der Euro; deshalb wird der konsolidierte Konzernabschluss in Euro aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ausländischer Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung nicht der Euro ist, werden grundsätzlich unter Anwendung der Stich-

tagskurs-Methode umgerechnet. Posten der Gewinn- und Verlust-Rechnungen werden dagegen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Berichtszeitraums umgerechnet. Unterschiede aus der Umrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden, die aus zu Vorjahren abweichenden Wechselkursen resultieren, werden innerhalb des Postens „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ (Other Comprehensive Income/Loss) separat im Eigenkapital ausgewiesen.

Nachfolgend sind die bei der Erstellung des Konzernabschlusses verwendeten Wechselkurse für die primären Währungen aufgeführt:

Währung in €		Wechselkurs zum 30. September		Jahresdurchschnittskurs	
		2004	2005	2004	2005
US-Dollar	1 USD	0,8115	<b>0,8290</b>	0,8209	<b>0,7869</b>
Japanischer Yen	100 JPY	0,7320	<b>0,7357</b>	0,7545	<b>0,7331</b>
Britisches Pfund	1 GBP	1,4667	<b>1,4650</b>	1,4704	<b>1,4507</b>
Singapur-Dollar	1 SGD	0,4793	<b>0,4911</b>	0,4808	<b>0,4749</b>

### Umsatzrealisierung

#### --- Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus Produktverkäufen werden gemäß SEC Staff Accounting Bulletin („SAB“) Nr. 104, „Revenue Recognition“, in der Rechnungslegung realisiert, wenn eine wirksame Vereinbarung besteht, der Kaufpreis fest oder eindeutig bestimmbar ist, die Lieferung erfolgt ist und die Zahlung seitens des Kunden hinreichend wahrscheinlich ist. Für mögliche Rückgaben von Produkten, Rabatte sowie Nachlässe aus Preissicherungsklauseln erfasst die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Umsatzlegung Abschläge auf die Umsatzerlöse. Diese Abschläge basieren auf historischen Erfahrungen. Im Allgemeinen sind Warenrückgaben nur innerhalb der normalen zwölfmonatigen Gewährleistungsgarantie auf Grund von Qualitätsmängeln erlaubt. Die Distributoren können unter bestimmten Umständen Bestände gegen gleiche oder andere Produkte umtauschen („Warenrotation“), Verwurfsgutschriften oder Preisabsicherung verlangen. Gutschriften werden basierend auf der erwarteten Warenrotation gemäß den vertraglichen Vereinbarungen abgegrenzt. Verwurfsgutschriften werden basierend auf den vertraglichen Vereinbarungen abgegrenzt und bei Berechtigung des Anspruchs bis zu einem bestimmten Maximalbetrag des durchschnittlichen Warenbestands werts gewährt. Preisabsicherungen ermöglichen den Distributoren, eine Gutschrift für noch nicht verkaufte Vorräte zu beantragen, wenn die Gesellschaft die Standardlistenpreise für solche Waren reduziert hat. In einigen Fällen werden Rabatte mit bestimmten Kunden vereinbart,

wobei Rabatte nur dann gewährt werden, wenn bestimmte Umsatzerlöse erreicht werden. Fallweise erhalten die Distributoren auch für gemeinsam festgelegte Werbung eine Erstattung.

#### --- Lizenzträge

Lizenzträge werden vereinnahmt, wenn die Leistung erbracht ist (siehe Anhang Nr. 5). Einmalzahlungen sind in der Regel nicht zurückzahlbar; sie werden entsprechend abgegrenzt und über den Zeitraum der künftigen Leistungserbringung vereinnahmt. Gemäß der Emerging Issues Task Force („EITF“) Issue Nr. 00-21, „Revenue Arrangements with Multiple Deliverables“, werden Umsatzerlöse aus Verträgen mit mehreren Bestandteilen, die nach dem 1. Juli 2003 abgeschlossen wurden, mit dem relativen Marktwert eines jeden Bestandteils dann realisiert, wenn es keine nicht gelieferten Elemente gibt, die für das Funktionieren der gelieferten Bestandteile von Bedeutung sind, und die Bezahlung nicht von der Lieferung der noch ausstehenden Bestandteile abhängt. Stücklizenzgebühren werden zum Realisierungszeitpunkt erfolgswirksam vereinnahmt.

#### Zulagen und Zuschüsse

Fördergelder für Investitionen beinhalten steuerfreie Investitionszulagen und zu versteuernde Investitionszuschüsse für Sachanlagen. Der Anspruch auf Fördermittel wird dann bilanziert, wenn ein rechtlicher Anspruch auf die Fördermittel besteht und die Kriterien für die Erlangung der Fördermittel

erfüllt wurden. Steuerfreie Investitionszulagen werden über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten periodengerecht abgegrenzt (siehe Anhang Nr. 22) und erfolgswirksam über die verbleibende Nutzungsdauer der geförderten Sachanlagen vereinnahmt. Zu versteuernde Investitionszuschüsse reduzieren die Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Anhang Nr. 6) und reduzieren damit die Abschreibungen der künftigen Perioden. Sonstige zu versteuernde Zuschüsse werden aufwandsmindernd erfasst (siehe Anhang Nr. 6, Nr. 20 und Nr. 22).

### Produktbezogene Aufwendungen

Transport- und Abwicklungskosten, die auf den Verkauf von Produkten entfallen, sind in den Umsatzkosten enthalten. Ausgaben für Produktmarketing und Werbung sowie für sonstige vertriebsbezogene Maßnahmen werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand erfasst. Gewährleistungsrückstellungen werden basierend auf angenommenen Ausfallquoten und historischen Erfahrungswerten grundsätzlich zum Zeitpunkt der Umsatzrealisierung gebildet. Forschungs- und Entwicklungskosten werden bei Anfall in voller Höhe als Aufwand gebucht.

### Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Gemäß Financial Accounting Standards Board („FASB“) Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 109, „Accounting for Income Taxes“, werden die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag nach der Verbindlichkeitsmethode ermittelt. Aktive und passive latente Steuern werden als sonstige Vermögensgegenstände bzw. als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert, um die künftige steuerliche Wirkung aus zeitlichen Unterschieden zwischen dem bilanziellen Wertansatz von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten und dem steuerlich beizulegenden Wert zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung der aktiven und passiven latenten Steuern wird von den erwarteten Steuersätzen zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Realisierung ausgegangen. Auswirkungen aus Steuersatzänderungen werden zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der gesetzlichen Regelung berücksichtigt. Steuervergünstigungen für Investitionen werden bei Erwerb des Vermögensgegenstands bilanziert.

### Aktienoptionspläne

Die Gesellschaft bilanziert Vergütungen in Form von Aktienoptionen auf der Grundlage der Innere-Wert-Methode entsprechend der Accounting Principles Board („APB“) Opinion 25, „Accounting for Stock Issued Employees“, und erfasst diese Personalkosten über den Zeitraum der Leistung. Die Gesellschaft hat das Wahlrecht wahrgenommen, nur die Erläuterung dieser Aktienoptionspläne gemäß SFAS Nr. 123, „Accounting for Stock-based Compensation“, ergänzt durch SFAS Nr. 148,

„Accounting for Stock-based Compensation – Transition and Disclosure, an Amendment of FASB Statement No. 123“, anzugeben (siehe Anhang Nr. 24).

### Kapitalerhöhungen von Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen

Gewinne oder Verluste aus der Durchführung von Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaften oder assoziierten Unternehmen werden entsprechend der Veränderung der Anteilshöhe gemäß den Regelungen des SAB Topic 5:H, „Accounting for Sales of Stock by a Subsidiary“, ergebniswirksam erfasst (siehe Anhang Nr. 16).

### Zahlungsmittel

Bargeld sowie alle Finanzmittel mit einer ursprünglichen Fälligkeit von bis zu drei Monaten werden als Zahlungsmittel ausgewiesen. Die Finanzmittel beliefen sich zum 30. September 2004 und 2005 auf €541 und €1.093; sie beinhalteten hauptsächlich Bankeinlagen und festverzinsliche Anleihen mit Fälligkeit von bis zu drei Monaten.

### Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel

Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel beinhalten Geldanlagen, die im Rahmen der Finanzierung als Sicherheit für die Abgrenzung von Personalaufwendungen, Unternehmensakquisitionen, Anlagen im Bau, Leasing oder Finanzierung hinterlegt sind (siehe Anhang Nr. 31).

### Wertpapiere

Die Gesellschaft hält frei veräußerbare Wertpapiere („Available for Sale“-Papiere), die zu dem zuletzt gehandelten Marktpreis am Bilanzstichtag bewertet sind. Kumulierte unrealisierte Gewinne und Verluste, nach Abzug von latenten Steuern, sind im Eigenkapital als „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste und voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens werden, sofern angefallen, in der Position „Sonstige Erträge und Aufwendungen“ erfasst. Im Veräußerungsfall wird für die Ermittlung realisierter Gewinne oder Verluste von den individuellen Anschaffungskosten der Wertpapiere ausgegangen.

### Vorräte

Die Vorräte werden entweder zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktpreis bewertet, wobei die Anschaffungs- und Herstellungskosten vorwiegend zu

Durchschnittswerten ermittelt werden. Die Herstellungskosten beinhalten die direkt zurechenbaren Material- und Lohnkosten sowie anteilige Gemeinkosten.

### Sachanlagen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen bilanziert. Kosten für Ersatzteile, laufende Instandhaltung und Reparaturen werden bei Anfall aufwandswirksam erfasst. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt. Anlagen im Bau enthalten Anzahlungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Grund und Boden, grundstücksgleiche Rechte und Anlagen im Bau werden nicht planmäßig abgeschrieben. Die Herstellungskosten bestimmter langlebiger Vermögensgegenstände enthalten aktivierte Finanzierungskosten, die über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände planmäßig abgeschrieben werden. Während der Geschäftsjahre 2004 und 2005 wurden Zinsen in Höhe von €9 und €9 aktiviert. Die den Abschreibungen zu Grunde gelegten Nutzungsdauern betragen bei:

	Jahre
Gebäuden	10–25
Technischen Anlagen und Maschinen	3–10
Sonstigen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1–10

### Leasing

Die Gesellschaft ist Leasingnehmer von Sachanlagen. Alle Leasinggeschäfte, bei denen die Gesellschaft in der Position des Leasingnehmers als wirtschaftlicher Eigentümer zu sehen ist, werden gemäß dem vom Financial Accounting Standards Board („FASB“) veröffentlichten SFAS Nr. 13, „Accounting for Leases“, und den zugehörigen Interpretationen als Finanzierungsleasing behandelt und bei der Gesellschaft als Sachanlagen bilanziert. Alle anderen Leasinggeschäfte werden als operatives Leasing behandelt.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Gemäß SFAS Nr. 141, „Business Combinations“, wendet die Gesellschaft die Erwerbsmethode an. Die Erwerbsmethode fordert, dass bei einem Unternehmenserwerb neben dem Geschäfts- und Firmenwert („Goodwill“) die immateriellen Vermögensgegenstände getrennt erfasst und ausgewiesen werden.

Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen hauptsächlich aus erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen, wie z. B. Lizenzen und erworbenen Technologien, die zum

Kaufpreis bilanziert wurden, sowie aus Geschäfts- und Firmenwerten, die im Zusammenhang mit Unternehmensakquisitionen als der Teil des Kaufpreises, der den Marktwert des erworbenen Nettovermögens überstieg, entstanden. Immaterielle Vermögensgegenstände werden linear über den erwarteten Nutzungszeitraum, der von drei bis zehn Jahren reicht, abgeschrieben. Gemäß SFAS Nr. 142, „Goodwill and Other Intangible Assets“, werden Geschäfts- und Firmenwerte nicht abgeschrieben, sondern nach den Vorgaben des SFAS Nr. 142 mindestens einmal jährlich auf eventuelle Wertminderungen geprüft. Die Gesellschaft nimmt die jährlichen Überprüfungen im letzten Quartal des Geschäftsjahrs vor. Falls der Buchwert der Geschäftseinheit inklusive Geschäfts- und Firmenwert den Marktwert übersteigt, ergibt sich die Wertminderung aus der Differenz zwischen dem Buchwert des Geschäfts- und Firmenwerts und dem Marktwert des Geschäfts- und Firmenwerts. Die Ermittlung der Marktwerte für die einzelnen Geschäftseinheiten und der zugehörigen Geschäfts- und Firmenwerte erfordert wesentliche Annahmen seitens des Managements.

### Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Gesellschaft überprüft Anlagegüter einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen, sobald Ereignisse oder Veränderungen eintreten, die darauf hindeuten, dass voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen könnten. Dabei wird der Restbuchwert mit den erwarteten künftigen Einnahmeüberschüssen, die von diesem Vermögensgegenstand generiert werden, verglichen. Wenn dieser Vermögensgegenstand als wertgemindert angesehen wird, bemisst sich die Wertminderung nach dem Betrag, um den der Buchwert den Marktwert des Vermögensgegenstands überschreitet. Die Beurteilung durch das Management erfordert wesentliche Annahmen, um diskontierte zukünftige Cash-Flows abschätzen zu können.

### Finanzanlagen

Die Gesellschaft überprüft Wertminderungen bei nach der Equity-Methode oder nach dem Anschaffungskostenprinzip bilanzierten Finanzanlagen, um festzustellen, ob es sich um eine nicht als vorübergehend zu bezeichnende Wertminderung handelt und sie somit dauerhaft ist. Diese Bewertung wird auf Basis verfügbarer Daten inklusive allgemeiner Marktdaten, spezifischer Industrie- und individueller Gesellschaftsdaten durchgeführt. Die Dauer und Höhe, um die der Marktpreis die Anschaffungskosten unterschreitet, die Finanzlage und die kurzfristigen Aussichten dieser Beteiligung werden ebenso berücksichtigt. Zusätzlich fließen in die Bewertung die Absicht und die Fähigkeit



der Gesellschaft ein, diese Finanzanlage für eine ausreichende Zeit zu halten, innerhalb derer die erwartete Wertaufholung zu realisieren ist.

### Finanzinstrumente

Die Gesellschaft ist als weltweit operierendes Unternehmen den Auswirkungen von Währungsschwankungen ausgesetzt. Zur Sicherung gegen Währungsrisiken werden derivative Finanzinstrumente wie Devisentermin- und Optionsverträge als auch Zins-Swap-Verträge eingesetzt. Die Gesellschaft wendet SFAS Nr. 133, „Accounting for Financial Derivatives and Hedging Activities“, erweitert durch SFAS Nr. 137, SFAS Nr. 138 und SFAS Nr. 149, an. Die Standards beinhalten Aussagen zur Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten einschließlich solcher, die Bestandteil anderer Verträge sind, sowie von Sicherungsgeschäften. Derivative Finanzinstrumente werden mit ihrem Marktwert unter den Sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenständen oder den Sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Üblicherweise betrachtet die Gesellschaft ihre derivativen Finanzinstrumente nicht als Sicherungsgeschäfte. Veränderungen der Marktwerte von nicht designierten Derivativen, die mit dem operativen Geschäft verbunden sind, werden als Teil der Umsatzkosten realisiert und die Veränderungen der Marktwerte der Derivative, die zu Finanzierungszwecken genutzt werden, als sonstige Aufwendungen. Veränderungen der Marktwerte von Derivativen, die für marktwertbezogene Sicherungsgeschäfte vorgesehen sind, werden ergebniswirksam erfasst. Veränderungen der Marktwerte von Derivativen, die für zahlungsmittelbezogene Sicherungsgeschäfte bestimmt sind, werden bei effektiver Wirkung als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit den Aktionären resultieren, abgegrenzt und nachfolgend erfolgswirksam erfasst, wenn die zu Grunde liegende Transaktion in der Gewinn- und -Verlust-Rechnung abgebildet wird. Bei ineffektiver Wirkung werden die Veränderungen der Marktwerte von Derivativen sofort ergebniswirksam realisiert. Der Marktwert der derivativen Finanzinstrumente und anderer Finanzinstrumente wird in Anhang Nr. 29 erläutert.

### Pensionsverpflichtungen

Im Dezember 2003 veröffentlichte das FASB das SFAS Nr. 132 (revised 2003), „Employer’s Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits, an Amendment of FASB Statements No 87, 88, and 106“, welche die Ausweispflicht des Arbeitgebers für Pensionszusagen und pensionsähnliche Leistungszusagen revidiert. Das 2003 revidierte SFAS Nr. 132 sieht zusätzliche Ausweispflichten vor (im Vergleich zu dem damit ersetzten ursprünglichen SFAS Nr. 132). Die Gesellschaft wendet seit dem am 30. September 2004 endenden Geschäftsjahr

den im Jahr 2003 revidierten SFAS Nr. 132 an. Die Angaben werden im Anhang Nr. 28 gezeigt.

### Schätzungen und Annahmen

Die Aufstellung des Konzernabschlusses erfordert Schätzungen und Annahmen des Managements. Diese haben Einfluss auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. Die tatsächlichen Beträge können wesentlich von den Schätzungen des Managements abweichen.

### Aktuelle Verlautbarungen zur Bilanzierung

Im Juni 2004 wurde die EITF Issue Nr. 03-1, „The Meaning of Other-Than-Temporary Impairment and its Application to Certain Investments“, veröffentlicht. EITF Issue Nr. 03-1 beinhaltet neue Anleitungen für die Beurteilung und Erfassung anderer als vorübergehender Verluste auf Gläubiger- und Anteilspapiere, bilanziert unter SFAS Nr. 115, „Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities“, und auf zu Anschaffungskosten bilanzierte Finanzanlagen, sowie neue Offenlegungspflichten für bestimmte Finanzanlagen, die als vorübergehend wertgemindert betrachtet werden. Während die Offenlegungsanforderungen für bestimmte Gläubiger- und Anteilspapiere und zu Anschaffungskosten bilanzierte Finanzanlagen für nach dem 15. Dezember 2003 endende Berichtsperioden anzuwenden sind, hat das FASB die FASB-Mitarbeiter angewiesen, die Einführung der in EITF Issue Nr. 03-1 enthaltenen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrift aufzuschieben. Diese Aufschiebung befreit nicht von den Verpflichtungen zur Bilanzierung von anderen als vorübergehenden Wertminderungen auf Grund bereits bestehender verbindlicher Vorschriften. Die Gesellschaft erwartet aus der Anwendung von EITF Issue Nr. 03-1 keine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens- oder Ertragslage.

Im November 2004 hat das FASB das SFAS Nr. 151, „Inventory Costs – an amendment of ARB No. 43, Chapter 4“, veröffentlicht. Dieses stellt die Bilanzierung von außergewöhnlich hohen Beträgen für Leerkosten, Fracht, Abwicklungskosten und Ausschuss klar und verlangt, dass diese Kosten in der gegenwärtigen Berichtsperiode als Aufwand erfasst und die Fertigungsgemeinkosten den Vorräten auf Basis einer normalen Kapazitätsauslastung der Produktionsstätten zugerechnet werden. SFAS Nr. 151 findet für die Gesellschaft ab dem 1. Oktober 2005 Anwendung. Die Gesellschaft erwartet aus der Anwendung von SFAS Nr. 151 keine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens- oder Ertragslage.

Im Dezember 2004 hat das FASB das SFAS Nr. 153, „Exchanges of Nonmonetary Assets – An Amendment of APB Opi-

nion No. 29“, veröffentlicht. Dieses Statement beseitigt die Befreiung für nicht monetäre Übertragungen von gleichartigen Produktionsanlagen und ersetzt diese durch eine generelle Befreiung der Übertragung von nicht monetären Vermögensgegenständen, die keine wirtschaftliche Substanz haben. Die Gesellschaft wendet SFAS Nr. 153 für Übertragungen von nicht monetären Vermögensgegenständen am und nach dem 1. Juli 2005 an. Die Anwendung von SFAS Nr. 153 hatte keine wesentliche Auswirkung auf die Vermögens- oder Ertragslage.

Im Dezember 2004 hat das FASB das Statement SFAS Nr. 123 (revised 2004), „Accounting for Share-Based Payments“, veröffentlicht. SFAS Nr. 123 (revised 2004) verlangt von Aktiengesellschaften, die Kosten für Mitarbeitervergütung in Form von eigenkapitalbasierten Instrumenten am Ausgabetag mit dem Marktwert zu bewerten und die Kosten über den Zeitraum der Beschäftigung des Mitarbeiters für diese Vergütung erfolgswirksam zu realisieren. SFAS Nr. 123 (revised 2004) schließt das Wahlrecht der Bilanzierung von an Mitarbeiter ausgegebene Aktien gemäß APB Nr. 25 aus. Die Securities and Exchange Commission hat am 14. April 2005 eine Anleihe veröffentlicht, nach der Publikumsgesellschaften SFAS Nr. 123 (revised 2004) in ihrem ersten Geschäftsjahr beginnend nach dem 15. Juni 2005 anzuwenden haben. Dementsprechend wird die Gesellschaft SFAS Nr. 123 (revised 2004) beginnend ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 anwenden. Durch die Anwendung des SFAS Nr. 123 (revised 2004) werden keine materiellen Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage erwartet. Gleichwohl geht die Gesellschaft davon aus, dass die Anwendung eine derzeit noch nicht exakt bestimmbare nachteilige Auswirkung auf die Ertragslage haben wird.

### 3 AKQUISITIONEN

Die Gesellschaft hat ein Joint Venture Infineon Technologies Flash (früher „Ingentix“) mit Saifun Semiconductors Ltd. („Saifun“) im April 2001 gegründet, an dem die Gesellschaft ursprünglich 51 Prozent der Anteile gehalten hatte. Im Geschäftsjahr 2003 hat die Gesellschaft ihre Geschäftsanteile an der Infineon Technologies Flash auf 70 Prozent erhöht und dabei Barmittel und in Eigenkapital umgewandelte Darlehen eingebracht. Das Joint Venture betrieb zwei Gesellschaften, die Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG mit Sitz in Dresden, Deutschland, und Infineon Technologies Flash Ltd. mit Sitz in Netanya, Israel. Im Dezember 2004 haben Saifun und die Gesellschaft ihre Kooperationsvereinbarung modifiziert. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die Gesellschaft den verbleibenden 30-prozentigen Anteil von Saifun am Infineon Technologies Flash Joint Venture im Januar 2005 übernommen und eine Lizenz für die Nutzung der NROM®-Technologien von Saifun erhalten. Hierfür sind 95 Millionen US-Dollar über zehn Jahre in

vierteljährlichen Raten zu zahlen; zudem fällt eine zusätzliche Kaufpreiszahlung durch Übernahme von Nettoverbindlichkeiten in Höhe von €7 an (siehe Anhang Nr. 5). Die erworbenen Vermögensgegenstände und die damit verbundenen Verbindlichkeiten wurden am Tag der Akquisition zu ihren Marktwerten in der beiliegenden Konzernbilanz erfasst. Auf Grund der höheren Kaufpreiszahlung gegenüber den Marktwerten dieser Vermögensgegenstände und den damit verbundenen Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft einen Geschäfts- und Firmenwert in Höhe von €7 bilanziert. Die vorläufige Kaufpreisallokation kann innerhalb eines Jahres nach dem Erwerb auf Grund von Änderungen in den Annahmen der Marktpreise der erworbenen Vermögensgegenstände und den verbundenen Verbindlichkeiten angepasst werden. Die Gesellschaft ist nun alleiniger Eigentümer dieses Unternehmens und hat dessen Ergebnisse ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 vollständig konsolidiert (siehe Anhang Nr. 21).

Am 30. April 2004 schloss die Gesellschaft die Übernahme von 100 Prozent der ADMtek Inc., Hsinchu, Taiwan („ADMtek“), für €75 in bar ab, wovon €6 zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen auf einem Treuhandkonto hinterlegt sind. Eine weitere Zahlung in Höhe von €28 ist auf einem Treuhandkonto hinterlegt und wird als für Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel bilanziert. Diese Zahlung ist vorgesehen zur Mitarbeiterbindung und das Erreichen bestimmter Geschäfts- und Entwicklungsziele über die nächsten zwei Jahre und wird auf Basis erreichter Meilensteine fällig. Zum 30. September 2005 hat die Gesellschaft einen Betrag in Höhe von €8 an ADMtek gezahlt; €13 sind an die Gesellschaft zurückgefließen, da bestimmte Entwicklungen und Meilensteine bisher nicht erfüllt wurden. Zum 30. September 2005 befindet sich noch ein Betrag von insgesamt €13 auf dem Treuhandkonto. Die Akquisition ermöglichte Infineon den Einstieg in den Markt für Home-Gateway-Systeme im Bereich der drahtgebundenen Kommunikation.

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots hat die Gesellschaft am 18. Juni 2003 92,5 Prozent sowie bis zum 30. Juni 2003 die restlichen 7,5 Prozent der ausstehenden Aktien der SensoNor AS („SensoNor“) für insgesamt €34 in bar erworben. Zusätzlich brachte die Gesellschaft im Zuge des Erwerbsvorgangs €13 Eigenkapital ein. SensoNor entwickelt, produziert und vermarktet Reifendrucküberwachungssysteme und Sensoren für die Beschleunigungsmessung. Mit dem Erwerb wollte die Gesellschaft ihre Position auf dem Automobilmarkt im Bereich der Halbleitersensoren stärken. Auf Grund der Reorganisation des SensoNor-Geschäfts im Geschäftsjahr 2004 realisierte die Gesellschaft eine im Rahmen des Erwerbs gebildete Wertberichtigung auf latente Steuern von €8 und reduzierte im gleichen Rahmen den Geschäfts- und Firmenwert. Im Geschäftsjahr 2005 hat die Gesellschaft bei SensoNor eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Die ursprüngliche Kaufpreisallokation wurde durch eine Rück-

nahme der Wertberichtigung auf latente Steuern in Höhe von €30 angepasst sowie der Geschäfts- und Firmenwert und andere immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von €14 und €16 reduziert.

Am 1. April 2003 hat die Gesellschaft den Netto-Vermögenerwerb von MorphICs Technology Inc. („MorphICs“) für €6 in bar abgeschlossen. MorphICs entwickelt digitale Basisbandschaltungen der dritten Generation für drahtlose Kommunikation. Die Erwerbsvereinbarung beinhaltet ebenfalls eine zusätzliche Vergütung von €9, die bei Erreichen bestimmter Meilensteine bezahlt werden. Zum 30. September 2005 verliefen zusätzliche Vergütungen in Höhe von €6, da bestimmte Entwicklungen nicht erreicht worden sind. Der restliche Betrag der Vergütung in Höhe von €3 wird beim Erreichen bestimmter Entwicklungen im Geschäftsjahr 2006 bezahlt.

Am 9. September 2002 erwarb die Gesellschaft alle Aktien der in Schweden ansässigen Ericsson Microelectronics AB („MIC“). MIC ist ein Hersteller von Hochfrequenz-Mikroelektronikbauteilen für Mobilfunkapplikationen, High-End-Leistungsverstärker, Bluetooth-Bauteile und Breitband-Kommunikationsprodukten. Damit fungiert MIC als strategischer Zulieferer von Ericsson, einem Marktführer bei Basisstationen, für Bluetooth-Lösungen und Hochfrequenz-Bauteile für Mobiltelefone und drahtlose Infrastruktur. Ferner traf die Gesellschaft eine strate-

gische Liefervereinbarung mit Ericsson über eine Laufzeit von zwei Jahren mit bestimmten Einkaufsschwellenvereinbarungen, wofür eine Verbindlichkeit in Höhe von €50 zum 30. September 2002 gebildet worden ist.

Im Juni 2003 haben die Gesellschaft und Ericsson eine Ergänzungsvereinbarung zur MIC-Erwerbsvereinbarung unterzeichnet. Die Gesellschaften beabsichtigten, ihre strategische Kooperation auf verschiedenen Gebieten der Mobilfunktechnologie und Mobilfunkinfrastruktur inklusive Bluetooth-Lösungen, RF ICs, RF Power und anderer Anwendungen zu verstärken. Darüber hinaus haben die Gesellschaften den Verzicht auf die restliche an Ericsson zahlbare Kaufpreisverpflichtung sowie die Aufhebung der noch nicht erfüllten Abnahmeverpflichtungen und zugehörigen Vertragsstrafe vereinbart. Zusätzlich erhielt die Gesellschaft €50 von Ericsson. Diese Beträge wurden als Anpassung berichtet – im Wesentlichen beim Geschäfts- und Firmenwert, aber auch bei den immateriellen Vermögensgegenständen und den latenten Steuern. Zudem wurden während des am 30. September 2003 abgelaufenen Geschäftsjahrs als Folge des restrukturierten MIC-Geschäfts die Eröffnungsbuchungen angepasst und die ursprüngliche Wertberichtigung auf aktivierte latente Steuern von €16 zurückgenommen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Akquisitionen der Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 zusammen:

Erwerbszeitpunkt Segment	2003		2004	2005
	SensoNor	Sonstige	ADMtek	Flash
	Juni 2003 Automobil-, Industrie- elektronik und Multimarket	2003 Verschiedene	April 2004 Kommunikation	Januar 2005 Speicherprodukte
Zahlungsmittel	3	–	18	1
Sonstiges Umlaufvermögen	6	1	10	16
Sachanlagen	25	1	2	4
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Aktuelle Produkttechnologie	5	5	14	–
Basistechnologie	–	–	5	58
Patente (Kundenbeziehungen)	–	2	2	–
Erworbene F&E	4	2	9	–
Geschäfts- und Firmenwert	–	6	23	7
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	38	–	1	3
<b>Gesamte erworbene Vermögensgegenstände</b>	<b>81</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>89</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	–11	–9	–8	–45
Langfristige Verbindlichkeiten	–36	–	–1	–2
<b>Gesamte übernommene Verbindlichkeiten</b>	<b>–47</b>	<b>–9</b>	<b>–9</b>	<b>–47</b>
<b>Erworbenes Nettovermögen</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>42</b>
Barzahlung	34	8	75	–

Die oben aufgeführten Akquisitionen wurden nach der Erwerbsmethode bilanziert. Somit enthält das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit die Ergebnisse der erworbenen Gesellschaften ab dem jeweiligen Erwerbszeitpunkt.

Bei jeder wesentlichen Akquisition wurde ein unabhängiger Dritter zur Bewertung des erworbenen Nettovermögens hinzugezogen. Als Folge dieser Bewertungen wurden in den Geschäftsjahren 2003 und 2004 Beträge von €6 und €9 für erwor-

bene, noch nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten („erworbene F&E“) den F&E-Aufwendungen zugerechnet, da eine technologische Anwendung der Entwicklungen noch nicht erkennbar war und keine zukünftige Alternativnutzung existierte.

Auf die Aufstellung von Pro-forma-Finanzdaten wurde verzichtet, da die Akquisitionen einzeln und im Gesamten gesehen keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage haben.

#### 4 AUFGEBEBENE GESCHÄFTE UND GESCHÄFTS-ANTEILSVERÄUSSERUNGEN

##### Aufgegebene Geschäfte

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und OSRAM GmbH („Osram“) hat die Gesellschaft ihre gesamten optoelektronischen Aktivitäten zum 31. März 2003 an Osram übertragen. Die Vereinbarung beinhaltet die Übergabe aller Kundenbeziehungen und zugehörigen Auftragsbestände sowie die Kündigung aller optoelektronischen Vertriebsvereinbarungen durch die Gesellschaft und gibt der Gesellschaft bestimmte Rechte zur Rückgabe von zum 31. März 2003 nicht verkauften Beständen. Der Gesellschaft ist aus der Aufgabe der optoelektronischen Aktivitäten kein Verlust entstanden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt Vergleichswerte für das aufgegebene Geschäft, das früher unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten war, für das Geschäftsjahr 2003:

	2003
<b>Optoelektronik:</b>	
<b>Umsatzerlöse:</b>	
Dritte	113
Verbundene Unternehmen	32
<b>Gesamte Umsatzerlöse</b>	<b>145</b>
Ergebnis vor Steuern aus aufgegebenem Geschäft	–
Steueraufwendungen	–
<b>Ergebnis aus aufgegebenem Geschäft</b>	<b>–</b>

In den Geschäftsjahren 2004 und 2005 hatte das aufgegebene Geschäft keine Auswirkung auf die Ertragslage der Gesellschaft, und zum 30. September 2004 und 2005 gab es keine ausstehenden Bilanzpositionen.

##### Veräußerung von Geschäftsanteilen

Im August 2003 hat die Gesellschaft ihren Anteil an UMCi verkauft und einen Vor-Steuer-Verlust von €9 realisiert. Dieser Betrag ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Am 1. Juli 2002 vollendete die Gesellschaft den Verkauf ihres Gallium-Arsenid-Geschäfts, das zum Segment Kommunikation gehörte, einschließlich bestimmter, nicht fertigungsrelevanter materieller und immaterieller Vermögensgegenstände sowie spezifizierter Kundenverträge und Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft hat in diesem Zusammenhang eine ursprüngliche Zahlung in Höhe von €50 erhalten. Eine Kaufpreisanpassung wurde durch die Menge verkaufter Gallium-Arsenid-Produkte, deren Preise wesentlich unter dem Marktpreis lagen und die bis zum 30. September 2004 durch den Erwerber abgesetzt wurden, ausgelöst. Daraufhin hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2004 bedingte Kaufpreisanpassungen vorgenommen, die in einer Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von €13 resultierten und im Geschäftsjahr 2005 gezahlt wurden.

Am 23. Dezember 2004 hat die Gesellschaft vereinbart, ihre Venture-Capital-Aktivitäten als Teil des Segments Sonstige Geschäftsbereiche an Cipio Partners, eine Wagniskapitalgesellschaft, zu verkaufen. Im Rahmen des Vertrags verkaufte die Gesellschaft ihre Beteiligung an der Infineon Venture GmbH, die den Großteil der Wagniskapitalbeteiligungen der Gesellschaft beinhaltete. Die Transaktion wurde am 23. Februar 2005 abgeschlossen. Der daraus erzielte Gewinn vor Steuern in Höhe von €13 ist in den sonstigen Erträgen enthalten.

Die Gesellschaft hat am 29. April 2004 eine Vereinbarung mit Finisar Corporation („Finisar“) über den Verkauf des Glasfaserkomponentengeschäfts, eines Teils des Segments Kommunikation, geschlossen. Am 11. Oktober 2004 wurde einer Änderung der Vereinbarung zugestimmt, nach der Infineon 110 Millionen Finisar-Stammaktien als Gegenleistung für die Veräußerung des Glasfaserkomponentengeschäfts und als finanzielle Unterstützung künftiger Restrukturierungsmaßnahmen erhalten hätte. Die Zahl der letztendlich zu erhaltenden Aktien wäre abhängig von der Veränderung im Netto-Umlaufvermögen des Glasfaserkomponentengeschäfts gewesen. Zusätzlich enthielt die Vereinbarung eine Anti-Wettbewerbs-Klausel über drei Jahre und limitierte die Schadensersatzhaftung auf 20 Prozent des durch Finisar gezahlten Gegenwerts. Die Vereinbarung wäre im gegenseitigen Einvernehmen beendet worden, wenn die Transaktion nicht bis zum 31. März 2005 abgeschlossen worden wäre.

Am 11. Januar 2005 hat die Gesellschaft entschieden, den am 11. Oktober 2004 einvernehmlich geänderten Vertrag mit Finisar zu kündigen. Am 25. Januar 2005 haben Finisar und die Gesellschaft einen neuen Vertrag unterzeichnet, dem zufolge Finisar bestimmte Vermögensgegenstände des Glasfaserkomponentengeschäfts von der Gesellschaft erwarb. Gemäß der neuen Vereinbarung hat die Gesellschaft 34 Millionen Finisar-Aktien im Wert von €40 für Vorräte, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Verbindung mit der Entwicklung und der Produktion von optischen Transceiver-Produkten erhalten. Auf Basis separater Liefervereinbarungen verpflichtete sich die Gesellschaft, für eine Dauer von bis zu einem Jahr

nach Abschluss der Transaktion Produkte für Finisar zu fertigen. Eine Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre oder Behörden ist nicht erforderlich. Die Transaktion wurde am 31. Januar 2005 abgeschlossen und führte zu einem Gewinn vor Steuern in Höhe von €21, der in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ist.

Am 8. April 2005 verkaufte Infineon die 34 Millionen Finisar-Stammaktien an VantagePoint Venture Partners. Als Ergebnis des Verkaufs hat die Gesellschaft im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 Wertminderungen in Höhe von €8 erfasst, die in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen worden sind, um den Beteiligungsbuchwert an den Nettoverkaufserlös anzupassen.

Bei der Gesellschaft verbleiben die übrigen Teile ihres Glasfaserkomponentengeschäfts, wie Bi-Directional-Fiber-Transmission(BIDI)-Komponenten für Fiber-To-The-Home (FTTH) Anwendungen, parallele optische Komponenten (PAROLI) und Plastic-Optical-Fiber(POF)-Komponenten, die in Anwendungen im Automobilbau zum Einsatz kommen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 wurden diese Vermögensgegenstände von der Kategorie „Zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände“ in die Kategorie „Zur Nutzung bestimmte Vermögensgegenstände“ umgegliedert und umstrukturiert. Die Umgliederung der zur Nutzung bestimmten Vermögensgegenstände des verbliebenen Glasfaserkomponentengeschäfts erfolgte am 25. Januar 2005 zum niedrigeren Wert aus Marktwert und Buchwert, der vor Umgliederung für die zum Verkauf stehenden Vermögensgegenstände bestand, vermindert um Abschreibungen, die bei fortbestehender Klassifizierung als zur Nutzung bestimmte Vermögensgegenstände angefallen wären. Dementsprechend hat die Gesellschaft im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 Wertminderungen in Höhe von €34 vorgenommen, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.

Am 2. August 2005 verkaufte die Gesellschaft langfristige Vermögensgegenstände aus der Entwicklung und Produktion von Bi-Directional-Fiber-Transmission(BIDI)-Komponenten an EZConn Corporation („EZConn“) gegen eine Barzahlung in Höhe von €3. Gleichzeitig verpflichtete sich die Gesellschaft, bis März 2006 Produkte für EZConn zu fertigen und zu liefern. Als Ergebnis der Transaktion hat die Gesellschaft einen Gewinn vor Steuern in Höhe von €2 erzielt, der in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ist. Zusätzlich wurden €1 abgegrenzt, die über den Zeitraum der Produktionsvereinbarung realisiert werden.

Am 7. April 2005 trafen die Gesellschaft und Exar Corporation („Exar“) eine Vereinbarung, nach der Exar einen wesentlichen Teil der Optischen-Netzwerk-Aktivitäten von der Gesellschaft gegen eine Barzahlung in Höhe von 11 Millionen US-Dollar erwarb. Entsprechend der Vereinbarung beinhaltet die Transaktion Vermögensgegenstände im Bereich der Multi-Raten-TDM-Framer-Produkte, Fiber Channel over SONET/SDH, Resilient Packet Ring (RPR) und spezifisches geistiges Eigentum für die Data Over SONET. Als Ergebnis dieser Transaktion hat die Gesellschaft diese langfristigen Vermögensgegenstände im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 als zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände umgegliedert und den Buchwert entsprechend dem Nettoverkaufserlös verringert. Der Verkauf der Vermögensgegenstände wurde im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 vollständig abgeschlossen.

Nachfolgend werden die Finanzinformationen zu den veräußerten Geschäftseinheiten (bis zum Tag der Veräußerung) für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 jeweils zum 30. September zusammenfassend dargestellt:

	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Gallium-Arsenid	45	–	–
Fiber Optics	41	35	23
BIDI	7	10	6
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>93</b>	<b>45</b>	<b>29</b>
<b>Ebit:</b>			
Gallium-Arsenid	5	–	–
UMCi	–11	–	–
Infineon Ventures GmbH	–25	–52	–3
Fiber Optics	–25	–33	–27
BIDI	–9	–28	–20
<b>Summe Ebit</b>	<b>–65</b>	<b>–113</b>	<b>–50</b>
Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
Gallium-Arsenid	–	–	–
UMCi	–9	–	–
Infineon Ventures GmbH	–	–	13
Fiber Optics	–	–	21
BIDI	–	–	2
Sonstige	–1	–2	3
<b>Summe Ergebnis aus der Veräußerung vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>Ertrag</b> (siehe Anhang Nr. 7)	<b>–10</b>	<b>–2</b>	<b>39</b>

## 5 LIZENZEN

In den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 weist die Gesellschaft Umsätze aus Lizenz- und Know-how-Überlassungsverträgen in Höhe von €183, €76 und €175 in den Konzern-Gewinn- und -Verlust-Rechnungen aus. Darin enthalten sind früher abgegrenzte Lizenzerlöse in Höhe von €135, €48 und €33, die entsprechend SAB 104 in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 als Umsatz realisiert wurden, da alle Verpflichtungen erfüllt wurden.

Im März 2000 hat die Gesellschaft mit ProMOS Technologies Inc. („ProMOS“) ein Technologietransfer-Abkommen geschlossen und bestehende Verträge mit Mosel Vitelic Inc. („MVI“), dem größten Anteilseigner von ProMOS, neu geordnet. Noch nicht vereinnahmte Lizenzerlöse von MVI wurden über die Laufzeit dieser abgeänderten Verträge als Umsätze realisiert.

Im Februar 2003 haben die Gesellschaft, ProMOS und MVI vereinbart, eine bestehende Verbindlichkeit gegenüber einem Dritten in Höhe von €60 zu tilgen, für die die Gesellschaft eine Garantie übernommen hatte. In diesem Zusammenhang wurden auch weitere Forderungen und Verbindlichkeiten der Parteien glattgestellt. Daher hat die Gesellschaft früher abgegrenzte Lizenzeinnahmen in Höhe von €60, die in Beziehung zu dieser Garantie standen, zum 30. September 2003 realisiert, da der Betrag vereinnahmt war.

Auf Grund der Änderung der Vereinbarung über den Austausch von Technologien zwischen der Gesellschaft und ProMOS wurden zusätzliche €36 als Umsatz zum 30. September 2003 realisiert, da die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen erfüllt hat. Dieser Betrag wurde zuvor als abgegrenzte Lizenzeinnahme erfasst.

Am 10. November 2004 haben die Gesellschaft und ProMOS eine Vereinbarung über die Lizenzvergabe von früher an ProMOS transferierten Technologien abgeschlossen. ProMOS darf Produkte auf Basis dieser Technologien herstellen und vertreiben und darauf basierende eigene Prozesse und Produkte entwickeln. Die Gesellschaft hat keine künftigen Verpflichtungen aus dieser Lizenzvergabe. ProMOS stimmte zu, einen Gesamtpreis von 156 Millionen US-Dollar in vier Raten bis April 2006 zu bezahlen. Bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von 36 Millionen US-Dollar aus dem Bezug von Produkten von ProMOS wurden angerechnet. Die Parteien haben vereinbart, alle damit verbundenen Klagen zurückzuziehen, inklusive des Schiedsgerichtsverfahrens. Der Barwert der Vereinbarung in Höhe von €118 wurde als Lizenzeinnahme im Quartal zum 31. Dezember 2004 realisiert.

Im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Technologieentwicklung, die mit Nanya Technology Corporation („Nanya“) durchgeführt wird (siehe Note 16), hat Infineon dem Joint-Venture-Partner 2003 ein Lizenznutzungsrecht über die 110-Nanometer-Technologie in dessen bestehenden Betrieben eingeräumt. Die Lizenzeinkünfte werden gleichmäßig über den Technologielebenszyklus realisiert.

Im Zusammenhang mit einer Vereinbarung über die Erweiterung von Kapazitätsreservierungen mit Winbond Electronics Corp., Hsinchu, Taiwan („Winbond“), im August 2004 gewährte die Gesellschaft Winbond eine Lizenz über die Nutzung ihrer 110-Nanometer-Technologie in Winbonds Produktionsprozess für die für die Gesellschaft produzierten Produkte. Die Lizenzerträge wurden abgegrenzt; sie werden über die Laufzeit der Vereinbarung realisiert.

Am 18. März 2005 haben die Gesellschaft und Rambus Inc. („Rambus“) ein Lizenzabkommen abgeschlossen, nach dem die Gesellschaft das Patentportfolio von Rambus für heutige und künftige Produkte der Gesellschaft nutzen kann. Im Rahmen des Abkommens erhält die Gesellschaft eine weltweit gültige Lizenz für die Nutzung von existierenden und künftigen Rambus-Patenten und -Patentanmeldungen für Speicherprodukte. Die Gesellschaft sagte zu, für die weltweit gültige Lizenz 50 Millionen US-Dollar in vierteljährlichen Raten zu 6 Millionen US-Dollar vom 15. November 2005 bis zum 15. November 2007 zu zahlen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 hat die Gesellschaft eine Lizenz und eine korrespondierende Verbindlichkeit in Höhe von €37 bilanziert, die dem Barwert der zukünftigen Mindestlizzenzzahlungen entsprechen. Nach dem 15. November 2007 – und nur wenn Rambus zusätzliche Lizenzabkommen mit bestimmten weiteren Speicherherstellern abschließt – würde die Gesellschaft vierteljährliche Zahlungen bis zu maximal 100 Millionen US-Dollar zusätzlich tätigen. Die Gesellschaft hat darüber hinaus die Option, bestimmte andere Lizenzen von Rambus zu erwerben. Mit dem vereinbarten Lizenzabkommen erhält die Gesellschaft den Status „bevorzugter Kunde“ („most-favored customer“) von Rambus. Rambus erhält von der Gesellschaft eine unbefristete und vollständig abgeglichene Lizenz für Speicherschnittstellen-Patente. Über die Lizenzvereinbarungen hinaus einigten sich beide Unternehmen, alle schwebenden Rechtsstreitigkeiten beizulegen und alle bestehenden Rechtsansprüche fallen zu lassen.

In Verbindung mit der Übernahme des verbleibenden 30-prozentigen Anteils von Saifun am Infineon Technologies Flash Joint Venture im Januar 2005 hat die Gesellschaft eine Lizenz

für die Nutzung der NROM®-Technologien von Saifun erhalten (siehe Anhang Nr. 3). Im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 hat die Gesellschaft eine Lizenz in Höhe von €58 und eine damit verbundene Verbindlichkeit in Höhe von €58 bilanziert, die den Marktwert der Lizenz und die zukünftigen Lizenzzahlungen darstellt. Infineon erhielt die Möglichkeit, die Lizenz im Ganzen oder teilweise zu jeder Zeit ohne Strafen zu kündigen. Im Quartal zum 30. Juni 2005 hat die Gesellschaft das Recht zur Aufhebung genutzt und den Teil der Lizenz gekündigt, der die NROM® Code Flash-Produkte beinhaltet. Als Ergebnis der Teilkündigung wurden zum 30. Juni 2005 die immateriellen Vermögensgegenstände und die damit verbundenen Verbindlichkeiten auf €28 bzw. €29 reduziert.

## 6 ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN

Die Gesellschaft hat im Rahmen staatlicher Wirtschaftsförderungsprogramme von verschiedenen staatlichen Stellen Fördermittel u. a. für die Errichtung von Fertigungsstätten, für Forschung und Entwicklung und Mitarbeiterschulung erhalten. Die in den vorliegenden konsolidierten Konzernabschlüssen enthaltenen Zuschüsse setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2003	2004	2005
In der Konzern-Gewinn- und-Verlust-Rechnung sind enthalten:			
Forschungs- und Entwicklungszuschüsse	59	74	50
Umsatzkosten	54	86	121
	113	160	171
Investitionszuschüsse, die von den Anschaffungskosten der Sachanlagen abgesetzt wurden	17	49	-
Abgegrenzte staatliche Zulagen (siehe Anhang Nr. 20 und 22)	303	281	288

## 7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

Die Materialaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2003	2004	2005
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.675	1.621	1.867
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.126	1.232	1.166
<b>Summe Materialaufwendungen</b>	<b>2.801</b>	<b>2.853</b>	<b>3.033</b>

Die Personalaufwendungen setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2003	2004	2005
Löhne und Gehälter	1.490	1.532	1.664
Sozialabgaben	268	280	285
Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 28)	27	28	28
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.785</b>	<b>1.840</b>	<b>1.977</b>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, netto, setzen sich für die Geschäftsjahre wie folgt zusammen:

	2003	2004	2005
Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Geschäftseinheiten (siehe Anhang Nr. 4)	-10	-2	39
Wertberichtigung auf Geschäfts- und Firmenwert sowie sonstige immaterielle Vermögensgegenstände (siehe Anhang Nr. 17)	-68	-71	-57
Wertberichtigung auf langfristige Vermögensgegenstände	-	-	-39
Kartellrechtlich bezogene Aufwendungen (siehe Anhang Nr. 31)	-20	-194	-20
Abgrenzung der Ausgabekosten der Wandelanleihe	-4	-8	-4
Andere	17	18	-11
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen, Saldo</b>	<b>-85</b>	<b>-257</b>	<b>-92</b>

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter nach Regionen für die Geschäftsjahre zum 30. September ist in folgender Übersicht dargestellt:

	2003	2004	2005
Deutschland	16.043	16.340	<b>16.334</b>
Übriges Europa	4.753	5.507	<b>5.606</b>
Nordamerika	2.779	2.822	<b>3.108</b>
Asien-Pazifik	7.725	9.220	<b>10.919</b>
Japan	108	126	<b>147</b>
Andere	115	112	<b>44</b>
<b>Summe Mitarbeiter</b>	<b>31.523</b>	<b>34.127</b>	<b>36.158</b>

Die gesamten Aufwendungen für Operating-Lease-Verträge betragen in den Geschäftsjahren 2003 €138, 2004 €126 und 2005 €125.

## 8 UMSTRUKTURIERUNGSMASSNAHMEN

Während des Geschäftsjahrs 2003 hatte die Gesellschaft Maßnahmen zur Umsetzung der Kostensenkung angekündigt. Diese beinhalteten die Entlassung von Mitarbeitern, Dezentralisierung und Outsourcing bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen plante die Gesellschaft, 550 Mitarbeiter vorwiegend in Konzernfunktionen und der Logik-Produktion, aber auch durch die von Auslagerungen an externe Anbieter zu entlassen.

Im Geschäftsjahr 2004 hat die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Kostensenkung angekündigt. Diese beinhalteten die Entlassung von Mitarbeitern, die Dezentralisierung und das Outsourcing bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen gab die Gesellschaft die geplante Entlassung von 325 Mitarbeitern bekannt. Die Entlassungen in 2004 sind hauptsächlich das Ergebnis der

Verlegung von Aktivitäten von Regensburg und München nach Dresden und der Verkleinerung von Design Centern in England, Irland, Schweden und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die geplanten Entlassungen wurden im Geschäftsjahr 2005 durchgeführt.

Während des Geschäftsjahrs 2005 hat die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen. Diese beinhalteten die Entlassung von Mitarbeitern und die Zusammenfassung bestimmter Funktionen und Geschäfte. Als Teil dieser Umstrukturierungsmaßnahmen beschloss die Gesellschaft die Entlassung von ungefähr 350 Mitarbeitern. Die Entlassungen sind hauptsächlich die Folge der Einstellung des Glasfaserkomponentengeschäfts in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Entlassungen werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2006 abgeschlossen sein. Zusätzlich hat die Gesellschaft weitere Umstrukturierungsmaßnahmen für die Chipfertigung innerhalb des Fertigungsverbunds Perlach, Regensburg und Villach beschlossen. Vorgesehen ist, die Produktion von München-Perlach im Wesentlichen nach Regensburg und zu einem geringeren Teil nach Villach zu verlagern. Die Fertigung im Werk München-Perlach soll bis Anfang 2007 auslaufen, da eine Vielzahl der Produkte das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Als Teil der Umstrukturierungsmaßnahmen plant die Gesellschaft die Entlassung von ungefähr 600 Mitarbeitern. Der Personalabbau wird voraussichtlich im Geschäftsjahr 2007 abgeschlossen sein.

In den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 wurden infolge der Umstrukturierungsmaßnahmen der Gesellschaft Aufwendungen in Höhe von €29, €17 und €78 ausgewiesen. Zudem wurden im Geschäftsjahr 2003 €11, die früher für Umstrukturierung zurückgestellt wurden, im Rahmen einer Vereinbarung eines Dienstleistungsvertrags erlassen. Dieser Betrag wurde entsprechend in den Rückstellungen abgegrenzt und über die Laufzeit des Servicevertrags erfolgswirksam aufgelöst.

Die Entwicklung der Restrukturierungsaufwendungen setzte sich zum 30. September 2005 wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr zum 30. September	2004		2005		
	Verbindlichkeiten	Umgliederungen	Restrukturierungsaufwendungen	Zahlungen	Verbindlichkeiten
Abfindungen	10	2	74	-22	64
Andere Ausstiegskosten	6	-	4	-2	8
<b>Gesamt</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>-24</b>	<b>72</b>



## 9 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der Gewinn (Verlust) vor Steuern und vor Abzug der auf die Minderheitsgesellschafter entfallenden Ergebnisanteile verteilt sich in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 wie folgt auf die Regionen:

	2003	2004	2005
Deutschland	-506	153	-298
Ausland	147	44	104
<b>Gesamt</b>	<b>-359</b>	<b>197</b>	<b>-194</b>

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und Ertrag ermitteln sich für die zum 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre wie folgt:

	2003	2004	2005
<b>Laufender Steueraufwand:</b>			
Deutschland	18	53	31
Ausland	50	5	1
	68	58	32
<b>Latente Steuern:</b>			
Deutschland	40	129	66
Ausland	-24	-33	22
	16	96	88
<b>Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>84</b>	<b>154</b>	<b>120</b>

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag sind für die zum 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre wie folgt ausgewiesen:

	2003	2004	2005
Steuern vom Einkommen und Ertrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	84	154	120
Geschäfts- und Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände, für den erstmaligen Ausweis von erworbenen Steuervorteilen, die bisher Gegenstand einer Wertberichtigung waren (siehe Anhang Nr. 3)	-16	-8	-30
Eigenkapital, für unrealisierte Gewinne (Verluste) aus gehaltenen Wertpapieren, unrealisierte Gewinne (Verluste) aus Sicherungsgeschäften und zusätzlichen Mindestpensionsverbindlichkeiten	-4	-10	-
	64	136	90

Der Körperschaftsteuersatz der Gesellschaft beträgt 25 Prozent. Zusätzlich werden ein Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent und Gewerbesteuer in Höhe von 13 Prozent erhoben, was einer Gesamtsteuerbelastung von 39 Prozent entspricht.

Die folgende Überleitung der Steuern vom Einkommen und Ertrag zum 30. September 2003, 2004 und 2005 erfolgte unter Zugrundelegung eines Gesamtsteuersatzes aus deutscher Körperschaftsteuer zuzüglich Gewerbesteuer für 2003 in Höhe von 41 Prozent (inklusive einer einjährigen Abgabe zur Flutopferhilfe von 2 Prozent) und für 2004 und 2005 in Höhe von jeweils 39 Prozent.

	2003	2004	2005
<b>Erwarteter Ertrag/Aufwand aus Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-147</b>	<b>77</b>	<b>-76</b>
Veränderung verfügbarer Steuervergünstigungen	-35	-26	-5
Steuerfreie Gewinne/Verluste aus Beteiligungen	14	6	-26
Differenz aus abweichenden Steuersätzen im Ausland	1	-51	-18
Steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen und sonstige Rückstellungen	58	69	29
Änderung des deutschen Steuersatzes – Auswirkung auf die Eröffnungsbilanz	2	-	-
Änderung des deutschen Steuersatzes – Auswirkung im laufenden Geschäftsjahr	7	-	-
Veränderung der Wertberichtigung	182	54	192
Nicht abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsprojekte	1	3	-
Sonstiges	1	22	24
<b>Tatsächlicher Aufwand aus Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>84</b>	<b>154</b>	<b>120</b>

Die aktiven und passiven latenten Steuern setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
<b>Aktive latente Steuern:</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	100	26
Sachanlagen	155	203
Passive Rechnungsabgrenzung	109	111
Verlustvortrag und Steuervergünstigungen	919	1.065
Sonstiges	227	169
Bruttobetrag der aktiven latenten Steuern	1.510	1.574
Wertberichtigungen	-567	-740
<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>943</b>	<b>834</b>
<b>Passive latente Steuern:</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	11
Sachanlagen	125	81
Forderungen	11	36
Rückstellungen	75	72
Sonstiges	39	41
<b>Passive latente Steuern</b>	<b>299</b>	<b>241</b>
<b>Summe latente Steuern, Saldo</b>	<b>644</b>	<b>593</b>

Die aktiven und passiven latenten Steuern werden in den konsolidierten Konzernbilanzen zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt ausgewiesen:

	2004	2005
<b>Aktive latente Steuern:</b>		
Kurzfristig	140	125
Langfristig	541	550
<b>Passive latente Steuern:</b>		
Kurzfristig	-16	-17
Langfristig	-21	-65
<b>Summe latente Steuern, Saldo</b>	<b>644</b>	<b>593</b>

Zum 30. September 2005 hatte die Gesellschaft in Deutschland steuerliche Verlustvorträge in Höhe von €2.140 (für Gewerbe- und Körperschaftsteuer und einen zusätzlichen Verlustvortrag nur auf Gewerbesteuer anwendbar in Höhe von €1.147); im Ausland fielen steuerliche Verlustvorträge in Höhe von €232 sowie aktivierte Vorträge aus Steuervergünstigungen in Höhe von €107 an. Diese steuerlichen Verlustvorträge und Steuervergünstigungen sind grundsätzlich nur durch die Gesellschaft nutzbar, bei der die steuerlichen Verluste oder die Steuerforderungen entstanden und nach geltendem Recht nicht verfallen

sind. Erträge aus Steuervergünstigungen werden bei Erwerb des Vermögensgegenstands bilanziert.

Entsprechend dem SFAS Nr. 109 hat die Gesellschaft die aktiven latenten Steuern auf die Notwendigkeit einer Wertberichtigung überprüft. Dazu ist eine Beurteilung erforderlich, ob es wahrscheinlich ist, dass Teile oder der Gesamtbetrag der aktiven latenten Steuern nicht realisierbar sein könnten. Die Überprüfung verlangt vom Management unter anderem eine Beurteilung von Erträgen aus verfügbaren Steuerstrategien und künftigem zu versteuerndem Einkommen sowie anderen positiven oder negativen Faktoren. Die tatsächliche Realisierung von aktiven latenten Steuern hängt von der Möglichkeit der Gesellschaft ab, entsprechendes künftiges zu versteuerndes Einkommen zu generieren, um Verlustvorträge oder Steuervergünstigungen vor ihrem Verfall nutzen zu können. Da die Gesellschaft in bestimmten Steuerhoheiten zum 30. September 2005 über einen Dreijahreszeitraum einen kumulativen Verlust ausgewiesen hat, wird der Einfluss von geplantem zu versteuerndem Einkommen in Übereinstimmung mit den Vorschriften des SFAS Nr. 109 für diese Bewertung ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt für diese Steuerhoheiten dementsprechend nur auf Grund der Erträge, die durch verfügbare Steuerstrategien und die Umkehr von zeitlichen Unterschieden in künftigen Perioden erlöst werden können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Überprüfung hat die Gesellschaft zum 30. September 2005 die Wertberichtigungen auf die aktiven latenten Steuern um €192 erhöht und damit auf einen Betrag gebracht, der wahrscheinlich in Zukunft realisiert werden kann. Während der Geschäftsjahre 2003 und 2004 wurden Wertberichtigungen auf Verlustvorträge für fortgeführte Geschäfte in Höhe von €182 und €54 gebildet, da die vollständige Nutzung dieser Verlustvorträge nicht wahrscheinlich erschien.

Zum 27. Dezember 2003 wurden von der deutschen Regierung neue Steuergesetze erlassen, welche die Verrechnung des Verlustvortrags für deutsche Unternehmenssteuern auf 60 Prozent des jährlichen steuerpflichtigen Gewinns begrenzen. Die neuen Gesetze beschränken nicht die Nutzungsdauer der Verlustvorträge, die weiterhin unbegrenzt bleibt. Für die Gesellschaft sind die neuen Steuergesetze ab dem Geschäftsjahr 2004 gültig. Die neuen Gesetze führten zu einer Erhöhung des laufenden Steueraufwands um €13 und €0 zum 30. September 2004 und 2005.

Die Veränderungen der Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern für die zum 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre stellen sich wie folgt dar:

	2003	2004	2005
<b>Stand zu Beginn des Geschäftsjahrs</b>	<b>310</b>	<b>521</b>	<b>567</b>
Anwendung auf fortgeführte Geschäfte	182	54	192
Aktive latente Steuern, die im Rahmen von Geschäftszusammenschlüssen erworben wurden	45	-	-
Anpassungen aus Erwerbsvorgängen	-16	-8	-30
Anpassung auf entsprechende Verlustvorträge	-	-	11
<b>Stand zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>521</b>	<b>567</b>	<b>740</b>

Die Gesellschaft hat zum 30. September 2005 auf kumulierte einbehaltene Gewinne ausländischer Gesellschaften keine zusätzlichen Ertrag- oder Quellensteuern berechnet, da diese Gewinne in den Auslandsgesellschaften unbegrenzt reinvestiert bleiben sollen. Eine betragsmäßige Schätzung der nicht berücksichtigten passiven latenten Steuern auf diese einbehaltenen Gewinne ist nicht durchführbar.

Die Gesellschaft hat einige Geschäftsaktivitäten in verschiedenen Steuerhoheiten neu organisiert und in den am 30. September 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahren aus den Geschäftsvorfällen zwischen verbundenen Unternehmen einen Steueraufwand von €54 und €85 abgegrenzt, wovon €39 und €71 unter den Langfristigen Vermögensgegenständen ausgewiesen werden (siehe Anhang Nr. 17).

## 10 ERGEBNIS JE AKTIE

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag, geteilt durch den gewogenen Mittelwert der während des Berichtsjahrs ausstehenden Aktien. Bei dem verwässerten Ergebnis je Aktie wird der gewogene Mittelwert der ausstehenden Aktien um die Anzahl der zusätzlichen Stückaktien erhöht, die ausstünden, wenn potenziell verwässernde Instrumente oder Stückaktien ausgegeben worden wären.

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie und das verwässerte Ergebnis je Aktie für die zum 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre (Aktienstückzahl in Millionen) errechnet sich wie folgt:

	2003	2004	2005
<b>Zähler:</b>			
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	-312
<b>Nenner:</b>			
Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – unverwässert	720,9	734,7	747,6
Effekt aus verwässernden Instrumenten	-	1,9	-
<b>Gewichtete Anzahl der ausstehenden Aktien – verwässert</b>	<b>720,9</b>	<b>736,6</b>	<b>747,6</b>
<b>Gewinn/Verlust je Aktie in €:</b>			
unverwässert und verwässert	-0,60	0,08	-0,42

Die durchschnittlichen potenziell verwässernden Instrumente, deren Ausübungspreis während der Berichtsperiode höher war als der durchschnittliche Aktienkurs, sowie diejenigen, die aus anderen Gründen nicht verwässernd gewirkt haben, wurden aus der Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie genommen. Dazu gehörten in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 28,0 Millionen, 24,1 Millionen und 39,4 Millionen an Mitarbeiter ausgegebene Aktienoptionen. Zusätzlich wurden in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 96,6 Millionen, 86,5

Millionen und 86,5 Millionen Aktien, die bei Wandlung der nachrangigen Wandelanleihen ausgegeben werden können, von der Berechnung des Ergebnisses je Aktie ausgenommen, da es keinen Verwässerungseffekt gegeben hätte.

## 11 WERTPAPIERE

Die Wertpapiere setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004				2005			
	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste	Anschaffungskosten	Marktwert	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste
Ausländische Staatsanleihen	9	10	1	-	9	11	2	-
Variabel verzinsliche Anleihen	548	551	7	-4	260	268	8	-
Sonstige Gläubigerpapiere	271	272	1	-	16	18	2	-
<b>Summe Gläubigerpapiere</b>	<b>828</b>	<b>833</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>	<b>285</b>	<b>297</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
Anteils-papiere	13	12	1	-2	4	5	1	-
Festgeldanlagen	1.112	1.112	-	-	590	590	2	-2
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>1.953</b>	<b>1.957</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>	<b>879</b>	<b>892</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>
Ausgewiesen als:								
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.935	1.938	9	-6	850	858	10	-2
Wertpapiere des Anlagevermögens (siehe Anhang Nr. 17)	18	19	1	-	29	34	5	-
<b>Summe Wertpapiere</b>	<b>1.953</b>	<b>1.957</b>	<b>10</b>	<b>-6</b>	<b>879</b>	<b>892</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>

Unrealisierte Verluste bei Wertpapieren, die in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 weniger als zwölf Monate gehalten wurden, beliefen sich auf €4 und €0.

Die realisierten Verluste (Gewinne) aus Wertpapieren, netto, sind unter den sonstigen Erträgen (Aufwendungen) in den jeweiligen Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen ausgewiesen und betragen für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005:

	2003	2004	2005
Realisierte Gewinne	60	10	8
Realisierte Verluste	-4	-1	-
<b>Realisierte Gewinne/Verluste, Saldo</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

Am 30. September 2005 hatten Festgeldanlagen in Höhe von €5 Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten.

Die Gläubigerpapiere zum 30. September 2005 werden vertragsgemäß wie folgt fällig:

	Anschaffungskosten	Marktwert
Innerhalb eines Jahres	262	270
Zwischen einem und fünf Jahren	4	5
Nach fünf Jahren	19	22
<b>Summe Gläubigerpapiere</b>	<b>285</b>	<b>297</b>

Die tatsächlichen Fälligkeiten können auf Grund von Veräußerungs- oder Rückzahlungsrechten abweichen.

## 12 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Dritte	879	839
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	206	145
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	12	12
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, brutto</b>	<b>1.097</b>	<b>996</b>
Wertberichtigungen	-41	-44
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto</b>	<b>1.056</b>	<b>952</b>

Die Wertberichtigungen auf Forderungen haben sich im Betrachtungszeitraum wie folgt entwickelt;

	2004	2005
Wertberichtigungen zu Beginn des Geschäftsjahrs	26	41
Zuführung zu Wertberichtigungen, Saldo	15	3
<b>Wertberichtigungen zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

## 13 VORRÄTE

Die Vorräte setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84	87
Unfertige Erzeugnisse	560	569
Fertige Erzeugnisse	316	366
<b>Summe Vorräte</b>	<b>960</b>	<b>1.022</b>

## 14 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Derivative		
Finanzinstrumente (siehe Anhang Nr. 29)	106	73
Zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände	88	-
Fördermittel	84	122
Umsatzsteuer und sonstige Steuerforderungen	147	84
Lizenzforderungen	-	19
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	49	5
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen Dritte	40	68
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	18	18
Vorauszahlungen	19	26
Forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang Nr. 27)	9	8
Immaterielle Vermögensgegenstände, Pensionen (siehe Anhang Nr. 28)	-	14
Sonstige	30	32
<b>Summe sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände</b>	<b>590</b>	<b>469</b>

Zum 30. September 2005 beinhalteten die sonstigen kurzfristigen Vermögensgegenstände zum Verkauf stehende Vermögensgegenstände, die zum Glasfaserkomponentengeschäft gehören (siehe Anhang Nr. 4).

Die zusammengefassten Bilanzdaten des Glasfaserkomponentengeschäfts sind nachfolgend dargestellt:

Geschäftsjahr zum 30. September	2004
Kurzfristige Vermögensgegenstände	47
Langfristige Vermögensgegenstände	41
<b>Summe zum Verkauf stehender Vermögensgegenstände</b>	<b>88</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	23
Langfristige Verbindlichkeiten	8
<b>Summe zum Verkauf stehender Verbindlichkeiten</b> (siehe Anhang Nr. 20)	<b>31</b>

Zum 30. September 2005 gab es keine zum Verkauf stehenden Vermögensgegenstände des Glasfaserkomponentengeschäfts.

## 15 SACHANLAGEN

Eine Zusammenfassung Entwicklung der Sachanlagen Geschäftsjahr 2005 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	Technische Anlagen und Maschinen	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Gesamt
<b>Anschaffungskosten</b>					
<b>30. September 2004</b>	1.101	7.002	2.176	484	<b>10.763</b>
Zugänge	30	385	151	832	<b>1.398</b>
Wertberichtigungen	-15	-19	-5	-	<b>-39</b>
Abgänge	-3	-558	-212	-	<b>-773</b>
Reklassifizierung	-	-2	34	-	<b>32</b>
Umbuchungen	292	685	80	-1.057	<b>-</b>
Fremdwährungseffekte	22	56	8	-6	<b>80</b>
<b>30. September 2005</b>	<b>1.427</b>	<b>7.549</b>	<b>2.232</b>	<b>253</b>	<b>11.461</b>
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					
<b>30. September 2004</b>	-548	-4.752	-1.876	-	<b>-7.176</b>
Zugänge	-73	-910	-237	-	<b>-1.220</b>
Abgänge	3	513	205	-	<b>721</b>
Umbuchungen	-	-	-	-	<b>-</b>
Fremdwährungseffekte	-4	-26	-5	-	<b>-35</b>
<b>30. September 2005</b>	<b>-622</b>	<b>-5.175</b>	<b>-1.913</b>	<b>-</b>	<b>-7.710</b>
<b>Buchwert 30. September 2004</b>	<b>553</b>	<b>2.250</b>	<b>300</b>	<b>484</b>	<b>3.587</b>
<b>Buchwert 30. September 2005</b>	<b>805</b>	<b>2.374</b>	<b>319</b>	<b>253</b>	<b>3.751</b>

Die Gesellschaft gab am 23. April 2004 ihre Pläne zur Erweiterung der Fertigungsstätte in Richmond/Virginia, USA, bekannt. Diese beinhalteten die Fertigstellung der Gebäude und die Installation von Produktionsanlagen für eine 300-Millimeter-Fertigungsstätte. Der Bau und die Abnahme der erweiterten Fertigungsstätte wurden während des Geschäftsjahrs 2005 abgeschlossen, und die Volumenproduktion begann im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005. Die Gesamtinvestitionen der Erweiterung der Fertigungsstätte in Richmond betragen €787.

Am 8. Dezember 2004 gab die Gesellschaft Pläne für den Bau einer neuen Front-End-Fabrik in Malaysia im Kulim High Tech Park bekannt. Am neuen Standort sollen Logik- und Leistungshalbleiter für den Einsatz in Automobil- und Industrieanwendungen gefertigt werden. Die Gesellschaft plant für dieses Projekt ein Investitionsvolumen von insgesamt etwa 1 Milliarde US-Dollar. Die Bauarbeiten haben im Frühjahr 2005 begonnen. Die Inbetriebnahme des Werks ist für 2006 vorgesehen. Bis zum 30. September 2005 investierte die Gesellschaft insgesamt €39 in diese Front-End-Fabrik.

## 16 FINANZANLAGEN

Die Finanzanlagen haben sich in dem am 30. September 2005 endenden Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Assoziierte Unternehmen	Beteiligungen	Gesamt
<b>Stand 30. September 2004</b>	664	44	<b>708</b>
Zugänge	87	48	<b>135</b>
Abgänge	–	–71	<b>–71</b>
Dividendenzahlungen	–51	–	<b>–51</b>
Aktivierungspflichtige Zinsen	–1	–	<b>–1</b>
Außerplanmäßige Abschreibungen	–26	–3	<b>–29</b>
Anteilige Jahresergebnisse assoziierter Unternehmen	57	–	<b>57</b>
Reklassifizierung	–16	3	<b>–13</b>
Fremdwährungseffekte	44	–	<b>44</b>
<b>Stand 30. September 2005</b>	<b>758</b>	<b>21</b>	<b>779</b>

Investitionen in Beteiligungen erfolgen überwiegend mit dem Ziel, das Zukunftspotenzial der Gesellschaft auf dem Gebiet der geistigen Eigentumsrechte zu stärken.

Die folgenden wesentlichen assoziierten Unternehmen wurden zum 30. September 2005 nach der Equity-Methode bilanziert:

Namen der assoziierten Unternehmen	Direkte und indirekte Anteile in %
Advanced Mask Technology Center GmbH & Co. KG, Dresden („AMTC“)	33,3
ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich („ALTIS“)	50,1
Hwa-Ken Investment Inc., Taipei, Taiwan („Hwa-Ken“)	50,0
Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan („Inotera“)	45,9
StarCore LLC, Austin/Texas, USA („StarCore“)	41,1

Die Gesellschaft hat diese Beteiligungen nach der Equity-Methode bilanziert, da keine einheitliche Leitung von der Gesellschaft ausgeübt worden ist (siehe Anhang Nr. 2). Die oben aufgeführten Gesellschaften sind vorwiegend mit Forschung und Entwicklung, Entwurf und Fertigung von Halbleiterprodukten und damit in Zusammenhang stehenden Produkten befasst.

Am 16. Mai 2002 ging die Gesellschaft mit den Partnern Advanced Micro Devices Inc. („AMD“), USA, und DuPont Photomasks Inc. („DuPont“), USA, das AMTC-Joint-Venture mit dem Ziel ein, gemeinsam fortschrittliche Fotomasken zu entwickeln und herzustellen. Zudem vereinbarte die Gesellschaft den Verkauf von speziellen Fotomasken-Anlagen an DuPont und ging eine langfristige Bezugsvereinbarung bis 2011 ein. Dem-

entsprechend wurden zum 30. September 2005 €17 abgegrenzt. Dieser Betrag wird über die Laufzeit der Bezugsvereinbarung vereinnahmt. Die Übernahme von DuPont durch Toppan Printing Co., Ltd. im April 2005 führte zu einer neuen Firmenbezeichnung; die frühere DuPont firmiert nun unter Toppan Photomasks Inc., Ltd.

ALTIS ist ein Joint Venture von Infineon und International Business Machines Corporation („IBM“), in dem beide Partner ein gleiches Stimmrecht haben. Im Geschäftsjahr 2003 änderten die Gesellschaft und IBM die Gesellschaftervereinbarung. Entsprechend wird die Gesellschaft ihren Anteil an den Produktionskapazitäten von ALTIS in den Kalenderjahren 2004 bis 2007 von 50 Prozent auf 100 Prozent erhöhen. IBM und die Gesellschaft haben vereinbart, über das zukünftige Geschäftsmodell von ALTIS nicht später als zum 1. Januar 2007 eine Entscheidung zu treffen. Zusätzlich gewährt die geänderte Vereinbarung Infineon eine Option auf den Erwerb des IBM-Anteils an ALTIS bis einschließlich 1. Juli 2007. Die Gesellschaft befindet sich derzeit mit IBM in Verhandlung über den zukünftigen Geschäftsplan von ALTIS.

Am 13. November 2002 schlossen die Gesellschaft und Nanya ein Abkommen über eine strategische Kooperation zur Entwicklung von DRAM-Speicherprodukten und die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (Inotera, direkt und indirekt über die Beteiligung der Gesellschaft Hwa-Ken) zur Errichtung und zum Betrieb einer 300-Millimeter-Fertigungsstätte in Taiwan. Gemäß den Vereinbarungen haben Nanya und die Gesellschaft bereits modernste 90-Nanometer-Technologie entwickelt und setzen die gemeinsame Entwicklung der 70-Nanometer-Technologie derzeit fort. Die Kosten hierfür werden zu zwei Dritteln von der Gesellschaft und zu einem Drittel von Nanya getragen. Die neue 300-Millimeter-Fertigungsstätte wird von dem Gemeinschaftsunternehmen Inotera finanziert und wendet zur DRAM-Fertigung die im Zusammenhang mit der zuvor genannten Vereinbarung entwickelte Technologie an. Die volle Kapazität der Fertigungsstätte wird in drei Stufen errichtet. Im Geschäftsjahr 2004 wurde die erste Ausbaustufe abgeschlossen und die Volumenproduktion begonnen. Die Fertigstellung der zweiten Ausbaustufe wurde im Geschäftsjahr 2005 abgeschlossen, und der Abschluss der dritten Ausbaustufe wird für das Geschäftsjahr 2006 erwartet. Beide Partner dieses Joint Venture haben sich verpflichtet, jeweils die Hälfte der Produktion dieser Fertigungsstätte zu Preisen, die teilweise auf Marktpreisen basieren, abzunehmen. Am 29. September 2005 schlossen die Gesellschaft und Nanya ein Abkommen mit dem Ziel, die Entwicklungskooperation zu DRAM-Produkten zu erweitern. Das Abkommen beinhaltet die gemeinsame Entwicklung der fortgeschrittenen 60-Nanometer-Technologie für 300-Millimeter Wafer ab September 2005. Die Entwicklungskosten werden zu zwei Dritteln von der Gesellschaft und zu einem Drittel von Nanya getragen. Die Kooperation ist die Erweiterung der existierenden

gemeinsamen Entwicklung der 90- und 70-Nanometer-Produktionstechnologie. Durch die Kooperation erwarten sich die Partner eine Verbesserung ihrer Position im DRAM-Markt. Die neue Produktionstechnologie, die gemeinsam am Infineon-Standort in Dresden entwickelt wird, kann in beiden Unternehmen und von Inotera verwendet werden. Es wird erwartet, dass die ersten 300-Millimeter-Wafer-Speicherprodukte, die die neue 60-Nanometer-Technologie verwenden, 2008 die Produktion verlassen.

In den Geschäftsjahren 2004 und 2005 hat die Gesellschaft €342 und €83 in Inotera investiert. Die Investition schließt aktivierte Zinsen in Höhe von €7 und €6 in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 mit ein. Während des Geschäftsjahrs 2004 hat Inotera Aktien an Mitarbeiter ausgegeben, was die Besitzanteile der Gesellschaft verwässert und zur gleichen Zeit den Anteil der Gesellschaft am Eigenkapital von Inotera um €2 erhöht hat. Die direkten und indirekten Gesellschaftsanteile der Gesellschaft betragen zum 30. September 2005 insgesamt 45,9 Prozent.

Inoteras Antrag, als börsenfähige Gesellschaft geführt zu werden, wurde am 7. Oktober 2004 von dem Taiwanese Securities and Futures Bureau genehmigt. Seit April 2005 werden die Aktien von Inotera auf dem Gre-Tai Markt in Taiwan gehandelt. Am 26. Oktober 2005 hat Inotera die Börsenzulassung an der Taiwanesischen Börse beantragt.

Im November 2003 hat Infineon mit United Epitaxy Company Ltd., Hsinchu, Taiwan („UEC“), das Gemeinschaftsunternehmen ParoLink gegründet. Infineon hat €6 Eigenkapital eingebracht und 56 Prozent der Anteile an ParoLink gehalten. Die Gesellschaft bilanzierte die Beteiligung an ParoLink unter Anwendung der Equity-Methode, da der Minderheitsgesellschafter wesentliche Rechte hat und eine beherrschende Kontrolle durch Infineon nicht gegeben war. Als Folge des Ausstiegs aus dem Glasfaserkomponentengeschäft (siehe Anhang Nr. 4) hat die Gesellschaft die ausstehenden Anteile übernommen, das Joint Venture mit UEC beendet und infolgedessen eine Wertberichtigung in Höhe von €3 vorgenommen, um diese Beteiligung an den zu erwartenden Marktwert anzupassen.

Am 1. Oktober 2002 gründeten die Gesellschaft, Agere Systems Inc. und Motorola Inc. die StarCore, ansässig in Austin/Texas. StarCore konzentriert sich auf die Entwicklung, Standardisierung und Verbreitung von Basistechnologien für Digital-Signal-Prozessoren (DSP). Zum 30. September 2005 hält die Gesellschaft einen Anteil von 41,1 Prozent, entsprechend einem Buchwert in Höhe von €15.

Die Gesellschaft hat während der Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 bei Finanzanlagen Wertminderungen in Höhe von €30, €65 und €29 erfasst, da es sich nicht um vorübergehende Wertminderungen handelte. Auf Grund der Beendigung

der Venture-Aktivitäten hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 eine Wertberichtigung in Höhe von €28 vorgenommen, um den Buchwert des Venture-Portfolios an den zu erwartenden Verkaufserlös anzupassen (siehe Anhang Nr. 4).

In den Finanzanlagen sind zum 30. September 2004 und 2005 Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von €32 und €15 enthalten.

Die zusammengefassten Finanzdaten der zum 30. September 2005 assoziierten Unternehmen für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 stellen sich wie folgt dar:

	2003	2004	2005
Umsatzerlöse	596	539	969
Bruttoergebnis vom Umsatz	65	26	187
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2	-25	90

	2003	2004	2005
Umlaufvermögen	243	400	744
Anlagevermögen	679	1.492	2.234
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-302	-383	-452
Langfristige Verbindlichkeiten	-15	-338	-908
<b>Eigenkapital</b>	<b>605</b>	<b>1.171</b>	<b>1.618</b>

## 17 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die sonstigen langfristigen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Immaterielle Vermögensgegenstände	398	315
Forderungen für Investitionszuschüsse	92	-
Abgegrenzter Steueraufwand (siehe Anhang Nr. 9)	39	71
Vorausgezahlte		
Pensionsaufwendungen (siehe Anhang Nr. 28)	27	-
Langfristige Forderungen	24	23
Wertpapiere des		
Anlagevermögens (siehe Anhang Nr. 11)	19	34
Finanzforderungen und sonstige		
Forderungen gegen sonstige verbundene und		
assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	10	67
Wechselforderungen	3	-
Forderungen gegen		
Arbeitnehmer (siehe Anhang Nr. 27)	2	2
Sonstige	13	30
<b>Summe sonstige langfristige</b>		
<b>Vermögensgegenstände</b>	<b>627</b>	<b>542</b>

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	Geschäfts- und Firmenwerte	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	Gesamt
<b>Anschaffungskosten</b>			
<b>30. September 2003</b>	243	339	<b>582</b>
Zugänge	–	125	<b>125</b>
Außerplanmäßige Abschreibungen (siehe Anhang Nr. 7)	–71	–	<b>–71</b>
Abgänge	–	–75	<b>–75</b>
Zukäufe (siehe Anhang Nr. 3)	23	30	<b>53</b>
Kaufpreis- anpassungen (siehe Anhang Nr. 3)	–8	–	<b>–8</b>
Fremdwährungseffekte	–15	–5	<b>–20</b>
<b>30. September 2004</b>	<b>172</b>	<b>414</b>	<b>586</b>
Zugänge	–	64	<b>64</b>
Außerplanmäßige Abschreibungen (siehe Anhang Nr. 7)	–18	–39	<b>–57</b>
Abgänge	–6	–36	<b>–42</b>
Zukäufe (siehe Anhang Nr. 3)	7	58	<b>65</b>
Kaufpreis- anpassungen (siehe Anhang Nr. 3)	–14	–16	<b>–30</b>
Fremdwährungseffekte	2	3	<b>5</b>
<b>30. September 2005</b>	<b>143</b>	<b>448</b>	<b>591</b>
<b>Kumulierte Abschreibungen</b>			
<b>30. September 2003</b>	–25	–146	<b>–171</b>
Zugänge	–	–89	<b>–89</b>
Erworbene F&E	–	–9	<b>–9</b>
Abgänge	–	75	<b>75</b>
Fremdwährungseffekte	4	2	<b>6</b>
<b>30. September 2004</b>	<b>–21</b>	<b>–167</b>	<b>–188</b>
Zugänge	–	–96	<b>–96</b>
Abgänge	–	5	<b>5</b>
Fremdwährungseffekte	3	–	<b>3</b>
<b>30. September 2005</b>	<b>–18</b>	<b>–258</b>	<b>–276</b>
<b>Buchwert 30. September 2003</b>	<b>218</b>	<b>193</b>	<b>411</b>
<b>Buchwert 30. September 2004</b>	<b>151</b>	<b>247</b>	<b>398</b>
<b>Buchwert 30. September 2005</b>	<b>125</b>	<b>190</b>	<b>315</b>

Die geschätzten Abschreibungen der sonstigen immateriellen Vermögensgegenstände weisen für die nächsten fünf Geschäftsjahre die folgenden Werte auf: 2006 €59, 2007 €51, 2008 €29, 2009 €11 und 2010 €7.

Im Juni 2003 hat die Gesellschaft eine Technologieentwicklungs- und Lizenzvereinbarung mit IBM und Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. („Chartered Semiconductor“) für modernste Logik-Produktionsprozess-Technologien geschlossen. Lizenzen in Höhe von €43 werden über die erwartete Nutzungsdauer der entsprechenden Technologie von fünf Jahren abgeschrieben.

In Verbindung mit der Übernahme des verbleibenden 30-Prozent-Anteils von Saifun an dem Infineon-Technologies-Flash-Gemeinschaftsunternehmen hat die Gesellschaft eine Lizenz für die Nutzung der NROM™-Technologien von Saifun erhalten (siehe Anhang Nr. 3). Die mit €28 bilanzierte Lizenz wird über die erwartete Nutzungsdauer der entsprechenden Technologien von zehn Jahren abgeschrieben.

Im März 2005 hat die Gesellschaft mit Rambus eine Vereinbarung, die alle Ansprüche zwischen den Parteien und die Lizenzierung des Rambus-Patentportfolios regelt, geschlossen. Die mit €37 bilanzierte Lizenz wird über die erwartete Nutzungsdauer der entsprechenden Technologien von zehn Jahren abgeschrieben.

In den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 hat die Gesellschaft Wertminderungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von €68, €71 und €57 vorgenommen.

Auf Grund reduzierter erwarteter Erträge und geringerer Markterwartungen und unter Berücksichtigung bis dato erreichter technischer Meilensteine hat die Gesellschaft die erwarteten Erträge ihres Optischen-Netzwerk-Geschäfts des Segments Kommunikation reduziert. Dementsprechend hat die Gesellschaft die Geschäfts- und Firmenwerte dieser Berichterstattungseinheit gemäß SFAS Nr. 142 auf notwendige Wertminderungen auf Basis künftiger diskontierter geschätzter Cash-Flows hin überprüft und eine Wertminderung in Höhe von €68 im Geschäftsjahr 2003 vorgenommen.

Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Werthaltigkeit der Geschäfts- und Firmenwerte hat die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 eine Wertminderung in Höhe von €71 vorgenommen, um den Geschäfts- und Firmenwert der Berichtseinheit an den Marktwert anzupassen. Dies ist hauptsächlich das Ergebnis verringerter Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2004 und reduzierter Markterwartungen.

Während des Geschäftsjahrs 2005 ist die Gesellschaft zu dem Schluss gekommen, dass ausreichend viele Indikatoren darauf hingewiesen haben, dass eine Analyse der Werthaltigkeit der Buchwerte der Geschäfts- und Firmenwerte und bestimmter sonstiger immaterieller Vermögensgegenstände in den Geschäftsbereichen Customer Premises Equipment, Wireless



Infrastructure, Short Range Wireless, RF Engine und im Optischen-Netzwerk-Geschäft notwendig war. Die Werthaltigkeit dieser immateriellen Vermögensgegenstände basiert auf dem Vergleich der Buchwerte und der künftig erwarteten Cash-Flows dieser Vermögensgegenstände. Die Wertminderungen sind der Betrag, um den der Buchwert der Vermögensgegenstände den Marktwert dieser Vermögensgegenstände übersteigt. Es wurden Wertminderungen in Höhe von €57 vorgenommen und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

### 18 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	969	868
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 27)	61	61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	68	140
<b>Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.098</b>	<b>1.069</b>

### 19 RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern	279	274
Gewährleistungen und Lizenzen	78	53
Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang Nr. 31)	67	31
Zinsen	33	34
Sonstige	98	105
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>555</b>	<b>497</b>

Am 15. September 2004 traf die Gesellschaft eine Einigung mit dem US-amerikanischen Justizministerium (DOJ) in Verbindung mit den kartellrechtlichen Ermittlungen (siehe Anhang Nr. 31) und erklärte sich bereit, eine Strafe von 160 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre zu zahlen. Der innerhalb des nächsten Geschäftsjahrs fällige Betrag ist in den Rückstellungen und Sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten, der langfristige Anteil in den Sonstigen Verbindlichkeiten (siehe Anhang Nr. 22).

### 20 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Umsatzsteuer- und sonstige Steuerverbindlichkeiten	272	202
Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	124	130
Abgegrenzte Zuschüsse und Zulagen (siehe Anhang Nr. 6)	90	106
Abgegrenzte Erträge	58	22
Restrukturierung (siehe Anhang Nr. 8)	16	72
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten (siehe Anhang Nr. 29)	17	74
Finanzverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 27)	2	4
Verbindlichkeiten aus zum Verkauf stehenden Vermögensgegenständen (siehe Anhang Nr. 14)	31	–
Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang Nr. 31)	–	31
Sonstige	20	59
<b>Summe sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>630</b>	<b>700</b>

Die abgegrenzten Erträge enthalten Erträge aus Lizenz- und Technologieübertragungen (siehe Anhang Nr. 5). Der langfristige Anteil ist in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten (siehe Anhang Nr. 22).

**21 FINANZVERBINDLICHKEITEN**

Die Finanzverbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten:</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:		
Durchschnittszinssatz 2,21 %	53	51
Kurzfristige Verbindlichkeiten	18	–
Durchschnittszinssatz 4,5 %		
Kurzfristige Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	498	48
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	2	–
<b>Summe kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>571</b>	<b>99</b>
<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten:</b>		
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 4,25%, fällig 2007	636	633
Ausstehende Wandelschuldverschreibung, Zinssatz 5,0%, fällig 2010	688	690
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:		
Unbesicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittszinssatz 2,58 %, fällig 2006–2013	69	206
Besicherte Darlehen mit Ratenzahlung, Durchschnittszinssatz 1,50 %, fällig 2006–2010	7	9
Darlehen der öffentlichen Hand, Zinssatz 3,18 %, fällig 2027	27	28
<b>Summe langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>1.427</b>	<b>1.566</b>

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen hauptsächlich aus Kreditaufnahmen im Rahmen von kurzfristigen Darlehensvereinbarungen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von €18 stellen Betriebskapitaldarlehen an die Infineon-Flash-Gesellschaften zum 30. September 2004 dar, die im Rahmen der Anteilsübernahme der Minderheitsanteile an dem Gemeinschaftsunternehmen Infineon Flash mit dem Kaufpreis verrechnet wurden (siehe Anhang Nr. 3).

Am 5. Juni 2003 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine im Jahr 2010 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €700 im Rahmen eines verbindlichen Übernahmeangebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese über die Laufzeit auf Anforderung in maximal 68,4 Millionen Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der

Wandelpreis 10,23 Euro pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 5,0 Prozent pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft und kann in den ersten drei Jahren nicht gewandelt werden. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger bei einem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft das Recht auf Rückzahlung. Eine Reorganisation der Gesellschaft mit Substitution der Bürgin wird nicht als Kontrollwechsel angesehen. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 125 Prozent des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Zum 30. September 2005 betragen die abgegrenzten Ausgabekosten dieser Anleihe €10.

Am 6. Februar 2002 begab die Gesellschaft (als Bürgin) durch ihre Tochtergesellschaft Infineon Technologies Holding B.V. (als Emittentin) eine im Jahr 2007 fällige nachrangige Wandelschuldverschreibung zum Nennwert von €1.000 im Rahmen eines garantierten verbindlichen Übernahmeangebots an institutionelle Investoren in Europa. Die Inhaber dieser Schuldverschreibungen können diese über die Laufzeit auf Anforderung in maximal 28,2 Millionen Aktien der Gesellschaft umwandeln, wobei der Wandelpreis €35,43 pro Aktie beträgt. Bei Umwandlung kann die Gesellschaft bei einem Teil oder allen Aktien auch einen Barausgleich vornehmen. Die Wandelanleihe verzinst sich mit 4,25 Prozent pro Jahr. Die Schuldverschreibung ist unbesichert und steht gleichrangig mit allen gegenwärtigen und künftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, solange die Anleihe aussteht, keine weiteren Sicherheiten aus ihrem Vermögen zu bestellen, ohne dass die Gläubiger der Anleihe gleichrangig an dieser Sicherheit teilnehmen. Die Wandelanleihe beinhaltet für die Gläubiger das Recht auf Rückzahlung bei dem definierten Kontrollwechsel der Gesellschaft. Nach drei Jahren kann die Gesellschaft die Anleihe zum Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen ablösen, falls die Aktie der Gesellschaft 115 Prozent des Wandlungspreises an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen übersteigt. Die Wandelschuldverschreibung wird an der Luxemburger Börse gehandelt. Während des Geschäftsjahrs 2004 tilgte

die Gesellschaft einen Nominalbetrag in Höhe von €360 der 2007 fälligen nachrangigen Wandelschuldverschreibung mit einem Gewinn in Höhe von €6 vor Steuern. Am 30. September 2005 betrug der ausstehende Nominalwert €640. Die abgegrenzten Ausgabekosten betragen €3.

In den kurzfristig fälligen Bestandteilen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten war zum 30. September 2004 eine Konsortialkreditlinie in Höhe von €450 für den Ausbau der Fertigungsstätte in Dresden enthalten, die am 30. September 2005 zurückgezahlt wurde.

Im September 2004 hat die Gesellschaft einen \$400/€400-Konsortialkredit mit fünfjähriger Laufzeit vereinbart. Dieser Kredit besteht aus zwei Tranchen: Tranche A umfasst 400 Millionen US-Dollar und ist zur Finanzierung der Erweiterung der Produktionsanlagen am Standort Richmond/Virginia, USA vorgesehen. Tranche B ist eine €400-Mehrwährungskreditlinie, die revolving für generelle betriebliche Zwecke genutzt werden kann und die vorherige in 2005 ausgelaufene €375-Mehrwährungs-

kreditlinie ersetzt. Der maximal ausstehende Betrag der Tranche A reduziert sich durch ab 30. September 2006 einsetzende gleichmäßige Rückzahlungen. Die neue Kreditlinie beinhaltet die Einhaltung branchenüblicher Finanzkennzahlen und marktgängige Zinsen. Gegenüber den Darlehensgebern wurde eine Negativerklärung bezüglich der Bestellung von nicht zugelassenen Sachsicherheiten abgegeben. Zum 30. September 2005 wurde diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Für den Ausbau der Fertigung in Porto, Portugal ist im Mai 2005 eine Projektfinanzierungskredit von €124 auf unbesicherter Basis abgeschlossen worden. Diese Finanzierungslinie war zum 30. September 2005 mit €80 in Anspruch genommen. Die Gesellschaft geht davon aus, den ab 2008 bis 2013 aus dieser Finanzierung resultierenden Rückzahlungsverpflichtungen aus verfügbaren Mitteln nachkommen zu können.

Die Gesellschaft hat verschiedene, voneinander unabhängige kurz- und langfristige Kreditlinien mit mehreren Finanzinstituten für den zu erwartenden Finanzbedarf vereinbart.

Laufzeit	Zusage durch Finanzinstitut	Zweck/beabsichtigter Einsatz	Zum 30. September 2005		
			Gesamthöhe	In Anspruch genommen	Verfügbar
Kurzfristig	feste Zusage	Betriebskapital, Garantien	120	51	69
Kurzfristig	keine feste Zusage	Betriebskapital, Cash-Management	305	–	305
Langfristig	feste Zusage	Betriebskapital	731	–	731
Langfristig <sup>1</sup>	feste Zusage	Projektfinanzierung	335	291	44
<b>Gesamt</b>			<b>1.491</b>	<b>342</b>	<b>1.149</b>

<sup>1</sup> Einschließlich kurzfristiger Bestandteile der langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Zum 30. September 2005 hatte die Gesellschaft die geforderten Bilanzrelationen zu den entsprechenden Kreditlinien erfüllt.

Die Zinsaufwendungen beliefen sich auf €115, €126 und €83 in den Geschäftsjahren 2003, 2004 bzw. 2005.

Von den Finanzverbindlichkeiten werden in den nächsten Jahren folgende Beträge fällig:

Geschäftsjahr	Betrag
2006	99
2007	650
2008	51
2009	64
2010	733
Folgende Jahre	68
<b>Gesamt</b>	<b>1.665</b>

## 22 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Abgegrenzte Zuschüsse und Zulagen (siehe Anhang Nr. 6)	191	182
Beilegung kartellrechtlicher Angelegenheiten (siehe Anhang Nr. 31)	109	88
Pensionsverpflichtungen (siehe Anhang Nr. 28)	98	162
Langfristige Vorauszahlungen	45	–
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Kapitalanteile	39	81
Sonstige abgegrenzte Erträge (siehe Anhang Nr. 5)	18	38
Pensionsähnliche Leistungszusagen (siehe Anhang Nr. 28)	5	5
Sonstige	63	86
<b>Summe sonstige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>568</b>	<b>642</b>

## 23 GRUNDKAPITAL

Am 30. September 2005 hatte die Gesellschaft 747.569.359 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,00 Euro pro Aktie ausgegeben. Während des Geschäftsjahrs 2004 wurde das Grundkapital um €53 durch Ausgabe von 26.679.255 neuen Aktien im Wert von €278 gegen Sacheinlage im Zusammenhang mit der Akquisition der restlichen Anteile an SC300 GmbH & Co. KG („SC300“) erhöht. Während des Geschäftsjahrs 2003 wurden 96.386 Aktien freigegeben, die als bedingte Kaufpreiskomponenten im Zusammenhang mit der Akquisition von Catamaran vor Beginn des Geschäftsjahrs ausgegeben waren und von einem Treuhänder verwahrt wurden, da vereinbarte Meilensteine erreicht wurden. Diese Freigabe ist in der Eigenkapitalveränderungsrechnung ausgewiesen.

### Genehmigtes und Bedingtes Kapital

Die Satzung der Gesellschaft ermächtigt den Vorstand, zusätzlich zu den ausgegebenen Anteilen das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Anteile zu erhöhen. Zum Stichtag 30. September 2005 kann der Vorstand folgende Genehmigte Kapitalien zur Ausgabe neuer Aktien ausüben:

- Das Genehmigte Kapital I/2002 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 21. Januar 2007 um bis zu €297 durch die Ausgabe von jungen Aktien gegen Bareinlagen, wobei das Bezugsrecht teilweise ausgeschlossen werden kann, oder im Zusammenhang mit Geschäftszusammenschlüssen (Sacheinlagen), wobei das Bezugsrecht für alle Aktien ausgeschlossen werden kann.
- Das Genehmigte Kapital II/2004 ermächtigt zur Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft bis zum 19. Januar 2009 um bis zu €30, um Aktien an Mitarbeiter auszugeben (wobei die Bezugsrechte bestehender Aktionäre ausgeschlossen sind).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €96 („Bedingtes Kapital I“) beziehungsweise um bis zu €29 („Bedingtes Kapital III“) bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital kann durch Ausgabe von bis zu 62,5 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien im Rahmen der Aktienoptionspläne der Gesellschaft verwendet werden (siehe Anhang Nr. 24). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €50 durch Ausgabe von bis zu 25 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die im Februar 2002 begeben wurden und bis zum 23. Januar 2007 jederzeit umgewandelt werden können (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu €136,8 durch Ausgabe von bis zu 68,4 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber der Wandelschuldverschreibung, die im Juni 2003 begeben wurde. Diese Wandelschuldverschreibung kann jederzeit bis zum 22. Mai 2010 in Aktien umgetauscht werden (siehe Anhang Nr. 21). Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

Weiterhin ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu €213,2 durch Ausgabe von bis zu 106,6 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital II/2002“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 21. Januar 2007 begeben werden können. Die neuen Aktien sind von Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie ausgegeben werden, dividendenberechtigt.

### Dividenden

Nach dem deutschen Aktiengesetz bestimmt sich der Betrag, der zur Dividendenzahlung an die Aktionäre zur Verfügung steht, nach dem Bilanzgewinn der Muttergesellschaft, der nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs ermittelt wird. Alle Dividendenzahlungen müssen von der Hauptversammlung beschlossen werden.

Auf der Hauptversammlung im Januar 2005 wurde beschlossen, keine Dividende zu zahlen. Ebenso kann für das Geschäftsjahr 2005 keine Dividende ausgeschüttet werden, da die Muttergesellschaft Infineon Technologies AG für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Bilanzverlust ausweist.

## 24 AKTIENOPTIONSPLÄNE

### Aktienoptionsplan mit fester Ausübungshürde

Im Jahr 1999 verabschiedete die Hauptversammlung einen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 1999), wonach nicht übertragbare Rechte zum künftigen Erwerb von Aktien gewährt werden. Entsprechend diesem Plan können über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 48 Millionen Aktienoptionen ausgegeben werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Aktienpreises während der fünf Handelstage vor dem Ausgabebetrag der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden, jedoch nur, wenn seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwei Jahre vergangen sind und der Aktienkurs an mindestens einem Handelstag während der jeweiligen Laufzeit den Ausgabepreis erreicht hat.

Im Jahr 2001 stimmten die Aktionäre einem internationalen Aktienoptionsplan (Long-Term-Incentive-Plan 2001) zu, der den Aktienoptionsplan 1999 ablöst. Optionen, die auf Grundlage des Aktienoptionsplans 1999 ausgegeben wurden, behalten ihre Wirksamkeit zu den damaligen Ausgabekonditionen, es

werden jedoch keine weiteren Optionen aus diesem Plan mehr ausgegeben. Entsprechend den Bedingungen des neuen Plans können insgesamt bis zu 51,5 Millionen Optionen innerhalb einer Fünfjahresfrist gewährt werden. Der Ausübungspreis für eine neue Aktie entspricht 105 Prozent des durchschnittlichen Aktienkurses während der fünf Handelstage vor Gewährung der Option. Die Optionsrechte können innerhalb von sieben Jahren ausgeübt werden, sofern seit der Ausgabe der jeweiligen Optionsrechte zwischen zwei und vier Jahre vergangen sind und der Aktienkurs der Gesellschaft den Ausübungspreis an mindestens einem Handelstag erreicht hat.

Nach den Regelungen des Aktienoptionsplans von 2001 entscheidet der Aufsichtsrat jährlich innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung des Konzernabschlusses über die Zahl der dem Vorstand zu gewährenden Optionen. Der Vorstand wird im gleichen Zeitraum über die Zahl der an bezugsberechtigte Mitarbeiter zu gewährenden Optionen entscheiden.

Die Aktienoptionspläne von 1999 und 2001 sowie ihre Änderungen innerhalb der letzten drei Jahre stellen sich wie folgt dar (Optionsvolumen in Millionen Stück, Ausübungspreis in Euro):

	2003		2004		2005	
	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis
Ausstehende Optionen zu Beginn des Geschäftsjahrs	19,9	€35,96	29,9	€25,56	36,0	€22,59
Gewährte Optionen	11,7	€8,97	8,1	€12,32	6,7	€9,10
Ausgeübte Optionen	-	-	-	-	-	-
Verfallene Optionen	-1,7	€32,80	-2,0	€25,17	-1,8	€24,07
<b>Ausstehende Optionen zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>29,9</b>	<b>€25,56</b>	<b>36,0</b>	<b>€22,59</b>	<b>40,9</b>	<b>€20,33</b>
<b>Ausübbar zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>9,6</b>	<b>€48,56</b>	<b>13,2</b>	<b>€39,89</b>	<b>19,6</b>	<b>€29,93</b>

Die folgende Tabelle fasst Informationen über die ausstehenden Aktienoptionen zum 30. September 2005 zusammen (Optionsvolumen in Millionen, Ausübungspreis in Euro):

Spanne der Ausübungspreise	Ausstehend			Ausübbar	
	Anzahl der Optionen	Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren)	Durchschnittlicher Ausübungspreis	Anzahl der Optionen	Durchschnittlicher Ausübungspreis
€5 – €10	16,6	4,95	€8,99	5,0	€8,93
€10 – €15	8,9	4,98	€12,41	1,0	€12,63
€15 – €20	0,2	3,84	€15,75	0,1	€15,75
€20 – €25	6,7	3,18	€23,70	5,0	€23,70
€25 – €30	0,1	3,02	€27,40	0,1	€27,43
€40 – €45	4,2	1,46	€42,03	4,2	€42,03
€50 – €55	0,1	2,50	€53,26	0,1	€53,26
€55 – €60	4,1	2,16	€55,18	4,1	€55,18
<b>Gesamt</b>	<b>40,9</b>	<b>4,02</b>	<b>€20,33</b>	<b>19,6</b>	<b>€29,93</b>

### Marktwert-Angaben

Wie in Anhang Nr. 2 erläutert, bilanziert die Gesellschaft Aktienoptionspläne gemäß APB Opinion 25 und den entsprechenden Regelungen zur Bilanzierung von Aktienoptionsplänen. SFAS Nr. 123 gibt eine alternative Möglichkeit zur Bewertung des Aufwands für Mitarbeitervergütung vor, indem der Marktwert der Optionen zum Gewährungszeitpunkt durch Optionspreismodelle bestimmt wird. Optionspreismodelle wurden entwickelt, um den Marktwert von frei handelbaren, fungiblen Optionen ohne Mindesthaltedauer zu bestimmen, die sich jedoch deutlich von den Optionen mit Ausübungsrestriktionen unterscheiden, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitern gewährt. Diese Modelle erfordern subjektive Annahmen einschließlich der künftigen Volatilität des Aktienkurses und dem erwarteten Zeitraum bis zur Ausübung, die den festgestellten Optionspreis erheblich beeinflussen. Die Gesellschaft bewertete den Marktwert einer gewährten Option zum Ausgabezeitpunkt mittels eines Black-Scholes-Optionspreismodells, das von einer Einzelbewertung der Optionen ausgeht und den Verfall zum jeweiligen Eintrittszeitpunkt annimmt.

In der folgenden Tabelle sind die durchschnittlichen Annahmen zur Optionspreisbewertung in den einzelnen Geschäftsjahren zum 30. September dargestellt:

	2003	2004	2005
<b>Durchschnittliche Annahmen:</b>			
Risikofreier Zinssatz in %	3,85	3,68	3,02
Erwartete Volatilität in %	59	59	58
Dividendenertrag in %	0	0	0
Erwartete Laufzeit in Jahren	4,50	4,50	4,50
Durchschnittlicher Marktwert pro Option zum Gewährungszeitpunkt in €	4,41	5,88	4,03

Wären Personalaufwendungen auf der Grundlage des Marktwerts nach SFAS Nr. 123 bilanziert worden, wodurch sich ein Aufwand für Mitarbeitervergütung auf Grundlage oben dargestellter Marktwerte ergeben hätte, so hätten sich der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag und das Ergebnis je Aktie gemäß der Anwendung von SFAS Nr. 148 wie in den folgenden Proforma-Angaben jeweils zu dem am 30. September endenden Geschäftsjahr verringert:

	2003	2004	2005
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag			
Ist	-435	61	-312
Abzüglich:			
Im Konzernjahresergebnis enthaltene Aufwendungen für aktienbezogene Mitarbeitervergütung, abzüglich zugehöriger Steuer	7	2	-
Zuzüglich:			
Aufwendungen für alle aktienbezogenen Mitarbeitervergütungen, über Marktwertmethode ermittelt, abzüglich Steuer	-43	-37	-39
Pro forma	-471	26	-351
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie			
Ist	€-0,60	€0,08	€-0,42
Pro forma	€-0,65	€0,03	€-0,47

## 25 ÄNDERUNGEN IM EIGENKAPITAL, DIE NICHT AUS TRANSAKTIONEN MIT AKTIONÄREN RESULTIEREN

Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, haben sich für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 wie folgt entwickelt:

	2003			2004			2005		
	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern	Vor Steuern	Steuer-effekt	Nach Steuern
<b>Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren:</b>									
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus gehaltenen Wertpapieren	11	-	11	4	-	4	13	-1	12
Umgliederung von im Periodenergebnis enthaltenen Gewinnen/Verlusten	4	-2	2	-11	-	-11	-4	-	-4
<b>Unrealisierte Gewinne/Verluste, netto</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>	<b>13</b>	<b>-7</b>	<b>-</b>	<b>-7</b>	<b>9</b>	<b>-1</b>	<b>8</b>
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Sicherungsgeschäften	-	-	-	1	-	1	-25	-	-25
Zusätzliche Mindestpensionsverbindlichkeit	4	-2	2	28	-10	18	-85	1	-84
Unterschiede aus Fremdwährungsumrechnung	-76	-	-76	-41	-	-41	64	-	64
<b>Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren</b>	<b>-57</b>	<b>-4</b>	<b>-61</b>	<b>-19</b>	<b>-10</b>	<b>-29</b>	<b>-37</b>	<b>-</b>	<b>-37</b>
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, zu Beginn des Geschäftsjahrs	-41	14	-27	-98	10	-88	-117	-	-117
<b>Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, am Ende des Geschäftsjahrs</b>	<b>-98</b>	<b>10</b>	<b>-88</b>	<b>-117</b>	<b>-</b>	<b>-117</b>	<b>-154</b>	<b>-</b>	<b>-154</b>

## 26 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUR KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die Gesellschaft gab Aktien aus, um den rückgewährbaren Anteil am SC300 Venture in Höhe von €278 während des am 30. September 2004 endenden Geschäftsjahrs abzulösen (siehe Anhang Nr. 23).

Die Gesellschaft richtete nach Ausgründung einen von Siemens getrennten und eigenständigen Pensionsplan für ihre US-amerikanischen Mitarbeiter ein. Zum Zeitpunkt der Ausgründung wurde der eingezahlte Bestand des der Gesellschaft zuzurechnenden Teils des US-amerikanischen Pensionsplans von Siemens im Verhältnis zu den übertragenen Mitarbeitern als Pensionsrückstellung erfasst. Nachträglich transferierte Siemens, basierend auf einer versicherungsmathematischen

	2003	2004	2005
<b>Auszahlungen für:</b>			
Zinsen	104	144	91
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53	59	79
<b>Operatives Geschäft:</b>			
Erhaltene Zahlungen für steuerfreie Investitionszulagen	34	65	33
<b>Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungsaktivitäten:</b>			
Einlagen an Siemens	-6	-	-
Über Kapitalleasing erworbene Vermögensgegenstände	5	-	-

Ermittlung, Vermögensgegenstände, um diese Rückstellung finanziell zu unterlegen. Die Differenz zwischen der versicherungsmathematischen Bewertung am Tag der Unterlegung und der ursprünglich verrechneten Rückstellung in Höhe von €-6 wurde als Eigenkapitaltransaktion im Geschäftsjahr 2003 ausgewiesen.

## 27 VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft unterhält Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen des Siemens-Konzerns und zu den sonstigen verbundenen

und assoziierten Unternehmen (im Folgenden als „verbundene Unternehmen“ bezeichnet) im Rahmen des normalen Geschäfts. Infineon bezieht bestimmte Vorprodukte, insbesondere Chipsätze, von verbundenen Unternehmen. Zugleich verkauft die Gesellschaft auch ihre Produkte an verbundene Unternehmen. Diese Käufe von und Verkäufe an verbundene Unternehmen orientieren sich grundsätzlich an Marktpreisen oder an Herstellungskosten zuzüglich einer Gewinnmarge.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Arbeitnehmer setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
<b>Kurzfristig:</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns	206	145
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen	12	12
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 14)	18	18
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 14)	49	5
Forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang Nr. 14)	9	8
	<b>294</b>	<b>188</b>
<b>Langfristig:</b>		
Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen (siehe Anhang Nr. 17)	10	67
Forderungen gegen Arbeitnehmer (siehe Anhang Nr. 17)	2	2
	<b>12</b>	<b>69</b>
<b>Summe Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>306</b>	<b>257</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich zum 30. September 2004 und 2005 wie folgt zusammen:

	2004	2005
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Unternehmen des Siemens-Konzerns (siehe Anhang Nr. 18)	61	61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 18)	68	140
Finanzverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen verbundenen und assoziierten Unternehmen (siehe Anhang Nr. 20)	2	4
<b>Summe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>131</b>	<b>205</b>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber bzw. Forderungen gegen verbundene Unternehmen wird wie folgt unterschieden: erstens Positionen, bei denen entweder von oder an Siemens-Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft Geschäftsanteile hält, schuldet oder geschuldet wird, und zweitens nach dem zu Grunde liegenden Geschäftsvorfall. Die als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Beträge resultieren aus dem Kauf bzw. Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Finanzforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten die geschuldeten Beträge aus Darlehen sowie die zu Interbankensätzen aufgelaufenen Zinsen.

Die Gesellschaft und IBM haben jeweils einen befristeten revolvingierenden Kredit an ALTIS verlängert. Zum 30. September 2004 war der Kredit in Höhe von €42 in der Position „kurzfristige Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ und zum 30. September 2005 in Höhe von €57 in der Position „langfristige Finanzforderungen und sonstige Forderungen gegen sonstige verbundene und assoziierte Unternehmen“ ausgewiesen.



Darstellung des Geschäftsverkehrs mit verbundenen Unternehmen für die zum 30. September 2003, 2004 und 2005 endenden Geschäftsjahre:

	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen:</b>			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	836	957	861
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	163	69	55
<b>Gesamte Umsatzerlöse mit verbundenen Unternehmen</b>	<b>999</b>	<b>1.026</b>	<b>916</b>
<b>Bezüge von verbundenen Unternehmen:</b>			
Unternehmen des Siemens-Konzerns	413	264	226
Assoziierte und sonstige verbundene, nicht konsolidierte Unternehmen	470	357	615
<b>Gesamtbezüge von verbundenen Unternehmen</b>	<b>883</b>	<b>621</b>	<b>841</b>
<b>Zinserträge/-aufwendungen von verbundenen Unternehmen</b>			
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	4	2	2
Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen	-1	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Die Umsätze mit Unternehmen des Siemens-Konzerns beinhalten Verkäufe an Siemens-Vertriebsorganisationen zum Weiterverkauf an Dritte, die sich in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 auf jeweils €86, €23 und €38 beliefen. Grundsätzlich wird der Verkauf an Dritte über die eigene Vertriebsorganisation der Gesellschaft abgewickelt. In bestimmten Ländern, in denen die Gesellschaft keine eigene Vertriebsorganisation unterhält, unterstützen die Vertriebsgesellschaften des Siemens-Konzerns den Verkauf an Dritte und erhalten hierfür eine Kommission.

Die Käufe von Gesellschaften des Siemens-Konzerns bestehen hauptsächlich aus Vermögensgegenständen, Vorräten, IT-Dienstleistungen und Verwaltungsdienstleistungen.

Im Februar 2004 hat die Gesellschaft den Erwerb von Vermögensgegenständen, inklusive der Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten, der Protocol-Software-Aktivitäten der Siemens AG für €13 und die Übernahme von rund 145 Software-Ingenieuren auf dem Gebiet der mobilen Kommunikation abgeschlossen.

Siemens hatte am 10. August 2000 garantierte Wandelanleihen (Exchangeable Notes) mit einem Nominalvolumen von €2.500 ausgegeben. Die mit 1 Prozent p.a. verzinsten Wertpapiere hatten eine Laufzeit bis zum 10. August 2005. Jeder Inhaber einer Teilschuldverschreibung hatte bei Eintritt bestimmter Bedingungen das Recht, diese Teilschuldverschreibung bis zum 27. Juli 2005 in 1.000 Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Während des Geschäftsjahrs 2004 hat Siemens Teilschuldverschreibungen in Höhe von €1.905 zurückgekauft. Im August 2005 tilgte Siemens die restlichen Wandelanleihen in Höhe von €595 zu 105,2 Prozent vom Nennwert.

Am 12. Januar 2004 hat die Siemens AG bekannt gegeben, dass sie 150 Millionen Aktien der Infineon Technologies AG verkauft hat. Auf Grund dieser Transaktion ist der Anteil der Siemens Nederland N.V. unter 10 Prozent gefallen. Zum 30. September 2004 wurde der noch übrige Siemens-Anteil in Höhe von 18,2 Prozent von der nicht stimmberechtigten Treuhandgesellschaft gehalten. Im November 2004 endete das Treuhandabkommen zwischen der Siemens AG und der nicht stimmberechtigten Treuhandgesellschaft gemäß den Bedingungen des Treuhandabkommens, und die 136.292.363 Aktien der Gesellschaft wurden an die Siemens AG übertragen. Zum 30. September 2005 betrug der Anteil an der Gesellschaft, für die die Siemens AG wirtschaftlich Berechtigter mit voller Stimm- und Verfügungsberechtigung ist, insgesamt 136.292.363 Aktien oder entsprechend 18,2 Prozent am Grundkapital.

**28 PENSIONSVERPFLICHTUNGEN**

Pensionszusagen der Gesellschaft werden zurzeit überwiegend über Pensionszusagen einem bedeutenden Anteil der Mitarbeiter gewährt. Die Pensionszusagen richten sich im Wesentlichen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ein Teil der Altersversorgungspläne bezieht sich auf das Einkommen im letzten oder in den vergangenen fünf Jahren der Betriebszugehörig-

keit, andere feste Versorgungspläne sind vom durchschnittlichen Einkommen und der Position abhängig. Der Bewertungsstichtag für die Pensionspläne der Gesellschaft ist der 30. Juni.

Die Daten zu den Pensionsplänen der Gesellschaft sind für die deutschen Versorgungspläne („Inland“) und die ausländischen Versorgungspläne („Ausland“) zum 30. September 2003, 2004 und 2005 in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2003		2004		2005	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
<b>Kumulierte Anwartschaftsbarwerte (ABO) zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	-205	-52	-226	-56	-337	-64
<b>Entwicklung der Anwartschaftsbarwerte (PBO):</b>						
Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Beginn des Geschäftsjahrs	-218	-58	-243	-70	-271	-78
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-13	-5	-14	-7	-16	-7
Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-13	-4	-13	-4	-15	-4
Versicherungstechnische Gewinne/Verluste	3	-5	-	3	-89	-2
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	-7	-1	-1	-	-
Desinvestitionen	-	-	1	-	1	4
Neu geschaffener Plan	-	-	-	-2	-	-
Planänderung	-4	-	-3	-	-8	-
Gezahlte Versorgungsleistungen	2	1	2	1	2	2
Kürzungen	-	3	-	-	4	1
Fremdwährungseffekte	-	5	-	2	-	-1
<b>Anwartschaftsbarwerte (PBO) zum Ende des Geschäftsjahrs</b>	-243	-70	-271	-78	-392	-85
<b>Entwicklung des Marktwerts des Planvermögens:</b>						
Marktwert zu Beginn des Geschäftsjahrs	120	26	143	27	174	30
Einlagen und Übertragungen	22	2	19	2	17	4
Tatsächliche Rendite auf das Planvermögen	3	-	14	3	19	2
Gezahlte Versorgungsleistungen	-2	-1	-2	-1	-2	-2
Akquisitionsbedingte Zugänge	-	4	-	-	-	-
Neu geschaffener Plan	-	-	-	-	-	-
Fremdwährungseffekte	-	-4	-	-1	-	1
<b>Zeitwert am Ende des Geschäftsjahrs</b>	143	27	174	30	208	35
Finanzierungsstatus des Planvermögens	-100	-43	-97	-48	-184	-50
Noch nicht in den Gewinn-und-Verlust-Rechnungen erfasster versicherungsmathematischer Verlust	66	6	59	2	138	4
Noch nicht in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasste Versorgungsansprüche aus vorhergehenden Geschäftsjahren	4	-2	7	-2	14	-2
<b>Zuführungen nach der Gutachtenberechnung</b>	16	-	1	1	16	1
<b>Pensionsverpflichtungen, Saldo</b>	-14	-39	-30	-47	-16	-47

Die in der konsolidierten Bilanz zum 30. September ausgewiesenen Verpflichtungen setzen sich jeweils wie folgt zusammen:

	2003		2004		2005	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Vorausgezahlte Pensionsaufwendungen (siehe Anhang Nr. 17)	-	1	27	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände (siehe Anhang Nr. 14)	4	-	-	-	14	-
Kumulierte Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren	29	-	-	-	85	-
Pensionsverbindlichkeiten (siehe Anhang Nr. 22)	-47	-40	-51	-47	-115	-47
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-6	-	-	-
<b>Pensionsverpflichtungen, Saldo</b>	-14	-39	-30	-47	-16	-47

(Euro in Mio., wenn nicht anders angegeben)

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von €6 zum 30. September 2004 bezogen sich auf die Pensionsverbindlichkeiten aus dem Glasfaserkomponentengeschäft, das zum Verkauf stand.

Die Daten zu den Pensionsplänen, bei denen die Anwartschaftsbarwerte und kumulierten Anwartschaftsbarwerte die Marktwerte des Planvermögens übersteigen, werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

	2003		2004		2005	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Anwartschaftsbarwerte	243	70	271	78	393	85
Marktwert des Planvermögens	143	27	174	30	208	35
Kumulierte Anwartschaftsbarwerte	205	48	53	51	337	57
Marktwert des Planvermögens	143	22	-	23	208	26

Der Ermittlung der durchschnittlich gewichteten versicherungsmathematischen Werte der wesentlichen Versorgungspläne lagen folgende Annahmen zu Grunde:

	2003		2004		2005	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Abzinsungsfaktor in %	5,8	5,9	5,8	5,6	4,5	4,8
Personalkostenteuerungsrate in %	3,0	3,9	3,0	3,7	2,5	3,1
Erwartete Rentenentwicklung in %	1,3	2,6	1,3	2,6	1,3	2,2
Erwartete Rendite auf das Planvermögen in %	4,9	6,8	6,8	7,0	7,3	6,9

Die Abzinsungsfaktoren werden auf der Basis erstklassiger Rentenpapiere gebildet, die, falls die Pensionsanwartschaften zum Stichtag glattgestellt würden, bis zum Fälligkeitszeitpunkt die benötigten zukünftigen Einzahlungen bereitstellen würden. Die Gesellschaft geht davon aus, dass kurzfristige Schwankungen der Zinssätze keinen Einfluss auf ihre langfristigen Verpflichtungen haben werden.

### Investitionsstrategie

Die Investitionsstrategie für den Pensionsplan der Gesellschaft beinhaltet ein gewisses Maß an Flexibilität, um sich ergebende Anlagechancen frühestmöglich ergreifen zu können. Gleichzeitig stellen angemessene Kennzahlen sicher, dass die Vorsichts- und Sorgfaltspflichten bei der Ausführung des Investitionsprogramms erfüllt werden. Das Vermögen des Pensionsfonds wird von mehreren Anlageberatern angelegt. Die Pläne sehen eine Kombination aus aktiven und passiven Investitionsprogrammen vor. Unter Berücksichtigung der Laufzeit der zu Grunde liegenden Verpflichtungen wird ein Portfolio der Investitionen des Planvermögens, bestehend aus Anteils-, Gläubiger- und anderen Wertpapieren, angestrebt, um die langfristige Gesamtkapitalrendite bei einem bestimmten Risiko zu maximieren. Das Investitionsrisiko wird durch laufende periodenweise Prüfungen des Portfolios, durch Meetings mit Anlageberatern und durch jährli-

che Verbindlichkeitsberechnungen kontrolliert. Die Investitionsmethoden und -strategien werden periodisch überprüft, um sicherzustellen, dass die Ziele der Versorgungspläne, unter Berücksichtigung jeder Änderung im Aufbau des Versorgungsplans, der Marktbedingungen oder anderer wesentlicher Punkte, erreicht werden.

### Erwartete langfristige Rendite des Planvermögens

Um die erwartete Gesamtkapitalrendite des Planvermögens festlegen zu können, bedarf es weiterer Annahmen. Die Methode der Gesellschaft, die Rendite des Planvermögens zu bestimmen, basiert auf dauerhaften historischen Finanzmarktbeziehungen, den verschiedenen Arten der Investitionsklassen, in denen das Pensionsvermögen angelegt wurde, langfristigen Investitionsstrategien sowie auch auf der kumulierten Rendite, welche die Gesellschaft mit ihrem Portfolio normalerweise in einem bestimmten Zeitraum erwarten kann.

Die Gesellschaft überprüft die erwartete langfristige Gesamtkapitalrendite jährlich und nimmt, wenn nötig, Anpassungen vor. Zusätzlich gibt die Gesellschaft detaillierte Vermögens-/Verbindlichkeits-Studien in Auftrag, die regelmäßig von unabhängigen Anlageberatern und Versicherungsfachleuten durchgeführt werden.

### Verteilung des Planvermögens

Am 30. September 2004 bzw. 2005 betrug der Prozentsatz des investierten Planvermögens in den wesentlichen Vermögensposten:

	2004		2005		Zielverteilung	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Anteilspapiere in %	45	60	44	57	45	59
Gläubigerpapiere in %	46	38	51	35	52	35
Sonstiges in %	9	2	5	8	3	6
<b>Gesamt in %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Die Verteilung des Planvermögens der Gesellschaft auf das Anlagevermögen des Pensionsplans basiert auf der Einschätzung der Geschäfts- und Finanzlage, demographischen und versicherungsmathematischen Daten, Finanzierungsmöglichkeiten, geschäftsbezogenen Risikofaktoren, Marktsensitivitätsanalysen und anderen relevanten Faktoren. Insgesamt soll die Verteilung der Sicherung des Planvermögens dienen und gleichzeitig für ausreichend stabile, also beispielsweise inflationsbereinigte Einkünfte sorgen, um sowohl derzeitige als auch zukünftige

Pensionszusagen zu erfüllen. Auf Grund des aktiven Portfoliomanagements kann die tatsächliche Verteilung des Anlagevermögens, innerhalb bestimmter Grenzen der verschiedenen Risikoklassen, von der geplanten Verteilung abweichen. Gemäß den Richtlinien der Gesellschaft investieren die Pensionspläne der Gesellschaft nicht in eigene Aktien.

Die Pensionsaufwendungen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 beinhalten:

	2003		2004		2005	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Aufwendungen für die im Geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche	-13	-5	-14	-7	-16	-7
Aufwendungen aus Aufzinsung der Anwartschaftsbarwerte	-13	-4	-13	-4	-15	-4
Erwarteter Ertrag aus Planvermögen	6	2	11	2	13	2
Amortisation von noch nicht realisierten Verlusten	-3	-	-3	-	-3	-
Realisierter Gewinn aus Kürzungen	-	3	-	-	1	1
<b>Aufwendungen für Pensionen und Pensionsverpflichtungen</b> (siehe Anhang Nr. 7)	<b>-23</b>	<b>-4</b>	<b>-19</b>	<b>-9</b>	<b>-20</b>	<b>-8</b>

Die aus den Pensionsplänen bereits entstandenen Versorgungsansprüche werden in gleich hohen Beträgen auf die Jahre, in denen jeder aktive Mitarbeiter voraussichtlich Bezüge aus dem Pensionsvermögen erhalten wird, umgelegt.

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in die Netto-Pensionskosten für diejenigen Jahre mit eingeschlossen, in denen zu Beginn des Geschäftsjahrs die nicht realisierten Gewinne oder Verluste den Anwartschaftsbarwert oder, falls größer, den Marktwert des Planvermögens um 10 Prozent übersteigen. Die Amortisation berechnet sich aus dem Überschuss dividiert durch die durchschnittlich verbleibende Versorgungsperiode, in der aktive Mitarbeiter voraussichtlich Bezüge aus dem Planvermögen erhalten werden.

Die versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste betragen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 €-2, €3 und €-91. Die Erhöhung des versicherungsmathematischen Verlusts

im Geschäftsjahr 2005 wurde im Wesentlichen durch die Reduzierung des Abzinsungsfaktors der Anwartschaftsbarwerte und die Einführung der neuen Sterbetafeln für die Berechnung der inländischen Versorgungspläne verursacht.

Am 25. September 2000 gründete die Gesellschaft den Infineon Technologies Pension Trust e.V. („Pension Trust“) zur Finanzierung künftiger Pensionszahlungen für Mitarbeiter in Deutschland, um das Unternehmensrisiko bezüglich der Pensionsverpflichtungen zu reduzieren. Die Gesellschaft leistete eine Einlage in Höhe von €155 in Form von Zahlungsmitteln und Wertpapieren, die Gläubiger- bzw. Eigentümerrechte verbriefen. Die Einlage fällt als Planvermögen des Pension Trust zur Finanzierung dieser Pensionsverpflichtungen unter die Bestimmungen von SFAS Nr. 87, „Employer’s Accounting for Pensions“, und reduziert insoweit die Pensionsrückstellungen der Gesellschaft.

Die Auswirkungen der Mitarbeiterentlassungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungen in der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 8) auf die Pensionsverpflichtungen der Gesellschaft werden auf Grund der Anwendung von SFAS Nr. 88, „Employers Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits“, als Kürzung in den Geschäftsjahren 2003 und 2005 dargestellt.

Die künftigen Pensionszahlungen, die eine zukünftige Leistung darstellen, belaufen sich entsprechend der Auszahlungserwartung der Pensionspläne der Gesellschaft in den nächsten fünf Geschäftsjahren und danach auf:

Für die Geschäftsjahre zum 30. September	Inland	Ausland
2006	7	1
2007	7	1
2008	8	2
2009	10	2
2010	13	2
2011–2015	77	18

Im Laufe des Geschäftsjahrs 2002 etablierte die Gesellschaft ein zusätzliches Programm zur betrieblichen Altersvorsorge für deutsche Mitarbeiter, wobei die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, einen Teil des Gehalts in eine Rentenzahlung inklusive aufgelaufener Zinsen zum Renteneintritt umzuwandeln. Die Verbindlichkeit für künftige Zahlungen in Höhe von €9 und €14 für die Geschäftsjahre 2004 und 2005 ist versicherungsmathematisch bestimmt und auf der gleichen Basis wie andere Pensionspläne der Gesellschaft berechnet worden.

Die Gesellschaft gewährt bestimmten Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten von Amerika nach ihrem Ausscheiden Krankenversicherungsleistungen. Der Gesellschaft entstanden hierfür Kosten in Höhe von weniger als €1 für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005. Die Nettoverbindlichkeit betrug in den Konzernbilanzen der Geschäftsjahre 2004 und 2005 €5.

## 29 DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Die Gesellschaft schließt Geschäfte über Derivate einschließlich Zins-Swap-Vereinbarungen, Fremdwährungstermin- und -optionengeschäften ab. Ziel dieser Transaktionen ist die Verringerung der Zins- und Währungsschwankungen für die in Fremdwährung lautenden künftigen Netto-Zahlungsströme. Derivative Finanzinstrumente werden bei der Gesellschaft nicht zu Handels- oder spekulativen Zwecken eingesetzt.

Die Nominal- und Marktwerte der von der Gesellschaft zum 30. September 2004 und 2005 gehaltenen Derivate sind im Folgenden dargestellt:

	2004		2005	
	Nominalwert	Marktwert	Nominalwert	Marktwert
<b>Forward-Verträge</b>				
<b>Verkauf:</b>				
US-Dollar	371	8	838	-20
Japanischer Yen	4	-	9	-
Singapur-Dollar	-	-	2	-
<b>Forward-Verträge</b>				
<b>Kauf:</b>				
US-Dollar	56	-1	195	4
Japanischer Yen	55	-	42	-
Singapur-Dollar	29	-	23	-
Britisches Pfund	4	-	5	-
Tschechische Kronen	-	-	1	-
Malaysische Ringit	-	-	32	1
Sonstige Währungen	5	-	23	-1
<b>Währungsoptionen:</b>				
<b>Verkauf:</b>				
US-Dollar	520	-16	527	-21
<b>Währungsoptionen:</b>				
<b>Kauf:</b>				
US-Dollar	514	9	522	3
<b>Währungsübergreifender Zins-Swap:</b>				
US-Dollar	406	60	389	21
<b>Zins-Swap-Vereinbarung</b>	1.442	29	1.442	14
<b>Sonstige</b>	-	-	259	-2
<b>Marktwert, Saldo</b>		89		-1

Im Geschäftsjahr 2004 hat die Gesellschaft zwei Zins-Swap-Vereinbarungen mit einem Nominalwert von €500 als zahlungsmittelbezogene Sicherungsgeschäfte zur Marktwertsicherung des korrespondierenden Grundbetrags der 2007 fälligen Wandelanleihe bestimmt. Die Veränderungen des Marktwerts des Sicherungsgeschäfts betragen €1 und €-5 in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 und sind in den Zinsaufwendungen enthalten. Die Gesellschaft löste das Sicherungsverhältnis im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2005 auf. Die Marktwertveränderung von €-4 seit Beginn des Sicherungsgeschäfts wird bis zur Fälligkeit der Wandelanleihe anteilmäßig in den Zinsaufwendungen gebucht.

Die Gesellschaft hat mit unabhängigen Finanzinstituten Zins-Swap-Vereinbarungen abgeschlossen. Diese Zins-Swaps dienen zur Absicherung des Cash-Flows gegenüber Veränderungen des Zinssatzes für die in den nächsten zehn Jahren zu

erwartenden Leasingzahlungen für den Campeon-Leasingvertrag (siehe Anhang Nr. 31). Der ineffektive Teil des Cash-Flow-Sicherungsgeschäfts betrug €0 in den Geschäftsjahren 2004 und 2005. Der effektive Teil in Höhe von €1 und €-24 wird als Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren, abgegrenzt und wird voraussichtlich anteilmäßig mit Beginn des Leasings über die gesamte Leasingzeit in das Ergebnis als Teil der Leasingaufwendungen umgliedert.

In den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 beinhaltete das Zinsergebnis Erträge in Höhe von €11, €22 und €21 aus Zins-Swap-Vereinbarungen.

Die im Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag enthaltenen Gewinne und Verluste aus Fremdwährungs-Transaktionen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften werden in den Umsatzkosten dargestellt, soweit diese aus operativem Geschäft resultieren. Sie sind in den sonstigen Erträgen/Aufwendungen enthalten, wenn diese aus dem Finanzgeschäft resultieren. In den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 stellen diese sich wie folgt dar:

	2003	2004	2005
<b>Gewinn/Verlust aus Fremdwährungs-Sicherungsgeschäfte:</b>			
Umsatzkosten	8	44	-14
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	106	3	-10
	114	47	-24
<b>Gewinn/Verlust aus Fremdwährungs-Transaktionen:</b>			
Umsatzkosten	-40	-50	-5
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	-106	-12	50
	-146	-62	45
<b>Netto-Gewinn/Verlust aus Fremdwährungs-Transaktionen und Fremdwährungs-Sicherungsgeschäften</b>	<b>-32</b>	<b>-15</b>	<b>21</b>

Die Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente wurden anhand von amtlichen Börsenkursen oder als Discounted-Cash-Flow ermittelt. Der Marktwert der unbesicherten Darlehen und der verzinslichen Bankverbindlichkeiten entspricht annähernd dem Buchwert, da die Verzinsung den derzeit marktüblichen Zinsen entspricht. Zum 30. September 2005 wurden die Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2007 bzw. 2010 an der Börse in Luxemburg mit Aufschlägen von 1,2 Prozent bzw. 9,4 Prozent gegenüber ihrem Nominalwert gehandelt. Die Marktwerte der Zahlungsmittel, Forderungen gegen Dritte, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

sowie der übrigen derivativen Finanzinstrumente entsprechen auf Grund ihrer kurzfristigen Fälligkeiten annähernd deren Buchwerten. Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Marktwerten bilanziert (siehe Anhang Nr. 11).

### 30 RISIKEN

Die Finanzrisiken der Gesellschaft resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Zahlungsmitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Fremdwährungs-Derivaten. Das Kreditrisiko bei Forderungen ist auf Grund der großen Anzahl sowie wegen der regionalen Verteilung der Kunden begrenzt. Die Gesellschaft steuert Kreditrisiken durch Kreditgenehmigungen, Kreditlimits und Überwachungsprozesse sowie umfassende Kreditprüfungen aller Kunden. Ein beträchtlicher Teil der Forderungen und Umsätze aus Lieferungen und Leistungen wird mit verbundenen Unternehmen realisiert. Das Kreditrisiko in Bezug auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Fremdwährungs-Derivate durch Transaktionen mit einer begrenzten Anzahl von internationalen Finanzinstituten ist auf vorgegebene Obergrenzen beschränkt. Die Gesellschaft glaubt, dass das Risiko einer Nichterfüllung eines Geschäftspartners gering ist, da die Gesellschaft deren Kreditrisiko prüft und die Höhe der Außenstände und die Anzahl der Vereinbarungen mit allen Finanzinstituten limitiert.

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit muss die Gesellschaft weiterhin hohe Aufwendungen für Prozesstechnologien sowie für Forschung und Entwicklung tätigen. Falls die Ergebnisse aus diesen Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Markt keine Akzeptanz finden oder die Marktbedingungen sich wesentlich verschlechtern, könnten Teile der erwarteten Rückflüsse aus diesen Investitionen ausbleiben.

Bedingt durch den High-Tech-Charakter des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft ist geistiges Eigentum von großer Bedeutung. Die Gesellschaft besitzt geistiges Eigentum, das selbst entwickelt, zugekauft oder von Dritten lizenziert wurde. Die Gesellschaft ist der Verletzung ihrer Rechte durch Dritte an diesem geistigen Eigentum ausgesetzt. Umgekehrt können Dritte behaupten, dass die Gesellschaft deren Rechte an geistigem Eigentum verletzt hat.

Auf Grund der Nutzung von Fremdfertigern und Joint-Venture-Abkommen hat die Gesellschaft einen bedeutenden Anteil an Produktionskapazitäten, der außerhalb ihrer direkten Kontrolle liegt. Die Gesellschaft ist von diesen anderen Gesellschaften in Bezug auf die rechtzeitige oder ununterbrochene Belieferung mit Produkten abhängig sowie möglichen Schwankungen der Einkaufspreise zu einem gewissen Maße ausgesetzt.

Die Gesellschaft hat Regeln und Verhaltensweisen für ihre Mitarbeiter etabliert; werden diese nicht eingehalten, wird die Gesellschaft Risiken ausgesetzt.

Ungefähr 10.000 Arbeitnehmer der Gesellschaft unterliegen Tarifvereinbarungen. Diese Tarifvereinbarungen betreffen vor allem die nicht der Unternehmensführung zugehörigen Arbeitnehmer in Deutschland (ungefähr 6.400 Arbeitnehmer), in der Tschechischen Republik (ungefähr 400 Arbeitnehmer) und in Österreich (ungefähr 2.300 Arbeitnehmer). Die Tarifvereinbarung in Deutschland ist unbefristet, kann aber durch die Gewerkschaft mit einer Kündigungsfrist von einem Monat vor dem 28. Februar 2006 gekündigt werden. Die Vereinbarung in Österreich endet am 1. Mai 2006. Die Vereinbarungen bleiben im Allgemeinen in Kraft, bis sie durch eine nachfolgende Vereinbarung ersetzt werden. Abkommen für die Zeit nach Ablauf der Vereinbarungen sind mit den jeweiligen Gewerkschaften in Tarifverhandlungen auszuhandeln.

### 31 FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

#### Rechtsangelegenheiten

Im März 2005 haben die Gesellschaft und Rambus ein Lizenzabkommen abgeschlossen, nach dem die Gesellschaft das Patentportfolio von Rambus für aktuelle und künftige Produkte der Gesellschaft nutzen kann. Gleichzeitig wurden alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen beigelegt. Im Rahmen des Abkommens erhielt die Gesellschaft eine weltweit gültige Lizenz für die Nutzung von Rambus-Patenten in Speicherprodukten. Die Gesellschaft sagte zu, für die weltweit gültige Lizenz 50 Millionen US-Dollar in vierteljährlichen Raten zu 6 Millionen US-Dollar vom 15. November 2005 bis zum 15. November 2007 zu zahlen. Nur wenn Rambus zusätzliche Lizenzabkommen mit bestimmten weiteren Speicherherstellern abschließt, wird die Gesellschaft nach dem 15. November 2007 vierteljährliche Zahlungen bis zu maximal 100 Millionen US-Dollar tätigen. Die Gesellschaft hat darüber hinaus die Option, bestimmte andere Lizenzen von Rambus zu erwerben. Mit dem vereinbarten Lizenzabkommen erhält die Gesellschaft den Status als „bevorzugter Kunde“ („most-favored customer“) von Rambus. Rambus erhält von der Gesellschaft eine unbefristete und vollständig abgeholte Lizenz für Speicherschnittstellen-Patente.

ProMOS erhob am 7. Mai 2003 eine Schiedsklage gegen die Gesellschaft und klagte auf Zahlung von zirka 36 Millionen US-Dollar für DRAM-Produkte, die an die Gesellschaft verkauft wurden, von zirka 338 Millionen US-Dollar Schadensersatz wegen Nichtlieferung von Technologie der Gesellschaft und das Recht, die bisher von der Gesellschaft gelieferte Technologie weiter kostenlos nutzen zu dürfen. Die Gesellschaft erhob Widerklage auf Unterlassung der Nutzung ihrer Technologie und auf Schadensersatz in Höhe von zirka 568 Millionen US-Dollar nach Verrechnung mit der ProMOS-Kaufpreisforderung von zirka 36 Millionen US-Dollar.

Am 10. November 2004 haben sich die Gesellschaft und ProMOS über eine Lizenz zur Nutzung der bereits transferierten DRAM-Technologie der Gesellschaft geeinigt. Der „S17-to-S12“-Lizenzvertrag aus dem Jahr 2000 besteht in angepasster Form fort. ProMOS war und bleibt auch lizenziert, die von der Gesellschaft transferierte Technologie zur Produktion und Vermarktung von Halbleiterprodukten weiter zu nutzen und auch eigene Produkte und Prozesse auf dieser Basis zu entwickeln. Im Rahmen der Vereinbarung wird ProMOS Lizenzgebühren in vier Raten bis zum 30. April 2006 in Höhe von insgesamt 156 US-Dollar Millionen zahlen, wobei 36 Millionen US-Dollar mit aufgelaufenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft für von ProMOS bezogene Produkte verrechnet werden. Die Gesellschaft und ProMOS haben außerdem sämtliche zwischen ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten zurückgenommen. Die Gesellschaft verbuchte das Lizenzeinkommen im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2005.

Im September 2004 hat die Gesellschaft mit der Kartellabteilung des US-Bundesjustizministeriums („DOJ“) in Verbindung mit der andauernden Untersuchung des DOJ von möglichen Verletzungen US-amerikanischer Kartellgesetze in der DRAM-Industrie ein so genanntes Plea-Agreement abgeschlossen. In diesem Vertrag hat die Gesellschaft sich bereit erklärt, sich in einem einzigen und begrenzten Anklagepunkt schuldig zu bekennen, der die Preisbildung für DRAM-Produkte zwischen dem 1. Juli 1999 und dem 15. Juni 2002 betrifft. Nach den Bedingungen dieses Vertrags hat sich die Gesellschaft verpflichtet, eine Strafzahlung in Höhe von 160 Millionen US-Dollar zu leisten. Die Zahlung inklusive angefallener Zinsen erfolgt in gleichen jährlichen Raten bis 2009. Am 25. Oktober 2004 hat das US-Bundesgericht für Nordkalifornien das Plea-Agreement zwischen der Gesellschaft und dem DOJ bestätigt. Damit ist die Angelegenheit zwischen der Gesellschaft und dem DOJ im Hinblick auf die andauernde industrieweite Untersuchung des DOJ geklärt. Allerdings ist die Gesellschaft weiterhin verpflichtet, mit dem DOJ bei dessen Untersuchung gegen andere DRAM-Hersteller zu kooperieren. Das vom DOJ vorgeworfene Fehlverhalten war auf sechs Original Equipment Manufacturer („OEM“-)Kunden, die Computer und Server herstellen, begrenzt. Die Gesellschaft hat mit allen bis auf einen dieser Kunden Vergleichsverträge abgeschlossen und erwägt die Möglichkeit eines Vergleichs mit dem verbleibenden Kunden, der nur eine sehr kleine Menge an DRAM-Produkten von der Gesellschaft gekauft hatte.

Seit dem Beginn des DOJ-Verfahrens sind mehrere Sammelklagen gegen die Gesellschaft, ihre US-Tochtergesellschaft und weitere DRAM-Hersteller eingereicht worden.

16 Klagen wurden zwischen Juni 2002 und September 2002 bei US-Bundesgerichten eingereicht, davon eine in dem südlichen Distrikt von New York, fünf im Distrikt von Idaho und zehn im Distrikt Nördliches Kalifornien. Jede dieser Klagen ist in der

Form der Sammelklage für Einzelpersonen und juristische Personen erhoben worden, die DRAM-Produkte direkt von DRAM-Anbietern in den Vereinigten Staaten von Amerika in einem festgelegten Zeitraum beginnend am oder nach dem 1. Oktober 2001 erworben hatten („Klasse der direkten US-Kunden“). Die Kläger behaupten die Verletzung des „Sherman Act“ durch Preisabsprachen und machen dreifachen Schadenersatz in unspezifizierter Höhe, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten geltend. Im September 2002 entschied das „Judicial Panel on Multi-District Litigation“ (Gerichtssenat für Zuständigkeitsentscheidungen bei Betroffenheit mehrerer Bezirke), diese Verfahren an das US-Bundesgericht für Nordkalifornien zu verweisen, um sie dort koordiniert und gemeinsam als Teil einer Multi-District Litigation („MDL“) weiter zu behandeln. Im Juni 2005 haben die Kläger mit Erlaubnis des US-Bundesgerichts für Nordkalifornien ihre Klage insofern ergänzt, als sie nun behaupten, dass das rechtswidrige Verhalten ungefähr am 1. April 1999 begonnen und bis mindestens 30. Juni 2002 angehalten hätte. Die Gesellschaft hat mit den Sammelklägern der Klasse der direkten US-Kunden, vorbehaltlich der Genehmigung durch das US-Bundesgericht für Nordkalifornien, einen Vergleichsvertrag geschlossen und mit sieben weiteren direkten Kunden, die nicht vom DOJ im Plea-Agreement benannt wurden, Vergleichsverträge abgeschlossen.

63 weitere Klagen wurden zwischen dem 2. August 2002 und 16. September 2005 bei einer Vielzahl von US-Bundes- und -Einzelstaatsgerichten eingereicht. Jede dieser Klagen (mit Ausnahme der am US-Bundesgericht für Ost-Pennsylvania anhängigen Klage) ist in der Form der Sammelklage im Namen von Einzelpersonen oder juristischen Personen erhoben worden, die indirekt DRAM-Produkte in einem bestimmten Zeitraum beginnend oder nach 1999 in den Vereinigten Staaten von Amerika erworben hatten („Klasse der indirekten US-Kunden“). Die am US-Bundesgericht für Ost-Pennsylvania anhängige Klage ist in der Form der Sammelklage im Namen von Einzelpersonen oder juristischen Personen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika erhoben worden, die direkt DRAM-Produkte zwischen April 1999 und Juni 2000 außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika erworben hatten („Klasse der direkten Nicht-US-Kunden“). Die Kläger behaupten in unterschiedlicher Form Verletzungen des „Sherman Act“, des kalifornischen „Cartwright Act“ und der Wettbewerbsrechte der jeweilig betroffenen US-Staaten sowie angeblich ungerechtfertigte Bereicherung und beantragen dreifachen Schadenersatz in unspezifizierter Höhe, Wiedergutmachung, Anwaltskosten und sonstige Kosten sowie eine Unterlassungsverfügung gegen das angeblich rechtswidrige Verhalten. Auf Antrag eines der Kläger entschied ein vom „Judicial Council of California“ benannter Richter, dass die zu jenem Zeitpunkt anhängigen kalifornischen Fälle an den „San Francisco County Superior Court“ übertragen

werden sollten, um dort koordiniert und gemeinsam behandelt zu werden. Zwölf der an US-Einzelstaatsgerichten anhängigen Klagen und die beim US-Bundesgericht für Ost-Pennsylvania anhängige Klage wurden auf Grund gerichtlicher Verfügung ebenfalls an das US-Bundesgericht für Nordkalifornien übertragen, um sie dort als Teil der oben beschriebenen MDL im Rahmen eines koordinierten und gemeinsamen Vorverfahrens („Pre-trial Proceedings“) weiter zu behandeln. Nach dieser Übertragung haben die Kläger zwei der übertragenen Klagen zurückgenommen. Zwei weitere der ursprünglich übertragenen Klagen wurden nachfolgend zu ihren jeweiligen US-Einzelstaatsgerichten zurückübertragen. Die Gesellschaft verteidigt sich energisch gegen diese Klagen.

Im April 2003 hat die Gesellschaft ein Auskunftsverlangen der Europäischen Kommission („Kommission“) erhalten, das einer Prüfung dienen soll, ob die EU-Wettbewerbsregeln im Rahmen bestimmter, der Kommission zur Kenntnis gelangter Praktiken am europäischen Markt für DRAM-Produkte verletzt wurden. Die Gesellschaft hat die Angelegenheit nach Abschluss des „Plea-Agreement“ mit dem DOJ erneut bewertet und im Geschäftsjahr 2004 eine Rückstellung für die Folgen dieses Verfahrens gebildet, um eine mögliche Mindeststrafe abzudecken, die verhängt werden könnte. Sollte die EU-Kommission tatsächlich eine Strafe verhängen, könnte diese auch erheblich höher als die Rückstellung sein. Allerdings kann die Gesellschaft derzeit die Höhe einer solchen Strafe nicht genauer abschätzen. Im Rahmen dieser Untersuchung kooperiert die Gesellschaft umfassend mit der Kommission.

Im Mai 2004 hat die kanadische Wettbewerbsbehörde („Competition Bureau“) die US-Tochtergesellschaft von Infineon davon in Kenntnis gesetzt, dass sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen Ziel einer formellen Untersuchung von mutmaßlichen Verletzungen des kanadischen Wettbewerbsgesetzes in der DRAM-Industrie sind. Ein Zwangsverfahren (zum Beispiel im Rahmen von hoheitlichen Anordnungen) wurde nicht eingeleitet. Die Gesellschaft unterstützt die Untersuchungen des Competition Bureau kooperativ.

Im Oktober 2004 wurde in der kanadischen Provinz Quebec eine Sammelklage gegen die Gesellschaft im Namen von indirekten Kunden eingereicht, die im Zeitraum zwischen Juli 1999 und Juni 2002 in Quebec indirekt DRAM-Produkte von bestimmten OEM-Kunden erworben hatten. Der in der Klage geltend gemachte Schadenersatz in unspezifizierter Höhe sowie die weiterhin geltend gemachten Aufklärungs-, Gerichts- und Anwaltskosten und Zinsen werden auf die Aktivitäten der Gesellschaft zurückgeführt, die Gegenstand des Plea-Agreement zwischen der Gesellschaft und dem DOJ vom 15. September 2004 waren. Zwischen Dezember 2004 und Februar 2005 wurden drei weitere Sammelklagen in den Provinzen Quebec, Britisch-Kolumbien und Ontario im Namen von allen direkten und indirekten Kunden eingereicht, die jeweils in den Provinzen



Quebec und Britisch-Kolumbien sowie im Fall der in Ontario eingereichten Klage in Kanada ansässig sind und im Zeitraum zwischen Juli 1999 und Juni 2002 direkt oder indirekt DRAM-Produkte erworben hatten. In den Klagen werden jeweils Schadensersatz, Strafschadensersatz („punitive damages“), Aufklärungs- und Verwaltungskosten in unspezifizierter Höhe sowie Zinsen, Gerichts- und Anwaltskosten geltend gemacht.

Zwischen dem 30. September 2004 und 4. November 2004 wurden bei US-Bundesgerichten in Kalifornien und New York insgesamt sieben Sammelklagen gegen die Gesellschaft eingereicht. Die Kläger haben die in New York erhobenen Klagen mittlerweile zurückgenommen und am 30. Juni 2005 in Kalifornien eine geänderte Klage eingereicht, die alle bislang erhobenen Klagen zu einer Klage zusammenfasst. Die Klagen behaupten Verletzungen von US-Kapitalmarktregeln und Anlegerschutzvorschriften und begehren Schadensersatz im Namen einer angeblichen Gruppe von Käufern von an Kapitalmärkten gehandelten Aktien und American Depositary Shares der Gesellschaft für die Zeit vom 13. März 2000 bis 19. Juli 2004. Die Gesellschaft wird sich energisch gegen Anschuldigungen verteidigen, US-Kapitalmarktregeln und Anlegerschutzvorschriften verletzt zu haben.

Gegen Jahresende 2002 behauptete MOSAID Technologies Inc., USA („MOSAID“), dass die Gesellschaft elf DRAM-bezogene US-Patente von MOSAID verletze. Im Dezember 2002 reichte die Gesellschaft beim US-Bezirksgericht für Nordkalifornien eine Klage ein mit dem Antrag festzustellen, dass die Gesellschaft diese US-Patente nicht verletze. Am 7. Februar 2003 erhob MOSAID Widerklage mit dem Antrag, neben der Klageabweisung auch auf Schadensersatz für Patentverletzung zu erkennen. Am 3. November 2003 gab MOSAID bekannt, dass sie eine erweiterte Widerklage eingereicht und damit zwei neue Patente der früheren Klage hinzugefügt hat. Das Verfahren wurde nach den Regelungen für „federal multidistrict litigation“ mit einem Verfahren von MOSAID gegen Samsung Electronics Co. Ltd. („Samsung“) vor dem US-Bezirksgericht für New Jersey zusammengelegt. Am 1. April 2005 hat das US-Bezirksgericht im summarischen Verfahren entschieden, dass Infineons Produkte die meisten der von MOSAID geltend gemachten Patentansprüche nicht verletzen, und lediglich die Entscheidung über zwei Patentansprüche aus einem Patent zur Entscheidung im Hauptverfahren offen gelassen. Ein Verhandlungstermin für diese Ansprüche ist noch nicht festgelegt worden. Am 6. April 2005 hat MOSAID eine weitere Klage beim US-Bezirksgericht für den Eastern District of Texas eingereicht und behauptet, die DRAM-Produkte der Gesellschaft verletzen einen oder mehrere Patentansprüche aus drei MOSAID-Patenten. Eine Gerichtsverhandlung über diese Ansprüche ist für Oktober 2006 eingeplant. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich energisch gegen die von MOSAID geltend gemachten Ansprüche zu verteidigen.

Am 5. März 2005 erhob Tessera Technologies, Inc. („Tessera“), Klage vor dem US-Bezirksgericht für den Eastern District von Texas mit der Behauptung, dass Produkte der Gesellschaft mit „Ball Grid Array Packages“ fünf Tessera-Patente verletzen. Am 13. April 2005 hat Tessera die Klage ergänzt und behauptet, Infineon und Micron hätten gegen US-Antitrust-Recht sowie gegen Wettbewerbsgesetze des Staates Texas verstoßen dadurch, dass sie sich verschworen hätten, den Verkauf von RDRAM zu behindern, und damit Tesseras Möglichkeiten, Gehäuse für RDRAM Chips zu vertreiben, behindert hätten. Eine Gerichtsverhandlung über diese Ansprüche ist für August 2006 terminiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich energisch gegen die von Tessera geltend gemachten Ansprüche zu verteidigen.

Rückstellungen für Rechtsverfahren werden dann gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung entstanden ist und der entsprechende Betrag annähernd abgeschätzt werden kann. Wo der abgeschätzte Betrag der Verbindlichkeiten innerhalb einer Bandbreite liegt und kein Betrag innerhalb der Bandbreite besser ist als ein anderer abgeschätzter Betrag oder die Bandbreite nicht abgeschätzt werden kann, wird der Mindestbetrag zurückgestellt. Die Gesellschaft hat am 30. September 2005 Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von €144 für die Kartellverfahren und die damit verbundenen kartell- und kapitalmarktrechtlichen zivilen Rechtsansprüche und -klagen bilanziert. Sowie weitere Informationen verfügbar werden, wird eine mögliche Verpflichtung erneut überprüft, und wenn notwendig, werden die Abschätzungen entsprechend angepasst. Bei künftigen neuen Entwicklungen in jeder Angelegenheit oder veränderten Umständen wird die Rückstellung angepasst, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Eine endgültige negative Entscheidung der Kartellverfahren, der damit verbundenen Zivilklagen oder Wertpapiersammelklagen – Klagen wie vorher beschrieben – könnte erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Gesellschaft begründen und andere negative Auswirkungen haben, was wiederum einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf das Geschäft und die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft haben kann. Unabhängig von der Richtigkeit der Vorwürfe und dem Erfolg der genannten Klagen können der Gesellschaft erhebliche Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung gegen die Vorwürfe oder mit deren gütlichen Erledigung entstehen, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben kann.

Eine endgültige negative Entscheidung in den MOSAID- oder Tessera-Klagen könnte zu erheblichen finanziellen Verpflichtungen führen und weitere negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, insbesondere einen erheblichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Gegen die Gesellschaft laufen verschiedene andere Rechtsstreite und Verfahren im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit. Diese betreffen Produkte, Leistungen, Patente und andere Sachverhalte. Die Gesellschaft hat Rückstellungen für erwartete Gerichtskosten verschiedener anhängiger und potenzieller Verfahren zum Bilanzstichtag gebildet. Das Management der Gesellschaft ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Auffassung, dass aus dem Ausgang der übrigen anhängigen Verfahren kein wesentlicher negativer Einfluss auf die Vermögenslage zu erwarten ist. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der Zukunft liegenden Verfahrensabschlüsse die Finanz- und Ertragslage im Jahr des Eingangs wesentlich negativ beeinflussen können.

Im Rahmen der Gründung der Gesellschaft verblieben bei Siemens bestimmte Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie die damit zusammenhängenden Umweltlasten. Die von Siemens bei der Gründung der Gesellschaft eingebrachten Geschäfte haben in der Vergangenheit einige dieser

Betriebsstätten genutzt. Auf Grund der US-amerikanischen Rechtsprechung könnte die Gesellschaft für die Beseitigung von Umweltlasten in Anspruch genommen werden, obwohl diese Betriebsstätten bei Siemens verblieben sind. Siemens hat gegenüber bestimmten Dritten sowie Behörden Garantien abgegeben. Alle beteiligten Parteien sehen die Verantwortung für die betreffenden Standorte bei Siemens. Bislang wurden keine Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht. Die Höhe eventueller Ansprüche aus der Beseitigung von Altlasten, sofern solche bestehen, wurde nicht ermittelt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass ihr Risiko zur Entsorgung der Altlasten der bei Siemens verbliebenen Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten von Amerika gering ist.

### Vertragliche Verpflichtungen

Die Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2005 sind wie folgt<sup>1, 2</sup>:

Zahlungen fällig in	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1–2 Jahren	2–3 Jahren	3–4 Jahren	4–5 Jahren	5 Jahren und länger
<b>Vertragliche Verpflichtungen:</b>							
Zahlungen aus Leasingverträgen	850	94	71	61	56	54	514
Unbedingte Abnahmeverpflichtungen	1.505	1.379	45	24	9	9	39
Andere langfristige Verpflichtungen	138	46	46	46	–	–	–
<b>Summe vertraglicher Verpflichtungen</b>	<b>2.493</b>	<b>1.519</b>	<b>162</b>	<b>131</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>553</b>

1 Oben stehende Tabelle enthält gewisse Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen, und solche, deren wahrscheinliche Fälligkeiten im jeweiligen Fall vom Management geschätzt wurden. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

2 Produktabnahmeverpflichtungen, die mit Kapazitätsvereinbarungen gekoppelt sind, werden in dieser Tabelle nicht dargestellt, da die Kaufpreise zum Teil auf zukünftigen Marktpreisen basieren und deshalb zum 30. September 2005 nicht quantifizierbar sind. Die Bezüge aus solchen Vereinbarungen betragen zirka €950 im Geschäftsjahr 2005.

Im Dezember 2002 haben die Gesellschaft und Semiconductor Manufacturing Industrial Corporation („SMIC“) eine Technologieübertragungs- und Kapazitätsreservierungs-Vereinbarung getroffen. Im Austausch für die Technologieübertragung wird SMIC für einen Zeitraum von fünf Jahren spezifische Produktionskapazitäten bereitstellen. Die Preise basieren auf einer Marktpreisformel. In 2004 ergänzten die Parteien die Vereinbarung, um eine neue Technologiegeneration einzubringen.

Am 28. Juli 2003 vereinbarten die Gesellschaft und China-Singapore Suzhou Industrial Park Venture Company („CSVC“) die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Bau einer Back-End-Fertigungsstätte in China. Das vom CSVC investierte Kapital wird verzinst und hat im Falle einer Gesellschaftsauflösung einen bestimmten Rangvortritt. Alle aufgelaufenen Ergebnisse und Dividenden stehen der Gesellschaft zu. Diese Gesellschaft wird deshalb von Beginn an vollkonsolidiert.

Die Gesellschaft ist mit verschiedenen verbundenen Unternehmen und externen Auftragsfertigern Vereinbarungen eingegangen, die der Gesellschaft Kapazitäten zur Produktion und zum Testen von Halbleiterprodukten garantieren. Diese verlängerbaren Vereinbarungen besitzen grundsätzlich eine Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr. Die Gesellschaft hat darin vereinbart, einen Teil der Produktion der Vertragspartner auf Marktpreisen basierend zu kaufen.

Bezüge aus diesen Vereinbarungen werden entsprechend dem üblichen Geschäftsverlauf als Aufwendungen erfasst. Um der Nachfrage seitens ihrer Kunden nach ihren Produkten entsprechen zu können, überprüft die Gesellschaft regelmäßig den voraussichtlichen Einkaufsbedarf. Die Einkaufsverträge werden regelmäßig auf drohende Verluste überprüft, die eintreten können, falls die voraussichtlichen Bedarfsmengen unter die Bestellmengen bzw. die Marktpreise unter die Vertragspreise fallen.

## Eventualverpflichtungen

Die folgende Tabelle zeigt die Eventualverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten zum 30. September 2005, ohne mögliche Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten<sup>1</sup>:

Ende der Verpflichtungsdauer in	Gesamt	weniger als 1 Jahr	1-2 Jahren	2-3 Jahren	3-4 Jahren	4-5 Jahren	5 Jahren und länger
<b>Maximale potenzielle künftige Zahlungen:</b>							
Garantien	462	99	204	23	5	–	131
Bedingte Zuschüsse und Zulagen <sup>2</sup>	516	67	101	128	42	55	123
<b>Summe Eventualverpflichtungen</b>	<b>978</b>	<b>166</b>	<b>305</b>	<b>151</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>254</b>

1 Oben stehende Tabelle enthält gewisse Zahlungsverpflichtungen oder Fälligkeiten von Verpflichtungen, die von dem Erreichen von Leistungszielen oder anderen Ereignissen, die nicht zeitlich fixiert sind, abhängen. Die wahrscheinliche Fälligkeit wurde von der Gesellschaft abgeschätzt. Die tatsächlichen Fälligkeiten können von diesen Schätzungen abweichen.

2 Bedingte Zuschüsse und Zulagen beziehen sich auf bisher erhaltene Beträge, die in Zusammenhang mit der Errichtung und Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten stehen und gegebenenfalls zurückerstattet werden müssen, falls die genannten behördlichen Projektanforderungen nicht erfüllt werden.

Die Gesellschaft hat zum 30. September 2005 gegenüber Dritten ausgereichte Garantien in Höhe von €462. Weiterhin hat die Gesellschaft als Mutterunternehmen, wie allgemein üblich, in bestimmten Fällen Garantien für bestimmte Verpflichtungen ihrer konsolidierten Tochterunternehmen gegenüber Dritten übernommen. Diese Verpflichtungen sind in den konsolidierten Finanzdaten durch die Konsolidierung bereits enthalten. Zum 30. September 2005 betragen solche Intercompany-Garantien von konsolidierten Tochterunternehmen gegenüber Dritten in Verbindung mit Finanzverbindlichkeiten €1.604, wovon €1.340 die Wandelschuldverschreibungen betreffen.

Die Gesellschaft hat Zuschüsse und Zulagen für den Bau und die Finanzierung von bestimmten Fertigungsstätten erhalten. Diese Beträge werden bei Erreichen definierter Kriterien erfolgswirksam vereinnahmt. Die Gesellschaft hat bestimmte Zuwendungen erhalten unter der Voraussetzung, dass bestimmte projektbezogene Kriterien innerhalb einer bestimmten Periode nach Erhalt der Zuwendung erfüllt werden. Die Gesellschaft ist verpflichtet, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollten jedoch diese Bedingungen nicht erfüllt werden, können €516 der zum Stichtag 30. September 2005 ausgewiesenen Zuwendungen zurückgefordert werden.

Am 23. Dezember 2003 hat die Gesellschaft einen langfristigen Leasingvertrag mit der MoTo Objekt Campeon GmbH & Co. KG („MoTo“) abgeschlossen. Dieser beinhaltet eine Leasingvereinbarung über einen Bürokomplex im Süden Münchens, der von MoTo errichtet wurde. Dieser Bürokomplex, genannt Campeon, ermöglicht der Gesellschaft, die Mehrheit der momentan in München über mehrere Standorte verteilten Mitarbeiter in einer zentralen Arbeitsumgebung zusammenzuführen. MoTo ist für den Bau, der im zweiten Halbjahr 2005 fertig gestellt wurde, verantwortlich. Die Gesellschaft hat keine Finan-

zierungsverpflichtung für MoTo und keine Garantien im Zusammenhang mit der Errichtung übernommen. Im Oktober 2005 hat die Gesellschaft Campeon im Rahmen einer operativen Leasingvereinbarung übernommen, und es wurde mit dem stufenweisen Umzug der Mitarbeiter zum neuen Standort begonnen. Der Bürokomplex wurde für 20 Jahre von der Gesellschaft gemietet. Nach 15 Jahren hat die Gesellschaft das Recht, den Bürokomplex (non-bargain purchase option) zu kaufen oder für die restlichen fünf Jahre weiterhin zu mieten. Gemäß der Leasingvereinbarung leistete die Gesellschaft eine Mietkaution in Höhe von €75 auf ein Treuhandkonto, die zum 30. September 2005 unter als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel enthalten war und vom Leasinggeber nicht vor Einzug verwendet werden konnte. Die Leasingzahlungen unterliegen limitierten Anpassungen, basierend auf festgelegten Finanzkennzahlen der Gesellschaft. Die Leasingvereinbarung wird in der Rechnungslegung als operatives Leasing gemäß SFAS Nr. 13 mit einer linearen monatlichen Aufwandsbelastung in Höhe der Leasingraten über den Leasingzeitraum ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit ihrer regelmäßigen Geschäftstätigkeit kann die Gesellschaft bei bestimmten Umsätzen und anderen Verträgen verpflichtet sein, ihre Vertragspartner unter bestimmten Konditionen vom Schadenersatz bei Gewährleistungsfällen, Patentverletzungen und anderen Vorfällen freizustellen. Der Höchstbetrag von eventuellen zukünftigen Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen kann nicht zuverlässig abgeschätzt werden, da die eventuelle Verpflichtung von Vorwissen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht bestimmbar ist, und von bestimmten vertragspezifischen Fakten und Umständen abhängig ist. Historisch gesehen, hatten Zahlungen für diese Art von Vereinbarungen keinen materiellen Effekt auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung der Gewährleistungsrückstellungen im Geschäftsjahr 2005:

	2005
<b>Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 1. Oktober 2004</b>	<b>68</b>
Zurückgestellt während des Jahres, netto	33
Beigelegt während des Jahres	-51
<b>Stand Gewährleistungsrückstellungen zum 30. September 2005</b>	<b>50</b>

### 32 SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Gesellschaft berichtet über ihre Segmente und nach Regionen gemäß den Regelungen des SFAS Nr. 131, „Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information“.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2005 hat die Gesellschaft ihre Organisationsstruktur vereinfacht und schafft damit im gesamten Unternehmen kürzere und schnellere Entscheidungswege, eine stärkere Ausrichtung auf ihre Kunden und eine höhere Effizienz und Flexibilität. Der Geschäftsbereich Mobile und das Segment Drahtgebundene Kommunikation wurden in dem neuen Segment Kommunikation gebündelt, um die Struktur der Gesellschaft entsprechend der Entwicklung im Markt anzupassen. Gleichzeitig wurden das Sicherheits- und Chipkarten-Geschäft und das ASIC & Design-Solutions-Geschäft in das erweiterte Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket eingegliedert. Dementsprechend wurden die Bilanzen und die Gewinn- und Verlust-Rechnungen der Segmente der Vorjahre dieser Umgliederung angepasst, um die Analyse gegenwärtiger und künftiger Finanzdaten zu unterstützen.

Als Ergebnis ist die Gesellschaft nun schwerpunktmäßig in drei operativen Segmenten tätig. Zwei von ihnen sind anwendungsorientiert: Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket und Kommunikation. Das Segment Speicherprodukte ist produktorientiert. Ferner entsprechen einige der verbleibenden Aktivitäten aus verkauften Geschäften, für die keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen nach dem Verkaufstermin bestehen, und neue Geschäftsaktivitäten der Definition gemäß SFAS Nr. 131 für ein Segment, aber nicht den Berichterstattungskriterien gemäß SFAS Nr. 131. Deshalb wurden für Berichterstattungs-zwecke diese Bereiche unter „Sonstige Geschäftsbereiche“ zusammengefasst.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für die Segmente entsprechen grundsätzlich den bereits erläuterten allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen der Gesellschaft (siehe Anhang Nr. 2). Jedes dieser Segmente wird von einem Bereichsleiter geführt, der direkt dem Chief Executive Officer und dem Finanzvorstand berichtet. Diese als Chief Operating Decision Maker („CODM“) Bezeichneten tragen gemeinsam die Entscheidungsverantwortung für das laufende Geschäft. Sie entscheiden gemeinsam über die Ressourcenzuteilung auf die Segmente und beurteilen deren Erfolg anhand der Kennzahlen Umsatzerlöse und Ebit. Die CODM rechnen weder die Vermögensgegenstände den Segmenten zu, noch bewerten sie regelmäßig die Segmente auf Basis dieser Kriterien, mit Ausnahme von bestimmten Vorratsinformationen, die den CODM regelmäßig auf Segmentbasis berichtet werden. Die Gesellschaft ordnet den einzelnen Segmenten die Abschreibungen nach Maßgabe des Produktionsvolumens und der erzeugten Produkte auf Basis von Standardkosten zu.

#### Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket

Das Segment Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte und Systemlösungen für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrieelektronik und im Multimarket-Bereich.

#### Kommunikation

Das Segment Kommunikation entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt eine große Bandbreite von ICs, anderen Halbleiterprodukten sowie kompletten Systemlösungen für drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsanwendungen.

#### Speicherprodukte

Das Segment Speicherprodukte entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterspeicherprodukte in verschiedenen Konfigurationen und Gehäusen bzw. Architekturen sowie mit verschiedenen Leistungsparametern für den Einsatz in standardisierten, speziellen und eingebetteten Speicheranwendungen.

#### Sonstige Geschäftsbereiche

Bestimmte verbleibende Aktivitäten von veräußerten Geschäften und andere sonstige Geschäftsaktivitäten sind in „Sonstige Geschäftsbereiche“ enthalten.

Die folgende Darstellung zeigt ausgewählte Segmentdaten für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005:

	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	2.186	2.540	2.516
Kommunikation	1.428	1.689	1.391
Speicherprodukte	2.485	2.926	2.826
Sonstige Geschäftsbereiche	21	11	12
Konzernfunktionen	32	29	14
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>6.152</b>	<b>7.195</b>	<b>6.759</b>

	2003	2004	2005
<b>Ebit:</b>			
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	148	252	134
Kommunikation	-213	-44	-295
Speicherprodukte	31	169	122
Sonstige Geschäftsbereiche	-50	-75	-4
Konzernfunktionen	-215	-46	-140
<b>Summe Ebit</b>	<b>-299</b>	<b>256</b>	<b>-183</b>

	2003	2004	2005
<b>Abschreibungen:</b>			
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	356	398	400
Kommunikation	305	232	185
Speicherprodukte	768	683	724
Sonstige Geschäftsbereiche	8	7	7
Konzernfunktionen	-	-	-
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.437</b>	<b>1.320</b>	<b>1.316</b>

	2003	2004	2005
<b>Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften:</b>			
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	-	-	-
Kommunikation	4	5	4
Speicherprodukte	22	-16	54
Sonstige Geschäftsbereiche	-1	-4	-2
Konzernfunktionen	-7	1	1
<b>Summe Anteiliges Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Gesellschaften</b>	<b>18</b>	<b>-14</b>	<b>57</b>

	2003	2004	2005
<b>Vorräte:</b>			
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	332	359	336
Kommunikation	209	266	201
Speicherprodukte	415	334	484
Sonstige Geschäftsbereiche	3	1	1
Konzernfunktionen	-	-	-
<b>Summe Vorräte</b>	<b>959</b>	<b>960</b>	<b>1.022</b>

Zum 30. September 2005 verteilte sich der Geschäfts- und Firmenwert wie folgt auf die einzelnen Segmente:

	2004	2005
<b>Geschäfts- und Firmenwert:</b>		
Automobil-, Industrie-elektronik und Multimarket	13	-
Kommunikation	51	27
Speicherprodukte	81	88
Sonstige Geschäftsbereiche	6	8
Konzernfunktionen	-	2
<b>Summe Geschäfts- und Firmenwert</b>	<b>151</b>	<b>125</b>

Zwischen den Segmenten werden auf Grund ihrer organisatorischen Struktur keine Umsätze getätigt. Dementsprechend resultieren die Umsatzerlöse der Segmente aus Umsätzen mit Dritten.

Zum 30. September 2003 und 2004 standen die Vorprodukte und unfertigen Erzeugnisse bestimmter gemeinsamer Logik-Front-End-Fabriken sowie die unfertigen Erzeugnisse der gemeinsamen Back-End-Fabriken nicht unter der direkten Kontrolle und Verantwortung der zuständigen Bereichsleiter, sondern unter der des Standortmanagements, das für die Umsetzung des Produktionsplans nach Mengen und Einheiten verantwortlich war. Deshalb wurden diese Vorräte in der Zeile „Konzernfunktionen“ ausgewiesen und nicht unter den einzelnen Segmenten. Lediglich die Vorprodukte der Back-End-Fabriken (Chipbestände) und die Fertigprodukte waren den Segmenten zugeordnet und in den Segmentinformationen, die an die verantwortlichen CODM berichtet werden, enthalten. Zum 30. September 2005 sind alle Vorräte den entsprechenden operativen Segmenten zugeordnet, soweit sie unter die direkte Kontrolle und die Verantwortlichkeit der ständigen Bereichsleiter fallen. Vorperioden wurden entsprechend angepasst, um der aktuellen Darstellung zu entsprechen.

Bestimmte Posten sind in den Konzernfunktionen enthalten und werden nicht auf die Segmente umgelegt; dies geschieht analog der internen Berichterstattung an das Management. Das gilt für bestimmte Kosten der Konzernzentrale, bestimmte Inkubatorkosten und Aufwendungen für Grundlagenforschung, für Einmalgewinne und spezielle strategische Technologieinitiativen. Restrukturierungsaufwendungen werden unter den Konzernfunktionen berücksichtigt und sind nicht in der internen oder externen Segmentberichterstattung aufgeführt, da sie zentral entschieden werden und nicht der direkten Kontrolle des Segmentmanagements obliegen. Rechtskosten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Produktangelegenheiten werden bei den Segmenten zum Zeitpunkt der Ausgabewirksamkeit gezeigt. Dieser kann sich vom Zeitpunkt der Aufwands erfassung im Bereich Konzernfunktionen unterscheiden. Die Gesellschaft ordnet Leerkosten auf Basis eines Auftragsfertigermodells zu, wobei die Vorlaufzeit der Auftragsstornierung oder -änderung bei der Leerkostenzuordnung berücksichtigt wird. Alle nicht verrechneten Leerkosten werden in den Konzernfunktionen gezeigt. Wesentliche Positionen im Ebit in den Konzernfunktionen für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 sind:

	2003	2004	2005
<b>Konzernfunktionen:</b>			
Nicht verrechnete Leerkosten	-101	-34	-12
Restrukturierungsaufwendungen	-29	-17	-78
Zentrale IT-Entwicklungskosten	-13	-	-
Andere	-72	5	-50
<b>Summe Konzernfunktionen</b>	<b>-215</b>	<b>-46</b>	<b>-140</b>

Die Umsatzerlöse und Sachanlagen nach Regionen für die Geschäftsjahre 2003, 2004 und 2005 stellen sich wie folgt dar:

	2003	2004	2005
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Deutschland	1.535	1.675	1.354
Übriges Europa	1.112	1.263	1.210
Nordamerika	1.393	1.524	1.504
Asien-Pazifik	1.821	2.263	2.223
Japan	256	364	332
Andere	35	106	136
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>6.152</b>	<b>7.195</b>	<b>6.759</b>

	2003	2004	2005
<b>Sachanlagen:</b>			
Deutschland	2.152	1.962	1.625
Übriges Europa	652	514	516
Nordamerika	641	619	1.093
Asien-Pazifik	369	490	515
Japan	1	1	2
Andere	2	1	-
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.817</b>	<b>3.587</b>	<b>3.751</b>

Der Ausweis des Umsatzes mit Dritten richtet sich nach dem Sitz des Rechnungsempfängers. Die Anzahl der Beschäftigten wird im Anhang Nr. 7 nach Regionen dargestellt.

Mit Ausnahme von Verkäufen an Siemens, die in Anhang Nr. 27 erläutert sind, entfielen in den Geschäftsjahren 2003, 2004 und 2005 auf keinen Einzelkunden mehr als 10 Prozent der Gesamtumsatzerlöse. Die Umsatzerlöse mit Siemens resultieren insbesondere aus den Nicht-Speicher-Segmenten.

Ebit ist definiert als das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Das Management der Gesellschaft nutzt das Ebit als Kennzahl für Budget- und operative Zielvorgaben, um seine Geschäfte zu führen und den Geschäftserfolg zu beurteilen. Die Gesellschaft berichtet Ebit-Daten, um Investoren nützliche Informationen über den operativen Geschäftserfolg der Gesellschaft und im Speziellen über die einzelnen operativen Segmente zur Verfügung zu stellen.

Das Ebit wird ohne Anpassung der US-GAAP-Werte wie folgt aus den Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen hergeleitet:

Geschäftsjahr zum 30. September	2003	2004	2005
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	-435	61	-312
Bereinigt um: Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84	154	120
Zinsergebnis	52	41	9
<b>Ebit</b>	<b>-299</b>	<b>256</b>	<b>-183</b>

### **33 WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG**

Im November 2005 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft dem Vorhaben zugestimmt, Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Segments Speicherprodukte an eine eigenständige und vollständig von Infineon gehaltene Tochtergesellschaft zu übertragen (gemäß deutschem Recht ist diese Übertragung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, oder Teilbetrieb, als Ausgliederung bekannt).

### **ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN**

#### **Ergänzende Erläuterungen für den nach US-GAAP aufgestellten Anhang zum Konzernabschluss entsprechend den Anforderungen gemäß der Übergangsregelung auf Grund des Bilanzrechtsreformgesetzes in Art. 58 Abs. 3 EGHGB**

Die Gesellschaft hat für das zum 30. September 2005 beendete Geschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht in Übereinstimmung mit dem deutschen Handelsgesetzbuch aufgestellt. Sie hat sich dabei gemäß den handelsrechtlichen Regelungen dafür entschieden, über den Konzernabschluss auf der Grundlage der international anerkannten US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze (US-GAAP) zu berichten. Die Berichterstattung nach dem deutschen Handelsrecht umfasst neben dem Konzernabschluss nach US-GAAP zusätzliche Angaben sowie den Konzernlagebericht.

#### **Wesentliche Unterschiede zwischen deutscher und US-Rechnungslegung**

##### **Vorbemerkung**

Die Gesellschaft muss als deutsches Mutterunternehmen grundsätzlich einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufstellen. Die Übergangsregelung auf Grund des Bilanzrechtsreformgesetzes in Art. 58 Abs. 3 EGHGB befreit jedoch von dieser Pflicht, wenn der Konzernabschluss nach international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellt und offen gelegt wird (wie zum Beispiel US-GAAP). Die Gesellschaft stellt den Konzernabschluss nach US-GAAP auf. Im Folgenden werden wesentliche, von den deutschen Rechnungslegungsvorschriften abweichende Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden erläutert. Weiterhin sind Gesellschaften mit einer Börsennotierung in den USA verpflichtet, den Bilanzierungs- und Berichterstattungsanforderungen der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) zu entsprechen.

#### **Grundsätzliche Unterschiede**

Die Rechnungslegung nach US-GAAP unterscheidet sich von der nach dem deutschen HGB hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Während US-GAAP den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von entscheidungs-relevanten Informationen für die Investoren legt, ist die HGB-Rechnungslegung von einer stärkeren Betonung des Gläubigerschutzes und Vorsichtsprinzips geprägt.

#### **Gliederungsvorschriften**

Die Bilanzgliederung nach US-GAAP orientiert sich an der geplanten Liquidation der Vermögensgegenstände und der Fristigkeit der Schulden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Die Bilanzgliederung für deutsche handelsrechtliche Zwecke ist für Kapitalgesellschaften grundsätzlich in § 266 HGB definiert. Die Gliederung orientiert sich hier an der geplanten Verweildauer von Vermögensgegenständen bzw. Finanzierungsquellen wie Schulden und Eigenkapital im Unternehmen.

#### **Umsatzrealisierung**

Die Umsatzrealisierung erfolgt laut HGB und US-GAAP grundsätzlich nach gleichen Grundsätzen, sofern die Leistung erbracht und die Einzahlung erfolgt ist. Unterschiede können bezüglich des Zeitpunkts der Vereinnahmung auftreten, wenn die leistende Gesellschaft weitere finanzielle, operative oder leistungsbezogene Verpflichtungen gegenüber der leistungsempfangenden Gesellschaft übernommen hat oder die vereinbarten Beträge nicht hinreichend objektivierbar sind.

#### **Marktgängige Wertpapiere**

Marktgängige Wertpapiere, die Anteils- oder Gläubigerrechte verbrieft, sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten.

Die von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapiere sind nach US-GAAP als Available-for-Sale-Securities zu klassifizieren und zum Marktwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Wertsteigerungen oder Wertminderungen dieser Wertpapiere werden nach Berücksichtigung latenter Steuern ergebnisneutral im Eigenkapital unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst.

### Vorräte

Die Vorräte sind nach HGB ebenso wie nach US-GAAP mit den Herstellungskosten zu bewerten.

Die Herstellungskosten nach US-GAAP werden als produktionsbezogene Vollkosten definiert, bei denen neben den Material- und Lohneinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung die Material- und Fertigungsgemeinkosten einzubeziehen sind. Zudem sind Verwaltungskosten zu berücksichtigen, sofern sie in eindeutigem Zusammenhang mit der Erzeugung der zu bewertenden Produkte stehen. Nach HGB brauchen von den oben genannten Kosten Teile der indirekten Kosten wie z. B. Verwaltungskosten nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einbezogen zu werden.

### Geschäfts- und Firmenwert

Unter US-GAAP ist gemäß SFAS Nr. 141 in Verbindung mit SFAS Nr. 142 der Geschäfts- und Firmenwert bei Kapitalkonsolidierungen unter Anwendung der Erwerbsmethode nach dem 30. Juni 2001 nicht mehr länger abzuschreiben, sondern jährlich auf Werthaltigkeit zu überprüfen. Unter HGB ist der Geschäfts- und Firmenwert in jedem folgenden Geschäftsjahr mindestens zu einem Viertel abzuschreiben oder kann über den Zeitraum der zu erwartenden Lebensdauer abgeschrieben werden.

### Nicht abgeschlossene Entwicklungen geistiger Eigentumsrechte bei Beteiligungserwerben

Aufwendungen, die bei erworbenen Unternehmen für nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Geschäfts- und Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

### Derivative Finanzinstrumente

Nach HGB werden derivative Finanzinstrumente grundsätzlich nicht bilanziert. Dies bedeutet, dass Wertsteigerungen nicht zu berücksichtigen sind. Für Wertminderungen, die nicht realisierte Verluste darstellen, sind dagegen Rückstellungen zu bilden. Nach US-GAAP sind derivative Finanzinstrumente in der Bilanz mit ihrem Marktwert anzusetzen. Die Marktwertänderungen werden in der Gewinn- und Verlust-Rechnung oder unter „Änderungen im Eigenkapital, die nicht aus Transaktionen mit Aktionären resultieren“ erfasst. Dies ist einerseits abhängig davon, ob die derivativen Finanzinstrumente Bestandteil eines Sicherungsgeschäfts sind, und andererseits von der Art des Sicherungsgeschäfts.

### Latente Steuern

Der wesentliche Unterschied in der Bilanzierung latenter Steuern zwischen HGB und US-GAAP besteht darin, dass bislang nach den Vorschriften des HGB keine latenten Steuern auf Verluste aktiviert werden. Nach US-GAAP sind latente Steuern auf Verluste (inklusive Verlustvorträgen) zu berücksichtigen. Auf aktive latente Steuern, deren Realisierung eher unwahrscheinlich ist, sind Wertberichtigungen vorzunehmen.

### Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Nach US-GAAP sind Pensionsrückstellungen unter Berücksichtigung der für die Zukunft zu erwartenden Entgeltentwicklungen nach dem Anwartschaftsbarwert-Verfahren zu bewerten. Diese Methode ist auch nach dem HGB zulässig.

Weiterhin kommen gegebenenfalls unterschiedliche Zinssätze für die Barwertberechnung der Rückstellung zum Ansatz.

Auf Grund der Übertragung der treuhänderischen Verwaltung von Pensionsfondsanteilen an einen Pensions-Trust-Verein wurden nach US-GAAP die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen nicht mehr bei der Gesellschaft bilanziert. Nach HGB sind die Pensionsfondsanteile und die Pensionsrückstellungen trotz der Übertragung auf den Pensions-Trust-Verein weiterhin bei der Gesellschaft zu bilanzieren.

### Aktienoptionsprogramm

Für die gewährten Aktienoptionen werden nach HGB Rückstellungen gebildet, sofern der Marktwert zum Bilanzstichtag über dem Ausübungspreis für die Optionsrechte liegt.

Nach US-GAAP bilanziert die Gesellschaft die gewährten Aktienoptionen nach der Innere-Wert-Methode entsprechend APB Opinion 25, die nicht zu einer Aufwandserfassung führt, wenn der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Ausgabe der Option nicht deren Ausübungspreis übersteigt. Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2006 werden Aufwendungen für Aktienoptionen nach SFAS 123 (revised 2004) in der Konzern-Gewinn- und Verlust-Rechnung ausgewiesen.

### Kosten für Kapitalerhöhungen

Nach HGB wurden direkten Aufwendungen im direkten Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung als Aufwendungen erfasst. Nach US-GAAP wurden diese Aufwendungen mit der Kapitalrücklage verrechnet.



### Rückstellungen

Nach deutschen handelsrechtlichen Vorschriften dürfen Aufwandsrückstellungen in bestimmten Fällen auch ohne Verpflichtung gegenüber Dritten gebildet werden. Nach US-GAAP sind Rückstellungen nur bei gegenüber Dritten bestehenden Verpflichtungen und darüber hinaus nur für eng eingegrenzte Tatbestände zu bilden.

### Fremdwährungsumrechnung

Nach HGB werden Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorfalles beziehungsweise jeweils zum ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag bewertet, wobei hieraus resultierende nicht realisierte Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Nach US-GAAP erfolgt die Bewertung der Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten zum Fremdwährungskurs des Bilanzstichtags, wobei die daraus ermittelten nicht realisierten Gewinne und Verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Die Gesellschaft hat zum 30. September 2004 und 2005 die Fremdwährungsumrechnung für kurzfristige Positionen auch nach HGB auf die Stichtagsbewertung umgestellt.

### Zuschüsse und Zulagen

Nach HGB dürfen Investitionszulagen und Zinszuschüsse im Geschäftsjahr des Zuflusses erfolgswirksam vereinnahmt werden. Nach US-GAAP wurden diese Zuwendungen abgegrenzt und über den Zeitraum der Verrechnung der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen erfolgswirksam vereinnahmt.

### Abschreibungen auf Sachanlagevermögen

Nach US-GAAP richten sich die Abschreibungen auf Sachanlagevermögen konzernweit nach der angenommenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer. Unter HGB bilanziert die Gesellschaft Abschreibungen auf Sachanlagevermögen überwiegend auf Basis der steuerlich vorgeschriebenen Abschreibungstabellen.

### Anteiliges Jahresergebnis von nach der Equity-Methode konsolidierten Gesellschaften

Nach HGB dürfen die anteiligen Ergebnisse der assoziierten Unternehmen, basierend auf den nach den jeweiligen landesrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Ergebnissen, vereinnahmt werden. Unter US-GAAP werden die nach US-GAAP ermittelten Ergebnisse der assoziierten Unternehmen anteilig vereinnahmt.

### Erträge aus der Realisierung von Wertsteigerungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen

Nach HGB dürfen Wertsteigerungen des anteiligen Eigenkapitals durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen erfolgswirksam erfasst werden. Nach US-GAAP und den SEC-Rechnungslegungsvorschriften hängt eine solche erfolgswirksame Vereinnahmung von der Erfüllung weiterer Kriterien neben der Durchführung der Kapitalerhöhung ab. Sofern diese Kriterien nicht erfüllt sind, ist die Werterhöhung des anteiligen Eigenkapitals erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen.

### Ergebnisanteile konzernfremder Gesellschafter

Die Berücksichtigung der Anteile konzernfremder Gesellschafter bei der Erstkonsolidierung als auch bei Verteilung der ihnen zugerechneten Ergebnisanteile einer Gesellschaft richtet sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, in der Regel nach den zivilrechtlichen Anteilsverhältnissen. US-GAAP folgt bei der Konsolidierung des Minderheitenanteils den wirtschaftlichen Verhältnissen des Joint Venture, und es kann daher zu Abweichungen hinsichtlich des Ausweises der Minderheitenanteile oder Ergebnisanteile kommen.

### Anwendung von Befreiungsvorschriften

Nach § 264a HGB haben offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen keiner der Gesellschafter eine natürliche Person oder eine offene Handelsgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft oder andere Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem Gesellschafter ist, einen Jahresabschluss nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gesellschaft hat die in § 264b HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

- COMNEON GmbH & Co. OHG, Nürnberg,
- Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden,
- Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG, Dresden (ehemals Ingentix GmbH & Co. KG),
- Infineon Technologies Immobilien Regensburg GmbH & Co. KG, Regensburg,
- Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG, Dresden, in Anspruch genommen, da diese Gesellschaften in den Konzernabschluss einbezogen sind.

Die Gesellschaft hat die in § 264 Abs. 3 HGB in diesem Zusammenhang eingeräumte Befreiungsmöglichkeit von der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen für Kapitalgesellschaften für die

--- Infineon Technologies Finance GmbH, München, in Anspruch genommen, da zwischen dem zuvor genannten Unternehmen und der Gesellschaft ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

#### Angabe gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die Wachovia Trust Company National Association, Wilmington, DE 19801, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 1. Dezember 2004 mitgeteilt, dass sie am 29. November 2004 die Schwellen von 10 Prozent und 5 Prozent der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG unterschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage nunmehr 0,00 Prozent. Dies entspreche Stück 0 Aktien, die eine gleiche Anzahl an Stimmrechten vermittelten.

Die Siemens AG, Berlin und München, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 29. November 2004 mitgeteilt, dass sie am 29. November 2004 die Schwellen von 5 Prozent und 10 Prozent der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage nunmehr 18,23 Prozent. Dies entspreche Stück 136.292.363 Aktien, die eine gleiche Anzahl an Stimmrechten vermittelten.

Die Capital Group International Inc., Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 mitgeteilt, dass sie am 25. September 2003 die Schwelle von 5 Prozent der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage 5,068 Prozent (entspreche 36.534.489 Stammaktien). Diese Stimmrechte würden ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 WpHG zugerechnet.

Die Capital Group Companies, Inc., Los Angeles, USA, hat der Gesellschaft mit Schreiben vom 2. Oktober 2003 mitgeteilt, dass sie am 25. September 2003 die Schwelle von 5 Prozent der Stimmrechte an der Infineon Technologies AG überschritten habe. Ihr Stimmrechtsanteil betrage 5,068 Prozent (entspricht 36.534.489 Stammaktien). Alle diese Stimmrechte würden ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 WpHG zugerechnet.

#### Angabe gemäß § 161 AktG

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechungserklärung wurde am 23. November 2004 abgegeben und den Aktionären im Internet dauerhaft zugänglich gemacht.

#### Aufwendungen für die Abschlussprüfung

Im Geschäftsjahr 2005 sind für weltweite Prüfungsleistungen des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, KPMG, Aufwendungen in Höhe von €3 angefallen.

#### VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Bezüge des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2005 €0,6 (bestehend aus fixen Bestandteilen in Höhe von €0,6, variablen Bestandteilen in Höhe von €0 und Vergütungen für sonstige Leistungen in Höhe von €0). Darüber hinaus erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats jeweils 1.500 Wertsteigerungsrechte. Der Vorstand erhielt für das Geschäftsjahr 2005 feste Gehaltsbestandteile in Höhe von €5,2 und sonstige Bezüge in Höhe von €0,2. Für variable Bezüge des Vorstands, die von der Rendite für eingesetztes Kapital abhängen, wurden im Geschäftsjahr 2005 Rückstellungen in Höhe von €0,5 gebildet. Die Rendite für eingesetztes Kapital errechnet sich als Verhältnis von Ergebnis vor Zinsen, Steuern, sonstigen betrieblichen Aufwendungen/Erträgen und sonstigen Aufwendungen/Erträgen zu eingesetztem Kapital. Zusätzlich haben die Mitglieder des Vorstands 475.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von Euro 9,18 pro Aktie erhalten. Die Aktienoptionen des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2005 nach den Regelungen des Long-Term-Incentive-Plans 2001 ausgegeben, der auch Grundlage für die Wertsteigerungsrechte des Aufsichtsrats ist. Der Wert pro Option bzw. Wertsteigerungsrecht, wenn nach den gleichen Grundsätzen wie Aktienoptionen bewertet, betrug zum Ausgabezeitpunkt Euro 4,07.

Die Bezüge des Vorsitzenden des Vorstands Herrn Dr. Ziebart bestanden aus einem festen Gehaltsbestandteil in Höhe von Euro 1.600.000, einem variablen Bestandteil in Höhe von Euro 100.000 und sonstigen Bezügen in Höhe von Euro 33.052. Zudem hat Herr Dr. Ziebart 190.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von Euro 9,18 erhalten.

Frühere Vorstandsmitglieder erhielten im Geschäftsjahr 2005 Gesamtbezüge in Höhe von €4,7. Dieser Betrag war zum 30. September 2004 zurückgestellt. Für Pensionsverpflichtungen früherer Mitglieder des Vorstands bestanden zum 30. September 2005 Pensionsrückstellungen in Höhe von €10,4. Mit Herrn Dr. Schumacher wurde eine Abfindungsvereinbarung abgeschlossen, die die Zahlung von €5,25 beinhaltet, um alle Rechtsstreitigkeiten, die Herr Dr. Schumacher im Rahmen des Angestelltenverhältnisses hätte haben können, beizulegen. Mit Herrn Dr. von Zitzewitz, der den Vorstand der Gesellschaft im

Juli 2005 verlassen hat, konnte noch keine endgültige Vereinbarung hinsichtlich seiner Ansprüche aus dem Angestelltenverhältnis abgeschlossen werden. Obwohl die Gesellschaft glaubt, dass mit Ausnahme der Pensionszahlungen keine weiteren Ansprüche bestehen, könnte eine Vereinbarung mit Herrn Dr. von Zitzewitz weitere Zahlungen der Gesellschaft nach sich ziehen.

Als Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr folgende Damen und Herren bestellt bzw. berufen:

<b>Der Vorstand</b>		
<b>Name</b>	<b>Alter</b>	<b>Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)</b>
Dr. Wolfgang Ziebart	55	Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer  Konzernmandate Vergleichbare Mandate Mitglied der Geschäftsleitung --- Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China
Peter Bauer	45	Mitglied des Vorstands  Externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Siemens VDO Automotive AG, München  Konzernmandate Vergleichbare Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich Stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors --- Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan  Mitglied des Board of Directors --- Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur --- Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China --- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA --- Infineon Technologies Savan Ltd., Netanya, Israel
Prof. Dr. Hermann Eul	46	Mitglied des Vorstands  Externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- 7Layers AG, Ratingen

**Der Vorstand**

Name	Alter	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)
Peter J. Fischl	59	<p>Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer</p> <p>Konzernmandate Vergleichbare Mandate Vorsitzender des Aufsichtsrats --- Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich</p> <p>Mitglied des Board of Directors --- Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur --- Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China --- Infineon Technologies North America Corp., Wilmington, Delaware, USA</p>
Kin Wah Loh	50	<p>Mitglied des Vorstands</p> <p>Externe Mandate Director --- Accton Technologies Corp., Hsinchu, Taiwan, Republik China</p> <p>Konzernmandate Vergleichbare Mandate Mitglied des Board of Directors --- Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur --- Infineon Technologies China Co., Ltd., Shanghai, China --- Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan</p>
<b>Ausgeschiedene Vorstände:</b>		
Dr. Andreas von Zitzewitz	45	<p>Mitglied des Vorstands bis zum 16. Juli 2005</p> <p>Externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Steag Hamatech AG, Sternenfels</p>

**Der Aufsichtsrat**

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)
Max Dietrich Kley	65	2010	€58.000,00	<p>Vorsitzender Mitglied des Aufsichtsrats BASF AG</p> <p>Weitere externe Mandate Vorsitzender des Aufsichtsrats --- SGL Carbon AG, Wiesbaden</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats --- Schott AG, Mainz --- HeidelbergCement AG, Heidelberg --- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München</p>
Klaus Luschtinetz <sup>1</sup>	62	2009	€43.500,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender (ab 20. Januar 2004)</p> <p>Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße</p> <p>Vergleichbare externe Mandate Mitglied des Verwaltungsrats Siemens Betriebskrankenkasse, München (bis Juni 2005)</p>
Alfred Eibl <sup>1</sup>	56	2009	€37.458,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender bis 20. Januar 2004</p> <p>Mitglied des Betriebsrats München Balan-/St.-Martin-Straße</p>
Dr. Joachim Faber	55	2010	€35.041,00	<p>Mitglied des Vorstands der Allianz AG</p> <p>Weitere externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Bayerische Börse AG, München</p> <p>Konzernmandate Vorsitzender des Aufsichtsrats --- Allianz Dresdner Global Investor Deutschland GmbH --- DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds GmbH --- DIT Deutscher Investment Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH</p> <p>Konzernmandate Vergleichbare Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- AGF Asset Management S.A., Paris, Frankreich --- ART Allianz Risk Transfer, Zürich</p>

## Der Aufsichtsrat

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)
Johannes Feldmayer	49	2010	€19.333,00	<p>Mitglied des Zentralvorstands --- Siemens AG</p> <p>Konzernmandate Vergleichbare Mandate Vorsitzender des Verwaltungsrats --- Siemens A.E. Athen, Griechenland</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrats --- Siemens Rt. Budapest, Ungarn</p> <p>Vorsitzender der Gesellschafterdelegation --- Siemens sro Prag, Tschechien</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats --- Siemens S.A. Madrid, Spanien --- Siemens S.p.A. Mailand, Italien --- Siemens Schweiz AG, Zürich, Schweiz</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrats --- Siemens France S.A., Saint-Denis, Frankreich --- Siemens A. S., Istanbul, Türkei --- Siemens A. S., Kopenhagen, Dänemark</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats --- Siemens Holdings plc, Bracknell, Großbritannien --- Siemens AB, Stockholm, Schweden --- Siemens AG, Wien, Österreich</p> <p>Vergleichbare externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH, Hamburg</p>
Jakob Hauser <sup>1</sup>	53	2009	€37.458,00	<p>Mitglied des Gesamtbetriebsrats Vorsitzender des Betriebsrats München-Perlach</p>

**Der Aufsichtsrat**

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)
Dr. Stefan Jentzsch	44	2010	€29.000,00	<p>Mitglied des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG (bis 18. November 2005)</p> <p>Weitere externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Deutsche Börse AG, Frankfurt --- Premiere AG, München (seit 9. März 2005) --- DAB Bank AG, München (bis 8. März 2005)</p> <p>Konzernmandate Mitglied des Aufsichtsrats --- HVB Systems AG, München</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrats --- HVB Wealth Management Holding GmbH, München</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats --- Vereins- und Westbank AG, Hamburg --- HVB Info AG, München (bis 31. Mai 2005)</p> <p>Vergleichbare Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Bank Austria Creditanstalt AG, Wien, Österreich</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrats --- HVB Alternative Financial Products AG, Wien, Österreich --- HVB Alternative Investment AG, Wien, Österreich</p>
Prof. Dr. Renate Köcher	53	2010	€19.333,00	<p>Geschäftsführerin --- Institut für Demoskopie Allensbach</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrats --- Allianz AG, München --- BASF AG, Ludwigshafen --- MAN AG, München</p>
Michael Ruth <sup>1</sup>	45	2009	€29.000,00	<p>Leiter Strategie, Planung und Controlling Advanced Logic Vertreter der leitenden Angestellten</p> <p>Vergleichbare Konzernmandate Mitglied des Verwaltungsrats --- Altis Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich</p>
Dieter Scheitor <sup>1</sup>	54	2009	€29.000,00	<p>Teamleiter Elektroindustrie beim Vorstand der IG Metall, Frankfurt</p>
Gerd Schmidt <sup>1</sup>	51	2009	€29.000,00	<p>Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Vorsitzender des Betriebsrats Regensburg-West</p>
Prof. Dr. rer. nat. Doris Schmitt-Landsiedel	52	2010	€22.958,00	<p>Professorin an der Technischen Universität München</p>
Kerstin Schulzendorf <sup>1</sup>	43	2009	€29.000,00	<p>Stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats Infineon Dresden</p>

**Der Aufsichtsrat**

Name	Alter	Ende der Amtszeit	Vergütung	Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (Stand 30. September 2005)
Alexander Trüby <sup>1</sup>	35	2009	€37.458,00	Mitglied des Betriebsrats Infineon Dresden
Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn	58	2010	€39.875,00	Vorsitzender des Vorstands der Audi AG Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG  Weitere externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Salzgitter AG, Salzgitter --- FC Bayern München AG, München --- TÜV Süddeutschland Holding AG, München  Konzernmandate Vergleichbare Mandate Vorsitzender des Verwaltungsrates --- SEAT S.A., Barcelona, Spanien --- Automobili Lamborghini Holding SpA, Sant'Agata Bolognese, Bologna, Italien
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer	61	2010	€37.458,00	Mitglied des Vorstands der Siemens AG  Weitere externe Mandate Mitglied des Aufsichtsrats --- Deutsche Messe AG, Hannover  Konzernmandate Mitglied des Aufsichtsrats --- BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München  Vergleichbare Konzernmandate Vorsitzender des Verwaltungsrats --- Siemens Ltd., Peking, China --- Siemens K.K., Tokio, Japan --- Siemens S.A., Lissabon, Portugal --- Siemens Ltd., Mumbai, Indien
<b>Ausgeschiedene Aufsichtsräte:</b>				
Ausgeschieden zum 25. Januar 2005:				
Günther Fritsch			€ 9.666,00	
Dr. h.c. Martin Kohlhaussen			€14.500,00	
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge			€14.500,00	

1 Arbeitnehmervertreter.



---

## Ausschüsse des Aufsichtsrats

---

### Vermittlungsausschuss

---

Max Dietrich Kley (ab 1. September 2004)  
Klaus Luschtinetz (ab 20. Januar 2004)  
Alexander Trüby (ab 20. Januar 2004)  
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (bis 29. April 2005)

---

### Präsidialausschuss

---

Max Dietrich Kley (ab 1. September 2004)  
Klaus Luschtinetz (ab 20. Januar 2004)  
Prof. Dr. Martin Winterkorn (ab 1. August 2005)  
Dr. Martin Kohlhaussen (bis 25. Januar 2005)

---

### Investitions-, Finanz- und Prüfungsausschuss

---

Max Dietrich Kley (ab 1. September 2004)  
Dr. Joachim Faber (ab 29. April 2005)  
Klaus Luschtinetz (ab 20. Januar 2004)  
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (vom 1. Oktober 2004 bis 25. Januar 2005)

---

### Strategie- und Technologieausschuss (existierte bis 30. April 2005)

---

Alfred Eibl  
Jakob Hauser  
Alexander Trüby  
Prof. Dr. rer. nat. Schmitt-Landsiedel (ab 25. Januar 2005)  
Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge (vom 1. Oktober 2004 bis 31. Januar 2005)  
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Klaus Wucherer (vom 1. Oktober 2004 bis 20. April 2005)

---

**Wesentliche Tochtergesellschaften und assoziierte Unternehmen**

<b>Name und Sitz der Gesellschaft</b>	<b>Anteil</b>
EUPEC Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH, Warstein-Belecke	100 %
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. OHG, Dresden	100 %
Infineon Technologies SC300 GmbH & Co. OHG, Dresden	100 %
Infineon Technologies Finance GmbH, München	100 %
Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG, Dresden	100 %
Infineon Technologies Austria AG, Villach, Österreich	100 %
Infineon Technologies-Fabrico de Semicondutores, Portugal S.A., Vila do Conde, Portugal	100 %
Infineon Technologies France S.A.S., Saint Denis, Frankreich	100 %
Infineon Technologies Holding B.V., Rotterdam, Niederlande	100 %
SensoNor AS, Horten, Norwegen	100 %
Infineon Technologies Holding North America Inc., Wilmington, Delaware, USA	100 %
Infineon Technologies Richmond LP, Wilmington, Delaware, USA	100 %
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd., Singapur	100 %
Infineon Technologies China Co. Ltd., Shanghai, China	100 %
Infineon Technologies (Advanced Logic) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies (Integrated Circuit) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd., Malacca, Malaysia	100 %
Infineon Technologies Japan K.K., Tokio, Japan	100 %
Infineon Technologies Suzhou Co., Ltd., Suzhou, China	73 %
ALTIS Semiconductor S.N.C., Essonnes, Frankreich	50 %
Inotera Memories Inc., Taoyuan, Taiwan	44 %

## Mehrjahresübersicht 2001–2005

### Ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG in Mio. €<sup>1</sup>

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Daten der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnungen</b>					
<b>Umsatzerlöse</b>	5.347	4.890	6.152	7.195	<b>6.759</b>
<b>nach Regionen:</b>					
Deutschland	1.636	1.266	1.535	1.675	<b>1.354</b>
Übriges Europa	1.172	943	1.112	1.263	<b>1.210</b>
Nordamerika	1.208	1.158	1.393	1.524	<b>1.504</b>
Asien-Pazifik	1.056	1.287	1.821	2.263	<b>2.223</b>
Japan	191	159	256	364	<b>332</b>
Andere	84	77	35	106	<b>136</b>
<b>nach Segmenten<sup>2</sup>:</b>					
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	2.206	1.945	2.186	2.540	<b>2.516</b>
Kommunikation	1.451	1.019	1.428	1.689	<b>1.391</b>
Speicherprodukte	1.614	1.861	2.485	2.926	<b>2.826</b>
Sonstige Geschäftsbereiche	20	18	21	11	<b>12</b>
Konzernfunktionen	56	47	32	29	<b>14</b>
<b>Umsatzkosten</b>	4.580	4.289	4.614	4.670	<b>4.909</b>
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	767	601	1.538	2.525	<b>1.850</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.189	1.060	1.089	1.219	<b>1.293</b>
Vertriebskosten und allgemeine Verwaltungskosten	782	643	679	718	<b>655</b>
Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen	117	16	29	17	<b>78</b>
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen, Saldo	-200	-46	85	257	<b>92</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	-1.121	-1.072	-344	314	<b>-268</b>
Zinsergebnis	-1	-25	-52	-41	<b>-9</b>
Anteiliger Jahresüberschuss/-fehlbetrag von nach der Equity Methode konsolidierten und assoziierten Unternehmen	21	-47	18	-14	<b>57</b>
Erträge/Aufwendungen aus der Realisierung von Wertänderungen durch Kapitalerhöhungen bei assoziierten Unternehmen	11	18	-2	2	<b>-</b>
Sonstige Erträge/Aufwendungen, Saldo	65	-41	21	-64	<b>26</b>
Auf konzernfremde Gesellschafter entfallende Ergebnisanteile	6	7	8	18	<b>2</b>
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.019	-1.160	-351	215	<b>-192</b>
Erträge/Aufwendungen aus Steuern vom Einkommen und Ertrag	427	143	-84	-154	<b>-120</b>
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag von fortgeführten Geschäften</b>	-592	-1.017	-435	61	<b>-312</b>
Ergebnis von aufgegebenen Geschäften	1	-4	-	-	<b>-</b>
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-591	-1.021	-435	61	<b>-312</b>
<b>Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag pro Aktie – unverwässert und verwässert</b>	-0,92	-1,47	-0,60	0,08	<b>-0,42</b>
<b>Ebit</b>	-1.018	-1.135	-299	256	<b>-183</b>
<b>nach Segmenten<sup>2</sup>:</b>					
Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket	466	169	148	252	<b>134</b>
Kommunikation	-340	-353	-213	-44	<b>-295</b>
Speicherprodukte	-938	-630	31	169	<b>122</b>
Sonstige Geschäftsbereiche	-26	-57	-50	-75	<b>-4</b>
Konzernfunktionen	-180	-264	-215	-46	<b>-140</b>

<sup>1</sup> Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

<sup>2</sup> Zum 1. Januar 2005 haben wir einige unserer Segmente reorganisiert, um eine bessere Abbildung der Kunden- und Marktbesonderheiten zu erhalten. Die Bereichsergebnisse der Vorjahre wurden entsprechend umgestellt, sodass sie der neuen Berichts- und Darstellungsstruktur des Geschäftsjahrs entsprechen und um die Vergleichbarkeit mit aktuellen und künftigen Ergebniszahlen zu ermöglichen.

Fortsetzung ausgewählte Konzernfinanzdaten Infineon Technologies AG in Mio. €<sup>1</sup>

Zum Ende des Geschäftsjahrs per 30. September	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Daten der Konzern-Bilanzen</b>					
Zahlungsmittel	757	1.199	969	608	1.148
Wertpapiere des Umlaufvermögens	93	738	1.784	1.938	858
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	626	758	876	1.056	952
Vorräte	882	891	959	960	1.022
Aktive kurzfristige latente Steuern	39	82	113	140	125
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände	479	523	675	590	469
Summe Umlaufvermögen	2.876	4.191	5.376	5.292	4.574
Sachanlagen	5.233	4.491	3.817	3.587	3.751
Finanzanlagen	655	708	425	708	779
Als Sicherheitsleistungen hinterlegte Zahlungsmittel	86	70	67	109	88
Bilanzsumme	9.743	10.918	10.875	10.864	10.284
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sowie kurzfristiger Teil langfristiger Finanzverbindlichkeiten	119	120	149	571	99
Langfristige Finanzverbindlichkeiten ohne kurzfristig fällige Bestandteile	249	1.710	2.343	1.427	1.566
Summe Eigenkapital	6.900	6.158	5.666	5.978	5.629
<b>Daten der Konzern-Kapitalflussrechnungen</b>					
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	221	226	731	1.857	1.039
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.813	-1.244	-1.522	-1.809	-238
Planmäßige Abschreibungen	1.121	1.370	1.437	1.320	1.316
Investitionen in Sachanlagen	-2.282	-643	-872	-1.163	-1.368
<b>Börsenkennzahlen (zum 30. September)</b>					
Dividendenertrag pro Aktie in €	0	0	0	0	0
Xetra Handelssystem in €	13,50	5,61	11,22	8,22	8,18
New York Stock Exchange (NYSE) in US-Dollar	12,39	5,70	12,89	10,22	9,92
Anzahl der Aktien in Mio. Stück	692,4	720,8	720,9	747,6	747,6
Marktkapitalisierung in Mrd. €	9.347	4.044	8.088	6.145	6.115
Marktkapitalisierung in Mrd. US-Dollar	8.579	4.109	9.292	7.640	7.416
<b>Kennzahlen</b>					
Eigenkapitalquote	71 %	56 %	52 %	55 %	55 %
Verschuldungsgrad	5 %	30 %	44 %	33 %	30 %
Netto-Cash-Position am 30. September <sup>2</sup>	482	107	261	548	341
<b>Mitarbeiter zum 30. September (absolute Zahlen)</b>					
	33.813	30.423	32.308	35.570	36.440
<b>nach Regionen:</b>					
Deutschland	16.814	15.716	16.166	16.387	16.119
Übriges Europa	5.007	4.590	5.034	5.631	5.482
Nordamerika	3.023	2.889	2.757	2.982	3.193
Asien-Pazifik	8.822	7.093	8.116	10.340	11.451
Japan	127	107	118	133	158
Andere	20	28	117	97	37
<b>nach Funktionen:</b>					
Produktion	23.416	20.822	22.405	24.540	25.114
Forschung und Entwicklung	5.510	5.374	5.935	7.160	7.401
Vertrieb und Marketing	2.259	2.010	2.048	1.948	2.016
Verwaltung	2.628	2.217	1.920	1.922	1.909

1 Abweichungen von der Summe durch Rundungsdifferenzen möglich.

2 Entspricht der Kalkulation: Zahlungsmittel plus Wertpapiere des Umlaufvermögens minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

## Finanz- und Technologieglossar

### Finanzglossar

**ADS:** American Depositary Shares – ADS sind in den USA gehandelte Aktienzertifikate über nicht amerikanische Aktien. Sie erleichtern nicht amerikanischen Unternehmen den Zugang zu US-amerikanischen Kapitalmärkten und bieten so US-amerikanischen Anlegern Investitionsmöglichkeiten in nicht amerikanischen Gesellschaften. Infineons ADS werden an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt (Verhältnis ADS:Aktie = 1:1).

**Anlagendeckung:** Eigenkapital im Verhältnis zu Sachanlagen.

**Brutto-Cash-Position:** Zahlungsmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens.

**Bruttoergebnis vom Umsatz:** Umsatz abzüglich Herstellungskosten des Umsatzes.

**Cash-Flow:** Zahlungswirksamer Saldo aus Mittelzuflüssen und -abflüssen innerhalb eines Geschäftsjahrs. Der Cash-Flow ist Teil des Konzernabschlusses und zeigt für einen bestimmten Zeitraum, aus welchen Quellen sich eine Gesellschaft finanziert und wofür die Zahlungsmittel verwendet wurden, gliedert nach laufender Geschäftstätigkeit (Mittel, die durch Kauf/Verkauf von Produkten und Dienstleistungen generiert wurden), Investitionstätigkeit (Mittelabfluss einer Gesellschaft für Investitionen oder Mittelzufluss aus Desinvestitionen) und Finanzierungstätigkeit (Mittelzufluss durch die Ausgabe von Aktien, Anleihen und Darlehen beziehungsweise Mittelabfluss durch die Rücknahme von Aktien und Anleihen beziehungsweise Rückzahlung von Darlehen).

**Dax:** Deutscher Aktienindex – der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 30 hinsichtlich Orderumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Aktiengesellschaften ab, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

**Ebit:** Earnings Before Interests and Taxes – bei Infineon ist Ebit definiert als Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Dies ist die Kennzahl, mit der Infineon die operative Ertragskraft seiner Segmente bewertet.

**Ebit-Marge:** Kennzahl zur Bestimmung der operativen Ertragskraft, die das Ebit im Verhältnis zum Umsatz darstellt.

**Eigenkapitalquote:** Zeigt den Anteil des Eigenkapitals in der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft, berechnet aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

**Eigenkapitalrendite:** Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Eigenkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

**Ergebnisanteile, auf konzernfremde Gesellschafter entfallende:** Anteile am Jahresergebnis, die nicht dem Konzern, sondern Konzernfremden, die Anteile an verbundenen Unternehmen des Konzerns halten, zugerechnet werden.

**Ergebnis je Aktie bzw. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag je Aktie:** Das unverwässerte Konzernergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum (Quartal oder Geschäftsjahr) ausstanden, dividiert wird. Das verwässerte Konzernergebnis je Aktie wird errechnet, indem der Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag durch den gewichteten Durchschnitt der Aktien, die im Berichtszeitraum ausstanden, zuzüglich der Zahl der Aktien, die emittiert würden, falls ausstehende Aktienoptionen, zugeteilte Aktienrechte und Wandelschuldverschreibungen ausgeübt bzw. gewandelt würden, dividiert wird.

**Erworbene Forschung & Entwicklung:** Aufwendungen, die im Rahmen von Akquisitionen für nicht abgeschlossene Entwicklungsprojekte entstanden sind, werden nach HGB nicht separat ermittelt, sondern als Bestandteil des Geschäfts- und Firmenwerts ausgewiesen. Nach US-GAAP werden diese Kosten zum Anschaffungszeitpunkt gesondert ermittelt und als Aufwand erfasst.

**Free-Cash-Flow:** Saldo des Mittelzuflusses beziehungsweise -abflusses aus Infineons laufender Geschäftstätigkeit und des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit, bereinigt um kurzfristig verfügbare Wertpapiere.

**Gesamtkapitalrendite:** Kennzahl für den finanziellen Erfolg eines Unternehmens, die den Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag im Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Gesamtkapital eines Betrachtungszeitraums darstellt.

**Goodwill (Geschäfts- und Firmenwert):** Immaterieller Vermögensgegenstand, der im Rahmen einer Unternehmensakquisition entstehen kann. Er stellt den Betrag dar, mit dem der Kaufpreis (die Kosten) für eine erworbene Gesellschaft den angenommenen Marktwert der erworbenen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten übersteigt. Nach US-GAAP wird der Geschäfts- und Firmenwert nicht über eine Nutzungsdauer abgeschrieben, sondern bei einer eventuellen Wertminderung durch eine außerplanmäßige Abschreibung reduziert. Die Überprüfung des Wertes erfolgt mindestens einmal jährlich.

**Latente Steuern:** Da die steuerliche Gesetzgebung des Öfteren von den handelsrechtlichen Vorgaben abweicht, können Unterschiede zwischen (a) dem zu versteuernden Einkommen und dem handelsrechtlichen Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und (b) der steuerlichen Bemessungsgrundlage

von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten und ihren jeweiligen Buchwerten entstehen. Eine latente Steuerverbindlichkeit und der zugehörige Aufwand entstehen aus dem Einkommen, das bereits handelsrechtlich, jedoch nicht steuerrechtlich erfasst ist. Umgekehrt entsteht eine latente Steuerforderung, wenn der Aufwand erst in Zukunft steuerlich abzugsfähig ist, jedoch handelsrechtlich bereits erfasst wurde.

**Namensaktien:** Aktien, die auf den Namen einer bestimmten Person lauten. Diese Person wird entsprechend den aktienrechtlichen Vorgaben mit einigen persönlichen Angaben sowie der Aktienanzahl in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Nur wer im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist, gilt gegenüber der Gesellschaft als Aktionär und kann beispielsweise seine Rechte in der Hauptversammlung ausüben.

**Netto-Cash-Position:** Brutto-Cash-Position minus kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten.

**US-GAAP:** Accounting Principles Generally Accepted in the United States of America; US-amerikanische Normen der Rechnungslegung. Infineon stellt den Konzernabschluss gemäß den Vorgaben von US-GAAP auf.

**Verschuldungsgrad:** Kennzahl der Finanzierungsstruktur einer Gesellschaft. Der Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis von kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Eigenkapital.

## Technologieglossar

**2G:** Zweite Generation – digitale Mobiltelefonie. Nach den analogen Netzen (erste Generation) bekommt der Teilnehmer hier mit digitalen Signalisierungen einheitlich gute Sprachqualität und zahlreiche Datendienste. Mobilfunkstandard der zweiten Generation in Europa: GSM.

**2,5G:** Gegenwärtig am weitesten verbreitete Infrastruktur des Mobilfunks. Mobilfunkstandard der 2,5-Generation in Europa: GPRS.

**3G:** Dritte Generation des Mobilfunks. Sprache und Daten werden gemeinsam breitbandig – also mit wesentlich höherer Transportkapazität als bei der zweiten Generation – übertragen. Mobilfunkstandard der dritten Generation in Europa: UMTS.

**300-Millimeter-Technologie:** Oberbegriff für die Herstellung und Prozessierung von Wafern mit einem Durchmesser von 300 Millimetern. Bei Infineon als Synonym für die Herstellung von Speicherchips auf 300-Millimeter-Wafern verwendet.

**300-Millimeter-Fabrik:** Eine Halbleiterfabrik, die Wafer mit einem Durchmesser von 300 Millimetern verarbeiten kann.

**Advanced Memory Buffer:** Der Advanced Memory Buffer (AMB) ist ein Chip auf einem FB-DIMM-Speichermodul. Er puffert die Daten und koordiniert die Kommunikation zwischen dem Speichermodul und dem Speicher-Controller.

**ADSL2, ADSL2+:** ADSL2 und ADSL2+ sind Weiterentwicklungen der ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)-Norm, die vor allem die Datenraten und Reichweite einer ADSL-Verbindung verbessern. Die Verbesserung der Reichweite erlaubt es dem Netzwerkbetreiber, ADSL einer größeren Zahl potenzieller Kunden anzubieten, während die höheren Datenraten neue Dienste wie hochauflösendes Fernsehen (HDTV) über das Internet ermöglichen. ADSL2+ erhöht die maximale Datenrate auf 25 Megabit pro Sekunde in Empfangsrichtung gegenüber 16 Megabit pro Sekunde für ADSL2. Mit einer solchen Datenrate können ohne weiteres mehrere (einzelne HD-)TV-Kanäle übertragen werden.

**ASIC:** Application Specific Integrated Circuit. Logikschaltung, die auf speziellen Kundenwunsch für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde.

**ASSP:** Application Specific Standard Product. Standardprodukt, das für eine spezifische Nutzung konstruiert wurde und von vielen Kunden genutzt werden kann.

**Back-End-Fertigung:** Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der ausgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat (vgl. Front-End-Fertigung). Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, etwaige notwendige Reparaturen der Chips, Sägen der Wafer und Verpackung der einzelnen Chips. Immer mehr Halbleiterhersteller lagern den Montagevorgang an unabhängige Montageunternehmen aus, einige sogar das Testen. Ein Großteil der Montageunternehmen befindet sich in Ländern des pazifischen Raumes.

**Basisband-IC:** Im Basisband-IC werden die empfangenen und zu sendenden digitalen Signale verarbeitet. Dieser komplexe Baustein enthält üblicherweise einen digitalen Signalprozessor, einen Mikrocontroller, Speicher und analoge Schaltungen. Er bildet gewissermaßen das Herz eines drahtlosen Kommunikationssystems.

**BiCMOS:** Bipolar Complementary Metal Oxide Substrate. IC-Technologie, die bipolare Transistoren und CMOS-Feldeffekt-Transistoren auf einem Chip vereint.

**Bit:** Informationseinheit, die einen von zwei Werten annimmt, zum Beispiel „richtig“/„falsch“ oder „0“/„1“.

**Bluetooth:** Technologie zur Funkübermittlung von Sprache und Daten über kurze Strecken.

**Breitbandanwendungen:** Hierzu zählen Netzwerktechnologien, die für die Datenübertragung mit hoher Bandbreite genutzt werden. Diese Technologie umfasst Bandbreiten von mehreren hundert Kilobit pro Sekunde oder mehr.

**Byte:** Maß für Informationseinheit bei Datenverarbeitungsanlagen. Ein Byte entspricht acht Bit.

**CDMA:** Code Division Multiple Access. Verfahren, das in Mobilfunksystemen eingesetzt wird und mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Übertragungskanal ermöglicht. Vorteil: bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Übertragungsbandbreite.

**Chipkarte:** Kunststoffkarte mit eingebautem Speicherchip oder Mikroprozessor; kann mit Geheimzahl kombiniert werden.

**CMOS:** Complementary Metal Oxide Substrate. Halbleiter-Standardfertigungstechnologie, um Mikrochips mit geringem Energieverbrauch und hohem Integrationsgrad zu produzieren.

**DDR:** Double Data Rate. Eine Technik zur Erhöhung des Datendurchsatzes bei Halbleiter-RAMs, die dadurch erreicht wird, dass sowohl bei der fallenden als auch bei der ansteigenden Flanke des Taktsignals Daten gelesen oder geschrieben werden, was zu einer doppelten Datenübertragungsrate führt gegenüber der Nutzung nur einer Taktflanke.

**DDR2:** Weiterentwicklung der DDR-Technologie. Die zurzeit gängige Speichertechnologie für PCs und Notebooks.

**DDR3:** Weiterentwicklung der DDR2-Technologie. Wird in PCs in der zweiten Hälfte des Kalenderjahrs 2007 erwartet.

**DECT:** Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Einheitlicher europäischer Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme.

**DRAM:** Dynamic Random Access Memory. Auf Grund der hohen Integrationsdichte und des daraus resultierenden niedrigen Preises weit verbreitete Speicherchip-Technologie. Beispiele für DRAM-Chips sind SDRAM, DDR DRAM, RDRAM, SGRAM (vgl. RAM).

**DSL:** Digital Subscriber Line. Eine breitbandige digitale Verbindung über Telefonnetze.

**Dual-die-Technologie:** Packungstechnologie für Speicherchips. Bei der Dual-die-Technologie werden zwei identische Chips in einem Ball Grid Array(BGA)-Gehäuse übereinander gestapelt. Dadurch kann die Kapazität eines Bausteins und damit auch des Speichermoduls ohne zusätzliche Platinenfläche verdoppelt werden.

**DVB-T:** Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Bezeichnet die terrestrische, das heißt erdgebundene Variante von DVB, die in Europa und anderen Staaten als Standard für die Übertragung von digitalem Fernsehen und Hörfunk per Antenne verwendet wird.

**EDGE:** Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Bezeichnet eine Technik zur Erhöhung der Datenrate in GSM-Mobilfunknetzen, die bisher nur sehr vereinzelt eingeführt wurde. EDGE ist wie GPRS eine evolutionäre Weiterentwicklung der GSM-Technik, die sich mit mäßigem Aufwand in die Mobilfunknetze einbauen lässt.

**FB-DIMM:** Fully Buffered Dual-Inline Memory Module. Repräsentiert eine neue Speichermodul-Technologie. Sie soll im Server-Umfeld sicherstellen, dass trotz steigender Memory-Taktfrequenz der maximale Speicherausbau eines Systems nicht verringert werden muss, sondern sogar erhöht werden kann.

**FCOS:** Flip Chip on Substrate. Steht für die neueste Entwicklung der Chipkartentechnologie. Dieses Verfahren kombiniert die neue Flip-Chip-Bestückung mit einem revolutionären Konzept des Materialeinsatzes. FCOS-Chipmodule bieten sowohl für Speicher- als auch für Mikroprozessorkarten eine höhere mechanische Stabilität sowie verbesserte optische Qualität.

**Flash-Memory:** Eine Variante nicht flüchtiger Speicher. Sein Inhalt bleibt erhalten, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

**Flüchtiger Speicher:** Speicher, der die in ihm gespeicherten Informationen verliert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

**Front-End-Fertigung:** Verarbeitung von Wafern, die im Reinraum durchgeführt wird, im Gegensatz zu dem Verarbeitungsprozess, der nach der eigentlichen Fertigstellung der Wafer stattfindet. Nachdem die Verarbeitung der Wafer im Reinraum beendet ist, werden sie an die Back-End-Fertigung weitergeleitet; dort werden sie getestet und verpackt (vgl. Back-End-Fertigung).

**Giga:**  $2^{30}$  im informationstechnischen Sinn, zum Beispiel Gigabit (Gbit), Gigabyte (Gbyte).

**GPRS:** General Packet Radio Service heißt eine neue Mobilfunkgeneration der 2,5-Gruppe für höhere Datenübertragungsraten (bis zu 115 Kilobit/Sekunde) in GSM-Netzen.

**GPS:** Global Positioning System. Satellitengestütztes Funkortungsverfahren zur Positionsbestimmung auf Grund von Laufzeitunterschieden der empfangenen Signale.

**Graphics RAM:** Auch SGRAM (Synchronous Graphics RAM) genannt. Eine spezielle erweiterte Variante von SDRAM-Bausteinen, die für Grafikanwendungen optimiert und auf hochwertigen Grafikkarten verwendet wird. Mit Hilfe einer internen Kommando-Pipeline können Zugriffssequenzen auf dem Chip gepuffert und hierdurch höhere Zugriffsbandbreiten erreicht werden.

**GSM:** Das Global System for Mobile Communication ist heute weltweit das am meisten genutzte digitale Mobilfunksystem.

**Halbleiter:** Kristalliner Werkstoff, dessen elektrische Leitfähigkeit durch Einbringung von Dotierstoffen (in der Regel Bor oder Phosphor) gezielt verändert werden kann. Halbleiter sind beispielsweise Silicium und Germanium. Der Begriff wird auch für ICs aus diesem Werkstoff verwendet.

**HDTV:** High Definition Television ist ein Sammelbegriff, der eine Reihe von Fernsehnormen bezeichnet, die sich gegenüber dem herkömmlichen Fernsehen durch eine erhöhte vertikale, horizontale und/oder temporale Auflösung auszeichnen. Damit geht die Umstellung des Seitenverhältnisses von 4:3 auf 16:9 einher.

**Hochfrequenz-Transceiver:** „Transceiver“ ist ein Kunstwort aus Transmitter (= Sender) und Receiver (= Empfänger). Es beschreibt für die drahtgebundene und drahtlose Kommunikation eine Kombination aus Sende- und Empfangsschaltung in einer Einheit. Hochfrequenz- oder Radio-Frequency(RF)-Transceiver werden in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt, zum Beispiel in Mobil- und Schnurlos-Telefonen.

**Home-Gateway:** Über das Home-Gateway können Daten mit hoher Geschwindigkeit vom und zum Privathaushalt übertragen werden. Sie gelten als der nächste evolutionäre Schritt nach dem Fernsehempfänger (Decoder).

**IPTV:** Internet Protocol Television. Damit wird die digitale Übertragung von Fernsehprogrammen und Filmen über ein digitales Datennetz bezeichnet. Hierzu wird das dem Internet zu Grunde liegende Internet-Protokoll (IP) verwendet. Die Übertragung von digitalen Videosignalen erfordert eine hohe Datenrate (etwa sechs bis acht Megabit pro Sekunde für HDTV). Daher ist IPTV erst durch die weite Verbreitung von Breitbandanschlüssen zum Teilnehmer (zum Beispiel ADSL2, Kabelmodem oder VDSL) und die Einführung neuer Kompressionsmethoden möglich geworden.

**IC:** Integrated Circuit (integrierte Schaltung). Bauelement auf Basis eines Halbleitermaterials wie beispielsweise Silizium, auf dem zahlreiche Komponenten wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren und Dioden integriert und miteinander verbunden sind.

**ISDN:** Integrated Services Digital Network. Online-Verbindungstyp, der Telekommunikationsdienste wie Telefon, Telefax oder Datenkommunikation in einem Netz integriert.

**Kilo:**  $2^{10}$  im informationstechnischen Sinn, zum Beispiel Kilobit (Kbit), Kilobyte (Kbyte).

**LAN:** Local Area Network (lokales Netzwerk). Datenkommunikationsnetz in einem räumlich eng begrenzten Gebiet, beispielsweise innerhalb eines Gebäudes.

**Leistungshalbleiter:** In den letzten 30 Jahren haben Leistungshalbleiter in der Antriebstechnik ebenso wie in der Energieübertragung und -verteilung weitgehend die elektromechanischen Lösungen verdrängt, weil mit ihnen hohe Energieflüsse fast nach Belieben geformt werden können. Der Vorteil der Bauelemente besteht darin, dass sie extrem schnell – typischerweise innerhalb von Bruchteilen von Sekunden – zwischen den Zuständen „offen“ und „geschlossen“ wechseln können. Durch die schnelle Folge von Ein/Aus-Pulsen kann fast jede beliebige Form des Energieflusses nachgebildet werden, beispielsweise auch eine Sinuswelle.

**Logikbereich:** Zusammenfassung der zwei Infineon-Segmente Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket und Kommunikation.

**Mega:**  $2^{20}$  im informationstechnischen Sinn, zum Beispiel Megabit (Mbit), Megabyte (Mbyte).



**Megahertz:** Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt. Das Hertz gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an, allgemeiner auch die Anzahl von beliebigen sich wiederholenden Vorgängen pro Sekunde. Häufig verwendete Einheiten sind Kilohertz (tausend Schwingungen pro Sekunde), Megahertz (eine Million Schwingungen pro Sekunde) und Gigahertz (eine Milliarde Schwingungen pro Sekunde).

**Memory-Stick:** Ein Memory-Stick ist ein digitales Speichermedium für Daten. Es ist ein proprietärer Standard von Sony und wurde 1998 eingeführt. Memory-Sticks finden in der Produktpalette von Sony im Bereich Unterhaltungselektronik Anwendung.

**Mikrocontroller:** Mikroprozessor, der auf einem einzelnen IC, mit Speicher und Schnittstellen kombiniert, integriert ist und als eingebettetes System funktioniert. In einem Mikrocontroller lassen sich komplexe logische Schaltungen realisieren und per Software kontrollieren.

**Micro-DIMM:** Micro Dual-Inline Memory Module. Eine Bauform von Speichermodulen, die gegenüber dem SO-DIMM noch weiter verkleinert ist. Dieses Miniatur-Speichermodul ist konstruiert für den Einsatz als Arbeitsspeicher in Sub-Notebooks.

**Mikrometer:** Metrisches Längenmaß. Entspricht dem millionsten Teil eines Meters ( $10^{-6}$  Meter), das Symbol ist  $\mu\text{m}$ . Der Durchmesser eines Menschenhaars beträgt zum Beispiel 0,1 Millimeter oder 100 Mikrometer.

**MicroSlim:** Neues Speicherkonzept des auf Chipkarten von Infineon verwendeten nicht flüchtigen Speichers. Hierbei wird statt zwei nur noch ein Transistor pro Speicherzelle benötigt.

**Mobile-RAM:** DRAM mit geringem Leistungsverbrauch für mobile Applikationen wie PDAs und Smartphones.

**MP3-Player:** Ein batteriebetriebenes Gerät, das digital gespeicherte Audiodateien abspielt, die im MP3-Format vorliegen.

**MultiMediaCard:** Ein Formfaktor für ein digitales Speichermedium. Der MultiMediaCard-Standard wurde 1997 von Infineon und SanDisk entwickelt. Eine MultimediaCard speichert Daten mittels NAND-Flash.

**NAND Flash:** NAND-Flash-Speicher sind überwiegend für große Speichermengen ausgelegt. Sie finden Verwendung in USB-Sticks und Flash-Speicherkarten (MultiMediaCard, SD Card, Memory-Stick, usw.). Diese Speicherkarten werden unter anderem in MP3-Playern und digitalen Kameras eingesetzt.

**Nicht flüchtiger Speicher:** Speicher, der die gespeicherten Informationen behält, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird.

**PDA:** Personal Digital Assistant. Elektronisches Adress-, Termin- und Notizbuch; wird im Allgemeinen mit dem PC synchronisiert.

**RAM:** Random Access Memory (Halbleiterspeicher mit wahlfreier Adressierung). Die Namensgebung leitet sich von der sequenziellen Adressierung eines Bandspeichers ab, wo im Gegensatz hierzu die Daten nur sequenziell gelesen werden konnten. Auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichneter Datenspeicher, enthält Programme und Daten. Beispiele sind SRAM und SDRAM (vgl. DRAM).

**ROM:** Read Only Memory. Digitaler, nicht flüchtiger Datenspeicher, in dem Daten auch ohne Spannungsversorgung dauerhaft gespeichert sind. Die jüngste Entwicklung stellen die Flash-Speicher (NAND und NOR) dar.

**SD Card:** Secure Digital Memory Card. Digitales Speichermedium. „Secure Digital“ leitet sich von zusätzlichen Hardware-Funktionen für das Digital Rights Management (DRM) ab. Mittels eines vom Nutzer nicht einsehbaren Speicherbereichs soll die Karte das unrechtmäßige Abspielen geschützter Mediendateien verhindern.

**Server:** Oberbegriff für leistungsfähige Rechner in Computernetzwerken, die unterschiedlichen Aufgaben zugeordnet sind. Beispiele sind Drucker-Server, Web-Server, Mail-Server, Datenbank-Server usw.

**Silicium:** Chemisches Element mit halbleitenden Eigenschaften. Silicium ist das wichtigste Ausgangsmaterial in der Halbleiterindustrie.

**Smartcard:** Eine Smartcard ist eine Plastikkarte mit eingebautem Mikrocontroller. Im Gegensatz zu einer speicherbasierten Karte ermöglicht der Mikroprozessor die Verarbeitung großer Datenmengen mit einem hohen Grad an Sicherheit. Die Smartcard hat gewöhnlich die Maße einer Kreditkarte.

**Smartphone:** Ein Smartphone vereint den Leistungsumfang eines PDA mit einem Mobiltelefon, wobei der Ansatzpunkt je nach Hersteller mehr der PDA oder das Mobiltelefon ist. Das heißt, Smartphones haben einerseits die Fähigkeit, sich in ein Mobilfunknetz einzuloggen, andererseits haben sie auch die Fähigkeit, als kleine Rechner Anwendungen auszuführen, wie dies auch ein PDA kann.

**SMS:** Short Message Service. Ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten, der zuerst für den GSM-Mobilfunk entwickelt wurde und nun auch im Festnetz verfügbar ist.

**Teilnehmeranschlussleitung:** Die Teilnehmeranschlussleitung, auch Amtsleitung oder letzte Meile genannt, stellt innerhalb eines Telefonnetzes die Verbindung zwischen der Ortsvermittlungsstelle des Dienstansbieters (Provider) und dem Telefonanschluss des Dienstnutzers/Nutzers (User, Subscriber) innerhalb des Hauses dar.

**Tire Pressure Monitoring System (TPMS):** Reifendrucksensoren überwachen den Luftdruck im Autoreifen und weisen den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

**Triple-Play:** Darunter versteht man das Kommunikationspaket der Zukunft, bestehend aus schneller Internet-Anbindung, Telefonservice (Voice over IP) und Online-Videodiensten. Triple-Play kann über Kupferkabel (DSL-Verbindung), über Kabel oder über Funkverbindung bereitgestellt werden.

**Trusted Platform Module:** Das Trusted Platform Module (TPM) ist ein Chip, der Computer sicherer machen soll. Er entspricht einer fest eingebauten Smartcard mit dem wichtigen Unterschied, dass er nicht an einen konkreten Benutzer, sondern an ein System gebunden ist. Neben der Verwendung in PCs soll er in PDAs, Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik integriert werden. Der Chip ist passiv und kann weder den Boot-Vorgang noch den Betrieb direkt beeinflussen. Er enthält eine eindeutige Kennung und dient damit zur Identifizierung des Rechners.

**UMTS:** Das Universal Mobile Telecommunications System soll ein künftiger digitaler Weltstandard für Mobilfunk werden. UMTS ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu zwei Megabit pro Sekunde.

**USB-Stick:** Als USB-Stick bezeichnet man USB-Geräte, die ein sehr kleines stock- oder steckenförmiges Format haben. Der Ausdruck ist allein umgangssprachlich und keine Bezeichnung

für eine Produktklasse. Meist versteht man unter diesem Ausdruck im deutschsprachigen Raum ein USB-Gerät, das als austauschbares Speichermedium dient.

**VDSL, VDSL2:** Very High Data Rate Digital Subscriber Line. VDSL ist wie ADSL eine digitale Übertragungstechnik zum Anschluss von Endkunden über Kupferleitungen. Sie bietet noch wesentlich höhere Datenraten von bis zu 52 Megabit pro Sekunde. Dabei verkürzt sich aber die Länge des überbrückbaren Kupferkabels auf maximal 1,5 Kilometer, so dass VDSL nur in Hybridnetzen einsetzbar ist, die bereits einen großen Teil der Ortsverkabelung in Form von Glasfaserkabel vorliegen haben. Der Nachfolgestandard VDSL2 wird Bandbreiten bis 100 Megabit pro Sekunde bieten. Als Reichweite werden für diese Geschwindigkeit etwa 200 Meter angestrebt.

**Voice over IP (VoIP):** Die IP-Telefonie ist das Telefonieren über ein Computernetzwerk auf der Grundlage des Internet-Protokolls. Wird die IP-Telefonie genutzt, um Gespräche über das Internet zu führen, spricht man von Internet-Telefonie. Der wesentliche Unterschied zur herkömmlichen Telefonie besteht darin, dass die Sprachinformation nicht über eine geschaltete Verbindung in einem Telefonnetz übertragen wird, sondern aufgeteilt in IP-Pakete, die auf nicht festgelegten Wegen in einem Netzwerk zum Ziel gelangen. Die IP-Telefonie kann sich die Infrastruktur, also das Netzwerk, mit anderen Kommunikationsdiensten teilen.

**Wafer:** Scheibe aus einem Halbleiterwerkstoff, zum Beispiel Silicium, mit einem Durchmesser von bis zu 300 Millimetern.

**WDCT:** Worldwide Digital Cordless Technology. Einheitlicher Standard für digitale schnurlose Kommunikationssysteme in Nordamerika; wurde vom DECT-Standard abgeleitet.

**WLAN:** Wireless Local Area Network. Lokales Rechnernetz, das die Rechner über eine Funkverbindung miteinander oder mit dem Internet verbindet.

**Workstation:** Sehr leistungsfähiger PC.

**xDSL:** xDigital Subscriber Line. Oberbegriff für verschiedene technische Konzepte zur breitbandigen digitalen Datenübertragung über herkömmliche verdrehte Kupferdoppeladern. Je nach Konfiguration steht das x für Asymmetric (A), High Rate (H), Single Line (S), Symmetric High Bit-Rate (SH) oder Very High Bit-Rate (V).

## Finanzkalender Wichtige Finanztermine 2006\*

... **Dienstag, 24. Januar:**

Veröffentlichung des Berichts über das 1. Quartal 2006

... **Donnerstag, 16. Februar, 10.00 Uhr:**

Hauptversammlung 2006 in München, ICM (Internationales Congress Center München)

... **Mittwoch, 26. April:**

Veröffentlichung des Berichts über das 2. Quartal 2006

\*Vorläufig.

### Impressum Geschäftsbericht 2005

**Herausgeber:** Infineon Technologies AG, München  
**Redaktion:** Investor Relations, Corporate Communications, Accounting & Financial Reporting  
**Redaktionsschluss:** 30. November 2005  
**Geschäftsjahr:** 1. Oktober bis 30. September  
**Abschlussprüfer:** KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main  
**Gestaltung:** häfelinger + wagner design, München  
**Fotonachweis:** Andreas Pohlmann  
**Druck:** Kunst- und Werbedruck GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Gedruckt in Deutschland.

Die folgenden Bezeichnungen sind **Marken und/oder Markennamen** der Infineon Technologies AG: Infineon, das Infineon-Logo, das AENEON-Logo, FCOS, COOLMOS, OptiMOS, SMARTi, TRICORE und VINAX sind eingetragene Marken von Infineon Technologies AG. E-GOLDlite, E-GOLDradio, GEMINAX Pro, MicroSlim, Mobile-RAM, MP1-G, MultiMediaCard und S-Gold2 sind Marken und/oder Markennamen der Infineon Technologies AG. CellularRAM ist eine Marke von Micron Technologies, Inc. innerhalb der USA und von Infineon Technologies AG außerhalb der USA und wird sowohl von Micron als auch Infineon in Lizenz verwendet.

Das **Bluetooth**-Markenzeichen wird von Infineon in Lizenz verwendet.

Alle anderen in diesem Geschäftsbericht verwendeten Bezeichnungen können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte die Rechte ihrer Inhaber verletzen kann.

Wenn Sie **zusätzliche Exemplare dieses Geschäftsberichts** in deutscher oder englischer Sprache bestellen oder wenn Sie diese Berichte und aktuelle Anlegerinformationen online lesen möchten, besuchen Sie uns im Internet unter [www.infineon.com/boerse](http://www.infineon.com/boerse). Aktionäre und andere interessierte Anleger können kostenlose Einzelexemplare telefonisch oder schriftlich bei der Abteilung Investor Relations anfordern.

### Für interne Bestellungen

**SPLS Fürth-Bislohe**  
**Per Intranet:** <http://www.click4business-supplies.com>  
**Per Fax:** +49 (0)911 6544271  
**Bestellnummer:** (deutsch) B192-H8086-G3  
(englisch) B192-H8086-G3-X-7600

**Hauptverwaltung:** Am Campeon 1–12, 85579 Neubiberg/München, Tel. +49 (0)89 234-0

**Kontakt für Anleger und Analysten:** [Investor.Relations@infineon.com](mailto:Investor.Relations@infineon.com), Tel. +49 (0)89 234-26655, Fax +49 (0)89 234-26155

**Kontakt für Journalisten:** [Media.Relations@infineon.com](mailto:Media.Relations@infineon.com), Tel. +49 (0)89 234-28480, Fax +49 (0)89 234-28482

**Besuchen Sie uns im Internet:** [www.infineon.com](http://www.infineon.com)



Never stop thinking